

本次股票发行拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



YingRen
英韧科技

英韧科技股份有限公司

(中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄40号601-606室)

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

(申报稿)

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人(主承销商)



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、公司上市的目的

(一) 攻坚存储核心技术壁垒，构建自主可控产业生态

公司是国际领先的数据存储主控芯片与半导体存储产品提供商，为客户提供从消费级到企业级、从通用计算到 AI 计算的全场景、全代次、高性能、高性价比存储产品矩阵。公司以 AI SSD 为代表的企业级产品为核心，依托自主研发能力，突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈，实现信息存储核心环节的自主可控，产品广泛应用于 AI 驱动的算力中心、云服务等前沿场景。

在 AI 驱动的数字经济发展中，算力是数据处理的引擎，而存力则是数据可持续供给的基石，在大模型训练、实时推理等场景中，存力的带宽、延迟与可靠性直接决定了算力的实际效率上限。当前我国关键信息基础设施对存储产品的需求日益迫切，但高端存储市场仍以国际厂商为主导。公司以“引领 AI 时代存储新颗粒、新代次、新架构革命”为己任，作为国内极少数具备企业级主控芯片及固态硬盘完整迭代研发能力的企业，芯片及固态硬盘产品已实现从 SATA 到 PCIe 5.0 的全代次覆盖，最新一代 PCIe 6.0 主控芯片和 CXL 主控芯片已于 2026 年上半年流片，技术水平位居国际第一梯队。

通过本次上市，公司将持续加大研发投入，聚焦 PCIe 6.0、CXL、AI SSD 等前沿技术攻关，完善“核心算法芯片加速-固件适配客户需求-闪存调优平台化”全技术链融合，进一步提升国产颗粒性能调优能力，推动 PCIe 7.0 等下一代存储技术预研，助力我国构建自主可控的半导体存储产业生态。

(二) 汇聚行业优秀人才，巩固研发团队优势

存储芯片行业是技术密集型产业，需要对芯片设计、固件算法、颗粒适配等多学科具备深入理解的复合型人才。通过本次上市，公司将进一步提升品牌影响力，完善人才激励机制与发展平台，吸引全球存储领域高端研发与管理人才，强化团队在数据存储主控芯片与固态硬盘研发设计等关键环节的技术积累，为持续的技术创新与产品迭代提供坚实人才保障。

(三) 完善公司治理体系，实现价值共享共赢

通过本次上市，公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，进一步优化公司治理结构，完善内部控制体系，提升经营管理的规范化、透明化水平。公司将建立长期稳定的利润分配政策，保障投资者合法权益，同时以国家产业战略为导向，依托科技创新实现业务规模与盈利能力的持续增长，在推动国产存储产业升级的过程中，为投资者、客户、员工及社会创造可持续的价值回报。

二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司自成立以来，始终致力于现代企业制度的建立与完善。已按照相关法律法规要求，建立了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的权责明确、运作规范的治理架构，设立独立董事与职工代表监事，明确各治理主体的议事规则与决策程序。公司制定了完善的研发管理、采购管理、销售管理等内控制度，确保经营活动合法合规、高效有序。

为保障投资者利益，公司已制定明确的利润分配计划，将在上市后持续优化利润分配机制，建立长期、稳定的分红政策，并通过定期信息披露、投资者互动等方式，保障投资者的知情权与参与权，构建透明、互信的投资者关系。

三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于“新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目”、“面向 AI 领域存储系统方案研发项目”及补充流动资金。

本次募集资金投资项目紧密围绕公司核心技术与战略发展方向，以公司数据存储主控芯片和固态硬盘从 SATA 到 PCIe 5.0 的技术迭代、升级拓展为基础，开发新一代 PCIe 6.0/7.0 存储主控芯片，并在此基础上开发相应的高性能固态硬盘产品。项目实施后，将进一步完善公司产品矩阵，提升在数据中心、AI 算力等高端市场的竞争力，扩大市场份额。补充流动资金将优化公司财务结构，支撑研发投入与市场拓展，保障业务持续快速发展。

本次募集资金是公司基于行业发展趋势、自身技术储备及战略规划作出的合理安排，募集资金使用符合国家产业政策与公司主营业务发展需求，将有效提升

公司核心竞争力与持续经营能力。

四、公司持续经营能力及未来发展规划

公司以数据存储主控芯片技术为核心、以固态硬盘解决方案为载体为国内外市场提供存储相关产品与服务，实现了从 SATA 到 PCIe 全系列技术覆盖，并在固件内算法实现和模组设计上实现全面自研。公司最新一代 CXL 芯片作为国内首颗获得国际颗粒原厂合同的数据存储主控芯片，满足算力直连存储最新需求，协同 GPU 共同驱动尖端 AI 应用场景，通过 GPU 直连架构、CXL 高速互连等前沿技术，与国内外 GPU 大厂深度协同，为人工智能算力中心提供高带宽、低延迟的存算一体解决方案。报告期内，公司营业收入金额分别为 35,777.31 万元、62,496.77 万元和 103,418.31 万元，2023-2025 年营业收入复合增长率为 70.02%，收入规模不断扩大，持续经营能力不断增强。

未来，公司将坚持“技术自主、创新引领、全球布局”的核心战略，聚焦高性能数据存储主控芯片与固态硬盘研发，积极探索更强性能、更高带宽、更大容量的下一代存储技术，旨在突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈，以“引领 AI 时代存储新颗粒、新代次、新架构革命”为己任，构建可扩展、可迭代的统一芯片架构平台。通过对 PCIe 6.0、CXL 等企业级存储产品的不断深入研发，公司计划产品将协同 GPU 共同驱动尖端 AI 应用场景，从而为 AI 算力中心、云服务等提供高性能、高安全的存储解决方案。通过深化与上下游行业头部客户的战略协同，公司将不断拓展在 AI 计算、互联网、云计算等核心应用场景的广度与深度，最终引领国内存储产业的技术提升，并在全球竞争中占据领先地位。

(本页无正文,为《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书致投资者的声明》之签署页)

董事长: 

ZINING WU

2026 年 6 月 18 日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟发行股份不低于 47,806,826 股，占发行后总股本的比例不低于 10%（行使超额配售选择权之前，最终以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不低于 478,068,253 股（不考虑超额配售选择权）
保荐人（主承销商）	国泰海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

声 明.....	1
致投资者的声明	2
一、公司上市的目的.....	2
二、公司现代企业制度的建立健全情况.....	3
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.....	3
四、公司持续经营能力及未来发展规划.....	4
本次发行概况	6
目 录.....	7
第一节 释义	11
一、一般释义.....	11
二、专业释义.....	17
第二节 概览	19
一、重大事项提示.....	19
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	21
三、本次发行概况.....	22
四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.....	23
五、发行人主营业务情况.....	24
六、发行人符合科创板定位的相关情况.....	26
七、发行人选择的具体上市标准.....	26
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....	27
九、募集资金用途与未来发展规划.....	27
十、其他对发行人有重大影响的事项.....	27
第三节 风险因素	28
一、与行业相关的风险.....	28
二、与发行人相关的风险.....	28
第四节 发行人基本情况	32
一、发行人的基本信息.....	32
二、发行人的设立情况.....	32

三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.....	36
四、发行人成立以来重要事件.....	40
五、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.....	40
六、发行人股权结构.....	41
七、发行人控股、参股公司情况.....	42
八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况.....	47
九、发行人特别表决权股份或类似安排情况.....	74
十、发行人协议控制架构的情况.....	74
十一、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.....	74
十二、发行人股本情况.....	75
十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	90
十四、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.....	104
十五、发行人员工及其社保情况.....	106
第五节 业务与技术	109
一、发行人主营业务及主要产品情况.....	109
二、行业基本情况.....	122
三、发行人销售情况和主要客户.....	142
四、发行人采购情况和主要供应商.....	144
五、发行人主要固定资产和无形资产.....	147
六、发行人核心技术及研发情况.....	150
七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.....	155
八、发行人境外生产经营情况.....	156
第六节 财务会计信息与管理层分析	157
一、发行人财务报表.....	157
二、会计师事务所审计意见类型.....	162
三、关键审计事项.....	162
四、分部信息.....	163
五、财务报表的编制基础及合并报表范围.....	163

六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计.....	164
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.....	173
八、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策.....	174
九、主要财务指标.....	176
十、经营成果分析.....	177
十一、资产质量分析.....	203
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	220
十三、重大资产业务重组或股权收购合并事项.....	232
十四、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项.....	233
十五、盈利预测.....	233
第七节 募集资金运用与未来发展规划	234
一、本次募集资金运用基本情况.....	234
二、募投项目可行性及与发行人主要业务、核心技术的关系.....	235
三、未来发展规划.....	237
第八节 公司治理与独立性	240
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....	240
二、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的审计意见.....	240
三、发行人报告期内存在的违法违规情况.....	240
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.....	241
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.....	241
六、同业竞争情况.....	242
七、关联方及关联关系.....	243
八、关联交易情况.....	246
九、报告期内关联交易程序履行情况和独立董事的意见.....	250
第九节 投资者保护	251
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.....	251
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策.....	251
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、累计未弥补亏损的情况.....	257

四、尚未盈利、存在累计未弥补亏损情况的投资者保护措施.....	257
第十节 其他重要事项	258
一、重大合同及其对发行人的影响和存在的风险.....	258
二、对外担保情况.....	260
三、重大诉讼或仲裁情况.....	260
第十一节 声明	261
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.....	261
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	268
三、保荐人（主承销商）声明.....	269
四、发行人律师声明.....	271
五、会计师事务所声明.....	272
六、资产评估复核机构声明.....	273
七、验资机构声明.....	274
八、验资复核机构声明.....	276
第十二节 附件	277
一、备查文件.....	277
二、查阅时间和地点.....	278
三、与投资者保护相关的承诺事项.....	278
四、发行人主要无形资产	298
五、发行人申报前十二个月新增股东基本情况.....	313
六、募集资金具体运用情况.....	336

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、一般释义

英韧科技、发行人、公司、股份公司	指	英韧科技股份有限公司
英韧有限、有限公司	指	英韧科技（上海）有限公司，发行人的前身
成都英韧	指	英韧科技（成都）有限公司，发行人的全资子公司
南京英韧	指	英韧科技（南京）有限公司，发行人的全资子公司
深圳英韧	指	英韧科技（深圳）有限公司，发行人的全资子公司
鄂州英韧	指	英韧科技（鄂州）有限公司，发行人的全资子公司
武汉英韧	指	英韧科技（武汉）有限公司，发行人的全资子公司
长鹰芯存	指	长鹰芯存（上海）集成电路有限公司，发行人的全资子公司
上海芯乾	指	上海芯乾集成电路有限公司，发行人的全资子公司
Nyquist HK	指	Nyquist Semiconductor Limited，发行人的二级子公司
Nyquist Cayman	指	Nyquist Semiconductor Limited，发行人全资子公司，已于2022年1月被注销
韧存集成	指	上海韧存集成电路有限公司
英韧集成	指	上海英韧集成电路科技有限公司
芯韧一号	指	上海芯韧一号企业管理合伙企业（有限合伙）
芯韧二号	指	上海芯韧二号企业管理合伙企业（有限合伙）
芯韧三号	指	上海芯韧三号企业管理合伙企业（有限合伙）
芯韧四号	指	上海芯韧四号企业管理合伙企业（有限合伙）
芯韧五号	指	上海芯韧五号企业管理合伙企业（有限合伙）
芯韧六号	指	上海芯韧六号企业管理合伙企业（有限合伙）
芳春丹桂	指	上海芳春丹桂企业管理合伙企业（有限合伙）
上海芯镒	指	上海芯镒企业管理合伙企业（有限合伙）
RENCUN ULELA	指	Rencun Ulela LLC
开曼英韧	指	InnoGrit Technologies Limited
上海韧存	指	上海韧存企业管理合伙企业（有限合伙）
朗玛永祥	指	北京朗玛永祥投资管理股份公司

朗玛一号	指	朗玛一号(北京)半导体产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)
朗玛十九号	指	朗玛十九号(深圳)创业投资中心(有限合伙)
朗玛二十一	指	朗玛二十一(深圳)创业投资中心(有限合伙)
朗玛二十三号	指	朗玛二十三号(深圳)创业投资中心(有限合伙)
朗玛三十九号	指	朗玛三十九号(深圳)创业投资中心(有限合伙)
朗玛八十七号	指	朗玛八十七号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
朗玛八十八号	指	朗玛八十八号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
朗玛八十九号	指	朗玛八十九号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
朗玛九十号	指	朗玛九十号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
朗玛九十二号	指	朗玛九十二号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
朗玛九十三号	指	朗玛九十三号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
中电通商	指	中电通商融资租赁有限公司
中电投资	指	中国电子投资控股有限公司
国家集成电路二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
GBC	指	Global Bridge Capital USD Fund I, L.P.
深圳鹏远昇	指	深圳鹏远昇企业管理合伙企业(有限合伙), 曾用名宁波大榭鹏创股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波鹏远昇企业管理合伙企业(有限合伙)
武岳峰集成电路	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)
上海晶湖	指	上海晶湖企业管理合伙企业(有限合伙)
交融君泓三期	指	交融君泓三期(大同)股权投资合伙企业(有限合伙)
经纬壹号	指	南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙)
国鑫投资	指	上海国鑫投资发展有限公司
中网投	指	中国互联网投资基金(有限合伙)
鄂州芯存储	指	鄂州市葛店芯存储产业投资基金合伙企业(有限合伙)
上海驰芯	指	上海驰芯企业管理合伙企业(有限合伙)
武岳峰华矽	指	常州武岳峰华矽创业投资合伙企业(有限合伙), 曾用名南京华矽创业投资合伙企业(有限合伙)
中电发展	指	北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
湖州龙翔	指	湖州龙翔股权投资合伙企业(有限合伙)

鼎洪广目	指	深圳市鼎洪广目创业投资企业（有限合伙）
南京星韧	指	南京星韧投资合伙企业（有限合伙）
天府数智	指	成都华泰天府数智创业投资合伙企业（有限合伙）
浦东创投	指	上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
南海成长湾科	指	深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
海南鼎泽	指	海南鼎泽创业投资合伙企业（有限合伙）
上海联新	指	上海联新科技股权投资中心（有限合伙）
上海集成电路	指	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
厦门融汇	指	厦门融汇弘上二期股权投资合伙企业（有限合伙）
湖杉明芯	指	湖杉明芯（成都）创业投资中心（有限合伙）
普华创投	指	普华中小二期（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）
交银华侨基金	指	昆山交银华侨数字经济股权投资合伙企业（有限合伙）
中信金石	指	金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
海南海鼎永和	指	海南海鼎永和投资合伙企业（有限合伙）
SPV A1	指	InnoGrit SPV A1, LLC
上海海望	指	上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）
腾晋天成	指	深圳腾晋天成投资中心（有限合伙）
鑫安源晟	指	鑫安源晟（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）
经纬叁号	指	南京经纬创叁号投资合伙企业（有限合伙）
联金创新	指	联金创新产业私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙），曾用名联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
磐鑫和涌	指	南京磐鑫和涌创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名宁波磐鑫和涌管理咨询中心合伙企业（有限合伙）
苏州宜仲	指	苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
普续润鑫	指	宁波梅山保税港区普续润鑫投资合伙企业（有限合伙）
华福成长	指	华福成长投资有限公司
南京爱诺	指	南京爱诺芯云股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳海鼎永和	指	深圳海鼎永和创业投资合伙企业（有限合伙）
红土投资	指	安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）
张江燧锋	指	上海张江燧锋二期创业投资合伙企业（有限合伙）

上海科创有限	指	上海科技创业投资有限公司
锡创聚成	指	杭州锡创聚成股权投资合伙企业(有限合伙)
尚融创新	指	尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)
福州追远	指	福州追远创业投资合伙企业(有限合伙)
同创同运	指	苏州同创同运创业投资合伙企业(有限合伙)
南京润信	指	南京润信协同中小企业发展基金合伙企业(有限合伙), 曾用名中小企业发展基金(南京)协同合伙企业(有限合伙)
山东新动能	指	山东省新动能投资管理有限公司
杭州创徒	指	杭州创徒创业投资合伙企业(有限合伙)
深创投	指	深圳市创新资本投资有限公司
上海衡峥	指	上海衡峥创业投资中心(有限合伙)
夏创星火	指	湖北夏创星火创业投资基金合伙企业(有限合伙)
云九资本	指	上海云玖一号创业投资合伙企业(有限合伙), 曾用名广州云仁投资合伙企业(有限合伙)
氢毅昕阳创投	指	上海氢毅昕阳创业投资合伙企业(有限合伙)
超越未来	指	深圳市超越未来创业投资合伙企业(有限合伙)
共青城栋晖峰	指	共青城栋晖峰创业投资合伙企业(有限合伙)
国泰君安证裕	指	国泰君安证裕投资有限公司
洞鉴信创	指	共青城洞鉴信创科技产业投资合伙企业(有限合伙)
晟联创投	指	泉州市晟联股权投资基金合伙企业(有限合伙), 曾用名泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业(有限合伙)
海鼎景行	指	深圳海鼎景行创业投资合伙企业(有限合伙)
启鹭厦门	指	启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
创熠爱诺	指	南京创熠爱诺股权投资基金合伙企业(有限合伙)
中叶创投	指	上海中叶至源创业投资合伙企业(有限合伙)
云涌岫阳	指	宁波梅山保税港区云涌岫阳股权投资合伙企业(有限合伙)
地纬华宸	指	山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业(有限合伙)
诸暨蔚康	指	诸暨蔚康企业管理咨询合伙企业(有限合伙), 曾用名北京蔚康管理咨询中心(有限合伙)、北京融汇阳光永兴投资管理中心(有限合伙)
上海科创集团	指	上海科技创业投资(集团)有限公司
迦明享誉	指	宁波梅山保税港区迦明享誉投资管理合伙企业(有限合伙)
诚鼎创投	指	泰兴诚鼎硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)

华鲁产投	指	华鲁产业股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）
济南云涌	指	济南云涌资本投资合伙企业（有限合伙）
衡盈芳华	指	宁波梅山保税港区衡盈芳华创业投资合伙企业(有限合伙)
济南云盛	指	济南云盛投资合伙企业（有限合伙）
济南云智	指	济南云智投资合伙企业（有限合伙）
天津镕英	指	天津镕英企业管理合伙企业（有限合伙）
武岳峰高科	指	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙），曾用名北京亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）
中金文化消费	指	中金文化消费产业股权投资基金（厦门）合伙企业（有限合伙）
融汇阳光	指	北京融汇阳光新兴产业投资管理中心（有限合伙）
嘉远资本	指	深圳市嘉远资本管理有限公司
伊敦传媒	指	深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）
Xin An	指	XIN AN CAPITAL FUND I,L.P.
武岳峰创投	指	上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）
zPark	指	zPark Capital II,L.P.
上海韧创	指	上海韧创企业管理合伙企业（有限合伙），已于 2023 年 7 月被注销
安存科技	指	安存科技（上海）有限公司，报告期内曾为发行人全资子公司，已于 2025 年 10 月注销
朗玛峰	指	朗玛永祥、朗玛一号、朗玛十九号、朗玛二十一、朗玛八十七号、朗玛八十八号、朗玛八十九号、朗玛九十号、朗玛九十二号、朗玛九十三号
武岳峰	指	上海驰芯、武岳峰集成电路、武岳峰华矽
联想	指	联想（北京）有限公司及其关联公司
新华三	指	新华三信息技术有限公司
长城	指	中电长城科技有限公司
芯科睿	指	深圳市芯科睿电子科技有限责任公司及其关联公司
佰维存储	指	深圳佰维存储科技股份有限公司及其关联公司
江波龙	指	深圳市江波龙电子股份有限公司及其关联公司
德梧信息	指	上海德梧信息技术有限公司
湖南天硕	指	湖南天硕创新科技有限公司
威刚科技	指	威刚科技股份有限公司及其关联公司
时创意	指	深圳市时创意电子股份有限公司及其关联公司

圣鼎达	指	北京圣鼎达科技有限公司
宏芯凯	指	江苏宏芯凯电子科技有限公司
雅创电子	指	上海雅创电子集团股份有限公司及其关联公司
优特技术	指	优特技术(香港)有限公司
知芯微	指	武汉知芯微科技有限公司
艾登集团	指	艾登商贸有限公司
WINWARD	指	WINWARD INDUSTRIAL LIMITED 及其实控人控制的 SIN YAN INVESTMENT CO.,LTD、AGI TECHNOLOGY CO., LTD 及 Intek Yu International Co.,Ltd
铠侠	指	KIOXIA Corporation
联芯集成	指	联芯集成电路制造(厦门)有限公司
保荐人、保荐机构、主承销商、国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
发行人律师、中伦	指	北京市中伦律师事务所
发行人会计师、安永	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
蓝策	指	蓝策亚洲(北京)咨询服务有限公司, 曾用名为蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司
洲蓝	指	洲蓝(上海)资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
《审核规则》	指	《上海证券交易所股票发行上市审核规则》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	发行人制定及不时修订的《英韧科技股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》	指	经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过并将于本次发行上市后施行的《英韧科技股份有限公司章程(草案)》
招股说明书、本招股说明书	指	《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
境外法律意见书	指	境外律师针对发行人境外子公司、股东或关联方的有关情况出具的法律意见书
境外知识产权核查意见	指	知识产权代理机构对发行人境外知识产权出具的核查意见
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
科创板	指	上海证券交易所科创板
A 股股票、A 股	指	在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股股票

元、千元、万元、亿元	指	如无特别指明，指人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
最近三年、报告期	指	2023 年度、2024 年度及 2025 年度

二、专业释义

SSD	指	Solid State Drive, 固态硬盘, 指以 NAND 闪存颗粒为主要存储介质、基于主控芯片与固件算法协同工作的非易失性存储设备
HDD	指	Hard Disk Drive, 机械硬盘, 指采用磁性介质作为存储介质、精密机械部件作为驱动结构的非易失性存储设备
SATA	指	Serial Advanced Technology Attachment, 一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口, 主要用于在计算机主板与大容量存储设备(如机械硬盘、固态硬盘、光驱等)之间进行高速、点对点的数据传输
PCIe	指	Peripheral Component Interconnect Express, 一种高速串行计算机扩展总线标准, 能够实现高速、高带宽的点对点串行双通道传输
NAND 闪存颗粒	指	是基于 NAND 型闪存逻辑架构构建的非易失性半导体存储介质, 是固态硬盘、智能手机闪存等现代存储设备的核心数据载体
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory, 动态随机存取存储器, 是一种半导体存储器, 需要周期性刷新以维持其存储的数据
SCM	指	Storage Class Memory, 存储级内存, 性能、延迟与单位成本介于 DRAM 与 NAND 闪存颗粒之间的非易失性存储产品
SLC	指	Single-level cell, 即单个存储单元存储 1bit 数据的 NAND 闪存颗粒。SLC 延迟低、寿命极长, 但成本极高
MLC	指	Multi-level cell, 即单个存储单元存储 2bit 数据的 NAND 闪存颗粒。MLC 速度快、寿命长, 成本较高且容量小
TLC	指	Triple-level cell, 即单个存储单元存储 3bit 数据的 NAND 闪存颗粒。TLC 具有容量大、价格低且速度较快的特点, 且寿命较长
QLC	指	Quad-level cell, 即单个存储单元存储 4bit 数据的 NAND 闪存颗粒。QLC 与 TLC 相比, 容量更大且成本更低
CPU	指	Central Processing Unit, 即微处理器, 是一台计算机的运算核心和控制核心, 它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
GPU	指	Graphics Processing Unit, 即图像处理器, 是一种在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上专门负责图像运算的微处理器
AI	指	Artificial Intelligence, 即人工智能, 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
AI SSD	指	算力直连高性能固态硬盘, 不同于传统以 CPU 为中心、基于存储块的分层存储架构, AI SSD 面向 AI 算力卡的 SIMT 并行计算模式, 以及以缓存行为单位的高随机吞吐存储需求, 推动存储设备加快实现从 PCIe 4.0/5.0 的传统块传输能力向 PCIe 6.0 的块传输+缓存行传输双模能力跨越
IOPS	指	Input/output Operations Per Second, 每秒输入输出操作次数, 是衡量存储设备在高并发、小数据块访问场景下随机读写能力的核心性能指标

NVMe	指	Non-Volatile Memory express, 非易失性存储标准, 是一种针对 PCIe SSD 开发的接口协议标准, 该标准针对 PCIe SSD 优化了寄存器接口、指令集和功能集, 充分发挥了固态存储的并发性能
CXL	指	Compute Express Link, 高速互联开放标准, 是一种构建在 PCIe 物理层和电气接口上的高性能、缓存一致性互联开放标准。该标准专为异构计算架构设计, 旨在以硬件级效率实现 CPU 与 GPU 等加速器及内存扩展设备之间的高效互联与资源共享
制程	指	芯片的制作工艺, 通常以芯片内特定电路结构的尺寸(晶体管栅极的最小长度)作为衡量指标, 代表了集成电路制作的精细度, 是衡量工艺先进程度的标准。制程工艺越小, 意味着在同样大小面积的 IC 中, 可以设计密度更高、功能更复杂的电路
晶圆	指	制作集成电路的材料, 多为硅晶片, 由于其形状为圆形, 故称为晶圆; 在硅晶片上可加工制作成各种电路元器件结构, 使其成为有特定电路功能的芯片
封装	指	芯片制作工艺流程中的一个步骤, 是把晶圆厂生产出来的集成电路裸片(Die)放在一块起到承载和链接作用的基板上, 用金线(或者铜线)把管脚引出, 然后固定包装成为一个整体, 以利于链接到上一级 PCB 板上
测试	指	把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认, 以保证半导体元件符合系统的需求
流片	指	Tape Out, 芯片设计企业将芯片设计版图提交晶圆厂试生产, 并获得物理芯片的全过程
Fabless	指	即无制造半导体, 是“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式
IP	指	Intellectual Property, 是一种知识产权, 特指那些可重利用的、具有某种确定功能的 IC 模块
EDA	指	Electronic Design Automation, 即电子设计自动化软件工具, 设计者在软件平台上, 用硬件描述语言完成设计文件, 然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化布局、布线和仿真, 直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作

本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

(一) 重大风险提示

1、尚未盈利且存在累计未弥补亏损风险

报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-36,569.22 万元、-53,982.82 万元、-47,028.70 万元，尚未实现盈利，截至 2025 年末，公司未弥补亏损为-127,926.22 万元，预计短期内无法进行利润分配，对投资者的投资收益造成一定影响。报告期内，公司亏损的主要原因系公司为保持技术先进性持续进行大额研发投入、企业级固态硬盘业务尚处于发展阶段、存储行业周期波动导致存货跌价计提金额较大和确认大额股份支付费用所致。若公司未来遭遇存储行业下行周期盈利空间被压缩、市场竞争激烈产品销售价格不及预期，则公司面临未来一定期间无法实现盈利的风险。

2、毛利率波动风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 33.09%、10.92%和 5.29%，主要系公司产品线由主控芯片延伸至消费级及企业级固态硬盘，主营业务产品结构发生变动，且报告期内企业级固态硬盘处于市场拓展与导入验证期所致。此外，2025 年下半年以来，因 AI 服务器需求爆发导致存储市场供需失衡，带动 DRAM 等主要原材料价格发生较大波动。报告期内，公司把握存储行业国产替代、自主可控趋势，不断提升主控芯片与国产颗粒适配性，与国产颗粒厂商建立了深度合作关系，提升了自身供应链的稳定性。但未来公司若不能有效控制产品成本、提升自身议价能力或行业供需状况发生较大变化，公司毛利率水平将存在一定波动风险。

3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 16,569.64 万元、39,593.44 万元和 68,643.80 万元，主要由原材料、产成品和合同履约成本构成。公司根据下游市场需求及主要原材料价格变动趋势管控存货规模。报告期各期末，公司存货跌价

准备余额分别为 4,840.39 万元、18,464.97 万元和 18,483.00 万元,其中包括合同履约成本跌价准备 0.00 万元、7,342.20 万元及 7,189.50 万元。公司已根据相关存货及合同履约成本的可变现净值预计可回收金额谨慎计提存货跌价准备。未来如出现产品销售价格大幅下跌、主要原材料价格剧烈波动、旧代际存量产品销售周转放缓或合同履约进度不及预期等情况,公司将面临一定存货跌价损失的风险。

4、技术和产品迭代风险

公司所处的存储行业及其细分的数据存储主控芯片和固态硬盘行业以技术创新为核心驱动力。近年来,随着主控芯片接口速度、闪存颗粒、工艺制程的快速演进,公司的技术路线及下游市场需求持续处于快速发展和迭代的状态。如果公司未来不能准确判断行业发展趋势、技术演变方向及下游市场需求,则可能导致公司技术及产品竞争力下降,存在业绩增速放缓或下滑的风险。

(二) 尚未盈利及存在累计未弥补亏损的特别事项与前瞻性信息

报告期各期,公司归属于母公司所有者的净利润分别为-36,569.22 万元、-53,982.82 万元、-47,028.70 万元,尚未实现盈利,截至 2025 年 12 月末,公司未弥补亏损为-127,926.22 万元。未来随着 AI 发展带动存储需求快速增长及国产替代的持续加速,公司销售规模将进一步扩大,营业收入保持稳步增长,经营性亏损金额将有望逐步缩小。公司从自身经营情况出发,结合产品市场空间、产品研发、客户接洽及导入情况,预计最早于 2027 至 2028 年实现合并报表盈利。

公司上述前瞻性信息是建立在推测性假设的数据基础上的预测,具有重大不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。

(三) 投资者保护措施及承诺

根据公司 2026 年第一次临时股东会批准,本次发行上市前的滚存利润由发行后新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有,累计未弥补亏损由发行后的新老股东按照发行后的持股比例相应承担。

公司及相关责任主体已按照中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求,就股份锁定、股东持股及减持意向、稳定股价等重要事项作出相关承诺,具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺事项”。

(四) 公司本次发行上市后的利润分配政策

公司已审议通过了本次发行上市完成后生效的《公司章程(草案)》及《上市后三年股东分红回报规划》，对公司本次发行上市后的股利分配政策作出了相应规定。具体请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策”相关内容。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
中文名称	英韧科技股份有限公司	成立日期	2017年6月27日
注册资本	43,026.1427万元	法定代表人	刘刚
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄40号601-606室(名义楼层6层,实际楼层5层)	主要生产经营地址	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄40号601-606室(名义楼层6层,实际楼层5层)
控股股东	无	实际控制人	ZINING WU
行业分类	软件和信息技术服务业(I65)	在其他交易所(申请)挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	国泰海通证券股份有限公司	主承销商	国泰海通证券股份有限公司
发行人律师	北京市中伦律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	评估机构	洲蓝(上海)资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系	截至本招股说明书签署日,国泰海通的全资子公司国泰君安证裕直接持有发行人0.27%的股份,国泰海通的控股股东上海国际集团有限公司的全资子公司国鑫投资直接持有发行人1.60%的股份。此外,国泰海通及其控股股东上海国际集团有限公司存在因投资其他机构导致被动间接持有发行人股份的情况,间接持股比例合计不超过1%。除前述情况外,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系		
(三) 本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	【】

其他与本次发行有关的机构	无
--------------	---

三、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股(A股)		
每股面值	1.00元		
发行股数	不低于47,806,826股(超额配售选择权行使前)	占发行后总股本比例	不低于10%(超额配售选择权行使前)
其中:发行新股数量	不低于47,806,826股(超额配售选择权行使前)	占发行后总股本比例	不低于10%(超额配售选择权行使前)
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不低于478,068,253股(超额配售选择权行使前)		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍(发行价格除以每股收益,每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算)		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行方式	采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用证券监管部门认可的其他发行方式		
发行对象	符合规定资格的询价对象和在上交所开立账户并已开通科创板市场交易账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目		
	面向AI领域存储系统方案研发项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元,包括:承销及保荐费【】万元、律师费用【】万元、审计及验资费用【】万元、信息披露费用【】万元、发行手续费用【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高管及员工战略配售,则在本次公开发行股票注册后、发行前,履行内部程序审议该事项的具体方案,并依法进行披露		
保荐人相关子公司拟参	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交		

与战略配售情况	所相关规定执行。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	无
(二) 本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
资产总额(万元)	183,392.93	108,450.87	107,098.78
归属于母公司所有者权益(万元)	68,979.49	8,004.45	51,154.94
资产负债率(合并)	62.39%	92.62%	52.24%
资产负债率(母公司)	55.36%	75.39%	42.20%
营业收入(万元)	103,418.31	62,496.77	35,777.31
净利润(万元)	-47,028.70	-53,982.82	-36,569.22
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-47,028.70	-53,982.82	-36,569.22
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	-48,792.55	-54,763.89	-37,448.10
基本每股收益(元/股)	-1.22	-1.50	-1.38
稀释每股收益(元/股)	-1.22	-1.50	-1.38
加权平均净资产收益率	-197.04%	-171.39%	-183.44%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-65,280.38	-85,172.22	-37,519.90
现金分红(万元)	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	25.76%	48.82%	93.20%

五、发行人主营业务情况

公司是国际领先的数据存储主控芯片与半导体存储产品提供商，主营业务为数据存储主控芯片和固态硬盘（SSD）的研发、设计及销售，完整覆盖企业级、工业级和消费级应用。公司以 AI SSD 为代表的企业级产品为核心，依托自主研发能力，突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈，实现信息存储核心环节的自主可控，产品广泛应用于 AI 驱动的算力中心、云服务等前沿场景。目前，公司产品已成功导入客户 B、腾讯、客户 A、联想、新华三、客户 C 等主流国产互联网、云计算及服务器厂商供应链，广泛应用于国产 AI 算力基础设施。

公司最新一代 CXL 芯片作为国内首颗获得国际颗粒原厂合同的数据存储主控芯片，满足算力直连存储最新需求，预计将协同 GPU 共同驱动尖端 AI 应用场景，如人工智能推理训练一体机等，通过 GPU 直连架构、CXL 高速互连等前沿技术，与国内外 GPU 大厂深度协同，为人工智能算力中心提供高带宽、低延迟的存算一体解决方案。未来随着国产 GPU 在算力性能上的持续突破，公司将通过持续迭代的存算一体解决方案，带动国产 AI 基础设施实现跨越式发展。

在 AI 驱动的数字经济发展中，算力是数据处理的引擎，而存力则是数据可持续供给的基石，在大模型训练、实时推理等场景中，存力的带宽、延迟与可靠性直接决定了算力的实际效率上限。固态硬盘作为关键存储设备，是现代数字经济高效运转及 AI 产业快速发展的基础，其组成主要包括主控芯片、固件和存储介质（NAND 闪存颗粒和 DRAM）。其中主控芯片相当于固态硬盘的“算力与算法核心”，负责与整机进行数据通信以及闪存颗粒数据管理，是闪存颗粒快速商业化落地的关键因素。

公司是以完整自研高性能数据存储主控芯片技术与产品为基础，将业务逐步拓展至企业级固态硬盘的半导体存储解决方案提供商。国产颗粒适配方面，通过深度优化算法与芯片内设计，公司数据存储主控芯片对国产闪存颗粒具备业界领先的适配与性能调优能力；产业链方面，公司作为国内极少数具备企业级主控芯片及固态硬盘完整迭代研发能力的企业，助力我国半导体存储行业构建起从主控芯片、固件实现到存储模组的完整国产化链条；产品迭代方面，公司芯片及固态硬盘产品覆盖 SATA 到 PCIe 5.0，最新一代 PCIe 6.0 主控芯片和 CXL 主控芯片

已于 2026 年上半年流片,产品代次发布国内领先,技术水平位居国际第一梯队。

公司拥有良好的声誉及稳定广阔的客户群体,已进入行业头部客户的供应链体系,产品广泛应用于下游技术要求最高的企业级客户与知名消费级客户,并实现规模出货,包括客户 A、联想、新华三、客户 C、长江计算、超云、长城等国内头部服务器厂商,客户 B、Bilibili、腾讯等互联网及云计算厂商,客户 E、闪迪、威刚科技、佰维存储、江波龙等国际颗粒原厂及存储模组厂商,终端客户触达互联网、云计算、AI 模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等各主要细分应用场景。

公司自成立以来不断拓展营销渠道,除境内的优质客户外,公司与国际客户建立了密切、稳定的合作关系,下游知名国际客户包括客户 E、威刚科技(全球第二大存储模组厂商)、闪迪(全球闪存存储解决方案领导者之一,分拆自西部数据)、TDK(全球领先的电子元件、传感器及电源解决方案提供商)、Swissbit(欧洲最大的独立嵌入式存储器和存储解决方案供应商)等。

公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业和国家高新技术企业,并承担上海市战略性新兴产业重大项目。此外,公司凭借领先的产品与服务积累了良好的声誉,成为“2025 年中国 IC 设计 Fabless100 排行榜——TOP10 存储器公司”中唯一全部采用自研数据存储主控芯片的企业,连续 5 年获评中国电子信息产业发展研究院颁布的“中国芯”存储芯片领域奖项,包括“优秀技术创新产品”和“优秀市场表现产品”奖项;连续 3 年获得“胡润全球瞪羚企业”等荣誉。根据 Frost&Sullivan 统计,在 2024 年中国固态硬盘市场中,公司在全部采用自研主控芯片的境内固态硬盘厂商中排名第一。

报告期内,公司主营业务收入情况如下:

单位:万元

类别	项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
数据存储主控芯片	PCIe	13,601.69	13.19%	16,480.65	26.41%	25,000.00	70.61%
	SATA	244.46	0.24%	75.13	0.12%	-	-
	小计	13,846.15	13.42%	16,555.78	26.53%	25,000.00	70.61%
固态硬	PCIe	58,820.66	57.03%	22,837.18	36.60%	8,992.50	25.40%

类别	项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
盘	SATA	30,072.00	29.16%	22,025.80	35.30%	1,199.25	3.39%
	小计	88,892.65	86.19%	44,862.98	71.89%	10,191.75	28.79%
技术服务		399.37	0.39%	983.11	1.58%	214.37	0.61%
合计		103,138.17	100.00%	62,401.86	100.00%	35,406.12	100.00%

六、发行人符合科创板定位的相关情况

(一) 发行人符合行业领域要求

公司所属 行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司主营业务为数据存储主控芯片和固态硬盘（SSD）的研发、设计及销售，完整覆盖企业级、工业级和消费级应用。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“165软件和信息技术服务业”，属于新一代信息技术领域。因此，公司符合科创板行业领域要求。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

(二) 发行人符合科创属性相关指标要求

科创属性相关指标	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000.00 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023-2025 年度，发行人研发投入分别为 33,344.39 万元、30,512.79 万元和 26,643.93 万元，合计研发投入金额 90,501.11 万元；发行人最近 3 年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 44.87%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，发行人研发人员共 198 人，占发行人员工总数的 64.29%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有可应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 156 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年至 2025 年度，公司营业收入分别为 35,777.31 万元、62,496.77 万元和 103,418.31 万元，公司最近三年营业收入复合增长率为 70.02%

七、发行人选择的具体上市标准

发行人结合自身状况，选择适用《科创板上市规则》第 2.1.2 条规定中的第

四套上市标准即“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

发行人 2025 年度实现营业收入为 10.34 亿元，结合最近一次外部股权融资情况，以及可比公司的估值情况，发行人符合所选择的上市标准。

八、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。

九、募集资金用途与未来发展规划

本次发行募集资金扣除相应发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	备案情况
1	新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目	149,837.26	127,200.00	已备案
2	面向 AI 领域存储系统方案研发项目	99,522.59	99,100.00	已备案
3	补充流动资金	97,000.00	97,000.00	-
合计		346,359.85	323,300.00	-

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述项目所需资金，则超出部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定、公司的实际经营需求，用于公司主营业务的发展。

十、其他对发行人有重大影响的事项

其他对发行人有重大影响的事项参见本招股说明书“第十节 其他重要事项”。

第三节 风险因素

一、与行业相关的风险

(一) 行业周期性波动风险

公司所处行业下游终端需求受宏观经济、技术发展、产能状况等因素影响呈现周期性变化,导致下游 AI、云计算、互联网等行业客户调整其对存储产品在内的信息基础设施资本开支。此外,受宏观经济周期、上下游技术进步及存储颗粒厂产能扩张计划等因素影响,NAND 闪存颗粒和 DRAM 市场呈现一定周期性波动的特征。如未来因存储颗粒厂产能变化、下游需求低迷等因素导致市场增长不如预期,则可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

(二) 市场竞争风险

近年来,随着中国对半导体存储产业的大力支持和国内企业技术实力的不断增强,国内厂商的市场份额处于快速增长阶段,市场竞争也日趋激烈。公司拥有自研主控芯片和固件算法,作为国产品牌代表厂商,同时面临全球行业龙头厂商和国内其他厂商的市场竞争。若市场竞争态势进一步加剧,公司行业地位和市场份额将受到国内外竞争对手冲击,进而对公司经营业绩产生不利影响。

二、与发行人相关的风险

(一) 尚未盈利且存在累计未弥补亏损风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)重大风险提示”之“1、尚未盈利且存在累计未弥补亏损风险”。

(二) 毛利率波动风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)重大风险提示”之“2、毛利率波动风险”。

(三) 存货跌价风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)重大风险提示”之“3、存货跌价风险”。

(四) 技术和产品迭代风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一) 重大风险提示”之“4、技术和产品迭代风险”。

(五) 研发人员流失及技术泄密风险

公司的核心竞争力来源于优秀的研发团队。经过多年的发展，公司已组建了一支覆盖芯片设计、固件与算法技术、颗粒适配与加速技术和企业与数据中心固态硬盘技术等多项核心技术的专业研发团队。为确保核心技术的安全性，公司高度重视对员工保密意识的培养，并通过与相关人员签署保密协议，严控机密外泄风险，同时也通过合理的薪酬制度和股权激励，确保研发团队的稳定。然而，由于国内相关领域的人才缺口大，市场竞争激烈，仍可能存在核心研发人员流失及核心技术泄密的风险，进而可能影响公司的核心竞争力。

(六) 客户集中度较高及主要客户变化风险

报告期内，公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为 78.96%、57.00% 和 69.83%，在报告期存在客户集中度较高的情况，主要系公司仍处于业务规模扩张阶段，优先与各应用领域的少数头部客户建立合作关系，对同一客户的销售规模受到客户采购计划、市场竞争状况、产品代际更迭和价格波动等因素影响，不同年度销售规模不同。报告期内，公司逐步丰富业务结构，产品条线由主控芯片延伸至消费级及企业级固态硬盘，导致公司报告期各期前五名客户构成存在一定变化。公司若未来不能稳定开拓客源，可能存在公司经营业绩不稳定的风险。

(七) 供应商集中度较高风险

报告期内，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 68.36%、56.57%和 70.09%。公司对外采购原材料主要为晶圆、NAND 闪存颗粒、DRAM 等，对外采购服务主要为自研主控芯片封装、测试服务和企业级 SSD 委托组装。由于半导体存储领域具有较高的资本技术壁垒和市场集中度，能够满足公司业务需求和技术要求的优质合作方较少，因此公司供应商集中度较高。如果未来出现全球贸易政策限制或产能分配变化、公司主要供应商出现发展经营不善等情形，影响与公司合作，将对公司正常经营造成不利影响。

(八) 应收账款回收风险

报告期各期末, 应收账款余额分别为 15,472.34 万元、40,978.66 万元和 56,366.04 万元, 应收账款余额占当期营业收入比例分别 43.25%、65.57%和 54.50%。报告期内, 随着公司业务规模快速发展, 应收账款也随之增长, 公司已谨慎计提了坏账准备。未来如宏观经济、客户经营情况等发生不利变化, 导致应收账款不能及时收回或发生坏账, 公司的资金周转和经营性活动现金流将受到不利影响。

(九) 经营性现金流净额为负及流动性风险

报告期各期, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为-37,519.90 万元、-85,172.22 万元和-65,280.38 万元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额持续为负, 主要系: (1) 报告期内公司处于尚未盈利阶段。公司为提升产品竞争力, 持续保持高强度研发投入, 经营活动流入现金尚无法全部覆盖各项成本费用支出; (2) 报告期内因销售规模持续扩大及主要原材料价格波动, 公司进行合理备货, 故购买商品、接受劳务支付的现金较多。未来公司将继续进行较大金额的研发投入以及其他必要的经营相关资金支出, 故存在未来一段时间内公司经营活动现金流持续为负的可能性。若公司外部融资渠道受限时, 将会对公司的现金流造成压力, 从而对公司研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面造成不利影响。

(十) 募投项目未能顺利实施或效益不达预期的风险

公司本次募集资金主要用于新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目和面向 AI 领域存储系统方案研发项目。公司已基于当前的行业状况、技术发展现状等情况对相关募投项目的必要性和可行性进行了充分论证。但是在项目实施过程中, 如果公司无法实现关键技术的突破、产品性能未达设计目标或者市场环境出现较大变化, 则募投项目可能存在无法顺利实施或效益不达预期的风险, 对公司的业绩产生一定影响。

(十一) 实际控制人持股比例较低的风险

截至报告期末, 本次发行前, 公司整体股权结构较为分散, 公司实际控制人 ZINING WU 的持股比例较低, 其通过开曼英韧控制公司 13.90%表决权、通过上海韧存控制公司 11.89%表决权, 合计控制公司 25.78%表决权。本次发行后实际

控制人的持股比例将进一步降低,如果未来公司股权发生重大变动导致公司的实际控制权发生变更,可能对公司经营管理产生不利影响。

第四节 发行人基本情况

一、发行人的基本信息

中文名称	英韧科技股份有限公司
英文名称	InnoGrit Technologies Co., Limited
注册资本	43,026.1427 万元人民币
法定代表人	刘刚
有限公司成立日期	2017-06-27
股份公司成立日期	2023-10-11
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄40号601-606室(名义楼层6层,实际楼层5层)
邮政编码	201210
互联网网址	https://www.yingren.cn
电子邮箱	investor@yingren.cn
信息披露和投资者关系管理部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系管理部门负责人	金昊
信息披露和投资者关系管理部门电话号码	021-61099118

二、发行人的设立情况

(一) 有限公司设立情况

2017年6月7日,开曼英韧和上海韧存签署《合资合同》和《上海英韧创信息科技有限公司章程》,约定共同出资设立英韧有限,注册资本为2,000.00万元。其中,开曼英韧以货币认缴出资1,006.40万元;上海韧存以货币认缴出资993.60万元。

2017年6月16日,英韧有限就其设立进行外商投资企业备案,并取得《外商投资企业设立备案回执》(编号:沪嘉外资备201700442)。

2017年6月27日,英韧有限取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

英韧有限设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开曼英韧	1,006.40	50.32
2	上海韧存	993.60	49.68
合计		2,000.00	100.00

(二) 股份有限公司设立情况

2023年9月15日,安永出具《审计报告》(安永华明(2023)专字第61559770_K01号),确认截至2023年7月31日,英韧有限经审计的净资产为311,194,524.58元。

2023年9月15日,蓝策出具《资产评估报告》(蓝策评报字【2023】第036号),确认截至2023年7月31日,英韧有限净资产评估值为543,045,994.50元。2026年3月27日,洲蓝出具《复核报告》(洲蓝咨报字【2026】第016号),对前述《资产评估报告》进行复核,确认《资产评估报告》的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。

2023年9月15日,英韧有限召开董事会,同意将英韧有限整体变更为股份有限公司。同日,英韧有限召开股东会,同意英韧有限整体变更为股份有限公司,以2023年7月31日为基准日,英韧有限经审计的净资产值为人民币311,194,524.58元,按照1:0.1656的比例折合为公司的股本51,527,286股,每股面值人民币1元,净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。

2023年9月21日,英韧有限全体股东作为发起人签署《英韧科技(上海)有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议》,一致同意由英韧有限全体股东作为发起人,以英韧有限截至2023年7月31日经审计确认的净资产人民币311,194,524.58元,按照1:0.1656的比例折合为公司的股份总额51,527,286股,每股面值为人民币1元,股份有限公司的注册资本(股本总额)为人民币51,527,286元;净资产折股后超出注册资本部分均计入股份有限公司的资本公积。各发起人以各自在英韧有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份,出资比例不变。

2023年9月21日,安永出具《验资报告》(安永华明(2023)验字第61559770_K01号),截至2023年9月21日,英韧科技已将英韧有限截至2023

年7月31日经审计的净资产311,194,524.58元折合股份总额51,527,286股。2026年3月25日,安永出具《实收资本/股本复核报告》(安永华明(2026)专字第70059504_K05号),对前述验资报告进行了复核。

2023年9月21日,公司召开创立大会,审议通过了英韧科技设立相关议案,并选举产生英韧科技第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事,并审议通过了《关于股份有限公司筹备情况的报告》《公司章程》等相关议案。

2023年10月11日,英韧科技取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

发行人设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	开曼英韧	9,424,730	18.29
2	上海韧存	8,061,832	15.65
3	武岳峰集成电路	3,373,781	6.55
4	中电通商	2,984,354	5.79
5	国家集成电路二期	2,511,416	4.87
6	GBC	2,317,102	4.50
7	上海晶湖	1,911,571	3.71
8	武岳峰高科	1,614,642	3.13
9	天津镨英	1,325,595	2.57
10	融汇阳光	1,215,631	2.36
11	深圳鹏远昇	1,189,387	2.31
12	上海驰芯	996,481	1.93
13	武岳峰华矽	867,690	1.68
14	中电发展	867,662	1.68
15	伊敦传媒	854,798	1.66
16	湖州龙翔	854,798	1.66
17	鼎洪广目	811,771	1.58
18	南京星韧	753,082	1.46
19	海南鼎泽	639,270	1.24

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
20	嘉远资本	603,708	1.17
21	上海联新	602,543	1.17
22	上海集成电路	602,543	1.17
23	海南海鼎永和	479,125	0.93
24	SPV A1	470,242	0.91
25	上海海望	469,328	0.91
26	腾晋天成	427,398	0.83
27	福州追远	419,307	0.81
28	鑫安源晟	408,747	0.79
29	联金创新	361,525	0.70
30	磐鑫和涌	345,212	0.67
31	苏州宜仲	341,919	0.66
32	普续润鑫	334,226	0.65
33	南京爱诺	324,223	0.63
34	尚融创新	264,243	0.51
35	朗玛十九号	256,439	0.50
36	南京润信	241,017	0.47
37	杭州创徒	231,624	0.45
38	上海衡峥	222,248	0.43
39	国泰君安证裕	180,763	0.35
40	晟联创投	170,959	0.33
41	朗玛二十一	170,959	0.33
42	中金文化消费	150,635	0.29
43	启鹭厦门	150,635	0.29
44	创熠爱诺	136,249	0.26
45	云涌岫阳	120,508	0.23
46	诸暨蔚康	119,671	0.23
47	迦明享誉	108,457	0.21

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
48	朗玛二十三号	85,480	0.17
49	衡盈芳华	85,480	0.17
50	朗玛三十九号	66,280	0.13
合计		51,527,286	100.00

三、发行人报告期内的股本和股东变化情况

(一) 发行人报告期初的股权结构

报告期初，英韧有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	开曼英韧	1,006.40	20.95
2	上海韧存	783.68	16.32
3	武岳峰集成电路	337.38	7.02
4	Xin An	298.44	6.21
5	GBC	231.71	4.82
6	武岳峰创投	180.83	3.76
7	上海晶湖	161.57	3.36
8	武岳峰高科	161.46	3.36
9	天津镭英	132.56	2.76
10	融汇阳光	121.56	2.53
11	深圳鹏远昇	118.94	2.48
12	中电发展	86.77	1.81
13	武岳峰华矽	86.77	1.81
14	伊敦传媒	85.48	1.78
15	湖州龙翔	85.48	1.78
16	上海韧创	79.49	1.65
17	嘉远资本	60.37	1.26
18	上海集成电路	60.25	1.25
19	上海联新	60.25	1.25

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
20	SPV A1	47.02	0.98
21	腾晋天成	42.74	0.89
22	福州追远	41.93	0.87
23	鑫安源晟	40.87	0.85
24	联金创新	36.15	0.75
25	苏州宜仲	34.19	0.71
26	普续润鑫	33.42	0.70
27	zPark	32.42	0.67
28	尚融创新	26.42	0.55
29	朗玛十九号	25.64	0.53
30	南京润信	24.10	0.50
31	上海海望	24.10	0.50
32	杭州创徒	23.16	0.48
33	上海衡崢	22.22	0.46
34	田茂程	20.51	0.43
35	磐鑫和涌	19.47	0.41
36	国泰君安证裕	18.08	0.38
37	朗玛二十一	17.10	0.36
38	晟联创投	17.10	0.36
39	中金文化消费	15.06	0.31
40	启鹭厦门	15.06	0.31
41	蔡恩豪	15.06	0.31
42	创熠爱诺	13.62	0.28
43	云涌岫阳	12.05	0.25
44	诸暨蔚康	11.97	0.25
45	迦明享誉	10.85	0.23
46	衡盈芳华	8.55	0.18
47	朗玛二十三号	8.55	0.18

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
48	朗玛三十九号	6.63	0.14
合计		4,803.45	100.00

(二) 发行人报告期初至今的股本和股东变化

报告期初至今，发行人股本和股东变化简要情况如下：

序号	时间	变动事项	变化情况	变化后 注册资本 (万元)
1	2023年1月	股权转让、增资	(1) zPark 将其持有的英韧有限注册资本 32.42 万元转让给南京爱诺。 (2) 英韧有限新增注册资本 349.28 万元，其中上海海望认购新增注册资本 22.83 万元；南京星韧认购新增注册资本 75.31 万元；国家集成电路二期认购新增注册资本 251.14 万元。	5,152.73
2	2023年4月	股权转让	(1) 蔡恩豪将其持有的英韧有限注册资本 15.06 万元转让给磐鑫和涌。 (2) Xin An 将其持有的英韧有限注册资本 298.44 万元转让给中电通商。	5,152.73
3	2023年6月	股权转让	(1) 田茂程将其持有的英韧有限注册资本 20.52 万元转让给海南海鼎永和。 (2) 上海韧存将其持有的英韧有限注册资本 21.69 万元转让给海南海鼎永和。 (3) 上海晶湖将其持有的英韧有限注册资本 5.71 万元转让给海南海鼎永和。 (4) 开曼英韧将其持有的英韧有限注册资本 63.93 万元转让给海南鼎泽。	5,152.73
4	2023年7月	股权转让	(1) 上海韧创将其持有的英韧有限注册资本 35.30 万元转让给上海晶湖。 (2) 上海韧创将其持有的英韧有限注册资本 44.19 万元转让给上海韧存。	5,152.73
5	2023年8月	股权转让	(1) 武岳峰创投将其持有的英韧有限注册资本 99.65 万元转让给上海驰芯。 (2) 武岳峰创投将其持有的英韧有限注册资本 81.18 万元转让给鼎洪广目。	5,152.73
6	2023年10月	股改	英韧有限整体变更为股份公司。	5,152.73
7	2023年12月 ~ 2024年2月	增资	(1) 公司新增注册资本 5,224,204 元，由交融君泓三期等 12 名投资人认购。 (2) 公司以资本公积转增方式新增注册资本 303,248,510 元。	36,000.00
8	2025年2月 ~ 2025年7月	增资、股份转让	(1) 公司新增注册资本 16,009,283 元，由朗玛八十七号等 8 名投资人认购。 (2) 武岳峰集成电路将其持有的公司 2,267,207 股股份转让给朗玛八十七号、朗玛八十八号、朗玛八十九号。	37,600.93

序号	时间	变动事项	变化情况	变化后 注册资本 (万元)
			(3) 朗玛二十一、朗玛二十三号、朗玛三十九号将其持有的公司共计 986,207 股股份转让给海鼎景行。 (4) 朗玛二十三号将其持有的公司 420,444 股股份转让给洞鉴信创。	
9	2025 年 8 月 ~ 2025 年 9 月	增资、股份转让	(1) 公司新增注册资本 54,252,144 元, 鄂州芯存储等共计 16 名投资人认购。 (2) 嘉远资本将其持有的公司 1,197,174 股股份转让给朗玛八十九号、朗玛九十号、朗玛九十二号、朗玛九十三号。 (3) 天津镭英将其持有的公司 1,393,922 股股份转让给朗玛八十九号、朗玛九十号、朗玛九十二号、朗玛九十三号。	43,026.14
10	2025 年 10 月 ~ 2025 年 11 月	股份转让	(1) 嘉远资本将其持有的公司 1,341,016 股股份转让给超越未来。 (2) 福州追远将其持有的公司 1,052,632 股股份转让给深圳海鼎永和。 (3) 天津镭英将其持有的公司 7,014,918 股股份转让给湖杉明芯、地纬华宸、华鲁产投、经纬叁号、经纬壹号、朗玛永祥、南海成长湾科、普华创投、山东新动能、夏创星火、深圳海鼎永和。 (4) 武岳峰高科将其持有的公司 10,242,394 股股份转让给朗玛永祥、朗玛一号、深圳鹏远昇。 (5) 嘉远资本将其持有的公司 1,291,399 股股份转让给深圳海鼎永和、济南云盛、济南云涌、济南云智。 (6) 融汇阳光将其持有的公司 7,711,289 股股份转让给经纬壹号、朗玛永祥、厦门融汇。 (7) 武岳峰集成电路将其持有的公司 6,477,733 股股份转让给朗玛一号、深圳鹏远昇。 (8) 伊敦传媒将其持有的公司 5,422,365 股股份转让给湖杉明芯、华鲁产投、经纬叁号、经纬壹号、朗玛永祥、南海成长湾科、普华创投、夏创星火。 (9) 中金文化消费将其持有的公司 955,545 股股份转让给朗玛一号。	43,026.14
11	2025 年 11 月	股份转让	中电通商将其持有的公司 18,931,088 股股份转让给中电投资。	43,026.14

四、发行人成立以来重要事件

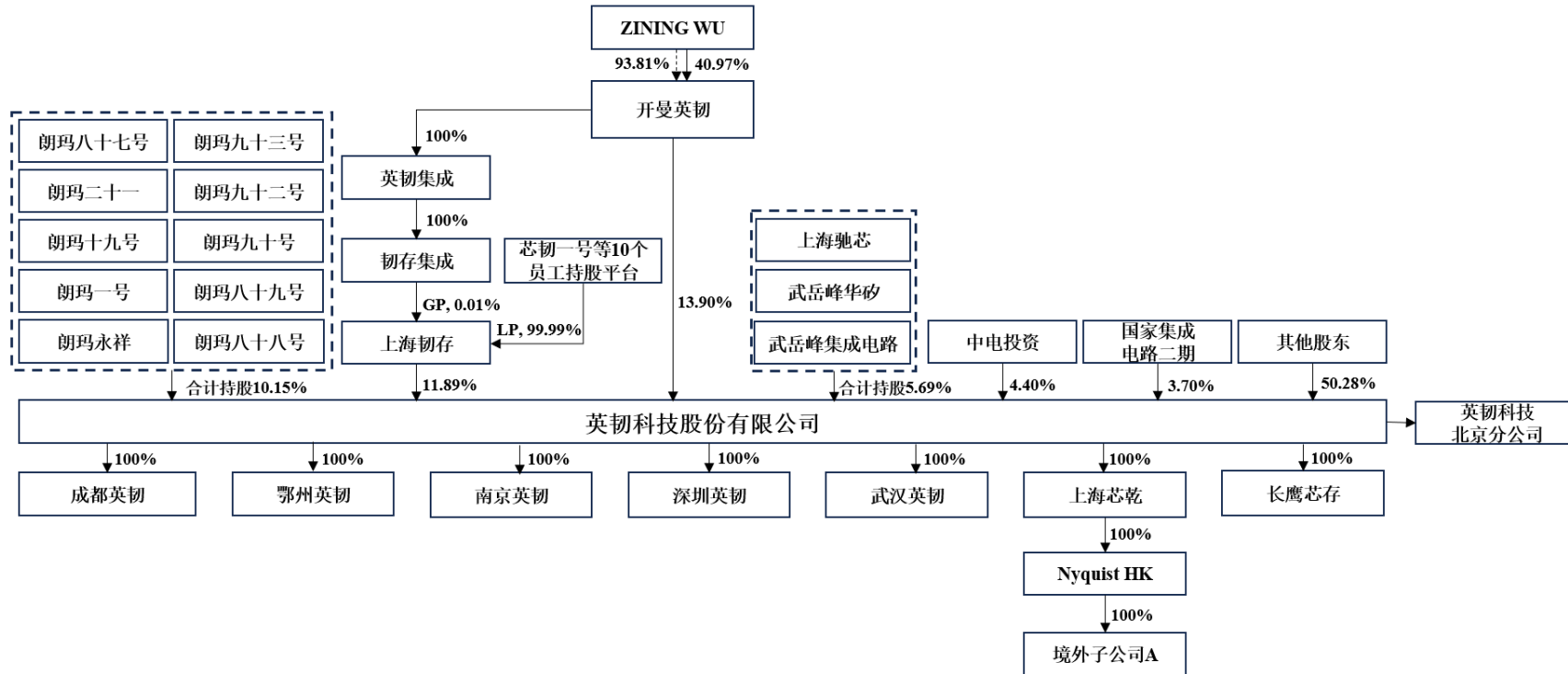
发行人成立以来，未曾发生重大资产重组等重要事件。

五、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况

截至本招股说明书签署日，发行人未曾在其他证券市场上市或挂牌。

六、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



注：根据开曼英韧层面表决权的设计，ZINING WU控制开曼英韧93.81%的表决权。

七、发行人控股、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 9 家全资子公司（含二级、三级子公司），1 家分公司，1 家注销子公司，无参股公司。

（一）重要子公司基本情况

公司根据子公司最近一年营业收入、总资产或净资产任一单个指标占公司同期合并财务报表相应指标比重超过 5%，以及子公司经营业务、未来发展战略、持有资质或证照等对公司的影响作为重要性依据认定。截至本招股说明书签署日，公司共有 6 家重要子公司。具体情况如下：

1、成都英韧

成都英韧为发行人全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	英韧科技（成都）有限公司
统一社会信用代码	91510122MA62X16354
法定代表人	程潜
注册资本	5,000 万元人民币
实收资本	1,500 万元人民币
成立时间	2018 年 10 月 17 日
住 所	成都市双流区东升街道成都芯谷产业园区集中区内
经营范围	信息技术、计算机软硬件技术开发、技术服务；集成电路、智能芯片、通讯设备、电子产品设计、研发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
业务定位	从事研发

成都英韧最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	3,448.48
净资产	1,810.83
营业收入	9,878.95
净利润	22.51

注：以上财务数据经安永在合并财务报表范围内审计。

2、南京英韧

南京英韧为发行人全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	英韧科技（南京）有限公司
统一社会信用代码	91320111MA1YMLHA7D
法定代表人	武剑
注册资本	4,000万元人民币
实收资本	4,000万元人民币
成立时间	2019年7月2日
住 所	南京市浦口区兰新路15号中科创新产业园-C10
经营范围	信息科技开发、集成电路、芯片、通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备设计、研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路芯片及产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
业务定位	从事运营、研发和销售

南京英韧最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	18,367.71
净资产	-3,519.67
营业收入	13,875.17
净利润	-587.70

注：以上财务数据经安永在合并财务报表范围内审计。

3、长鹰芯存

长鹰芯存为发行人全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	长鹰芯存（上海）集成电路有限公司
统一社会信用代码	91310106MACEJL993T
法定代表人	刘刚
注册资本	2,000万元人民币
实收资本	300万元人民币

成立时间	2023年4月7日
住 所	上海市静安区万荣路1256-1258号419室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；企业管理咨询；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
业务定位	从事研发、销售

长鹰芯存最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	5,946.65
净资产	-1,655.40
营业收入	1,210.70
净利润	-1,118.71

注：以上财务数据经安永在合并财务报表范围内审计。

4、上海芯乾

上海芯乾为发行人全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	上海芯乾集成电路有限公司
统一社会信用代码	91310114MA1GT9UK04
法定代表人	刘刚
注册资本	25,875.63万元人民币
实收资本	25,875.63万元人民币
成立时间	2016年4月15日
住 所	上海市静安区江场三路238号1601室
经营范围	从事集成电路及芯片、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,产品设计,企业管理,企业管理咨询,从事货物进出口及技术进出口业务,集成电路、计算机、软件及辅助设备、通讯器材、通信设备及相关产品、电子产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
业务定位	从事销售、出口业务

上海芯乾最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	47,719.44
净资产	25,499.97
营业收入	32,688.31
净利润	-342.64

注：以上财务数据经安永在合并财务报表范围内审计。

5、Nyquist HK

Nyquist HK 为发行人全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	Nyquist Semiconductor Limited
注册地	中国香港
设立/入股日期	2016年5月19日
注册号	66182248
发行股份数	38,552,517股
注册地址	ROOM B3, 19/F, TUNG LEE COMMERCIAL BUILDING, 91-97 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN HONG KONG
业务定位	从事海外出口业务

Nyquist HK 最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	32,331.88
净资产	4,707.35
营业收入	53,039.44
净利润	-634.97

注：以上财务数据经安永在合并财务报表范围内审计。

6、境外子公司 A

境外子公司 A 为发行人全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	境外子公司A
注册地	***
设立/入股日期	*年*月*日

注册号	***
发行股份数	*股
注册地址	***
业务定位	***

境外子公司 A 最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	11,889.68
净资产	-13,045.76
营业收入	8,045.15
净利润	-6,058.29

注：以上财务数据经安永在合并财务报表范围内审计。

(二) 其他子公司基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本	主营业务	股权结构
1	深圳英韧	2021 年 10 月 8 日	1,000 万元人民币	从事销售、研发服务	发行人持有 100% 股权
2	鄂州英韧	2025 年 8 月 13 日	5,000 万元人民币	从事运营、销售业务	发行人持有 100% 股权
3	武汉英韧	2025 年 11 月 20 日	6,400 万元人民币	从事运营、销售业务	发行人持有 100% 股权

(三) 分公司基本情况

1、英韧科技北京分公司

英韧科技北京分公司的基本情况如下：

公司名称	英韧科技股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码	91110108MAC6WD3W58
负责人	周燕
注册资本	-
成立时间	2023 年 1 月 31 日
住所	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 9 层 901 室
经营范围	一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；物联网技术研发；软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路销售；计算

	机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务定位	从事销售和客户支持

（四）注销子公司基本情况

1、安存科技

报告期内，安存科技曾为发行人全资子公司，于 2025 年 10 月完成注销。安存科技注销前的基本情况如下：

公司名称	安存科技（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K48FE0F
法定代表人	柯川
注册资本	100 万元人民币
成立时间	2018 年 11 月 23 日
住 所	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 2 幢 3 层
经营范围	电子科技、信息科技、物联网技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，计算机软件及辅助设备的销售，数据处理与存储服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
业务定位	无实际业务

八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

截至本招股说明书签署日，发行人无单一持股 30%以上的股东，不存在控股股东。

截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人为 ZINING WU。ZINING WU 能控制公司第一大股东开曼英韧 93.81%的表决权，并担任开曼英韧的唯一董事，因此 ZINING WU 通过控制开曼英韧，从而控制公司 13.90%表决权；上海韧存的执行事务合伙人为韧存集成，韧存集成为开曼英韧控制的企业，且 ZINING WU 担任韧存集成执行董事，因此，ZINING WU 通过控制上海韧存从而控制公司 11.89%表决权，综上，ZINING WU 合计控制公司 25.78%表决权，且公司其他股

东持股比例较低且较为分散。ZINING WU 担任公司董事长，ZINING WU 控制的开曼英韧提名发行人过半数非独立董事，ZINING WU 在公司股东会决策、推选董事人选过程中均能产生重大影响，且其全面负责公司经营战略和市场拓展等，主导公司业务活动及经营管理，对公司生产经营、重大决策具有实际的控制力。

实际控制人 ZINING WU 的基本情况如下：ZINING WU，男，美国国籍，护照号为 A805*****。其简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”部分。

最近两年内，发行人实际控制人未发生变更。

（二）控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，公司不存在控股股东，公司实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况。

（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东

截至本招股说明书签署日，其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东如下：

序号	股东名称	持股比例
1	开曼英韧	直接持有发行人 13.90%股份
2	上海韧存	直接持有发行人 11.89%股份
3	朗玛永祥	朗玛永祥、朗玛一号、朗玛八十九号、朗玛九十号、朗玛九十三号、朗玛八十八号、朗玛九十二号、朗玛十九号、朗玛八十七号、朗玛二十一均为同一主体实际控制的企业。上述主体合计持有发行人 10.15%股份。
4	朗玛一号	
5	朗玛八十九号	
6	朗玛九十号	
7	朗玛九十三号	
8	朗玛八十八号	
9	朗玛九十二号	
10	朗玛十九号	
11	朗玛八十七号	

序号	股东名称	持股比例
12	朗玛二十一	
13	武岳峰集成电路	武岳峰集成电路、上海驰芯、武岳峰华矽之间存在一致行动关系。上述主体合计持有发行人 5.69% 股份。
14	上海驰芯	
15	武岳峰华矽	

上述股东的基本情况如下：

1、开曼英韧

企业名称	InnoGrit Technologies Limited
注册地	开曼群岛
设立/入股日期	2016 年 11 月 25 日
注册号	317472
注册地址/主要生产经营地	Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands
股份总数	46,823,977 股
主营业务与发行人主营业务的关系	发行人的境外员工持股平台，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，开曼英韧的出资结构如下：

序号	股东姓名	股份类别	股本(股)	持股比例(%)
1	ZINING WU	A-2 类股	18,000,000	38.44
2		B 类股	1,184,987	2.53
3	其他 73 名自然人股东	A-1 类股	11,867,500	25.34
4		B 类股	15,771,490	33.68
合计			46,823,977	100.00

注：开曼英韧每份 A-2 类股份拥有 10 票表决权，每份 A-1 类股份拥有 1 票表决权，B 类股无表决权。

2、上海韧存

企业名称	上海韧存企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310114MA1GU37185
执行事务合伙人	上海韧存集成电路有限公司
认缴出资额	405.7380 万元

实缴出资额	405.6880 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 5 月 18 日
注册地址/主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围	企业管理，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务与发行人主营业务的关系	发行人的境内员工持股平台，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，上海韧存的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	韧存集成	普通合伙人	0.05	0.01
2	上海芯镒	有限合伙人	273.61	67.44
3	芯韧一号	有限合伙人	51.30	12.64
4	芯韧二号	有限合伙人	23.53	5.80
5	芯韧四号	有限合伙人	20.87	5.14
6	芯韧三号	有限合伙人	18.58	4.58
7	芯韧五号	有限合伙人	17.79	4.39
合计			405.74	100.00

3、朗玛峰

（1）朗玛永祥

企业名称	北京朗玛永祥投资管理股份公司
统一社会信用代码	91110108335446872X
法定代表人	肖建聪
认缴出资额	50,037 万元人民币
实缴出资额	50,037 万元人民币
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2015 年 3 月 12 日
注册地址/主要生产经营地	北京市海淀区北四环西路 58 号 18 层 1817
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的

	其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日，朗玛永祥的出资结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	赵红京	5,450.00	10.89
2	蒋薇	4,576.00	9.15
3	纪芳	4,475.00	8.94
4	王连	3,185.00	6.37
5	吕凤娥	3,020.00	6.04
6	孙学文	2,770.00	5.54
7	罗梅	2,529.00	5.05
8	吴慧娟	2,247.00	4.49
9	高丽	2,114.00	4.22
10	黄燕平	2,018.00	4.03
11	张晓辉	1,888.00	3.77
12	高彩虹	1,849.00	3.70
13	杨文霞	1,744.00	3.49
14	徐建东	1,624.00	3.25
15	贺乃新	1,531.00	3.06
16	李凤兰	1,465.00	2.93
17	贺然	1,264.00	2.53
18	安娜	1,250.00	2.50
19	刘岩	1,180.00	2.36
20	梁维娜	1,127.00	2.25
21	北京朗玛峰创业投资管理有限公司	1,100.00	2.20
22	邵玉平	1,075.00	2.15
23	肖闯	556.00	1.11

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
	合计	50,037.00	100.00

(2) 朗玛一号

企业名称	朗玛一号(北京)半导体产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MADX84RX72
执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	46,328 万元人民币
实缴出资额	46,328 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024 年 8 月 19 日
注册地址/主要生产经营地	北京市海淀区北四环西路 58 号 18 层 1803
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资,与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日,朗玛一号的出资结构如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	100.00	0.22
2	朗玛一百零一(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	7,260.00	15.67
3	朗玛一百零二(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,308.00	13.62
4	朗玛一百零三(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,950.00	12.84
5	马庆年	有限合伙人	5,300.00	11.44
6	郝蕾	有限合伙人	3,000.00	6.48
7	周继权	有限合伙人	3,000.00	6.48
8	秦燕	有限合伙人	1,200.00	2.59
9	赵雅齐	有限合伙人	1,100.00	2.37

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
10	赵永东	有限合伙人	1,060.00	2.29
11	王键	有限合伙人	1,050.00	2.27
12	李金阳	有限合伙人	1,000.00	2.16
13	肖金英	有限合伙人	1,000.00	2.16
14	刘明杰	有限合伙人	1,000.00	2.16
15	唐景海	有限合伙人	1,000.00	2.16
16	许晋华	有限合伙人	1,000.00	2.16
17	谢莉莉	有限合伙人	1,000.00	2.16
18	潘梅	有限合伙人	1,000.00	2.16
19	王晓亮	有限合伙人	1,000.00	2.16
20	宋雁翎	有限合伙人	1,000.00	2.16
21	乐红琴	有限合伙人	1,000.00	2.16
22	临沂宏盛铸业有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.16
合计			46,328.00	100.00

(3) 朗玛八十九号

企业名称	朗玛八十九号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5HR60K9Q
执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	6,367 万元人民币
实缴出资额	6,367 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023 年 3 月 24 日
注册地址/主要生产经营地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 101
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资,与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日,朗玛八十九号的出资结构如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	100.00	1.57
2	黄跃	有限合伙人	600.00	9.42
3	孙国锋	有限合伙人	300.00	4.71
4	沙若泓	有限合伙人	216.00	3.39
5	牟惜龙	有限合伙人	200.00	3.14
6	王鹏涛	有限合伙人	190.00	2.98
7	潘玉华	有限合伙人	181.00	2.84
8	李军	有限合伙人	160.00	2.51
9	邓雄哲	有限合伙人	160.00	2.51
10	陈国筠	有限合伙人	150.00	2.36
11	任永伟	有限合伙人	150.00	2.36
12	白振慧	有限合伙人	130.00	2.04
13	邓桂琴	有限合伙人	120.00	1.88
14	梁天霞	有限合伙人	110.00	1.73
15	高峰	有限合伙人	100.00	1.57
16	匡燕平	有限合伙人	100.00	1.57
17	宋晋林	有限合伙人	100.00	1.57
18	尧燕	有限合伙人	100.00	1.57
19	徐姗	有限合伙人	100.00	1.57
20	迟媛	有限合伙人	100.00	1.57
21	王爽	有限合伙人	100.00	1.57
22	王茂华	有限合伙人	100.00	1.57
23	胡雪姣	有限合伙人	100.00	1.57
24	马蕾	有限合伙人	100.00	1.57
25	徐伟东	有限合伙人	100.00	1.57
26	林娜	有限合伙人	100.00	1.57
27	闫庆华	有限合伙人	100.00	1.57
28	马代光	有限合伙人	100.00	1.57

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
29	姜月	有限合伙人	100.00	1.57
30	杨雨	有限合伙人	100.00	1.57
31	夏亮	有限合伙人	100.00	1.57
32	赵翠	有限合伙人	100.00	1.57
33	刘妍君	有限合伙人	100.00	1.57
34	李玉芳	有限合伙人	100.00	1.57
35	石晶晶	有限合伙人	100.00	1.57
36	赵文杰	有限合伙人	100.00	1.57
37	任诚	有限合伙人	100.00	1.57
38	范坤芳	有限合伙人	100.00	1.57
39	刘志远	有限合伙人	100.00	1.57
40	董卫彬	有限合伙人	100.00	1.57
41	刘莉娜	有限合伙人	100.00	1.57
42	武文妙	有限合伙人	100.00	1.57
43	郭月	有限合伙人	100.00	1.57
44	刘瑾	有限合伙人	100.00	1.57
45	张春明	有限合伙人	100.00	1.57
46	纪芳	有限合伙人	100.00	1.57
47	邱建芳	有限合伙人	100.00	1.57
48	刘颖	有限合伙人	100.00	1.57
49	张淑华	有限合伙人	100.00	1.57
50	马庆平	有限合伙人	100.00	1.57
合计			6,367.00	100.00

(4) 朗玛九十号

企业名称	朗玛九十号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5HR6BL72
执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	6,173 万元人民币

实缴出资额	6,173 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023 年 3 月 24 日
注册地址/主要生产经营地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 101
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资,与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日,朗玛九十号的出资结构如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	100.00	1.62
2	黄晓农	有限合伙人	300.00	4.86
3	魏刚	有限合伙人	200.00	3.24
4	李素焕	有限合伙人	200.00	3.24
5	肖金英	有限合伙人	200.00	3.24
6	谢雪萍	有限合伙人	200.00	3.24
7	徐金国	有限合伙人	200.00	3.24
8	高娟	有限合伙人	200.00	3.24
9	李亚茹	有限合伙人	150.00	2.43
10	王京	有限合伙人	150.00	2.43
11	高秀英	有限合伙人	150.00	2.43
12	丛达	有限合伙人	150.00	2.43
13	高彩雯	有限合伙人	137.00	2.22
14	何文兴	有限合伙人	130.00	2.11
15	黄昉	有限合伙人	130.00	2.11
16	李海军	有限合伙人	130.00	2.11
17	朱紫	有限合伙人	120.00	1.94
18	石晶晶	有限合伙人	112.00	1.81
19	王嘉仪	有限合伙人	108.00	1.75

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
20	茆淑萍	有限合伙人	105.00	1.70
21	袁家铮	有限合伙人	101.00	1.64
22	刘红云	有限合伙人	100.00	1.62
23	贺素珍	有限合伙人	100.00	1.62
24	尹海月	有限合伙人	100.00	1.62
25	王永俸	有限合伙人	100.00	1.62
26	牟冬	有限合伙人	100.00	1.62
27	高龙鑫	有限合伙人	100.00	1.62
28	王薇	有限合伙人	100.00	1.62
29	刘颖	有限合伙人	100.00	1.62
30	杨浸	有限合伙人	100.00	1.62
31	孙立民	有限合伙人	100.00	1.62
32	付松华	有限合伙人	100.00	1.62
33	伍霄	有限合伙人	100.00	1.62
34	马庆平	有限合伙人	100.00	1.62
35	陶媛	有限合伙人	100.00	1.62
36	李岩	有限合伙人	100.00	1.62
37	杨三星	有限合伙人	100.00	1.62
38	张倩	有限合伙人	100.00	1.62
39	纪芳	有限合伙人	100.00	1.62
40	熊珍	有限合伙人	100.00	1.62
41	徐可	有限合伙人	100.00	1.62
42	王智萍	有限合伙人	100.00	1.62
43	王洪	有限合伙人	100.00	1.62
44	吕静	有限合伙人	100.00	1.62
45	程国兆	有限合伙人	100.00	1.62
46	王玉玲	有限合伙人	100.00	1.62
47	林娜	有限合伙人	100.00	1.62

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
48	孙丽杰	有限合伙人	100.00	1.62
49	马丽霞	有限合伙人	100.00	1.62
50	李玉生	有限合伙人	100.00	1.62
合计			6,173.00	100.00

(5) 朗玛九十三号

企业名称	朗玛九十三号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5HRC087J
执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	6,222 万元人民币
实缴出资额	6,222 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023 年 3 月 28 日
注册地址/主要生产经营地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 102
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资,与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日,朗玛九十三号的出资结构如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	100.00	1.61
2	张燕梅	有限合伙人	400.00	6.43
3	李薇	有限合伙人	350.00	5.63
4	苏学娟	有限合伙人	200.00	3.21
5	赵雅齐	有限合伙人	170.00	2.73
6	张萌	有限合伙人	168.00	2.70
7	苗丽萍	有限合伙人	150.00	2.41
8	田伟	有限合伙人	150.00	2.41

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
9	周淑凤	有限合伙人	150.00	2.41
10	李歌	有限合伙人	150.00	2.41
11	张慧	有限合伙人	150.00	2.41
12	王秀萍	有限合伙人	148.00	2.38
13	关童文	有限合伙人	140.00	2.25
14	冯芳	有限合伙人	125.00	2.01
15	姚艺	有限合伙人	120.00	1.93
16	闫广平	有限合伙人	120.00	1.93
17	熊珍	有限合伙人	120.00	1.93
18	朱紫	有限合伙人	110.00	1.77
19	陈志新	有限合伙人	101.00	1.62
20	胡少泊	有限合伙人	100.00	1.61
21	梁志红	有限合伙人	100.00	1.61
22	朱云霞	有限合伙人	100.00	1.61
23	巢宇辉	有限合伙人	100.00	1.61
24	王丹	有限合伙人	100.00	1.61
25	李俊	有限合伙人	100.00	1.61
26	陈庚华	有限合伙人	100.00	1.61
27	吴颐菲	有限合伙人	100.00	1.61
28	苏海波	有限合伙人	100.00	1.61
29	王晓红	有限合伙人	100.00	1.61
30	佟璐瑶	有限合伙人	100.00	1.61
31	朱宾	有限合伙人	100.00	1.61
32	赵翬	有限合伙人	100.00	1.61
33	宋曙光	有限合伙人	100.00	1.61
34	于柳凤	有限合伙人	100.00	1.61
35	鲁绯	有限合伙人	100.00	1.61
36	尹静	有限合伙人	100.00	1.61

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
37	朱勇	有限合伙人	100.00	1.61
38	田丽文	有限合伙人	100.00	1.61
39	周倩	有限合伙人	100.00	1.61
40	郭晓娟	有限合伙人	100.00	1.61
41	易霞	有限合伙人	100.00	1.61
42	杨静超	有限合伙人	100.00	1.61
43	杜娟	有限合伙人	100.00	1.61
44	李芝灵	有限合伙人	100.00	1.61
45	李春梅	有限合伙人	100.00	1.61
46	王蕾	有限合伙人	100.00	1.61
47	鲁秀丽	有限合伙人	100.00	1.61
48	刘卓	有限合伙人	100.00	1.61
49	王乐宇	有限合伙人	100.00	1.61
50	杨林	有限合伙人	100.00	1.61
合计			6,222.00	100.00

(6) 朗玛八十八号

企业名称	朗玛八十八号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5HR63399
执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	5,908 万元人民币
实缴出资额	5,908 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023 年 3 月 24 日
注册地址/主要生产经营地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 101
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务与发行人主营业务	股权投资,与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

的关系	
-----	--

截至本招股说明书签署日，朗玛八十八号的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	100.00	1.69
2	张冬梅	有限合伙人	300.00	5.08
3	路亚利	有限合伙人	300.00	5.08
4	何利荣	有限合伙人	202.00	3.42
5	刁丽军	有限合伙人	200.00	3.39
6	杨青	有限合伙人	200.00	3.39
7	尹小融	有限合伙人	160.00	2.71
8	赵海容	有限合伙人	150.00	2.54
9	段辉燕	有限合伙人	150.00	2.54
10	赵小红	有限合伙人	120.00	2.03
11	刁爱丽	有限合伙人	114.00	1.93
12	石晶晶	有限合伙人	110.00	1.86
13	于柳凤	有限合伙人	101.00	1.71
14	乔引芳	有限合伙人	101.00	1.71
15	裴玖	有限合伙人	100.00	1.69
16	张跃	有限合伙人	100.00	1.69
17	李楠	有限合伙人	100.00	1.69
18	张松友	有限合伙人	100.00	1.69
19	马耀平	有限合伙人	100.00	1.69
20	刘青云	有限合伙人	100.00	1.69
21	胡雪姣	有限合伙人	100.00	1.69
22	关童文	有限合伙人	100.00	1.69
23	张倩	有限合伙人	100.00	1.69
24	蔡昊雨	有限合伙人	100.00	1.69
25	王健	有限合伙人	100.00	1.69
26	田佳皓	有限合伙人	100.00	1.69

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
27	郭雪杰	有限合伙人	100.00	1.69
28	郝男男	有限合伙人	100.00	1.69
29	王海龙	有限合伙人	100.00	1.69
30	杨莲花	有限合伙人	100.00	1.69
31	梁亚宁	有限合伙人	100.00	1.69
32	雷铁	有限合伙人	100.00	1.69
33	张立国	有限合伙人	100.00	1.69
34	王强	有限合伙人	100.00	1.69
35	刘燕	有限合伙人	100.00	1.69
36	陶媛	有限合伙人	100.00	1.69
37	陈敬	有限合伙人	100.00	1.69
38	宋基莲	有限合伙人	100.00	1.69
39	张劼	有限合伙人	100.00	1.69
40	武秉辰	有限合伙人	100.00	1.69
41	冯芳	有限合伙人	100.00	1.69
42	彭德成	有限合伙人	100.00	1.69
43	高茹	有限合伙人	100.00	1.69
44	王秋群	有限合伙人	100.00	1.69
45	苗云生	有限合伙人	100.00	1.69
46	金成玉	有限合伙人	100.00	1.69
47	张纬	有限合伙人	100.00	1.69
48	高凤亦	有限合伙人	100.00	1.69
49	夏钢	有限合伙人	100.00	1.69
50	王乐宇	有限合伙人	100.00	1.69
合计			5,908.00	100.00

(7) 朗玛九十二号

企业名称	朗玛九十二号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5HRC0H06

执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	6,307 万元人民币
实缴出资额	6,307 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023 年 3 月 28 日
注册地址/主要生产经营地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 102
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日，朗玛九十二号的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	100.00	1.59
2	黄跃	有限合伙人	500.00	7.93
3	张婷	有限合伙人	300.00	4.76
4	周继权	有限合伙人	300.00	4.76
5	刘逸虹	有限合伙人	200.00	3.17
6	林华露澈	有限合伙人	200.00	3.17
7	赵雅齐	有限合伙人	170.00	2.70
8	孙强	有限合伙人	150.00	2.38
9	李红霞	有限合伙人	142.00	2.25
10	茱淑萍	有限合伙人	139.00	2.20
11	李亚茹	有限合伙人	130.00	2.06
12	毕正中	有限合伙人	130.00	2.06
13	魏宝耀	有限合伙人	115.00	1.82
14	张立	有限合伙人	110.00	1.74
15	高菲菲	有限合伙人	110.00	1.74
16	马丽霞	有限合伙人	110.00	1.74
17	许晓凤	有限合伙人	101.00	1.60

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
18	夏向彬	有限合伙人	100.00	1.59
19	蒋珊	有限合伙人	100.00	1.59
20	尹海月	有限合伙人	100.00	1.59
21	刘晶	有限合伙人	100.00	1.59
22	叶惠媛	有限合伙人	100.00	1.59
23	吴燕红	有限合伙人	100.00	1.59
24	刘梦琪	有限合伙人	100.00	1.59
25	侯向阳	有限合伙人	100.00	1.59
26	顾晋华	有限合伙人	100.00	1.59
27	唐卫	有限合伙人	100.00	1.59
28	刘颖	有限合伙人	100.00	1.59
29	冯志跃	有限合伙人	100.00	1.59
30	马庆平	有限合伙人	100.00	1.59
31	董卫彬	有限合伙人	100.00	1.59
32	赵阳	有限合伙人	100.00	1.59
33	于丽娟	有限合伙人	100.00	1.59
34	司徒海斌	有限合伙人	100.00	1.59
35	高娟	有限合伙人	100.00	1.59
36	付宇	有限合伙人	100.00	1.59
37	曹桂海	有限合伙人	100.00	1.59
38	洪雁	有限合伙人	100.00	1.59
39	熊珍	有限合伙人	100.00	1.59
40	水生伟	有限合伙人	100.00	1.59
41	常瑞倩	有限合伙人	100.00	1.59
42	梁维娜	有限合伙人	100.00	1.59
43	刘华京	有限合伙人	100.00	1.59
44	纪威	有限合伙人	100.00	1.59
45	龚海峰	有限合伙人	100.00	1.59

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
46	姚艺	有限合伙人	100.00	1.59
47	巢宇辉	有限合伙人	100.00	1.59
48	韩博宇	有限合伙人	100.00	1.59
49	雷铁	有限合伙人	100.00	1.59
50	孙鹏晰	有限合伙人	100.00	1.59
合计			6,307.00	100.00

(8) 朗玛十九号

企业名称	朗玛十九号(深圳)创业投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5FF83R39
执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	6,869 万元人民币
实缴出资额	6,869 万元人民币
企业类型	有限合伙
成立日期	2019 年 1 月 3 日
注册地址/主要生产经营地	深圳市前海深港合作区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 101
经营范围	创业投资业务; 创业投资咨询业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资, 与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日, 朗玛十九号的出资结构如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	565.00	8.23
2	徐姗	有限合伙人	621.00	9.04
3	常瑞倩	有限合伙人	310.00	4.51
4	王智	有限合伙人	300.00	4.37
5	王云峰	有限合伙人	260.00	3.79
6	高文茹	有限合伙人	200.00	2.91
7	王小平	有限合伙人	200.00	2.91
8	陈宝增	有限合伙人	150.00	2.18

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
9	齐宝英	有限合伙人	150.00	2.18
10	刘海峰	有限合伙人	140.00	2.04
11	卢玉芬	有限合伙人	122.00	1.78
12	马庆年	有限合伙人	118.00	1.72
13	任静	有限合伙人	110.00	1.60
14	刘翠平	有限合伙人	110.00	1.60
15	蒋晓荣	有限合伙人	110.00	1.60
16	李艳	有限合伙人	103.00	1.50
17	朱乐明	有限合伙人	100.00	1.46
18	刘红	有限合伙人	100.00	1.46
19	俞凌梅	有限合伙人	100.00	1.46
20	李军	有限合伙人	100.00	1.46
21	夏亮	有限合伙人	100.00	1.46
22	马晓琴	有限合伙人	100.00	1.46
23	邹高洪	有限合伙人	100.00	1.46
24	韩博宇	有限合伙人	100.00	1.46
25	杨少鸿	有限合伙人	100.00	1.46
26	佐静	有限合伙人	100.00	1.46
27	孙洁	有限合伙人	100.00	1.46
28	高娟	有限合伙人	100.00	1.46
29	郝蕾	有限合伙人	100.00	1.46
30	牛延平	有限合伙人	100.00	1.46
31	吴杰	有限合伙人	100.00	1.46
32	钱继纲	有限合伙人	100.00	1.46
33	高彩雯	有限合伙人	100.00	1.46
34	程百荣	有限合伙人	100.00	1.46
35	李迪	有限合伙人	100.00	1.46
36	于然华	有限合伙人	100.00	1.46

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
37	张军	有限合伙人	100.00	1.46
38	官正学	有限合伙人	100.00	1.46
39	白月春	有限合伙人	100.00	1.46
40	高秀英	有限合伙人	100.00	1.46
41	马耀平	有限合伙人	100.00	1.46
42	苗丽萍	有限合伙人	100.00	1.46
43	吴玲玲	有限合伙人	100.00	1.46
44	孙鹏晰	有限合伙人	100.00	1.46
45	赵玉华	有限合伙人	100.00	1.46
46	崔进辉	有限合伙人	100.00	1.46
47	肖春梅	有限合伙人	100.00	1.46
48	付琨	有限合伙人	100.00	1.46
49	郭晓路	有限合伙人	100.00	1.46
合计			6,869.00	100.00

(9) 朗玛八十七号

企业名称	朗玛八十七号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5HLMW428
执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	5,822 万元人民币
实缴出资额	5,822 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2022 年 12 月 13 日
注册地址/主要生产经营地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 102
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资,与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日,朗玛八十七号的出资结构如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	100.00	1.72
2	赵海容	有限合伙人	230.00	3.95
3	张如彬	有限合伙人	200.00	3.44
4	彭德成	有限合伙人	200.00	3.44
5	刘晓杰	有限合伙人	200.00	3.44
6	虞欣	有限合伙人	190.00	3.26
7	田炜	有限合伙人	160.00	2.75
8	石慧	有限合伙人	150.00	2.58
9	李传斌	有限合伙人	140.00	2.40
10	张凤英	有限合伙人	135.00	2.32
11	金晔	有限合伙人	130.00	2.23
12	覃秀丽	有限合伙人	130.00	2.23
13	梁芳	有限合伙人	120.00	2.06
14	罗耀平	有限合伙人	120.00	2.06
15	赵凯	有限合伙人	110.00	1.89
16	董赞	有限合伙人	105.00	1.80
17	金玉清	有限合伙人	102.00	1.75
18	杨宝清	有限合伙人	100.00	1.72
19	张占利	有限合伙人	100.00	1.72
20	陈静	有限合伙人	100.00	1.72
21	吕婧	有限合伙人	100.00	1.72
22	王辉	有限合伙人	100.00	1.72
23	李春梅	有限合伙人	100.00	1.72
24	袁燕林	有限合伙人	100.00	1.72
25	张燕楠	有限合伙人	100.00	1.72
26	胡雪姣	有限合伙人	100.00	1.72
27	茹占军	有限合伙人	100.00	1.72
28	蒋薇	有限合伙人	100.00	1.72

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
29	马庆平	有限合伙人	100.00	1.72
30	丁淑琴	有限合伙人	100.00	1.72
31	曹晓玲	有限合伙人	100.00	1.72
32	姚冰	有限合伙人	100.00	1.72
33	陈淑凤	有限合伙人	100.00	1.72
34	梁雪	有限合伙人	100.00	1.72
35	安建东	有限合伙人	100.00	1.72
36	刘静	有限合伙人	100.00	1.72
37	刘妍君	有限合伙人	100.00	1.72
38	赵翠	有限合伙人	100.00	1.72
39	余凡娟	有限合伙人	100.00	1.72
40	张明花	有限合伙人	100.00	1.72
41	张立国	有限合伙人	100.00	1.72
42	杨幼瑛	有限合伙人	100.00	1.72
43	陈捍东	有限合伙人	100.00	1.72
44	雒玉梅	有限合伙人	100.00	1.72
45	王学萍	有限合伙人	100.00	1.72
46	姚凤革	有限合伙人	100.00	1.72
47	王蔚红	有限合伙人	100.00	1.72
48	李红梅	有限合伙人	100.00	1.72
49	张琴	有限合伙人	100.00	1.72
50	孙颖	有限合伙人	100.00	1.72
合计			5,822.00	100.00

(10) 朗玛二十一

企业名称	朗玛二十一(深圳)创业投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5FFQXTX2
执行事务合伙人	朗玛峰创业投资有限公司
认缴出资额	6,693 万元人民币

实缴出资额	6,693 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019 年 1 月 16 日
注册地址/主要生产经营地	深圳市前海深港合作区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 101
经营范围	创业投资；创业投资业务；创业投资咨询业务；（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日，朗玛二十一的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	朗玛峰创业投资有限公司	普通合伙人	100.00	1.49
2	刘国斌	有限合伙人	330.00	4.93
3	唐景海	有限合伙人	300.00	4.48
4	李秀兰	有限合伙人	280.00	4.18
5	安娜	有限合伙人	220.00	3.29
6	张同强	有限合伙人	200.00	2.99
7	房桂艳	有限合伙人	200.00	2.99
8	李川	有限合伙人	200.00	2.99
9	李曦	有限合伙人	200.00	2.99
10	唐悦	有限合伙人	200.00	2.99
11	沈美芳	有限合伙人	200.00	2.99
12	谢荣	有限合伙人	150.00	2.24
13	吴智广	有限合伙人	150.00	2.24
14	匡燕彬	有限合伙人	140.00	2.09
15	张立铭	有限合伙人	130.00	1.94
16	刘永勤	有限合伙人	130.00	1.94
17	陈华	有限合伙人	130.00	1.94
18	任芳笛	有限合伙人	125.00	1.87
19	张风荣	有限合伙人	120.00	1.79
20	王亦卫	有限合伙人	120.00	1.79

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
21	尹兰芳	有限合伙人	120.00	1.79
22	石锁印	有限合伙人	110.00	1.64
23	刘小明	有限合伙人	110.00	1.64
24	邱伟	有限合伙人	110.00	1.64
25	吴晓英	有限合伙人	110.00	1.64
26	董杰	有限合伙人	106.00	1.58
27	张小平	有限合伙人	102.00	1.52
28	胡增科	有限合伙人	100.00	1.49
29	付春华	有限合伙人	100.00	1.49
30	胡基兰	有限合伙人	100.00	1.49
31	刘沙沙	有限合伙人	100.00	1.49
32	王军	有限合伙人	100.00	1.49
33	王欢	有限合伙人	100.00	1.49
34	李慧卿	有限合伙人	100.00	1.49
35	吴建德	有限合伙人	100.00	1.49
36	陈宝增	有限合伙人	100.00	1.49
37	邓桂琴	有限合伙人	100.00	1.49
38	张旭	有限合伙人	100.00	1.49
39	白雪	有限合伙人	100.00	1.49
40	田雨文	有限合伙人	100.00	1.49
41	胡少泊	有限合伙人	100.00	1.49
42	李楠	有限合伙人	100.00	1.49
43	张文建	有限合伙人	100.00	1.49
44	徐菊娇	有限合伙人	100.00	1.49
45	顿作洲	有限合伙人	100.00	1.49
46	王秀萍	有限合伙人	100.00	1.49
47	刘小青	有限合伙人	100.00	1.49
48	王蕙	有限合伙人	100.00	1.49

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
49	于海龙	有限合伙人	100.00	1.49
50	张子健	有限合伙人	100.00	1.49
合计			6,693.00	100.00

4、武岳峰

(1) 武岳峰集成电路

企业名称	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000351127927X
执行事务合伙人	Digital Time Investment Limited
认缴出资额	10,000 万元人民币
实缴出资额	10,000 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 8 月 3 日
注册地址/主要生产经营地	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2196 室
经营范围	股权投资, 投资咨询, 投资管理, 企业管理咨询。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资, 与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日, 武岳峰集成电路的出资结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	Digital Time Investment Limited	普通合伙人	46.25	0.46
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	有限合伙人	2,775.03	27.75
3	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,662.82	26.63
4	上海创业投资有限公司	有限合伙人	1,665.02	16.65
5	Gaintech Co. Limited	有限合伙人	1,050.81	10.51
6	安徽皖信投资管理有限责任公司	有限合伙人	925.01	9.25
7	SummitView Electronic Investment L.P.	有限合伙人	320.05	3.20
8	上海张江浩成创业投资有限公司	有限合伙人	240.50	2.41
9	Shanghai (Z.J.) Holdings Limited	有限合伙人	129.50	1.30

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
10	上海张江科技创业投资有限公司	有限合伙人	92.50	0.93
11	上海张江火炬创业投资有限公司	有限合伙人	92.50	0.93
合计			10,000.00	100.00

(2) 上海驰芯

企业名称	上海驰芯企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310114MABM82HL6U
执行事务合伙人	上海荣祎企业管理有限公司
认缴出资额	7,853.7460 万元人民币
实缴出资额	7,853.7459 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2022 年 4 月 29 日
注册地址/主要生产经营地	上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 4 层 J
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日，上海驰芯的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海荣祎企业管理有限公司	普通合伙人	0.00	0.00
2	南京武岳峰亦合创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,926.61	37.26
3	上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,926.61	37.26
4	上海信煜私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,000.52	25.47
合计			7,853.75	100.00

(3) 武岳峰华矽

企业名称	常州武岳峰华矽创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320111MA26RBJQ7P
执行事务合伙人	常州武岳峰仟朗咨询合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	7,202 万元人民币
实缴出资额	7,200.10 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 8 月 11 日
注册地址/主要生产经营地	常州市武进区常武中路 18-50 号常州科教城创研港 4 号楼 603
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或者上下游关系

截至本招股说明书签署日，武岳峰华矽的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	常州武岳峰仟朗咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1.00	0.01
2	常州武岳峰仟朗半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,201.00	99.99
合计			7,202.00	100.00

九、发行人特别表决权股份或类似安排情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

十、发行人协议控制架构的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构的情况。

十一、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人 ZINING WU 不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十二、发行人股本情况

(一) 本次发行前后发行人股本情况

本次发行前，公司总股本为 430,261,427 股。本次拟发行股票数量不低于 47,806,826 股（不含因行使超额配售选择权增发的股份），本次发行后，公开发行人股数占发行后公司总股数的比例不低于 10%。若本次发行股份 47,806,826 股，本次发行前后发行人股本结构如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	开曼英韧	59,785,264	13.90	59,785,264	12.51
2	上海韧存	51,139,794	11.89	51,139,794	10.70
3	朗玛永祥	19,240,490	4.47	19,240,490	4.02
4	中电投资(SS)	18,931,088	4.40	18,931,088	3.96
5	国家集成电路二期(SS)	15,931,031	3.70	15,931,031	3.33
6	GBC	14,698,411	3.42	14,698,411	3.07
7	深圳鹏远昇	14,427,403	3.35	14,427,403	3.02
8	武岳峰集成电路	12,656,457	2.94	12,656,457	2.65
9	上海晶湖	12,125,947	2.82	12,125,947	2.54
10	交融君泓三期	11,678,499	2.71	11,678,499	2.44
11	朗玛一号	7,948,991	1.85	7,948,991	1.66
12	经纬壹号	7,861,574	1.83	7,861,574	1.64
13	国鑫投资(SS)	6,869,704	1.60	6,869,704	1.44
14	中网投	6,616,115	1.54	6,616,115	1.38
15	鄂州芯存储	6,351,471	1.48	6,351,471	1.33
16	上海驰芯	6,321,123	1.47	6,321,123	1.32
17	武岳峰华矽	5,504,144	1.28	5,504,144	1.15
18	中电发展	5,503,967	1.28	5,503,967	1.15
19	湖州龙翔	5,422,365	1.26	5,422,365	1.13
20	鼎洪广目	5,149,425	1.20	5,149,425	1.08

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
21	南京星韧	4,777,135	1.11	4,777,135	1.00
22	天府数智	4,669,374	1.09	4,669,374	0.98
23	浦东创投	4,647,606	1.08	4,647,606	0.97
24	南海成长湾科	4,599,980	1.07	4,599,980	0.96
25	海南鼎泽	4,055,175	0.94	4,055,175	0.85
26	上海联新	3,822,199	0.89	3,822,199	0.80
27	上海集成电路	3,822,199	0.89	3,822,199	0.80
28	厦门融汇	3,643,725	0.85	3,643,725	0.76
29	湖杉明芯	3,437,693	0.80	3,437,693	0.72
30	普华创投	3,437,693	0.80	3,437,693	0.72
31	交银华侨基金	3,434,855	0.80	3,434,855	0.72
32	中信金石	3,308,058	0.77	3,308,058	0.69
33	海南海鼎永和	3,039,303	0.71	3,039,303	0.64
34	SPV A1	2,982,955	0.69	2,982,955	0.62
35	上海海望	2,977,157	0.69	2,977,157	0.62
36	朗玛八十九号	2,844,228	0.66	2,844,228	0.59
37	朗玛九十号	2,810,878	0.65	2,810,878	0.59
38	腾晋天成	2,711,176	0.63	2,711,176	0.57
39	鑫安源晟	2,592,864	0.60	2,592,864	0.54
40	经纬叁号	2,451,505	0.57	2,451,505	0.51
41	朗玛九十三号	2,390,635	0.56	2,390,635	0.50
42	朗玛八十八号	2,330,599	0.54	2,330,599	0.49
43	联金创新	2,293,314	0.53	2,293,314	0.48
44	朗玛九十二号	2,277,236	0.53	2,277,236	0.48
45	磐鑫和涌	2,189,834	0.51	2,189,834	0.46
46	苏州宜仲	2,168,945	0.50	2,168,945	0.45
47	普续润鑫	2,120,145	0.49	2,120,145	0.44

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
48	华福成长(SS)	2,060,909	0.48	2,060,909	0.43
49	南京爱诺	2,056,691	0.48	2,056,691	0.43
50	深圳海鼎永和	2,024,293	0.47	2,024,293	0.42
51	红土投资	1,992,216	0.46	1,992,216	0.42
52	张江燧锋	1,984,835	0.46	1,984,835	0.42
53	上海科创有限(SS)	1,984,835	0.46	1,984,835	0.42
54	锡创聚成	1,984,835	0.46	1,984,835	0.42
55	尚融创新	1,676,211	0.39	1,676,211	0.35
56	朗玛十九号	1,626,707	0.38	1,626,707	0.34
57	福州追远	1,607,219	0.37	1,607,219	0.34
58	同创同运	1,587,868	0.37	1,587,868	0.33
59	朗玛八十七号	1,543,476	0.36	1,543,476	0.32
60	南京润信	1,528,878	0.36	1,528,878	0.32
61	山东新动能(SS)	1,528,818	0.36	1,528,818	0.32
62	杭州创徒	1,469,294	0.34	1,469,294	0.31
63	深创投(CS)	1,442,639	0.34	1,442,639	0.30
64	上海衡崢	1,409,818	0.33	1,409,818	0.29
65	夏创星火	1,375,077	0.32	1,375,077	0.29
66	云九资本	1,373,940	0.32	1,373,940	0.29
67	氢毅昕阳创投	1,373,940	0.32	1,373,940	0.29
68	超越未来	1,341,016	0.31	1,341,016	0.28
69	共青城栋晖峰	1,323,223	0.31	1,323,223	0.28
70	国泰君安证裕(CS)	1,146,660	0.27	1,146,660	0.24
71	洞鉴信创	1,107,414	0.26	1,107,414	0.23
72	晟联创投	1,084,469	0.25	1,084,469	0.23
73	海鼎景行	986,207	0.23	986,207	0.21
74	启鹭厦门	955,545	0.22	955,545	0.20

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
75	创熠爱诺	864,288	0.20	864,288	0.18
76	中叶创投	824,362	0.19	824,362	0.17
77	云涌岫阳	764,436	0.18	764,436	0.16
78	地纬华宸	764,409	0.18	764,409	0.16
79	诸暨蔚康	759,127	0.18	759,127	0.16
80	上海科创集团(SS)	714,450	0.17	714,450	0.15
81	迦明享誉	687,991	0.16	687,991	0.14
82	诚鼎创投	686,970	0.16	686,970	0.14
83	朗玛二十一	640,500	0.15	640,500	0.13
84	华鲁产投	593,435	0.14	593,435	0.12
85	济南云涌	547,598	0.13	547,598	0.11
86	衡盈芳华	542,238	0.13	542,238	0.11
87	济南云盛	252,738	0.06	252,738	0.05
88	济南云智	42,123	0.01	42,123	0.01
本次发行流通股		-	-	47,806,826	10.00
合计		430,261,427	100.0000	478,068,253	100.0000

注：SS 是 State-owned Shareholder 的缩写，表示国有股东；CS 是 Controlling State-owned Shareholder 的缩写，表示国有实际控制股东。

(二) 发行人前十名股东持股情况

本次发行前，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	开曼英韧	59,785,264	13.90
2	上海韧存	51,139,794	11.89
3	朗玛永祥	19,240,490	4.47
4	中电投资	18,931,088	4.40
5	国家集成电路二期	15,931,031	3.70
6	GBC	14,698,411	3.42

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
7	深圳鹏远昇	14,427,403	3.35
8	武岳峰集成电路	12,656,457	2.94
9	上海晶湖	12,125,947	2.82
10	交融君泓三期	11,678,499	2.71
合计		230,614,384	53.60

(三) 发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任职务的情况

截至本招股说明书签署日，发行人无自然人股东。

(四) 发行人股本中的国有股份及外资股份情况

1、国有股东

截至本招股说明书签署日，公司有9名国有股东，具体情况如下：

股东名称	股份性质	持股数量(股)	直接持股比例(%)
中电投资	SS	18,931,088	4.40
国家集成电路二期	SS	15,931,031	3.70
国鑫投资	SS	6,869,704	1.60
华福成长	SS	2,060,909	0.48
上海科创有限	SS	1,984,835	0.46
山东新动能	SS	1,528,818	0.36
深创投	CS	1,442,639	0.34
国泰君安证裕	CS	1,146,660	0.27
上海科创集团	SS	714,450	0.17
合计		50,610,134	11.76

2026年3月28日，国务院国有资产监督管理委员会出具《国务院国资委关于英韧科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》，同意对公司前述9名国有股东证券账户进行相应标注。

2、外资股东

截至本招股说明书签署日，发行人外资股东包括开曼英韧、GBC、SPV A1，其持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	直接持股比例(%)
1	开曼英韧	59,785,264	13.90
2	GBC	14,698,411	3.42
3	SPV A1	2,982,955	0.69
合计		77,466,630	18.00

(五) 发行人申报前十二个月新增股东的相关情况

1、新增股东的入股原因、入股价格及定价依据

申报前 12 个月，发行人新增股东的具体情况如下：

序号	新增股东名称	入股情况	入股价格	入股时间	入股原因	定价依据
1	共青城栋晖峰	认购新增股份 1,323,223 股	15.11 元/股	2025.08	看好公司发展， 参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定
2	鄂州芯存储	认购新增股份 6,351,471 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展， 参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定
3	张江燧锋	认购新增股份 1,984,835 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展， 参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定
4	南海成长湾科	认购新增股份 3,175,735 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展， 参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定
		自天津镭英、 伊敦传媒受让 1,424,245 股	天津镭英： 13.08 元/股 伊敦传媒： 12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
5	同创同运	认购新增股份 1,587,868 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展， 参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定
6	湖杉明芯	认购新增股份 2,646,446 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展， 参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定
		自天津镭英、 伊敦传媒受让 791,247 股	天津镭英： 13.08 元/股 伊敦传媒： 12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
7	中网投	认购新增股份 6,616,115 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展， 参与公司融资	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
8	普华创投	认购新增股份 2,646,446 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展， 参与公司融资	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定

序号	新增股东名称	入股情况	入股价格	入股时间	入股原因	定价依据
		自天津镭英、伊敦传媒受让 791,247 股	天津镭英：13.08 元/股 伊敦传媒：12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
9	上海科创有限	认购新增股份 1,984,835 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展，参与公司融资	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
10	夏创星火	认购新增股份 1,058,578 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展，参与公司融资	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
		自天津镭英、伊敦传媒受让 316,499 股	天津镭英：13.08 元/股 伊敦传媒：12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
11	中信金石	认购新增股份 3,308,058 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展，参与公司融资	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
12	朗玛永祥	认购新增股份 6,616,115 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展，参与公司融资	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
		认购新增股份 2,381,800 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展，参与公司融资	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
		自武岳峰高科、融汇阳光受让 6,120,407 股	武岳峰高科：12.35 元/股 融汇阳光：12.35 元/股、13.08 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
		自天津镭英、伊敦传媒受让 4,122,168 股	天津镭英：13.08 元/股 伊敦传媒：12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
13	经纬壹号	认购新增股份 6,052,091 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展，参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定
		自融汇阳光、天津镭英、伊敦传媒受让 1,809,483 股	融汇阳光：12.35 元/股、13.08 元/股 天津镭英：13.08 元/股 伊敦传媒：12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
14	经纬叁号	认购新增股份 1,887,247 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展，参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定
		自天津镭英、伊敦传媒受让 564,258 股	天津镭英：13.08 元/股 伊敦传媒：12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等，协商确定
15	锡创聚成	认购新增股份 1,984,835 股	15.11 元/股	2025.09	看好公司发展，参与公司融资	参考公司经营情况、同行业估值水平等，经各方协商确定

序号	新增股东名称	入股情况	入股价格	入股时间	入股原因	定价依据
16	济南云盛	自嘉远资本受让 252,738 股	11.87 元/股	2025.10	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
17	济南云涌	自嘉远资本受让 547,598 股	11.87 元/股	2025.10	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
18	济南云智	自嘉远资本受让 42,123 股	11.87 元/股	2025.10	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
19	深圳海鼎永和	自福州追远、天津镭英、嘉远资本受让 2,024,293 股	福州追远: 12.35 元/股 天津镭英: 13.08 元/股 嘉远资本: 11.50 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
20	超越未来	自嘉远资本受让 1,341,016 股	12.84 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
21	华鲁产投	自天津镭英、伊敦传媒受让 593,435 股	天津镭英: 13.08 元/股 伊敦传媒: 12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
22	山东新动能	自天津镭英受让 1,528,818 股	13.08 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
23	地纬华宸	自天津镭英受让 764,409 股	13.08 元/股	2025.10	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
24	朗玛一号	自武岳峰高科、武岳峰集成电路、中金文化消费受让 7,948,991 股	武岳峰高科、武岳峰集成电路: 12.35 元/股 中金文化消费: 13.08 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
25	厦门融汇	自融汇阳光受让 3,643,725 股	12.35 元/股	2025.11	看好公司发展	参考公司融资价格、转让方成本价格等, 协商确定
26	中电投资	自中电通商处受让 18,931,088 股	3.65 元/股	2025.11	中电通商系中电投资全资子公司, 系基于中电投资内部管理要求, 变更持股主体	经中国电子信息产业集团有限公司批复, 根据投资成本确定(不低于经审计的净资产值)

综上, 上述申报前 12 个月新增股东的入股原因及定价依据具有合理性。

2、新增股东的基本情况

发行人申报前 12 个月新增股东的基本情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、发行人申报前十二个月新增股东基本情况”。

3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系

新增股东之间、新增股东与其他股东之间的关联关系参见本节之“十二、发行人股本情况”之“(六)本次发行前各股东间的一致行动关系、关联关系”。

发行人董事陈冲系新增股东中电投资员工，除前述情形外，发行人新增股东与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系

截至本招股说明书签署日，国泰海通的全资子公司国泰君安证裕直接持有发行人 0.27% 的股份，国泰海通的控股股东上海国际集团有限公司的全资子公司国鑫投资直接持有发行人 1.60% 的股份。此外，国泰海通及其控股股东上海国际集团有限公司存在因投资其他机构导致被动间接持有发行人股份的情况，间接持股比例合计不超过 1%。

除上述情形外，申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他关联关系。

5、新增股东是否存在股份代持情形

截至本招股说明书签署日，申报前十二个月新增股东不存在股份代持情形。

(六) 本次发行前各股东间的一致行动关系、关联关系

截至本招股说明书签署日，本次发行前各股东间主要的一致行动关系、关联关系及关联股东各自持股比例如下表所示：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	关联关系、一致行动关系
1	开曼英韧	59,785,264	13.90	开曼英韧与上海韧存均为 ZINING WU 实际控制的企业。
	上海韧存	51,139,794	11.89	
2	朗玛永祥	19,240,490	4.47	朗玛永祥、朗玛一号、朗玛八十九号、朗玛九十号、朗玛九十三号、朗玛八十八号、朗玛九十二号、朗玛十九号、朗玛八十七号、朗玛二十一均为同一主体实际控制的企业。
	朗玛一号	7,948,991	1.85	
	朗玛八十九号	2,844,228	0.66	
	朗玛九十号	2,810,878	0.65	

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	关联关系、一致行动关系
	朗玛九十三号	2,390,635	0.56	
	朗玛八十八号	2,330,599	0.54	
	朗玛九十二号	2,277,236	0.53	
	朗玛十九号	1,626,707	0.38	
	朗玛八十七号	1,543,476	0.36	
	朗玛二十一	640,500	0.15	
3	武岳峰集成电路	12,656,457	2.94	武岳峰集成电路、上海驰芯、武岳峰华矽之间存在一致行动关系。
	上海驰芯	6,321,123	1.47	
	武岳峰华矽	5,504,144	1.28	
4	交融君泓三期	11,678,499	2.71	交融君泓三期、交银华侨基金的执行事务合伙人均为交银资本管理有限公司。
	交银华侨基金	3,434,855	0.80	
5	经纬壹号	7,861,574	1.83	经纬壹号、经纬叁号的执行事务合伙人均为南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)。
	经纬叁号	2,451,505	0.57	
6	鼎洪广目	5,149,425	1.20	鼎洪广目、海南鼎泽的执行事务合伙人均为深圳市招银鼎洪投资管理有限公司。
	海南鼎泽	4,055,175	0.94	
7	国泰君安证裕	1,146,660	0.27	国泰君安证裕持有中电发展24.24%财产份额。
	中电发展	5,503,967	1.28	
8	中电发展	5,503,967	1.28	鑫安源晟的执行事务合伙人为鑫安资本有限责任公司,其持有中电发展执行事务合伙人中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司40%股权。
	鑫安源晟	2,592,864	0.60	
9	南海成长湾科	3,175,735	1.07	南海成长湾科、同创同运的执行事务合伙人均为深圳同创锦绣资产管理有限公司。
	同创同运	1,587,868	0.37	
10	海南海鼎永和	3,039,303	0.71	海南海鼎永和、深圳海鼎永和、海鼎景行的执行事务合伙人均为海鼎私募基金管理(海南)有限公司。
	深圳海鼎永和	2,024,293	0.47	
	海鼎景行	986,207	0.23	
11	红土投资	1,992,216	0.46	红土投资的执行事务合伙人为安徽红土创业投资管理有限公司,其与深创投均为深圳市创新投资集团有限公司直接或间接持有100%股权的企业。
	深创投	1,442,639	0.34	
12	联金创新	2,293,314	0.53	启鹭厦门的执行事务合伙人中金资

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	关联关系、一致行动关系
	启鹭厦门	955,545	0.22	本运营有限公司持有联金创新的执行事务合伙人联金私募股权创业投资基金管理(深圳)有限公司51%股权。
13	南京爱诺	2,056,691	0.48	南京爱诺、创熠爱诺的执行事务合伙人均为南京丰诺科技咨询有限公司。
	创熠爱诺	864,288	0.20	
14	上海科创有限	1,984,835	0.46	上海科创有限系上海科创集团有限公司全资子公司。
	上海科创集团	714,450	0.17	
15	上海科创集团	714,450	0.17	上海科创集团持有上海集成电路30.70%股权。
	上海集成电路	3,822,199	0.89	
16	锡创聚成	1,984,835	0.46	锡创聚成的执行事务合伙人为上海弘信股权投资基金管理有限公司,其持有华鲁产投执行事务合伙人上海华鲁弘信私募基金管理有限公司40%股权。
	华鲁产投	593,435	0.14	
17	上海衡峥	1,409,818	0.33	上海衡峥的执行事务合伙人上海向风投资管理有限公司、衡盈芳华的执行事务合伙人上海衡盈屹盛资产管理有限公司,均为上海衡盈资产管理有限公司的控股子公司。
	衡盈芳华	542,238	0.13	
18	济南云涌	547,598	0.13	济南云盛、济南云涌的执行事务合伙人云涌(济南)产业投资有限公司及济南云智的执行事务合伙人山东浪潮投资管理有限公司均为山东浪潮产业投资有限公司的控股子公司。
	济南云盛	252,738	0.06	
	济南云智	42,123	0.01	
19	浦东创投	4,647,606	1.08	浦东创投持有张江燧锋24.97%财产份额。
	张江燧锋	1,984,835	0.46	

(七) 公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情形。

(八) 特殊权利条款的内容及终止情况

1、发行人回购义务的终止情况

2023年9月15日,英韧有限与英韧有限当时的全体股东签署《公司回购义务终止合同》,约定英韧有限承担的相关回购股权义务不可撤销地终止,并自始无效。

2、股东协议约定的特殊权利条款及清理情况

发行人与全体股东于 2025 年 12 月 31 日签署了《英韧科技股份有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议（2025 年 12 月）》”），约定任何股东之间所达成的口头或书面意向、协议、备忘录和沟通记录，包括但不限于原股东协议，公司、创始人（ZINING WU）及各轮投资人之间签署的增资协议、增资协议补充协议等全部相关协议以及其他相关文件项下关于本协议项下约定的股东权利的条款（如有），应不再具有法律效力并由《股东协议（2025 年 12 月）》及其附件完全替代。

《股东协议（2025 年 12 月）》约定了股份转让限制、优先购买权、共同出售权、拟转让股份的转让、优先认购权、反稀释、分红权、知情权、清算优先权、回购权（由实际控制人承担回购责任）、最优惠待遇等股东特殊权利条款，公司部分现有股东享有股东特殊权利。

2026 年 3 月，发行人与全体股东签署《英韧科技股份有限公司股东协议补充协议》（以下简称“《股东协议补充协议》”），对《股东协议（2025 年 12 月）》约定的股东特殊权利主要约定如下：

（1）各方同意，《股东协议（2025 年 12 月）》于公司首次向境内证券交易所（指上海证券交易所、深圳证券交易所或者其他根据《股东协议（2025 年 12 月）》约定的程序批准的境内股票交易市场，全国中小企业股份转让系统除外，下同）递交的上市申报材料被受理之日终止。《股东协议（2025 年 12 月）》终止后，投资人所享有的股东权利自动适用届时有效的公司章程的约定以及相关适用规则中的规定。

（2）如发生以下任一情形（以较早发生的日期为准），则《股东协议（2025 年 12 月）》自动恢复至本补充协议签署前的状态，视同本补充协议从未签署：

（一）公司未能于 2026 年 12 月 31 日前或当日完成在境内证券交易所提交上市申报；（二）公司的上市申请未被受理；（三）公司的上市申请被撤回；（四）公司的上市申请被有权证券监管机构终止审核、审核未通过或不予注册；（五）有权证券监管机构向公司核发的本次发行上市批文/注册文件失效。

3、创始人与投资人约定的其他特殊权利条款及清理情况

除股东协议约定的特殊权利条款外，发行人部分股东在投资公司时，与 ZINING WU 签订的《强制售股权协议》（以下合称“《各轮强制售股权协议》”）中存在强制售股权等股东特殊权利。

《股东协议补充协议》对《各轮强制售股权协议》约定的股东特殊权利主要约定如下：

（1）各方同意，《各轮强制售股权协议》于公司首次向境内证券交易所递交的上市申报材料被受理之日终止。

（2）如发生以下任一情形（以较早发生的日期为准），则《各轮强制售股权协议》自动恢复至本补充协议签署前的状态，视同本补充协议从未签署：（一）公司未能在 2026 年 12 月 31 日前或当日完成在境内证券交易所提交上市申报；

（二）公司的上市申请未被受理；（三）公司的上市申请被撤回；（四）公司的上市申请被有权证券监管机构终止审核、审核未通过或不予注册；（五）有权证券监管机构向公司核发的本次发行上市批文/注册文件失效。

综上，发行人部分现有股东享有股东特殊权利，相关股东特殊权利条款将在发行人首次向境内证券交易所递交的上市申报材料被受理之日起终止；在发行人首次向境内证券交易所递交的上市申报材料被受理之日，发行人未作为对赌协议当事人，对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，对赌协议未与发行人市值挂钩，对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

（九）发行人股东中涉及私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，公司股东共计 88 名，其中 65 名股东按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》的规定履行了私募基金备案程序，具体情况如下：

序号	名称	基金备案编号	基金管理人名称	基金管理人登记编号
1	海南鼎泽	SZU011	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司	P1063345
2	鼎洪广目	SGY507	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司	P1063345

序号	名称	基金备案编号	基金管理人名称	基金管理人登记编号
3	南京爱诺	STQ747	爱诺投资管理(南京)有限公司	P1069767
4	福州追远	SN5576	北京追远创业投资有限公司	P1021019
5	武岳峰集成电路	SE3644	仟品(上海)股权投资管理有限公司	P1029450
6	创熠爱诺	SJD621	爱诺投资管理(南京)有限公司	P1069767
7	杭州创徒	SS9219	上海创徒投资管理有限公司	P1032434
8	湖州龙翔	SJZ678	北京中财龙马资本投资有限公司	P1005328
9	朗玛十九号	SGZ059	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
10	朗玛二十一	SJF370	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
11	腾晋天成	SJM060	深圳腾晋投资基金管理有限公司	P1063396
12	上海衡峥	SX1876	上海衡盈屹盛资产管理有限公司	P1001371
13	衡盈芳华	SET267	上海衡盈屹盛资产管理有限公司	P1001371
14	海南海鼎永和	SZU074	海鼎私募基金管理(海南)有限公司	P1072579
15	晟联创投	SEE481	泉州市七晟创业投资有限公司	P1068245
16	苏州宜仲	SEK016	苏州维特力新创业投资管理有限公司	P1032365
17	普续润鑫	SLX948	诸暨同君投资管理有限公司	P1064092
18	尚融创新	SGV057	尚融资本管理有限公司	P1028564
19	中电发展	SJJ698	中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司	P1068911
20	上海联新	SND827	上海联新资本管理有限公司	P1060771
21	上海海望	SNJ333	上海浦东海望私募基金管理有限公司	P1072004
22	迦明享誉	SQM578	杭州迦明资产管理有限公司	P1062046
23	云涌岫阳	SQP955	宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司	P1064802
24	上海集成电路	SEJ523	上海集成电路产业投资基金管理有限公司	P1068675
25	联金创新	SGT377	联金私募股权创业投资基金管理(深圳)有限公司	GC2600031589
26	南京润信	SQT187	中信建投资本管理有限公司	GC2600011623
27	国家集成电路二期	SJU890	华芯投资管理有限责任公司	P1009674
28	交融君泓三期	SAFC54	交银资本管理有限公司	P1070925
29	交银华侨基金	STS087	交银资本管理有限公司	P1070925

序号	名称	基金备案编号	基金管理人名称	基金管理人登记编号
30	云九资本	SVH557	上海云涌投资管理有限公司	P1070500
31	洞鉴信创	SABY08	上海洞鉴私募基金管理有限公司	P1071747
32	氢毅昕阳创投	SST536	深圳前海春阳资产管理有限公司	P1008852
33	诚鼎创投	SB3470	上海诚鼎创富投资管理有限公司	P1009373
34	深创投	SD2403	深圳市创新资本投资有限公司	P1000980
35	红土投资	SNK851	安徽红土创业投资管理有限公司	P1010710
36	中叶创投	SJL465	上海中叶创业投资管理有限公司	P1074035
37	朗玛八十七号	SZP728	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
38	朗玛八十八号	SZU890	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
39	朗玛八十九号	SZU894	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
40	朗玛九十号	SB0587	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
41	朗玛九十二号	SB6999	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
42	朗玛九十三号	SB7000	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
43	天府数智	SANE60	华泰紫金投资有限责任公司	PT2600011618
44	浦东创投	SGN932	上海浦东私募基金管理有限公司	P1061819
45	海鼎景行	SATH66	海鼎私募基金管理(海南)有限公司	P1072579
46	鄂州芯存储	SATQ57	湖北国翼投资管理有限公司	P1069652
47	张江燧锋	SALF46	上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	P1070658
48	南海成长湾科	STV656	深圳同创锦绣资产管理有限公司	P1010186
49	同创同运	STA705	深圳同创锦绣资产管理有限公司	P1010186
50	湖杉明芯	SXT312	上海湖杉投资管理有限公司	P1020294
51	中网投	SS8838	中国互联网投资基金管理有限公司	P1060330
52	普华创投	SAPC19	浙江普华天勤股权投资管理有限公司	P1002055
53	夏创星火	SB6951	湖北夏创创业投资管理有限公司	P1073643
54	中信金石	SB7480	中信金石投资有限公司	PT2600030645
55	朗玛永祥	SCX739	北京朗玛峰创业投资管理有限公司	P1001707
56	经纬壹号	SQQ064	上海旌卓投资管理有限公司	P1019378
57	经纬叁号	SSF141	上海旌卓投资管理有限公司	P1019378

序号	名称	基金备案编号	基金管理人名称	基金管理人登记编号
58	锡创聚成	SZA372	上海弘信股权投资基金管理有限公司	P1000542
59	济南云智	SAAR81	山东浪潮投资管理有限公司	P1060743
60	深圳海鼎永和	SBGK17	海鼎私募基金管理(海南)有限公司	P1072579
61	超越未来	S09587	海南超越创业投资有限公司	P1074420
62	华鲁产投	SAHW85	上海华鲁弘信私募基金管理有限公司	P1074749
63	地纬华宸	STE607	山东华宸股权投资管理有限公司	P1029961
64	朗玛一号	SANS93	朗玛峰创业投资有限公司	P1064801
65	厦门融汇	STS300	阳光融汇资本投资管理有限公司	P1009409

十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

截至本招股说明书签署日,发行人的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的的基本情况如下:

(一) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

1、董事会成员

公司董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名。董事会成员构成、提名人及任期情况如下:

姓名	职位	提名人	任期
ZINING WU	董事长	开曼英韧	2023.10 至 2026.10
吴一亮	董事	上海驰芯	2023.10 至 2026.10
于力	董事	GBC	2023.10 至 2026.10
陈冲	董事	中电通商	2025.08 至 2026.10
陈杰	董事、副总经理	开曼英韧	2023.10 至 2026.10
刘刚	董事、总经理	开曼英韧	2023.10 至 2026.10
JUN WU	董事	开曼英韧	2023.10 至 2026.10
魏晨阳	独立董事	开曼英韧	2023.10 至 2026.10
陈菁	独立董事	开曼英韧	2025.12 至 2026.10
HAO XU	独立董事	开曼英韧	2023.10 至 2026.10
陈志武	独立董事	开曼英韧	2023.10 至 2026.10

ZINING WU, 男, 1972年3月出生, 美国国籍, 博士研究生学历, 本科毕业于清华大学电子工程专业, 硕士及博士研究生毕业于斯坦福大学电子工程专业。1999年7月至2016年9月, 历任 Marvell Technology, Inc 工程师、总监、副总裁、首席技术官; 2017年6月至今, 创立发行人, 历任发行人总经理、董事长。

吴一亮, 男, 1981年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 毕业于北京航空航天大学电子信息工程专业。2003年9月至2005年9月, 任青岛海信营销有限公司业务经理; 2005年12月至2010年10月, 任硅谷数模半导体(北京)有限公司高级销售经理; 2010年10月至2015年3月, 任新诺普思科技(北京)有限公司产品销售经理; 2015年3月至2015年12月, 任上海盈方微电子有限公司销售总监; 2015年12月至今, 任北京武岳峰中清正合科技创业投资管理有限公司合伙人; 2023年10月至今, 任发行人董事。

于力, 女, 1971年1月出生, 中国国籍, 拥有境外永久居留权, 硕士研究生学历, 毕业于圣路易斯华盛顿大学工商管理专业。1993年6月至1995年3月, 任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)SA; 1995年3月至1997年6月, 任新恒基国际物业管理有限公司(北京办事处)Finance Manager; 1997年6月至1999年6月, 任 Walker Interactive System Application Manager; 2001年6月至2002年6月, 任 Cisco Systems Analyst; 2002年6月至2004年5月, 任 Merrill Lynch Analyst; 2004年5月至2009年3月, 任 Du Pont China Holding Co., Ltd. 兼并收购负责人; 2009年3月至2014年12月, 任 Bertelsmann China Holding GmbH 财务法务政府关系及业务发展负责人; 2014年12月至2017年11月, 任北京贝利农垦饲料有限公司合伙人; 2017年11月至今, 任 GBC Fund Management, LLC 董事总经理; 2021年10月至今, 任发行人董事。

陈冲, 女, 1983年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 毕业于北京大学法学专业。2007年7月至2011年10月, 任北京市海淀区私立新东方学校会计; 2011年10月至2014年5月, 任富恩德(北京)粮食产业投资基金管理有限公司财务部经理; 2014年5月至2016年3月, 任中国电子投资控股有限公司风险法律部高级经理; 2016年4月至2018年5月, 任中电鑫安投资管理有限责任公司风险法律部高级经理; 2018年6月至2025年3月, 任中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司风控总监; 2025年4月至今, 任中

国电子投资控股有限公司业务管理部经理；2025年8月至今，任发行人董事。

陈杰，男，1979年8月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于美国明尼苏达大学双城分校电子工程专业。2008年8月至2016年12月，任Marvell Semiconductor, Inc资深芯片设计研发经理；2017年6月至今，历任发行人数据存储技术副总裁、副总经理、董事。

刘刚，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京工商大学法学专业。1997年7月至2012年7月，任北京市海淀区人民法院审判员；2012年7月至2022年1月，任北京颐合中鸿律师事务所高级合伙人；2022年1月至今，历任发行人法务副总裁、总经理、董事。

JUN WU，男，1967年4月出生，美国国籍，博士研究生学历，毕业于约翰霍普金斯大学计算机专业。1989年6月至1991年9月，任中国教育电子有限责任公司(曾用名：中国教育电子公司)工程师；1991年9月至1993年6月，就读于清华大学；1993年6月至1996年8月，任清华大学讲师；1996年8月至2002年5月，就读于约翰霍普金斯大学；2002年5月至2010年3月，任Google Inc资深研究员；2010年3月至2012年4月，任深圳市腾讯计算机系统有限公司副总裁；2012年4月至2014年6月，任Google Inc高级资深研究员；2014年6月至2016年8月，任Amino Capital Management Company LLC 创始合伙人、顾问；2017年5月至2023年3月，任中信出版集团股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任驭势科技(北京)股份有限公司董事；2020年3月至今，任发行人董事。

魏晨阳，男，1973年1月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于美国纽约大学斯特恩商学院金融专业。2006年6月至2011年6月，任Federal Reserve Bank of New York(美国纽约联邦储备银行)经济学家；2011年6月至2012年8月，任Federal Reserve Bank of Philadelphia(美国费城联邦储备银行)高级经济学家；2012年8月至2016年12月，任American International Group(美国国际集团)信用研究部主任；2016年12月至2019年3月，任Zenity Asset Management 高级董事总经理；2019年3月至今，任清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心主任；2021年5月至今，任Waterdrop Inc. 独立董事；2021年11月至今，任北京金融科技研究院副院长；2023年1月至今，任

汇丰人寿保险有限公司、中国人民财产保险股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任发行人独立董事。

陈菁，女，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于厦门大学会计学专业。2015年9月至2019年2月，任厦门大学国际学院助理教授，2019年2月至2025年12月，历任江西师范大学经济与管理学院副教授、教授；2025年6月至今，任天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任汕头大学商学院教授；2025年12月至今，任发行人独立董事。

HAO XU，男，1971年6月出生，美国国籍，博士研究生学历，毕业于斯坦福大学电气工程专业。2000年3月至2002年10月，任Lightwave Microsystem, USA Design Engineer；2002年10月至2008年8月，任NeoPhotonics Corp, USA PE、PM；2008年8月至2016年3月，任NeoPhotonics Corp China, China Senior Director, VP；2016年3月至2022年8月，任NeoPhotonics Corp, USA Senior Director；2022年8月至2024年5月，任Lumentum Inc, USA Senior Director PLM；2023年10月至今，任发行人独立董事。

陈志武，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国人民大学民商法学专业。1991年8月至1998年9月，任陕西省西安市中级人民法院书记员、助理审判员；1998年9月至2005年7月，就读于中国人民大学；2003年8月至2004年5月，就读于哥伦比亚大学；2004年8月至2004年11月，任美国纽约曼哈顿律师事务所律师；2005年8月至今，任北京国家会计学院教师、副教授；2006年5月至2008年11月，任北京市诚华律师事务所兼职律师；2018年1月至今，任中国大连高级经理学院特聘教授；2018年5月至今，任天津低碳发展与绿色供应链管理服务中心有限公司董事；2008年12月至今，任北京市中洲律师事务所兼职律师；2023年6月至2026年3月，任中关村至臻环保股份有限公司（835461）董事；2025年12月至今，任山东恒邦冶炼股份有限公司（002237）独立董事。2023年10月至今，任发行人独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由6名监事组成，其中监事会主席1名，职工代表监事2名。监事会成员构成、提名人及任期情况如下：

姓名	职位	提名人	任期
张帅	监事会主席	国家集成电路二期	2023.10至2026.10
蒙刚	监事	深圳鹏远昇	2023.10至2026.10
汪滢	监事	交融君泓三期	2026.04至2026.10
冯正田	监事	开曼英韧	2026.02至2026.10
刘颖	职工代表监事	职工代表大会	2023.10至2026.10
朱高星	职工代表监事	职工代表大会	2024.07至2026.10

张帅，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于英国南安普顿大学微电子系统设计专业。2007年10月至2008年10月，任第29届奥林匹克运动会组织委员会抵离中心信息技术处处员；2008年10月至2020年8月，历任国家开发银行评审二局行员、副处长；2020年8月至今，历任华芯投资管理有限责任公司投资二部副总经理、业务二部总经理；2022年12月至今，任发行人监事会主席。

蒙刚，男，1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1997年7月至2002年10月，任中国长城科技集团股份有限公司部门经理；2003年6月至2004年11月，就读于中欧国际工商学院；2005年1月至2007年3月，任Mavilor Motors S.A.（西班牙）中国区负责人；2007年3月至2010年8月，任国际商业机器采购（中国）有限公司部门经理；2010年8月至今，任深圳鹏瑞集团有限公司合伙人；2019年3月至今，任发行人监事。

汪滢，女，1986年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于浙江大学国际贸易学专业。2011年7月至2018年3月，历任交通银行股份有限公司管理培训生、授信管理部非信贷评审部授信审查专员；2018年3月至今，历任交银金融资产投资有限公司风险合规部副总裁、投资三部副总裁、投资三部副总经理、投资五部副总经理；2020年3月至2021年3月，任交银资本管理有限公司风控负责人；2026年4月至今，任发行人监事。

冯正田，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业。1999年7月至2002年6月，任沪士电子（昆山）有限公司软件开发工程师；2002年6月至2004年8月，任安迈信息科技（昆山）有限公司 BIOS 工程师；2004年9月至2006年2月，任乔鼎（上海）计算机科技有限公司软件工程师；2006年2月至2017年5月，任美满电子科技（上海）有限公司高级软件经理；2017年5月至今，任发行人固件高级总监；2026年2月至今，任发行人监事。

刘颖，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东政法大学经济法专业。2000年7月至2001年6月，任上海欣广房地产咨询有限公司法务专员；2002年3月至2002年8月，任上海盛亚房地产经纪有限公司合同专员；2002年9月至2004年3月，任上海世茂湖滨房地产有限公司法务主管；2004年3月至2007年3月，任上海联洋集团有限公司（前上海联洋广告装潢有限公司）办公室主任；2007年3月至2017年10月，任展讯通信（上海）有限公司人力资源副总监；2017年10月至2019年8月，任中科院通用芯片与基础软件研究中心人力资源总监；2019年9月至今，任发行人人力资源总监；2023年1月至今，任发行人职工代表监事。

朱高星，女，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华东政法大学民商法专业。2020年6月至2023年2月，任格科微电子（上海）有限公司法务专员；2023年3月至今，历任发行人法务经理、高级法务经理；2024年7月至今，任发行人职工代表监事。

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司计划于上市审核阶段根据《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》的规定，择机取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

3、高级管理人员成员

公司共有高级管理人员5名，高级管理人员的构成、职务及任期情况如下：

姓名	职位	任期
刘刚	总经理	2023.10 至 2026.10

姓名	职位	任期
陈杰	副总经理	2023.10 至 2026.10
LIN CHEN	副总经理	2023.10 至 2026.10
钟晓蕙	财务负责人	2023.10 至 2026.10
金昊	董事会秘书	2023.10 至 2026.10

刘刚，公司总经理，其简历请参见本节“十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。

陈杰，公司副总经理，其简历请参见本节“十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。

LIN CHEN，男，1970年3月出生，美国国籍，博士研究生学历，毕业于加州大学洛杉矶分校电子工程专业。1999年7月至2006年12月，任ATI Research Silicon Valley, Inc. 资深技术研发；2006年12月至2017年7月，任Marvell Semiconductor, Inc. 高级研发总监；2017年7月至今，历任发行人产品工程副总裁、副总经理。

钟晓蕙，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于萨福克大学会计学专业。2001年9月至2008年7月，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、审计经理；2008年9月至2010年5月，就读于萨福克大学；2010年6月至2013年2月，任特瑞堡轮胎工业（河北）有限公司中区财务负责人；2013年3月至2020年9月，任银联智策顾问（上海）有限公司董事、副总经理、财务总监；2020年9月至今，历任发行人财务副总裁、财务负责人。

金昊，男，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，毕业于上海交通大学金融学专业。2018年7月至2021年4月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理；2021年4月至2023年7月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理；2023年7月至今，历任发行人证券事务总监、董事会秘书。

4、核心技术人员

公司共有核心技术人员 3 名，核心技术人员的的基本情况如下：

武剑，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于曼彻斯特大学计算机专业。2010 年 3 月至 2010 年 11 月，任犹他大学博士后研究员；2010 年 12 月至 2015 年 1 月，任 Marvell Technology, Inc. 资深设计验证工程师；2015 年 2 月至 2017 年 2 月，任 Toshiba America Electronic Components, Inc. 高级工程师；2017 年 6 月至今，历任发行人芯片设计总监、芯片设计高级总监。

冯正田，其简历请参见本节“十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“2、监事会成员”。

周晓东，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学材料工程专业。2000 年 4 月至 2001 年 7 月，任上海焊接技术研究所工程师；2001 年 7 月至 2003 年 9 月，任纬创资通（上海）研发中心硬件工程师；2003 年 9 月至 2004 年 5 月，任英特尔产品（上海）有限公司硬件设计工程师；2004 年 5 月至 2007 年 7 月，任英特尔（上海）研发中心资深硬件工程师；2007 年 7 月至 2022 年 6 月，任易安信信息技术研发（上海）有限公司硬件研发部负责人；2022 年 6 月至今，历任发行人硬件高级总监、中国区硬件副总裁。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在除发行人及其子公司外其他单位的主要兼职情况如下：

序号	姓名	公司任职	任职的其他单位	其他单位职务	所兼职单位与公司的关系
1	ZINING WU	董事长	英韧集成	执行董事	关联方
			韧存集成	执行董事	关联方
			开曼英韧	董事	关联方
			RENCUN ULELA	管理人	关联方
2	吴一亮	董事	常州一倩企业管理	投资人、财	关联方

序号	姓名	公司任职	任职的其他单位	其他单位职务	所兼职单位与公司的关系
			中心	务负责人	
			北京武岳峰中清正合科技创业投资管理有限公司	合伙人	无
			北京一倩科技有限公司	执行董事、经理	关联方
			上海合见工业软件集团股份有限公司	董事	关联方
			常州承芯半导体有限公司	董事	关联方
			圆周率科技(常州)有限公司	董事	关联方
			北京海尔集成电路设计有限公司	董事	关联方
			毫厘科技(常州)有限公司	董事	关联方
			昂宝集成电路股份有限公司	董事	关联方
			昆泰集成电路(常州)有限公司	董事	关联方
			芯合电子(上海)有限公司	董事	关联方
3	于力	董事	GBC Fund Management, LLC	董事总经理	无
			北京贝利农垦饲料有限公司	监事	关联方
4	陈冲	董事	中电通商	董事	关联方
			长沙军民先进技术研究有限公司	董事	关联方
			重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司	董事	关联方
			澜至电子科技(成都)有限公司	董事	关联方
			中电投资	业务管理部兼综合管理部经理	关联方
			迅芯科源(宁波)私募基金管理有限公司	监事	无
5	刘刚	董事、总经理	芳春丹桂	执行事务合伙人	关联方
			芯韧一号	执行事务合伙人	关联方
			芯韧二号	执行事务	关联方

序号	姓名	公司任职	任职的其他单位	其他单位职务	所兼职单位与公司的关系
				合伙人	
			芯韧三号	执行事务合伙人	关联方
			芯韧四号	执行事务合伙人	关联方
			芯韧五号	执行事务合伙人	关联方
			芯韧六号	执行事务合伙人	关联方
6	JUN WU	董事	驭势科技(北京)股份有限公司	董事	关联方
7	魏晨阳	独立董事	清华大学五道口金融学院	中国保险与养老金研究中心主任	无
			北京金融科技研究院	副院长	无
			汇丰人寿保险有限公司	独立董事	无
			Waterdrop Inc.	独立董事	无
			中国人民财产保险股份有限公司	独立董事	无
8	陈菁	独立董事	天元航材(营口)科技股份有限公司	独立董事	无
			汕头大学商学院	教授	无
			江西省民政学会	副主任委员	无
9	陈志武	独立董事	北京国家会计学院	教师、教授	无
			中国大连高级经理学院	特聘教授	无
			北京市中洲律师事务所	兼职律师	无
			天津低碳发展与绿色供应链管理服务中心有限公司	董事	无
			山东恒邦冶炼股份有限公司	独立董事	无
			中金物联商品交易中心有限公司	董事	无
			新华丝路商品交易中心有限公司	董事	无
10	张帅	监事会主席	华芯投资管理有限责任公司	业务二部总经理	无
			赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	董事	关联方

序号	姓名	公司任职	任职的其他单位	其他单位职务	所兼职单位与公司的关系
			北京赛微电子股份有限公司	董事	关联方
			北京奕斯伟计算技术股份有限公司	董事	关联方
			北京华大九天科技股份有限公司	董事	关联方
			上海合见工业软件集团股份有限公司	董事	关联方
			芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	董事	关联方
			上海燧原科技股份有限公司	董事	关联方
11	蒙刚	监事	深圳鹏瑞集团有限公司	合伙人	无
			深圳市博圣达投资发展企业(有限合伙)	执行事务合伙人	关联方
			深圳市右城规划建筑设计有限公司	监事	关联方
			深圳市耀汇隆投资发展有限公司	执行董事、总经理	关联方
			合源生物科技股份有限公司	董事	关联方
			江苏量点科技有限公司	董事	关联方
			哈尔滨瀚邦生物制药有限公司	董事	关联方
			陕西天基通信科技有限责任公司	董事	关联方
			深圳飞特尔科技有限公司	董事	关联方
			广东艾勒可科技有限公司	董事	关联方
			贵州嘉宝医疗科技有限公司	董事	关联方
			北京力泰克科技有限公司	董事	关联方
			匠岭科技(上海)有限公司	监事	无
			佛山恒义创贸易有限公司	监事	无
			佛山卓威盛贸易有限公司	监事	无
12	汪滢	监事	交银金融资产投资有限公司	投资五部副总经理	无
			山鹰华中纸业有限公司	董事	关联方

序号	姓名	公司任职	任职的其他单位	其他单位职务	所兼职单位与公司的关系
			东华能源(宁波)新材料有限公司	董事	关联方
13	钟晓蕙	财务负责人	银联智策顾问(上海)有限公司	董事	关联方

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的近亲属关系

截至本招股说明书签署日, 公司董事 ZINING WU 与 JUN WU 为兄弟关系。除上述亲属关系外, 公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间不存在其他亲属关系。

(四) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

截至本招股说明书签署日, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重要协议及其履行情况

截至本招股说明书签署日, 发行人已与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了劳动合同以及保密、期权激励相关的协议。

截至本招股说明书签署日, 发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行协议约定的义务和职责, 遵守相关承诺。除上述协议之外, 发行人未与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况

公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动系因公司经营管理需要与规范公司治理需要而发生, 使得公司治理结构得到进一步规范和优化。最近两年内, 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动对公司日常管理不构成重大影响, 也不影响公司的持续经营。具体变动情况如下:

1、董事变动情况

变动日期	变动前	变化后	变动原因
2025年8月	ZINING WU、吴一亮、于力、邓向东、陈杰、刘刚、JUN WU、魏晨阳、郑登津、HAO XU、陈志武	ZINING WU、吴一亮、于力、陈冲、陈杰、刘刚、JUN WU、魏晨阳、郑登津、HAO XU、陈志武	中电通商因人事变动等原因，更换提名董事
2025年12月	ZINING WU、吴一亮、于力、陈冲、陈杰、刘刚、JUN WU、魏晨阳、郑登津、HAO XU、陈志武	ZINING WU、吴一亮、于力、陈冲、陈杰、刘刚、JUN WU、魏晨阳、陈菁、HAO XU、陈志武	郑登津基于个人原因辞任独立董事，补选独立董事

2、监事变动情况

变动日期	变动前	变化后	变动原因
2024年1月	张帅、蒙刚、郑焱、刘颖、严国庆	张帅、蒙刚、郑焱、蔡勇、刘颖、严国庆	股东交融君泓三期提名蔡勇担任监事
2024年7月	张帅、蒙刚、郑焱、蔡勇、刘颖、严国庆	张帅、蒙刚、郑焱、蔡勇、刘颖、朱高星	严国庆基于个人原因辞任职工代表监事职务，补选职工代表监事
2026年2月	张帅、蒙刚、郑焱、蔡勇、刘颖、朱高星	张帅、蒙刚、蔡勇、冯正田、刘颖、朱高星	郑焱基于个人原因辞任监事职务，补选监事
2026年4月	张帅、蒙刚、蔡勇、冯正田、刘颖、朱高星	张帅、蒙刚、汪滢、冯正田、刘颖、朱高星	股东交融君泓三期因人事变动等原因，更换提名监事

3、高级管理人员变动情况

最近两年，发行人高级管理人员为刘刚、陈杰、LIN CHEN、钟晓蕙、金昊，未发生变更。

4、核心技术人员变动情况

发行人的核心技术人员为武剑、冯正田、周晓东，前述人员最近两年内均在发行人处任职，发行人的核心技术人员最近两年内未发生变化。

(七) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资与公司及其业务不存在相同或相似的情形，不存在与公司业务产生利益冲突的情形。

(八) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

1、持有公司股份情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接持有公司股份，其中部分人员间接持有公司股份，具体情况如下：

序号	姓名	职务	持股主体	间接持股比例(%)
1	ZINING WU	董事长	开曼英韧	5.6932
			RENCUN ULELA	5.2736
2	吴一亮	董事	常州一倩企业管理中心	0.0054
3	陈冲	董事	天津伊莱克企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.0012
4	陈杰	董事、副总经理	芳春丹桂	0.1289
			开曼英韧	0.6188
5	刘刚	董事、总经理	芳春丹桂	1.0334
6	刘颖	职工代表监事	芳春丹桂	0.0366
7	朱高星	职工代表监事	芯韧三号	0.0038
8	LIN CHEN	副总经理	开曼英韧	0.5968
9	钟晓蕙	财务负责人	芳春丹桂	0.4282
10	金昊	董事会秘书	芯韧三号	0.0293
11	武剑	核心技术人员	开曼英韧	0.2442
12	冯正田	监事、核心技术人员	芯韧一号	0.1463
13	周晓东	核心技术人员	芯韧一号	0.0381

2、近亲属持股情况

截至本招股说明书签署日，除 JUN WU 的兄弟 ZINING WU 通过开曼英韧、RENCUN ULELA 间接持有公司股份外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近亲属均未持有公司股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的质押或冻结情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

及其近亲属持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

(九) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据及履行的程序

公司建立了完善的薪酬制度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（除独立董事、外部董事及外部监事）的薪酬由基本工资、奖金、社保福利等构成。其中基本工资及社保福利由劳动合同进行约定；奖金视公司当年度业绩情况进行确定。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司外部董事、外部监事均不在公司领取报酬。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均已履行公司相应的内部审议程序。

2、报告期内薪酬总额占发行人利润总额的比例

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额（不含股份支付）占各期利润总额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	2,243.51	2,184.54	1,732.31
利润总额	-47,010.02	-53,974.22	-36,562.69
占比	-4.77%	-4.05%	-4.74%

3、最近一年薪酬具体情况

最近一年，公司独立董事在公司仅领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。其他外部董事、监事不在公司领薪。除上述人员外的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司及/或公司控股子公司领取薪酬。

2025 年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额（不含股份支付）为 2,243.51 万元。

十四、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排

(一) 股权激励及相关安排

为进一步健全公司员工激励机制，充分调动优秀员工的工作积极性，增强优

秀员工对实现公司稳定、持续及快速发展的责任感和使命感，公司制定并施行期权激励计划。

公司在本次申报前已制定和实施的股权激励系通过员工持股平台进行，截至本招股说明书签署日，相关员工持股平台合计持有公司 25.78% 股权。

(二) 员工持股平台基本情况

1、员工持股平台设置情况

公司实施员工持股计划的员工持股主体分别为公司股东开曼英韧、上海韧存及其上层的员工持股平台，参与人包括董事/监事/高级管理人员/核心技术人员、其他员工、离职员工或继承激励份额人员、外部顾问。截至本招股说明书签署日，开曼英韧直接持有公司 59,785,264 股股份，占公司发行前总股本的 13.90%，上海韧存直接持有公司 51,139,794 股股份，占公司发行前总股本的 11.89%。

上海韧存、开曼英韧的基本信息参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“(三) 其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东”部分。

2、人员离职后的股份处理

公司对境内外员工持股计划参与人所持激励份额在离职后的安排如下：就服务期尚未到期部分的持股权益，由员工持股平台或公司指定主体回购该等权益，参与人取得该等权益所支付的价款退还参与人。

(三) 股份锁定安排

截至本招股说明书签署日，开曼英韧、上海韧存已出具《关于股份锁定的承诺函》，具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺事项”。

(四) 对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

通过实施上述股权激励，公司充分调动了员工的工作积极性，有利于稳定管理团队和核心人员，提升了公司经营效率，上述激励对促进公司业务发展和人才队伍建设起到了积极作用。

报告期内，公司根据《企业会计准则》的要求计入股份支付的费用分别为4,655.78万元、2,833.02万元和1,748.08万元。上述已实施的股权激励不会导致公司的控制权发生变化。

十五、发行人员工及其社保情况

(一) 员工基本情况

1、员工人数及变化情况

报告期各期末，公司（含子公司和分公司）员工数量分别为298人、296人和308人。

2、员工专业结构

截至2025年12月31日，公司（含子公司和分公司）员工的专业构成情况如下：

专业岗位	人数（人）	比例
研发人员	198	64.29%
技术支持及市场人员	59	19.16%
管理人员	51	16.56%
合计	308	100.00%

3、员工受教育程度

截至2025年12月31日，公司（含子公司和分公司）员工的受教育程度情况如下：

专业岗位	人数（人）	比例
博士	8	2.60%
硕士	133	43.18%
本科	155	50.32%
大专及以下	12	3.90%
合计	308	100.00%

4、员工年龄结构

截至2025年12月31日，公司（含子公司和分公司）员工的年龄结构情况

如下:

年龄构成	人数(人)	比例
30岁及以下	104	33.77%
31-40岁	115	37.34%
41-50岁	72	23.38%
51岁及以上	17	5.52%
合计	308	100.00%

(二) 社会保险和住房公积金缴纳情况

1、发行人及境内子公司社会保险和住房公积金的缴纳情况

报告期各期末, 发行人及境内子公司为员工缴纳社会保险的情况如下:

单位: 人

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
各期末境内员工总数	282	267	264
已缴纳社保人数	282	266	262
已缴纳人数占比	100%	99.63%	99.24%

报告期各期末, 发行人及境内子公司为员工缴纳住房公积金的情况如下:

单位: 人

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
各期末境内员工总数	282	267	264
已缴纳公积金人数	282	266	262
已缴纳人数占比	100%	99.63%	99.24%

报告期各期末, 发行人及境内子公司部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的主要原因系退休返聘、部分中国港澳台员工自愿放弃。

根据发行人及其境内子公司的专项信用报告, 报告期内, 发行人及其境内子公司不存在社保及住房公积金相关领域的违法记录信息。

2、发行人境外子公司社会保险和住房公积金的缴纳情况

发行人境外子公司不适用境内的社会保险、住房公积金缴纳制度。根据相关境外法律意见书, Nyquist HK 报告期内未聘任员工, 境外子公司 A 在劳动用工

方面符合当地相关法律、法规，不存在重大违法违规情形。

(三) 其他劳务用工

报告期内，发行人项目测试及财务、运营等活动中，可能会出现阶段性人员短缺等情况，为保证项目进度及业务高效开展，对于部分非核心、辅助性的工作内容，公司通过劳务外包方式予以解决。报告期内，向发行人提供劳务外包服务的劳务公司系独立经营的主体，发行人劳务外包仅涉及业务辅助岗位，无需具备特定专业资质，业务实施及人员管理符合相关法律法规的规定。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务及主要产品情况

(一) 主营业务情况

公司是国际领先的数据存储主控芯片与半导体存储产品提供商，主营业务为数据存储主控芯片和固态硬盘（SSD）的研发、设计及销售，完整覆盖企业级、工业级和消费级应用。公司以 AI SSD 为代表的企业级产品为核心，依托自主研发能力，突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈，实现信息存储核心环节的自主可控，产品广泛应用于 AI 驱动的算力中心、云服务等前沿场景。目前，公司产品已成功导入客户 B、腾讯、客户 A、联想、新华三、客户 C 等主流国产互联网、云计算及服务器厂商供应链，广泛应用于国产 AI 算力基础设施。

公司最新一代 CXL 芯片作为国内首颗获得国际颗粒原厂合同的数据存储主控芯片，满足算力直连存储最新需求，预计将协同 GPU 共同驱动尖端 AI 应用场景，如人工智能推理训练一体机等，通过 GPU 直连架构、CXL 高速互连等前沿技术，与国内外 GPU 大厂深度协同，为人工智能算力中心提供高带宽、低延迟的存算一体解决方案。未来随着国产 GPU 在算力性能上的持续突破，公司将通过持续迭代的存算一体解决方案，带动国产 AI 基础设施实现跨越式发展。

在 AI 驱动的数字经济发展中，算力是数据处理的引擎，而存力则是数据可持续供给的基石，在大模型训练、实时推理等场景中，存力的带宽、延迟与可靠性直接决定了算力的实际效率上限。固态硬盘作为关键存储设备，是现代数字经济高效运转及 AI 产业快速发展的基础，其组成主要包括主控芯片、固件和存储介质（NAND 闪存颗粒和 DRAM）。其中主控芯片相当于固态硬盘的“算力与算法核心”，负责与整机进行数据通信以及闪存颗粒数据管理，是闪存颗粒快速商业化落地的关键因素。

公司是以完整自研高性能数据存储主控芯片技术与产品为基础，将业务逐步拓展至企业级固态硬盘的半导体存储解决方案提供商。国产颗粒适配方面，通过深度优化算法与芯片内设计，公司数据存储主控芯片对国产闪存颗粒具备业界领

先的适配与性能调优能力；产业链方面，公司作为国内极少数具备企业级主控芯片及固态硬盘完整迭代研发能力的企业，助力我国半导体存储行业构建起从主控芯片、固件实现到存储模组的完整国产化链条；产品迭代方面，公司芯片及固态硬盘产品覆盖 SATA 到 PCIe 5.0，最新一代 PCIe 6.0 主控芯片和 CXL 主控芯片已于 2026 年上半年流片，产品代次发布国内领先，技术水平位居国际第一梯队。

公司拥有良好的声誉及稳定广阔的客户群体，已进入行业头部客户的供应链体系，产品广泛应用于下游技术要求最高的企业级客户与知名消费级客户，并实现规模出货，包括客户 A、联想、新华三、客户 C、长江计算、超云、长城等国内头部服务器厂商，客户 B、Bilibili、腾讯等互联网及云计算厂商，客户 E、闪迪、威刚科技、佰维存储、江波龙等国际颗粒原厂及存储模组厂商，终端客户触达互联网、云计算、AI 模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等各主要细分应用场景。

公司自成立以来不断拓展营销渠道，除境内的优质客户外，公司与国际客户建立了密切、稳定的合作关系，下游知名国际客户包括客户 E、威刚科技（全球第二大存储模组厂商）、闪迪（全球闪存存储解决方案领导者之一，分拆自西部数据）、TDK（全球领先的电子元件、传感器及电源解决方案提供商）、Swissbit（欧洲最大的独立嵌入式存储器和存储解决方案供应商）等。

公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业和国家高新技术企业，并承担上海市战略性新兴产业重大项目。此外，公司凭借领先的产品与服务积累了良好的声誉，成为“2025 年中国 IC 设计 Fabless100 排行榜——TOP10 存储器公司”中唯一全部采用自研数据存储主控芯片的企业，连续 5 年获评中国电子信息产业发展研究院颁布的“中国芯”存储芯片领域奖项，包括“优秀技术创新产品”和“优秀市场表现产品”奖项；连续 3 年获得“胡润全球瞪羚企业”等荣誉。根据 Frost&Sullivan 统计，在 2024 年中国固态硬盘市场中，公司在全部采用自研主控芯片的境内固态硬盘厂商中排名第一。

立足未来，公司旨在服务国家关键信息基础设施建设，满足自主存储供应链的重大战略需求。为此，公司将坚持聚焦于技术壁垒更高、产品性能更优、市场前景更广阔的高性能存储主控芯片及固态硬盘产品的研发，探索更强性能、更高带宽、更大容量的 PCIe 6.0 之上的 AI SSD 应用，从而引领国内存储产业技术升

级。

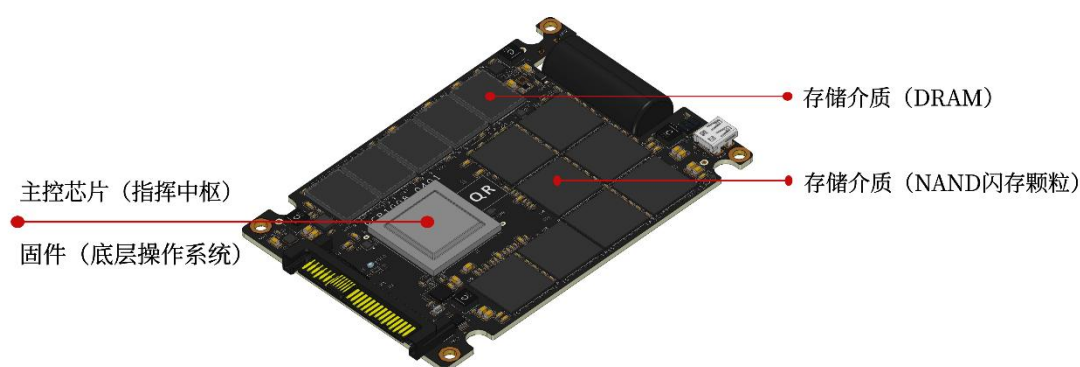
(二) 主要产品及服务情况

报告期内，公司主要产品包括数据存储主控芯片和固态硬盘。

1、固态硬盘构成

固态硬盘组成主要包括主控芯片、固件和存储介质（NAND 闪存颗粒和 DRAM）。其中，主控芯片与固件协同工作，共同实现了包括坏块管理、纠错校验、磨损均衡、垃圾回收等关键功能，直接决定了固态硬盘在性能、稳定性、数据安全及使用寿命等方面的综合表现，广泛应用于服务器、消费电子、工业控制等领域。

固态硬盘构成



①主控芯片

主控芯片是固态硬盘的核心指挥中枢，作为固态硬盘的“算力与算法核心”，负责与计算机的 CPU/GPU 进行高速数据通信，并全面管理闪存颗粒的数据读写、纠错与均衡操作，有效弥合了存储介质物理特性与处理器对数据高速吞吐、高可靠性及长效寿命要求间的差距，是保障固态硬盘整体性能、稳定性与使用寿命的核心硬件基础。

②固件

固件是固态硬盘的“底层操作系统”，与主控芯片深度协同。作为衔接主控芯片和 NAND 闪存颗粒的核心软件层，固件通过内置的专属算法与程序逻辑，精准执行坏块管理、纠错校验、磨损均衡、垃圾回收等核心功能，同时负责闪存颗粒的参数配置、读写指令调度以及数据传输优化，并实时监控固态硬盘的运行

状态、进行功耗调节与故障预警。固件的算法优化程度直接影响主控芯片性能的发挥效率，决定了闪存颗粒的读写速度、数据存储可靠性与使用寿命，是保障固态硬盘在不同应用场景下稳定、高效、安全运行的关键核心要素。

③NAND 闪存颗粒、DRAM

NAND 闪存颗粒是固态硬盘的核心数据存储载体，作为非易失性存储器，其可在断电后长久保存各类数据，是实现固态硬盘数据存储的物质基础，其颗粒类型、制程工艺、容量大小与性能参数直接决定了固态硬盘的基础存储能力、读写速度上限与存储密度，不同规格的 NAND 闪存颗粒也会影响固态硬盘的成本、耐久性与适用场景。

DRAM 作为固态硬盘的高速缓存，承担着临时存储数据的作用，可快速缓存固态硬盘运行过程中待读写的临时数据与指令，大幅减少主控芯片直接访问 NAND 闪存颗粒的频次，有效降低数据读写延迟，提升固态硬盘的随机读写性能与数据处理效率。

④企业级固态硬盘完整设计方案

企业级固态硬盘的完整设计方案是主控芯片及存储介质选型、固件、硬件深度融合、协同优化的系统性解决方案，其设计难点体现在多维度的技术攻坚与全环节的深度适配。

A. 主控芯片及存储介质选型

固态硬盘设计的根基在于主控芯片与存储介质的匹配选型，需选择性能强大、能效比高的主控芯片，并搭配在原始误码率、延迟一致性及耐久性等关键指标上表现优异的存储介质，通过主控芯片、固件、存储介质的垂直整合与优化，满足企业级应用高带宽、低延迟、高可靠性的严苛要求。

B. 固件方案设计

固件方案需基于特定主控架构，并针对所选存储介质的特性进行精细调优，其核心挑战在于协同芯片开发出能同时实现高吞吐、低延迟、性能稳定与长寿命的智能算法，通过调试数据存储、介质管理、数据安全等核心功能的算法参数，让固件与主控芯片、存储介质形成高效配合，确保固态硬盘各项功能性能指标达

到企业级应用的严苛要求。

C. 硬件方案设计

企业级固态硬盘对于硬件方案的设计要求极高,需实现高可靠性企业级掉电保护,通过精准的电源管理与数据缓存保护机制,确保突发掉电时数据的完整性与安全性;同时,方案需在紧凑空间内完成全盘散热与功耗控制的联合设计,针对企业级场景 7×24 小时高负荷运行的特点,通过结构、材料和策略的协同设计,保障主控芯片及存储介质在高温、高负载下的长期稳定运行;此外,还需确保主控芯片与众多存储介质间高速互联的信号完整性,克服芯片间高速互联带来的时序、串扰与噪声问题。

上述主控芯片及存储介质选型方案、固件方案与硬件方案环环相扣、联系紧密,任一环节的设计优化都需与其他环节协同调整,三者的深度融合与精准匹配,共同构成了满足企业级高要求、高标准的固态硬盘完整设计方案。

2、公司主要产品情况

(1) 数据存储主控芯片

公司数据存储主控芯片已实现从 SATA 到 PCIe 5.0 的主流代次全覆盖,以及企业级、消费级、工业级的应用领域全覆盖。公司最新一代 PCIe 6.0 主控芯片和 CXL 主控芯片已于 2026 年上半年流片,协同 GPU 共同驱动尖端 AI 应用场景。

公司目前已成熟量产的主控芯片产品具体情况如下表:

接口类型	公司产品应用领域	产品型号	产品示意图	产品典型性能
PCIe 5.0	企业级	YRS900		14,700MB/s、12,000MB/s; 3,500K IOPS、2,500K IOPS
	消费级	YRS820		14,700MB/s、12,000MB/s; 3,500K IOPS、2,500K IOPS
PCIe 4.0	企业级	IG5636		7,400MB/s、6,400MB/s; 1,000K IOPS、800K IOPS







接口类型	公司产品应用领域	产品型号	产品示意图	产品典型性能
	消费级/ 工业级	IG5638		7,400MB/s、7,000MB/s; 1,700K IOPS、900K IOPS
		IG5220		7,400MB/s、6,800MB/s; 1,000K IOPS、1,000K IOPS
		IG5222		7,400MB/s、6,800MB/s; 1,200K IOPS、1,200K IOPS
		IG5236		7,400MB/s、6,400MB/s; 1,000K IOPS、800K IOPS
PCIe 3.0	消费级/ 工业级	IG5208		1,750MB/s、1,500MB/s; 250K IOPS、200K IOPS
		IG5216		3,400MB/s、3,000MB/s; 500K IOPS、350K IOPS
SATA	企业级	IG5600		560MB/s、520MB/s; 98K IOPS、70K IOPS

注：产品典型性能分别列示顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度和随机写入速度。

(2) 固态硬盘

报告期内，公司固态硬盘产品均使用自研主控芯片。公司以主控芯片核心技术为基础，面向企业级、工业级、消费级应用领域持续推出 PCIe SSD 和 SATA SSD 产品系列，成为少数实现主流代次及应用领域全覆盖的国产 SSD 厂商。公司 PCIe SSD 凭借高带宽、低延迟等特性，为 AI 算力集群及数据中心提供极致性能支撑；同时，SATA SSD 作为存量市场主力与国产化关键抓手，在温冷数据存储场景中持续高效替代传统机械硬盘（HDD）。在国内 HDD 产业链薄弱、核心技术对外依赖度高的背景下，大容量 SATA SSD 凭借成熟稳定、高性价比、低功耗、易部署等优势，成为替代 HDD，补齐存储短板的最优路径。

公司固态硬盘主要产品的具体情况如下：

接口类型	公司产品应用领域	产品型号	产品示意图	产品典型性能
PCIe 5.0	企业级	洞庭-N3系列		14,600MB/s、12,400MB/s; 3,500K IOPS、620K IOPS
	企业级	洞庭-N3Q系列		14,500MB/s、3,600MB/s; 2,000K IOPS、45K IOPS
	企业级	洞庭-N3X系列		14,000MB/s、11,000MB/s; 3,500K IOPS、1,600K IOPS
PCIe 4.0	企业级	洞庭-B1系列		3,400MB/s、1,400MB/s; 630K IOPS、90K IOPS
	企业级	洞庭-N2系列		7,400MB/s、6,700MB/s; 1,700K IOPS、370K IOPS
SATA	企业级	洞庭-S1系列		530MB/s、510MB/s; 85K IOPS、50K IOPS

注 1: 除上述企业级固态硬盘产品, 公司还提供消费级/工业级定制化固态硬盘解决方案。

注 2: 产品典型性能分别列示顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度和随机写入速度。

公司凭借对存储接口及协议的全面覆盖与深刻理解, 从 SATA 到 PCIe 5.0 以及研发中的 PCIe 6.0, 构建了可扩展、可迭代的统一芯片架构平台, 使得同一代自研主控芯片能够通过固件配置, 灵活适配不同品牌(包括三星、铠侠、闪迪、SK 海力士等)的闪存颗粒。通过持续的产品迭代, 公司不断优化主控芯片的并发处理能力、颗粒指令调度及功耗管理, 从而能够充分挖掘并释放各类厂商颗粒的潜在性能。无论是面向高速数据处理的 PCIe 接口, 还是注重成本效益的 SATA 接口, 公司均能通过精准的固件调优, 实现颗粒性能的最大化利用, 为客户提供从消费级到企业级、从通用计算到 AI 计算的全场景、全代次、高性能、高性价比存储产品矩阵。

实现存储产品的全国产化, 核心难点在于打通“核心算法芯片加速-固件适

配客户需求-闪存调优平台化”这一完整技术链，并实现深度融合。具体而言，NAND 闪存颗粒在原始误码率、读写延迟一致性、耐久性等底层物理特性上与整机需求存在客观差距。公司凭借芯片完整自研优势，针对各种颗粒特性进行了芯片架构与算法加速的深度优化，将基于国产颗粒的固态硬盘误码率显著降低多个数量级，有效延长颗粒使用寿命，使其在关键性能与可靠性指标上实现对国际主流厂商产品的对标与赶超，为下游客户在关键信息基础设施领域提供了高性能、高安全、自主可控的存储解决方案。

公司始终坚持国产化替代与国际化拓展双轨并行发展，自研主控芯片及固态硬盘产品已获得国内外客户的广泛验证与采用。公司技术实力与产品性能位居国际第一梯队，深度融合并引领全球存储产业前沿演进趋势，积极布局 PCIe 6.0/7.0、CXL 等下一代接口技术，并与国际颗粒原厂开展合作，确保其产品迭代与全球产业升级同步。CXL 是一种构建在 PCIe 物理层之上的高速互联开放标准，其核心价值在于通过硬件级缓存一致性协议，实现 CPU 与 GPU、FPGA 等加速器及内存扩展设备之间的高效、低延迟互联与资源共享。在 AI 算力需求爆发的背景下，传统以 CPU 为中心的存储架构已出现性能瓶颈，而 CXL 通过支持内存语义访问和资源池化，能够有效突破“内存墙”限制，为高性能异构计算提供关键基础设施支撑，是未来存储产业升级的关键技术方向。

随着 GPU 等 AI 算力对存储系统的要求持续演进，以英伟达为代表的 GPU 厂商正不断推动基于 PCIe 6.0 的 GPU 直连存储系统解决方案落地。为此，国际颗粒原厂已迅速推动 PCIe 6.0/7.0 AI SSD（算力直连高性能固态硬盘）的技术研究与产品开发。铠侠于 2025 年明确了其 AI SSD 的发展路径：在行业普遍实现 PCIe 5.0 约 300 万 IOPS 的基础上，于 2026 年底依托 PCIe 6.0 主控芯片率先达成 1,000 万 IOPS，并计划在 2027 年结合 PCIe 7.0 主控芯片进一步提升至 1 亿 IOPS。

结合与客户 E 的合作情况，公司最新一代 PCIe 6.0 芯片和 CXL 芯片将能够较好满足国内外人工智能市场需求。在 AI 算力中心的推动下，AI SSD 将进入技术快速演进与规模化商用关键阶段。

3、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入结构如下：

单位：万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
数据存储 主控芯片	PCIe	13,601.69	13.19%	16,480.65	26.41%	25,000.00	70.61%
	SATA	244.46	0.24%	75.13	0.12%	-	-
	小计	13,846.15	13.42%	16,555.78	26.53%	25,000.00	70.61%
固态硬盘	PCIe	58,820.66	57.03%	22,837.18	36.60%	8,992.50	25.40%
	SATA	30,072.00	29.16%	22,025.80	35.30%	1,199.25	3.39%
	小计	88,892.65	86.19%	44,862.98	71.89%	10,191.75	28.79%
技术服务		399.37	0.39%	983.11	1.58%	214.37	0.61%
合计		103,138.17	100.00%	62,401.86	100.00%	35,406.12	100.00%

(三) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事数据存储主控芯片和固态硬盘的研发、设计及销售，通过向下游厂商或经销商等客户销售数据存储主控芯片和固态硬盘实现收入。公司不断推出全代次高性能数据存储主控芯片和固态硬盘产品，导入下游知名客户并实现批量销售，满足 AI、算力中心等企业级应用，并覆盖消费级、工业级应用。

2、采购和生产模式

公司结合自身对市场的判断和客户的需求预测拟定相应的采购计划，并根据市场行情协商确定采购价格。公司建立并执行了规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选择等事项进行了明确的规定。

公司主要业务板块为数据存储主控芯片和固态硬盘。两者的生产模式存在着一定的不同。

(1) 数据存储主控芯片制造

芯片设计完成、流片成功并进入量产后，公司的整体生产流程为：

①根据销售预测，向晶圆代工厂发送订单，委托其代为生产晶圆，公司产品工程部门对晶圆生产工艺进行监督；

②晶圆生产完成后，将晶圆发送给封装代工厂；公司将包含基板图号、打线

图号等信息的封装工单发送给封装代工厂进行封装；

③封装完成后，将芯片发至测试厂商按照公司提供的工单及测试程序进行测试。

(2) 固态硬盘制造

公司主要通过委外加工的方式进行固态硬盘生产装配。目前国内优质委托加工厂商数量众多、市场竞争充分，公司综合考虑产品质量、技术水平、交付能力、价格和账期等因素，确定委托加工厂商。主控芯片由公司自主研发，对于 NAND 闪存颗粒和 DRAM 等部件，通常由公司自行向上游厂商进行订购，其他辅助材料则由委托加工商自行采购。

在生产方面，公司将结合客户的实际需求和对市场需求的预测，制定产品生产计划。报告期内，公司委托加工厂商进行产品的生产装配，公司将生产需求下达给委托加工厂商，委托加工厂商根据代工合同履行生产排配、加工生产，最后按照公司自研方案进行系统级测试。

3、销售模式

公司已建立专业化、国际化的销售团队及健全的销售管理制度，并采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。

(1) 直销模式

直销模式下，公司通过自身的销售渠道直接面向客户，双方签订产品销售合同或订单，公司根据订单组织生产、结算、发货。通过该模式，公司直接向行业内知名客户提供产品及技术服务，有利于扩大公司在相关行业中的知名度和影响力，提高公司的市场地位。

(2) 经销模式

经销模式下，公司综合考虑经销商资信状况、产品推广能力、销售服务水平等，与其签订合同或订单；经销商以买断方式向公司购买产品后，通过其销售渠道最终将产品销售给其下游客户。公司借助经销商客户渠道广的优势，以扩展公司产品的客户覆盖度、提高市场开拓效率、降低客户维护成本。

4、研发模式

公司的研发流程包括方案立项、设计研发、产品验证三个阶段。具体如下：

(1) 方案立项阶段

本阶段是根据行业技术动态、市场机会和竞争格局，结合公司现有资源能力，提出满足市场需求的研发方案。公司各相关部门负责人对新产品的功能及性能指标、技术难点、基本设计方案、开发周期等进行讨论及审核。本阶段经审批通过后，研发项目获得正式立项。

(2) 设计研发阶段

项目立项后，公司启动实质性研发，研发人员依据产品规格需求进行产品规格分析，并编制产品设计方案。方案评估通过后，各研发部门依据设计方案完成产品设计、集成和验证、制造工艺设计和实施。

(3) 产品验证阶段

该阶段主要完成内部各类功能和性能测试以及相关的专业测试，包括进行软硬件压力测试，标准和规格的一致性测试等，并做好相关的产品发布和上市的准备工作。

(四) 公司成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司以主控芯片技术为起点，持续推动芯片技术产业化落地，凭借技术迭代与客户服务体系的完善，将业务逐步拓展至企业级固态硬盘。公司完整自研的芯片技术为固态硬盘产品构筑了性能、能效及可靠性核心竞争力，形成底层技术壁垒。通过芯片的持续迭代，公司的固态硬盘产品得以不断突破性能边界，精准适配 AI 驱动的算力中心、云服务的前沿一线场景的极致需求。

同时，规模化发展的固态硬盘业务对芯片研发形成了至关重要的反哺与驱动，在为公司提供持续稳定的现金流，支撑长期高强度研发投入的同时，助力公司直接触达终端客户与复杂应用场景，提高公司对终端市场需求与技术发展方向的洞察能力。终端应用的反馈直接指导了下一代主控芯片的架构定义与功能创新，确保公司技术演进始终与市场变化同频共振。

在此基础上,芯片业务与固态硬盘业务的深度协同,进一步锤炼并提升了公司的系统级解决方案开发能力。公司凭借对芯片到固态硬盘的全链路技术掌控,能够将领先的芯片设计能力与深刻的系统开发理念相结合,为客户提供远超标准组件的高附加值定制化解决方案,从而高效应对不同客户在性能、功耗、可靠性及综合成本等方面的多元化与复杂化挑战,推动存储产业的整体进步。公司具体发展历程如下:



(五) 主要业务经营情况和核心技术产业化情况

公司主要从事数据存储主控芯片和固态硬盘的研发、设计和销售,是以完整自研高性能数据存储主控芯片技术与产品为基础,将业务逐步拓展至企业级固态硬盘的半导体存储解决方案提供商。作为国内极少数具备企业级主控芯片及固态硬盘完整迭代研发能力的企业,助力我国半导体存储行业构建起从主控芯片、固件实现到存储模组的完整国产化链条,终端客户触达互联网、云计算、AI 模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等各主要细分应用场景。

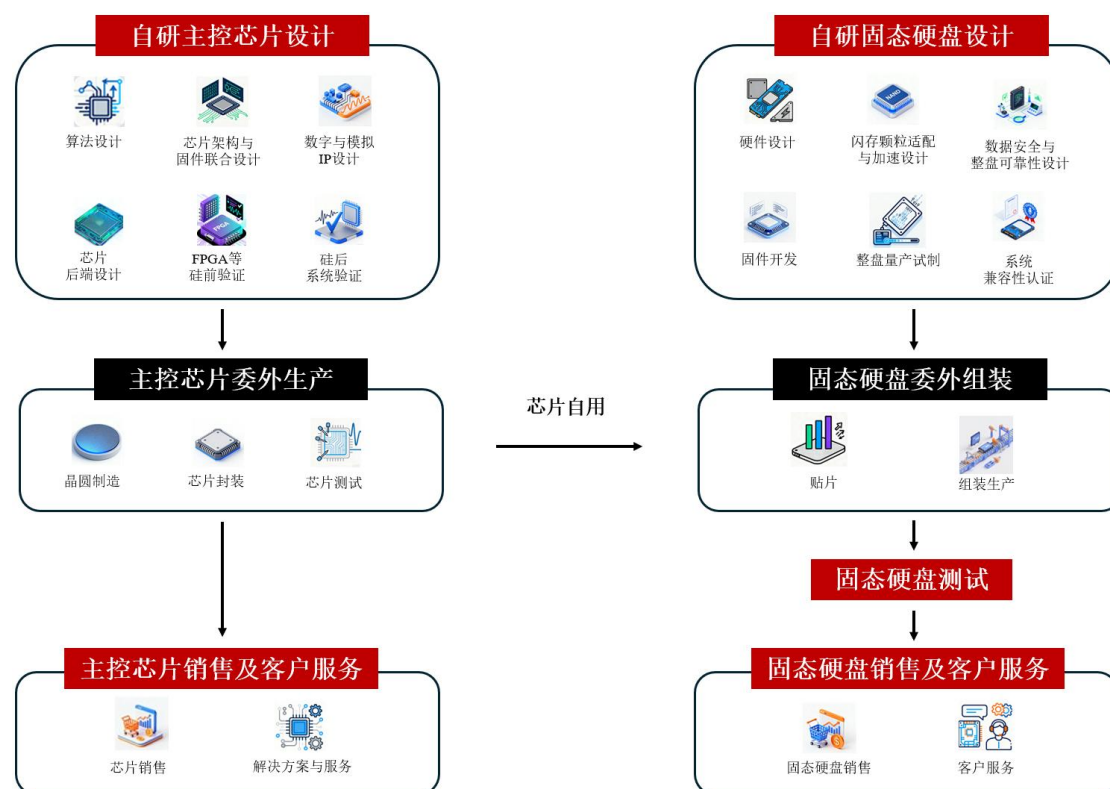
报告期内,公司主营业务收入分别为 35,406.12 万元、62,401.86 万元和 103,138.17 万元。公司持续推动产品迭代升级,并不断深化与优质客户的合作关

系。随着公司自研数据存储主控芯片及固态硬盘产品陆续推出并全面导入下游客户,叠加人工智能等下游市场需求开始显现,报告期内,公司经营业绩大幅增长。公司始终围绕核心技术开展主营业务,报告期内,公司核心技术收入占营业收入的比例分别为 98.96%、99.85%和 99.73%。

(六) 主要产品或服务的工艺流程图或服务流程图

公司具备完整的主控芯片自研能力,芯片研发流程包括芯片算法设计、架构与固件联合设计、数字与模拟 IP 设计、芯片后端设计、FPGA 等硅前验证、硅后系统验证等,固态硬盘研发流程包括硬件与固件的协同开发和全流程测试、量产测试设备及配套方案的研发等。

公司主要产品的生产工艺流程如下:



注: 主控芯片委外生产及固态硬盘委外组装环节由公司与供应商协同完成。

(七) 具有代表性的业务指标情况

公司主要从事数据存储主控芯片和固态硬盘解决方案的研发、设计和销售。报告期内,具有代表性的业务指标主要为数据存储主控芯片及固态硬盘的销量、销售收入等,具体情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”。

(八) 主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司所属行业为半导体和集成电路行业,属于《战略性新兴产业分类(2018)》《产业结构调整指导目录(2024年本)》等列示的受国家政策鼓励的产业范围,符合行业政策和国家经济发展战略,具体情况参见本节“二、行业基本情况”之“(一) 所属行业及确定所属行业的依据”相关内容。

公司凭借芯片完整自研优势,针对各种颗粒特性进行了芯片架构与算法加速的深度优化,将基于国产颗粒的固态硬盘误码率显著降低多个数量级,有效延长颗粒使用寿命,使其在关键性能与可靠性指标上实现对国际主流厂商产品的对标与赶超,为下游客户在关键信息基础设施领域提供了高性能、高安全、自主可控的存储解决方案。公司主要产品和业务对我国算力基础设施升级具有重大意义,符合产业政策和国家经济发展战略。

二、行业基本情况

(一) 所属行业及确定所属行业的依据

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65 软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520)。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“新一代信息技术产业”,符合战略性新兴产业的发展方向。

(二) 行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业由工业和信息化部进行宏观管理和政策指导,中国半导体行业协会(CSIA)是本行业的自律监管机构。

(1) 工业和信息化部

工业和信息化部主要职责是研究提出行业发展战略,拟订行业规划和产业政策并组织实施;指导行业技术法规和行业标准的拟订;按国务院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资等项目等。

(2) 中国半导体行业协会

中国半导体行业协会下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会、半导体支撑业分会和 MEMS 分会等分支机构，是公司所属行业的行业自律组织。其主要职责是落实政府发布的有关的政策、法规；开展产业及市场研究；向政府主管部门和会员单位提供咨询服务；参与制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准并推动标准的贯彻执行等。

2、主要政策和法律法规

集成电路行业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育和发展新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。政府自 2000 年以来将集成电路行业确定为国民经济支柱性行业之一，并先后出台了一系列针对集成电路行业的产业政策，推动了行业的迅速发展。近年来，集成电路行业主要的法律法规及政策列表如下：

序号	发布时间	发布单位	政策名称	相关内容
1	2026 年	全国人大常委会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	统筹布局、有序建设算力设施，推进算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展。加快国家枢纽算力设施集群建设，支持有条件地区根据低时延场景需求适度发展算力，推进云边端协同发展。加强高性能高质量智算资源供给，论证建设超大规模智算集群
2	2024 年	中共中央	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业政策和治理体系；抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用
3	2024 年	工信部	《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》	深入推进 5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，前瞻布局 6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施
4	2024 年	网信办、市监局、工信部	《信息化标准建设行动计划（2024-2027 年）》	建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系……围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片……等应用标准研制
5	2023 年	国家发改委	《产业结构调整指导目	集成电路设计，集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产，线宽小

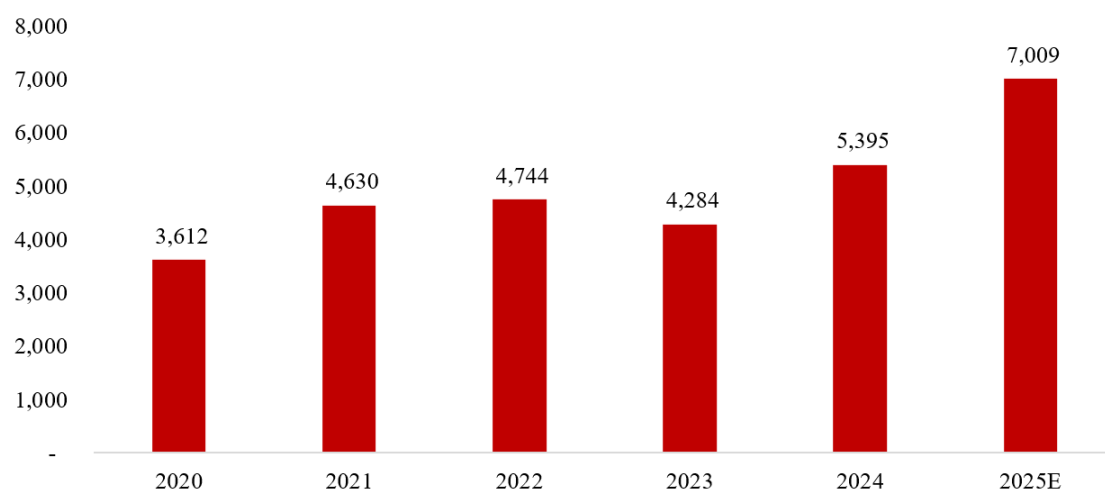
序号	发布时间	发布单位	政策名称	相关内容
			录(2024 年本)》	于 0.25 微米(含)的特色工艺集成电路生产(含掩模版、8 英寸及以上硅片生产),集成电路线宽小于 0.5 微米(含)的化合物集成电路生产,和球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)、栅格阵列封装(LGA)、系统级封装(SIP)、倒装封装(FC)、晶圆级封装(WLP)、传感器封装(MEMS)、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试,集成电路装备及关键零部件制造
6	2023 年	工业和信息化部等六部门	《算力基础设施高质量发展行动计划》	加速存力技术研发应用。围绕全闪存、蓝光存储、硬件高密、数据缩减、编码算法、芯片卸载、多协议数据互通等技术,推动先进存储创新发展。鼓励先进存储技术的部署应用,实现存储闪存化升级,进一步提升我国全闪存技术竞争力并持续提升存储产业能力。鼓励存储产品制造企业持续提升关键存储部件等自主研发制造水平,打造存储介质、存储芯片、存储系统和存储应用相互促进、协同发展的产业生态

(三) 所属行业发展情况与未来发展趋势

1、集成电路行业

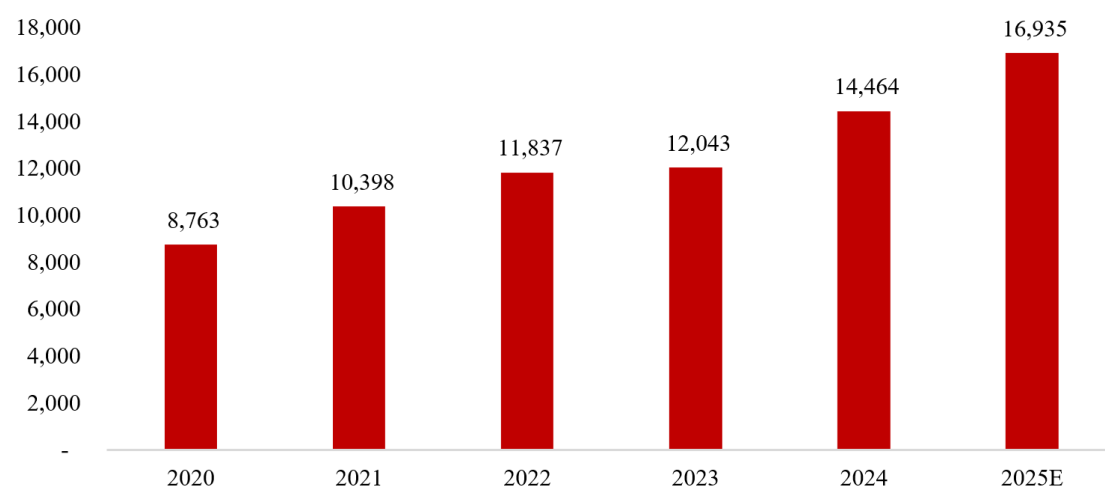
集成电路(Integrated Circuit)简称 IC,是一种微型电子元器件。主要制作原理为采用一定的工艺将电路中所需的晶体管、二极管、电容、电阻等基本元器件通过布线互连,集成在一小块或几小块半导体晶粒或介质基片上,并封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构,封装完成的集成电路亦被称为芯片。集成电路通常采用光刻、刻蚀、离子注入等微纳加工工艺,在平方厘米级面积上实现数亿至数百亿晶体管的集成,典型产品包括中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、系统级芯片(SoC)、存储器(DRAM/NAND)等,通过“功能集成化、尺寸微型化”创新路径实现了电子系统性能的指数级提升与功耗的大幅降低,已成为支撑人工智能、云计算、物联网等战略性新兴产业发展的关键技术,助力经济向高质量发展转型。

从市场规模来看,近年来,全球集成电路市场持续波动增长。根据 WSTS 数据,2024 年度全球半导体市场规模首次突破 5,000 亿美元,高达 5,395 亿美元,相较于 2023 年增长率约为 25.93%,这一数据也反映了半导体行业的强劲复苏。

2020-2025 年全球集成电路行业市场规模（亿美元）

数据来源：WSTS

我国集成电路产业经历了从技术引进到自主创新的过程。通过对国际先进工艺的持续学习与深度融合，我国集成电路设计、制造以及封装测试技术得到了快速发展，带动产业规模迅速扩张，整体实力显著提升。根据中国半导体行业协会、中商产业研究院数据，2024 年中国集成电路市场规模达 14,464 亿元，2020-2024 年复合增长率达到 13.35%，预计 2025 年将达到 16,935 亿元。尽管我国集成电路产业在部分领域已取得了一系列突破，但目前自给率仍相对较低。加速构建自主可控的集成电路产业体系，全面提升本土企业核心竞争力，深入推进国产替代进程，已成为把握发展主动权、保障国家信息安全的当务之急。

2020-2025 年中国集成电路行业市场规模（亿元）

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院

2、公司产品主要应用市场概况及发展趋势

(1) 存储行业发展概况

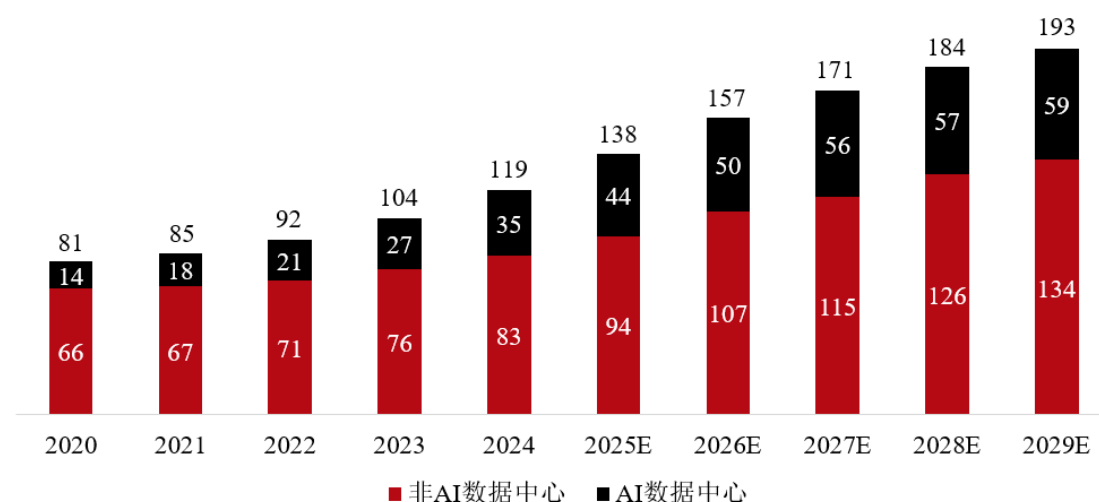
AI 的快速演进正成为全球存储市场最具颠覆性的驱动力，随着 AI 在算力、算法和数据三大要素上的突破，存储需求从传统的容量导向转向高性能、低延迟和场景化分层存储，推动了固态硬盘及其主控芯片技术的迭代与创新。AI 不仅加速了数据量的爆发式增长，还催生了新型存储技术和产品的增量需求，为存储行业带来结构性机遇。2025 年以来，以英伟达为代表的厂商正不断推动基于 PCIe 6.0 的 GPU 直连存储系统解决方案落地，通过 PCIe 6.0 总线互联直接联通 GPU 算力，省去 CPU 环节，大幅提升 AI 性能与效率，进一步加速了 AI SSD 的规模化商用。

AI 产业规模的扩张直接拉动了存储基础设施的投资，根据 Frost&Sullivan 统计，2024 年全球 AI 产业规模为 4.55 万亿元，2029 年将达到 20.24 万亿元，年均复合增长率 34.78%；中国 AI 产业规模同期将由 0.73 万亿元增长至 3.36 万亿元，年均复合增长率 35.71%。规模快速增长的背后是 AI 应用对数据存储的刚性需求，例如 AI 训练和推理需要处理海量数据集，推动存储系统向高带宽、高并发和低延迟演进。

①数据中心与服务器需求增长

AI 的普及正在驱动数据中心基础设施发生根本性变革，其需求增长已远超传统云计算时代。全球主要云服务厂商和大型互联网企业的资本支出正明显向 AI 基础设施倾斜，用于采购和部署 AI 服务器及相关的存储、网络设备，以构建大规模 AI 训练和推理集群。这种结构性的投资变化，是推动企业级高端 SSD 需求的核心动力。

2020-2029 年全球数据中心新增机柜数量 (万台)



数据来源: Frost&Sullivan

根据 Frost&Sullivan 统计, 全球数据中心新增机柜数量从 2020 年的 80.6 万台增长至 2024 年的 119 万台, 预计 2029 年将达到 193 万台, 2024 年至 2029 年的年复合增长率为 10.15%。其中, AI 数据中心与非 AI 数据中心存在显著差异。AI 数据中心专为高性能计算设计, 主要用于自动驾驶算法、大型模型训练、生成式 AI 语言模型等复杂的计算任务。非 AI 数据中心主要依赖低功耗 CPU 来处理日常数据存储、网站服务等基础需求。AI 数据中心的工作负载特性要求存储架构必须支持高并发、低延迟和高带宽。这不仅体现在单块 SSD 的性能上, 更体现在整个存储系统的设计上。例如, 为加速大模型训练的数据读取速度, 采用计算存储或更高速的接口 (如 PCIe 5.0/6.0) 已成为趋势。同时, 为应对图片、语音、视频等海量非结构化数据, 对象存储和并行文件系统的应用日益广泛, 其对底层硬盘的容量和性能要求也水涨船高。AI 数据中心的扩展模式更倾向于水平扩展, 即通过增加标准化的服务器节点来提升整体算力。这意味着每台 AI 服务器都需要配置高性能的本地存储, 从而极大地增加了对企业级 SSD 的采购数量。

②AI 服务器存储容量提升

AI 服务器已成为驱动存储容量和性能需求增长的核心引擎, 但其内部存储配置因应用场景 (训练/推理) 而异。

AI 训练服务器是海量数据的“快取仓”, 需要频繁读取海量的原始数据集进行模型学习。因此, 它们普遍配置大容量、高性能的 NVMe SSD 作为高速缓

存，以尽量减少从远端存储系统读取数据造成的延迟。单机配置 4TB 至 8TB 甚至更高容量的高性能 SSD 已成为常态，旨在将频繁使用的“热数据”本地化，从而极大提升训练效率。

AI 推理服务器是模型部署的“承载者”，推理服务器主要负载是将训练好的模型部署上线，处理实时或准实时的推理请求。这类服务器需要存储体积庞大（可达数百 GB 甚至 TB 级别）的模型文件本身。为了支持高并发、低延迟的推理服务，并实现模型的快速加载和切换，推理服务器正越来越多地采用更高容量（如 16TB 及以上）的 SSD 来存储整个模型库，从而避免频繁从网络加载，显著降低响应时间。大容量 SSD 因其更高的存储密度和更低的成本，在此类读密集型场景中优势明显。

在上述趋势下，SSD 凭借远低于 HDD 的访问延迟、更高的随机读写性能以及出色的并发处理能力，成为承载温热数据的理想介质。其中，SATA SSD 正凭借其成熟稳定的接口、优异的性价比及与现有基础设施的高度兼容性，大规模替代传统 HDD，成为温数据存储层的主流选择。SSD 的应用不仅提升了 AI 工作负载的整体效率，也促使存储架构从“容量优先”向“性能优先”转型，进一步加快高性能 SSD 的普及速度。

③CXL 商业化落地加速，驱动 SSD 行业架构革新与性能跃升

CXL 作为构建在 PCIe 物理层之上的新一代高速互联标准，是解决 AI 时代异构计算场景下存储与算力协同瓶颈的核心技术，其发展呈现协议版本快速迭代、生态持续完善、商业化进程加速的显著特征。自 2019 年 CXL 1.0 版本发布以来，协议已完成从基础缓存一致性功能向大规模集群互联功能的进阶。CXL 技术的普及将对存储行业产生颠覆性影响，推动存储产品从单一数据存储载体向算力协同核心节点转型，重塑行业竞争格局。CXL 的应用使 SSD 可直接与 GPU 等算力单元高速互连，实现数据的就近处理与实时调度，大幅降低 AI 训练场景下的数据读写延迟的同时，极大地提升了带宽，彻底解决传统架构中 CPU 中转带来的性能损耗，其具体发展情况如下：

维度	CXL 1.0	CXL 2.0	CXL 3.0	CXL 4.0
标准发布时间	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年

维度	CXL 1.0	CXL 2.0	CXL 3.0	CXL 4.0
底层物理层	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0	PCIe 7.0
单通道传输速率	32 GT/s	32 GT/s	64 GT/s	128 GT/s
关键功能特性	1、实现 CPU 与加速器的缓存一致性通信，首次打破数据搬运壁垒； 2、仅支持单设备直连，资源调度能力有限	1、新增内存池化技术，支持多主机共享同一内存设备资源； 2、支持交换机拓扑，实现多设备互联扩展	1、升级为多级、多主机拓扑，支持机柜级大规模设备互连； 2、支持跨节点资源调度，适配 AI 大模型训练的海量内存需求	1、新增端口捆绑技术，提升多设备连接的稳定性与带宽利用率； 2、新增端到端加密，提升数据安全等级； 3、实现零额外延迟，适配实时 AI 推理、高性能计算低延迟场景
典型应用场景	入门级异构计算、单节点服务器加速	云计算数据中心、企业级存储共享	AI 大模型训练集群、高性能计算、超大规模云基础设施	下一代 AI 算力中心、存算一体数据中心

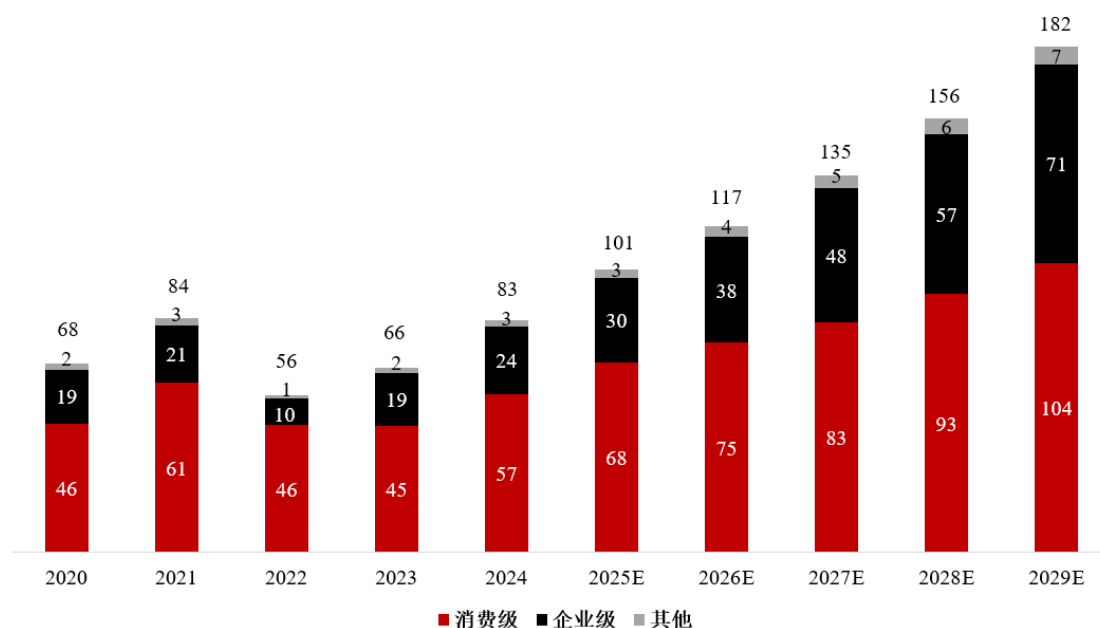
CXL 技术标准的应用正从早期的内存扩展向存算一体、资源池化等场景深化。根据行业技术路线图，2026 至 2028 年将是 CXL 技术从标准制定迈向规模化商用的关键阶段，尤其在 AI 训练与推理、高性能计算等领域，CXL 技术以其优秀的内存语义访问与资源池化能力，预计将成为下一代算力中心的主流互联方案之一。铠侠计划依托 PCIe 6.0 主控芯片在 2026 年底实现 1,000 万 IOPS 的性能目标，而 CXL 技术的加持可进一步释放硬件潜力，助力 SSD 在 AI 推理、高性能计算等场景中实现存算一体化。随着 AI 算力中心、云计算、边缘计算等场景需求的爆发，CXL SSD 预计将成为新一代基础设施的标配，带动企业级 SSD 市场规模快速增长。

(2) 固态硬盘主控芯片市场

①全球固态硬盘主控芯片市场规模情况

受益于服务器等下游需求驱动，固态硬盘主控芯片市场规模快速扩张，未来固态硬盘主控芯片需求将在 AI、5G 以及汽车智能化的驱动下步入下一轮成长周期。根据 Frost&Sullivan 统计，2024 年全球固态硬盘主控芯片市场规模为 83 亿元，预计 2029 年全球固态硬盘主控芯片市场规模将达到 182 亿元。

2020-2029 年全球固态硬盘主控芯片行业市场规模情况 (亿元)

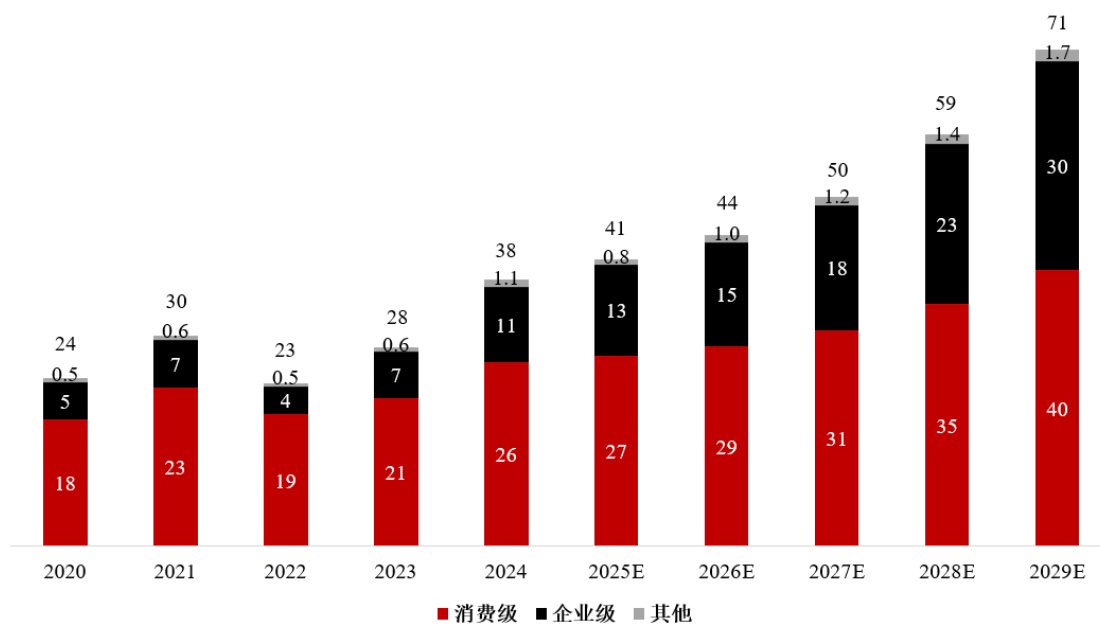


数据来源: Frost&Sullivan

②中国固态硬盘主控芯片市场规模情况

固态硬盘主控芯片市场规模中国占全球比重也在逐渐增加,从 2020 年的 35.29%,增加至 2024 年的 45.78%。根据 Frost&Sullivan 统计,2024 年中国固态硬盘主控芯片市场规模为 38 亿元,预计 2029 年中国固态硬盘主控芯片市场规模将达到 71 亿元,年均复合增长率 13.32%。

2020-2029 年中国固态硬盘主控芯片行业市场规模情况 (亿元)



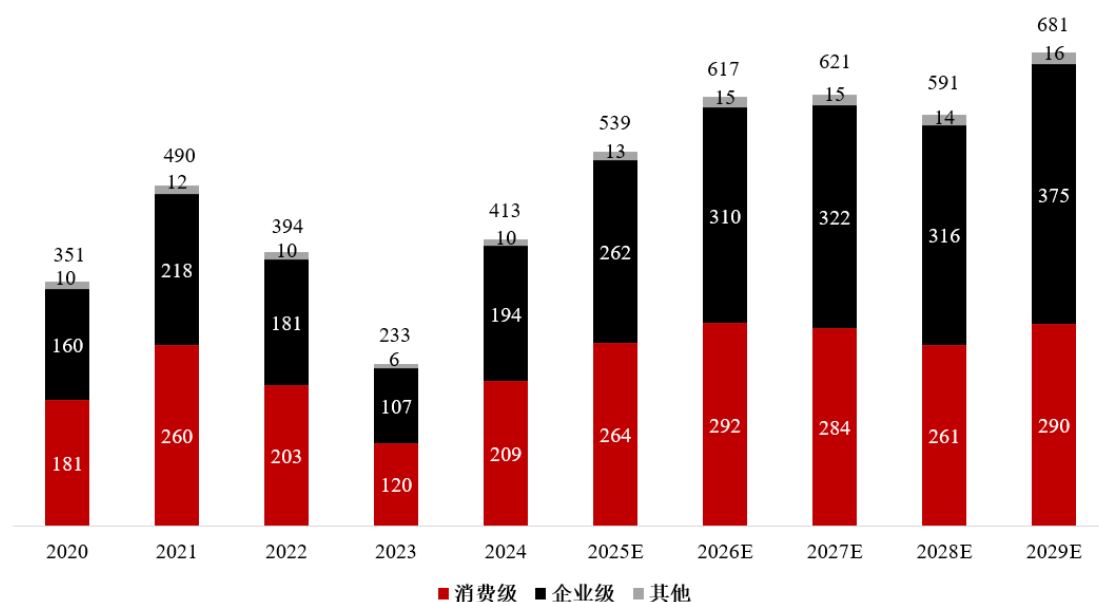
数据来源: Frost&Sullivan

(3) 固态硬盘市场

①全球固态硬盘市场规模情况

随着半导体存储周期性复苏,数字经济规模持续扩大。根据 Frost&Sullivan 统计,2024 年,全球固态硬盘市场规模为 413 亿美元,并将随着存储行业需求提振不断增长,预计 2029 年市场规模将达到 681 亿美元,年复合增长率达到 10.52%,其中,企业级固态硬盘占比将持续上升,其在终端数据中心等场景的应用覆盖率不断增加。

2020-2029 年全球固态硬盘行业市场规模情况(亿美元)

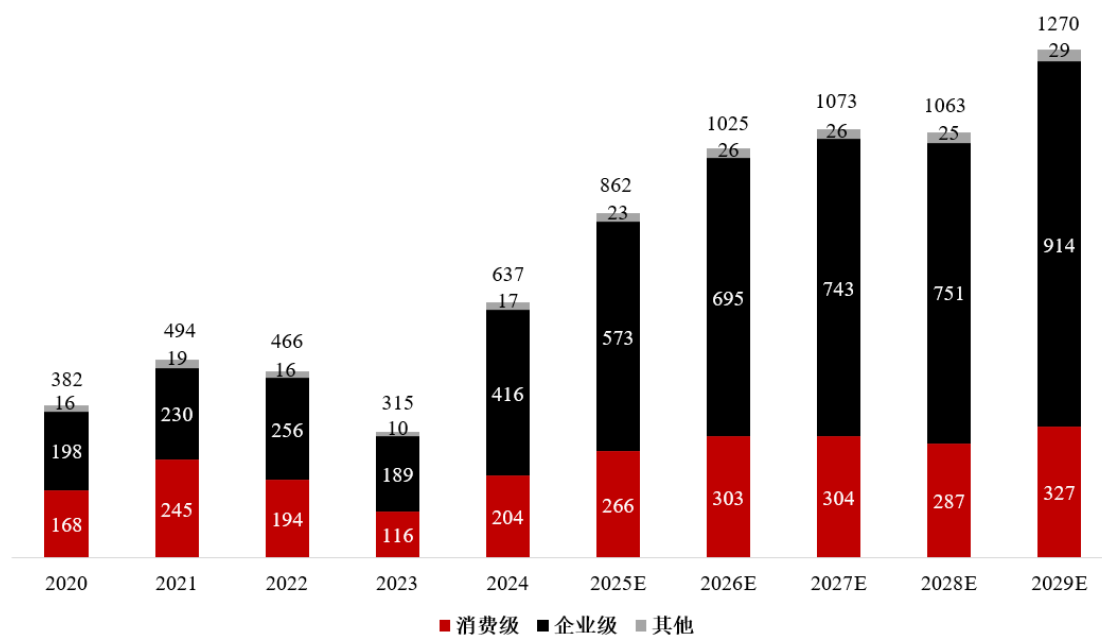


数据来源: Frost&Sullivan

②中国固态硬盘市场规模情况

随着 AI 应用推动存储需求,叠加服务器厂商需求升温,固态硬盘采购需求明显增长。根据 Frost&Sullivan 统计,2024 年,中国固态硬盘市场规模为 637 亿元,预计中国固态硬盘市场规模将保持增长,2029 年将达到 1,270 亿元,年复合增长率为 14.80%。

2020-2029 年中国固态硬盘行业市场规模情况 (亿元)



数据来源: Frost&Sullivan

(四) 行业发展面临的机遇和挑战

1、行业机遇

(1) 国家政策大力支持存储市场发展

近年来,国家层面密集出台系列政策,为数据存储主控芯片及固态硬盘行业带来显著发展机遇。《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》等政策相继出台,明确要求加强关键信息基础设施安全保护,其中特别规定“关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储”。这一政策导向正推动金融、能源、交通、政务等重要行业加速数据中心建设与升级,直接带动存储设备需求增长。在自主可控的战略要求下,上述关键领域的存储设备采购正加速向国产化产品倾斜,为国内企业级固态硬盘及主控芯片厂商提供了明确的增量市场。

(2) 国内外市场需求快速增长

随着数字经济的高速发展,国内外数据存储主控芯片及固态硬盘行业迎来多重增长契机。在人工智能领域,大模型训练需要高带宽、低延迟的存储解决方案,推动 PCIe 5.0/6.0 等高接口标准固态硬盘需求激增, AI 训练集群的存储投资占比大幅提升, GPU 直连存储解决方案的推出进一步增加了对高性能固态硬盘的刚

性需求；在云计算与大数据领域，企业上云进程加速带动数据中心建设热潮，全球超大规模数据中心数量迅速增长，同时对企业级固态硬盘的容量和可靠性提出更高要求。

(3) 国产化替代进程不断深化

在当前国际贸易环境背景下，存储芯片国产化已上升为国家战略，为国产厂商创造了快速发展的机遇。目前我国存储芯片自给率较低，特别是在企业级高端市场，国外品牌仍占据主导地位。随着国家战略规划明确提出要强化集成电路等关键核心技术攻关，存储芯片作为信息技术应用的核心部件，国产化份额逐步扩大。同时，国内颗粒厂商的技术突破为产业链上下游协同创新奠定了基础，具备数据存储主控芯片完整自研能力的企业将在这一轮国产化替代进程中获得先发优势。

2、面临的挑战

(1) 半导体存储专业人才短缺

半导体存储行业作为技术密集型产业，高度依赖技术及专业化人才。与产业发展成熟的韩国、美国等国家相比，中国在存储芯片领域的高端人才储备存在明显差距。存储主控芯片设计需要架构、算法、固件等多学科交叉知识，人才培养周期较长。尽管近年来国家通过设立集成电路一级学科、加大人才培养投入等措施缓解人才短缺，但在数据存储主控芯片领域仍存在较大缺口，尤其是兼具丰富的研发经验和管理能力的高端人才，这直接制约了行业技术创新步伐和产品迭代速度。

(2) 技术迭代快

数据存储行业正面临技术快速演进带来的严峻挑战。在数据存储主控芯片层面，接口标准已从 PCIe 3.0 快速演进至 PCIe 6.0，传输速率提升四倍以上，对芯片设计复杂度、信号完整性提出极高要求。闪存颗粒方面，3D NAND 堆叠层数从 64 层向现阶段 300 层以上发展，颗粒特性变化要求主控芯片持续优化纠错算法和读写管理策略。这种快速技术迭代导致单个芯片项目的研发投入呈指数级增长，先进工艺节点下，一次流片成本可能高达上千万美元。同时，企业需要并行开展多代技术研发，以现有产品保障当期收入的同时，投入 PCIe 6.0 等前沿技术

研发，这也进一步加深了研发压力。

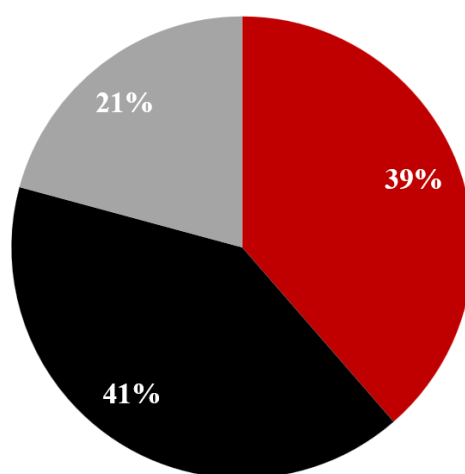
(五) 发行人市场地位和行业竞争格局

1、发行人市场地位和技术水平

(1) 固态硬盘

固态硬盘厂商可以分为全自研主控芯片厂商（如英韧科技）、半自研半外采主控芯片厂商（如大普微）和外采主控芯片厂商（如忆恒创源）。全自研主控芯片厂商一般具备完整的芯片自研能力，依托自主研发的核心技术，提供高性能、高可靠性的主控芯片。由于研发覆盖芯片、固件及模组全流程设计，该类厂商能对产品性能、功耗、可靠性及固件算法进行最深层次的优化，实现软硬件的高度协同，技术上的自主性使得该类厂商能快速响应市场需求，推出新品。根据 Frost&Sullivan 统计，2024 年中国 SSD 市场不同类型厂商的市场份额情况如下：

2024 年中国 SSD 市场不同类型厂商的市场份额



■ 全自研主控芯片厂商 ■ 半自研半外采主控芯片厂商 ■ 外采主控芯片厂商

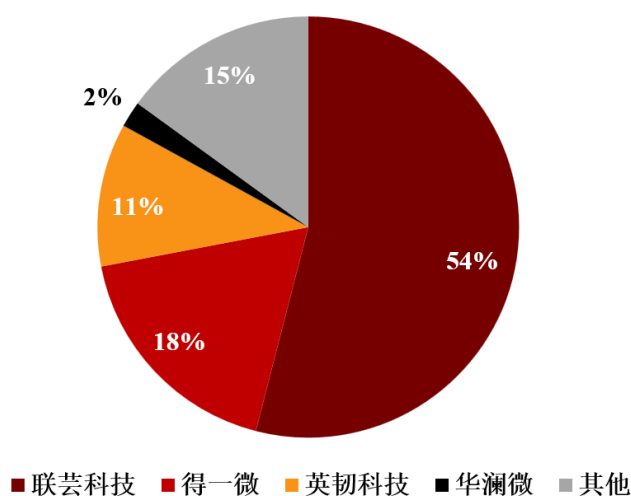
根据 Frost&Sullivan 统计，在 2024 年中国固态硬盘市场中，公司在全部采用自研主控芯片的境内固态硬盘厂商中排名第一。

(2) 固态硬盘主控芯片

固态硬盘主控芯片厂商可以分为 NAND 原厂自研自用固态硬盘主控芯片厂商、非 NAND 原厂自研自用固态硬盘主控芯片厂商、独立固态硬盘主控芯片厂商。根据 Frost&Sullivan 统计，在独立固态硬盘主控芯片市场，2024 年公司销售

规模在境内厂商中排名第三，具体情况如下：

2024 年境内独立固态硬盘主控芯片厂商竞争格局



数据来源：Frost&Sullivan

2、行业竞争格局及主要竞争对手

公司是以完整自研高性能数据存储主控芯片技术与产品为基础，将业务逐步拓展至企业级固态硬盘的半导体存储解决方案提供商。目前 A 股上市公司中，暂无与发行人产品和业务完全可比的公司，因此分别从数据存储主控芯片产品可比和固态硬盘产品可比角度选取多家代表公司进行对比。

数据存储主控芯片产品可比方面，发行人选取了 6 家数据存储主控芯片知名厂商作为同行业可比公司，境外公司为 Marvell、慧荣科技、群联电子、FADU，境内公司为联芸科技、平头哥；固态硬盘产品可比方面，发行人选取了 5 家固态硬盘知名厂商作为同行业可比公司，境外公司为三星电子、SK 海力士，境内公司为大普微、忆联信息、忆恒创源。

佰维存储、德明利的固态硬盘产品主要应用于消费级领域，与公司固态硬盘产品主要应用领域存在差异，但考虑到佰维存储、德明利均为 A 股上市公司且公开数据可获得，因此将其作为同行业境内可比上市公司。

(1) 同行业可比公司情况

公司名称	所属地区	2025 年营业收入	主营业务及市场地位
三星电子	韩国	333.61 万亿韩元	全球半导体产业龙头，在闪存颗粒和 DRAM 市场占有率全球第一，具备从芯片设计到存储模组的全产业链整合能力。其存储领域技术积累深厚，

公司名称	所属地区	2025 年营业收入	主营业务及市场地位
			企业级固态硬盘产品在全球数据中心市场占据主导地位。
SK 海力士	韩国	97.15 万亿韩元	全球领先的存储器解决方案供应商，DRAM 与闪存颗粒市场份额稳居全球前三。2021 年完成对英特尔闪存及固态硬盘业务的收购，成立 Solidigm 品牌，进一步强化在企业级存储市场的产品布局与技术积累。
Marvell	美国	81.95 亿美元	全球领先的数据基础设施半导体解决方案提供商，成立于 1995 年，为主控芯片领域的技术先驱，在全球主控芯片市场的占有率长期保持前三位。
FADU	韩国	924.19 亿韩元	FADU 成立于 2015 年，核心产品为 PCIe 系列固态硬盘主控芯片及配套企业级固态硬盘成品，主打高性能与低功耗优势，产品广泛应用于企业级市场。
群联电子	中国台湾	726.64 亿新台币	群联电子成立于 2000 年，是中国台湾领先的存储控制芯片设计企业，主营业务涵盖存储主控芯片、固态硬盘成品、移动存储解决方案等。其主控芯片产品覆盖消费级、工业级、企业级全场景。
慧荣科技	中国台湾	8.86 亿美元	慧荣科技成立于 1995 年，总部位于中国台湾，是全球最大的数据存储主控芯片供应商，其产品广泛应用于资料中心、PC、手机、车用、商用及工控市场。
联芸科技	中国大陆	13.27 亿元	联芸科技成立于 2014 年，2024 年在上交所科创板上市。主营业务为数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的研发、设计及销售，主要产品应用于消费电子智能物联、工业控制、数据通信等领域。联芸科技在数据存储主控芯片领域，已成为全球出货量排名第二的独立固态硬盘主控芯片厂商。
大普微	中国大陆	22.89 亿元	大普微成立于 2016 年，主要从事数据中心企业级固态硬盘产品的研发和销售，2023 年中国市场企业级固态硬盘市占率第四、国内厂商第二。
佰维存储	中国大陆	113.02 亿元	佰维存储成立于 2010 年，2023 年在上交所科创板上市。主营业务为半导体存储器的研发、生产和销售。产品应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。
德明利	中国大陆	107.89 亿元	德明利成立于 2008 年，主要从事集成电路存储芯片设计、研发及产业化应用，是国内存储主控芯片行业第一家上市公司。自设立以来，其主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。
忆联信息	中国大陆	未披露	忆联信息成立于 2017 年，深耕企业级固态硬盘、数据中心级固态硬盘、消费级固态硬盘、嵌入式存储领域，为服务器、数据中心、个人电脑、移动终端、智能穿戴等应用提供高性能、高可靠性的产品与解决方案。

公司名称	所属地区	2025 年营业收入	主营业务及市场地位
忆恒创源	中国大陆	18.85 亿元	忆恒创源成立于 2011 年, 是一家企业级 PCIe SSD 产品和技术方案提供商, 产品应用于数据库、虚拟化、云计算、大数据、人工智能等领域。
平头哥	中国大陆	未披露	平头哥成立于 2018 年, 是阿里巴巴集团旗下专注于芯片研发的业务品牌, 存储领域聚焦固态硬盘主控芯片及存储系统解决方案。

(2) 与同行业公司产品技术指标的比较

公司数据存储主控芯片和固态硬盘已实现从 SATA 到 PCIe 5.0 的主流代次全覆盖, 以及企业级、消费级、工业级的应用领域全覆盖, 公司主要产品与同行业公司产品的对比情况如下:

①数据存储主控芯片

A. 消费级 PCIe 4.0 固态硬盘主控芯片

项目	发行人	联芸科技	慧荣科技	群联电子
型号	IG5222	MAP1602-C	SM2268XT2	PS5029-E29T
适配闪存类型	SLC/MLC/TLC/QLC	MLC/TLC/QLC	未披露	TLC/QLC
顺序读取速度 (MB/s)	7,400	7,400	7,400	7,400
顺序写入速度 (MB/s)	6,800	6,500	6,700	6,600
随机读取速度 (K IOPs)	1,200	1,000	1,200	1,000
随机写入速度 (K IOPs)	1,200	1,000	1,200	1,400

注: 顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度数值越大越好, 下同。

公司自研消费级 PCIe 4.0 主控芯片 IG5222 具有高性能、低功耗、较小芯片面积的产品特性, 相较于同行竞品, 在各项核心指标方面均对标行业最高水平。

B. 企业级 PCIe 4.0 固态硬盘主控芯片

项目	发行人	FADU	慧荣科技
型号	IG5638	FC4121	8266
适配闪存类型	SLC/MLC/TLC/QLC	未披露	未披露
顺序读取速度 (MB/s)	7,400	7,050	6,500
顺序写入速度 (MB/s)	7,000	4,200	3,500
随机读取速度	1,700	1,350	900

项目	发行人	FADU	慧荣科技
(K IOPs)			
随机写入速度 (K IOPs)	900	390	200
随机写入延迟 (μ s)	9	未披露	15

注：随机写入延迟为企业级固态硬盘主控芯片核心指标之一，数值越小越好，下同。

公司自研企业级 PCIe 4.0 主控芯片 IG5638 具备高性能、低延时的产品特性，适用于数据中心、云计算、AI 等下游应用。相较于同行竞品，IG5638 在各项核心指标方面均具备显著优势。

C. 企业级 PCIe 5.0 固态硬盘主控芯片

项目	发行人	平头哥	FADU	Marvell	慧荣科技
型号	YRS900	镇岳 510	FC5161	MV-SS1331/S S1333	SM8366
适配闪存类型	SLC/MLC/TL C/QLC	TLC/QLC	TLC	SLC/MLC/TL C/QLC	TLC/QLC
顺序读取速度 (MB/s)	14,700	14,000	14,000	14,000	14,200
顺序写入速度 (MB/s)	12,000	10,000	12,000	9,000	9,400
随机读取速度 (K IOPS)	3,500	3,400	3,500	2,000	3,500
随机写入速度 (K IOPS)	2,500	2,500	1,600	1,000	2,800
随机写入延迟 (μ s)	4	<4	10	<6	9

公司自研企业级 PCIe 5.0 主控芯片 YRS900 在顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度、随机写入延迟等核心指标方面均优于或与同行业公司主流产品持平。

②固态硬盘

A. 企业级 PCIe 4.0 固态硬盘

项目	发行人	大普微	忆联信息	忆恒创源	三星电子	Solidigm
型号	Dongting-N2 2000	R5100	UH811a	PBlaze6 6930	PM1733	D7-P5520
可用容量 (TB)	7.68					
顺序读取速度 (MB/s)	7,400	7,400	7,100	6,900	7,500	7,100
顺序写入速	6,700	5,500	4,500	7,000	6,000	4,200

项目	发行人	大普微	忆联信息	忆恒创源	三星电子	Solidigm
度 (MB/s)						
随机读取速度 (K IOPs)	1,700	1,750	1,700	1,600	1,700	1,100
随机写入速度 (K IOPs)	370	280	210	340	300	220
随机读取延迟 (μ s)	55	65	96	69	未披露	75
随机写入延迟 (μ s)	9	9	17	9	未披露	15

注：顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度数值越大越好，随机读取延迟、随机写入延迟数值越小越好，下同。

公司企业级 PCIe 4.0 固态硬盘 Dongting-N2 2000 在顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度、随机读取延迟、随机写入延迟等核心指标方面均优于或与同行业公司主流产品持平。

B. 企业级 PCIe 5.0 固态硬盘

项目	发行人	大普微	忆联信息	忆恒创源	三星电子	Solidigm	华为
型号	Dongting-N3	R6101	UH812a	PBlaze7 7A40	PM1743	D7-PS1010	SP560
可用容量 (TB)	7.68						
顺序读取速度 (MB/s)	14,600	14,500	14,900	14,100	14,000	14,500	14,700
顺序写入速度 (MB/s)	12,400	11,000	10,500	11,200	6,000	10,000	11,200
随机读取速度 (K IOPs)	3,500	3,400	3,500	3,300	2,500	3,000	3,500
随机写入速度 (K IOPs)	620	500	470	500	300	400	600
随机读取延迟 (μ s)	52	52	55	55	未披露	60	52
随机写入延迟 (μ s)	5	7	7	5	未披露	7	5.4

公司企业级 PCIe 5.0 固态硬盘在顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度、随机写入延迟等核心指标方面均优于或与同行业公司主流产品持平。

C. 高性能 AI SSD

项目	发行人	华为
型号	Dongting-N3X	EX560
接口类型	PCIe 5.0	PCIe 5.0
可用容量 (TB)	1.6	
顺序读取速度 (MB/s)	14,000	14,900
顺序写入速度 (MB/s)	11,000	12,000
随机读取速度 (K IOPs)	3,500	2,863
随机写入速度 (K IOPs)	1,600	1,500
随机读取延迟 (μ s)	18	40
随机写入延迟 (μ s)	4	5.4

注：目前行业内除发行人及华为外，暂无其他公司发布高性能 AI SSD 产品。

公司高性能 AI SSD 在随机读取速度、随机写入速度、随机写入延迟等核心指标方面均优于华为主流产品，顺序读取速度、顺序写入速度略低于华为。

（六）发行人的竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）具备主控芯片完整自研能力及全球化的技术布局

公司具备完整的芯片自研能力，研发流程覆盖芯片算法设计、架构与固件联合设计、数字与模拟 IP 设计、芯片后端设计、FPGA 等硅前验证、硅后系统验证，实现了从 SATA 到 PCIe 全系列技术覆盖，并在固件内算法实现和模组设计上实现全面自研。公司坚持自主研发主控芯片和固件内算法实现，通过多代际技术迭代，已成功推出覆盖 SATA、PCIe 3.0、PCIe 4.0 及 PCIe 5.0 等接口标准的主控芯片产品，并配套自研固件，支持并行队列动态管理、智能资源管理和颗粒管理与优化等先进算法。这种芯片完整自研模式不仅确保了产品性能的持续领先，还赋予公司快速响应市场变化的能力，能够根据客户需求高效实现功能定制和迭代升级，缩短产品研发周期。

技术布局方面，公司核心研发成果已在全球主要市场获批专利，构建起国际化的知识产权保护体系，为产品全球推广奠定合规基础。公司坚持“自主创新+全球协同”的研发模式，与国际存储行业龙头企业深度合作，最新一代 CXL 芯片是国内首颗获得国际颗粒原厂合同的主控芯片，并将与国内外 GPU 大厂深度

协同，为尖端 AI 应用场景提供高带宽、低延迟存算一体解决方案。同时，在国产化替代趋势下，公司通过核心技术自主可控，有力推动了存储产业链关键环节的国产化进程，降低对外部技术的依赖，保障数据存储安全。

(2) 具有完整的产品矩阵

公司产品矩阵横跨企业级、消费级和工业级市场，形成了多元化的业务布局，显著增强了抗市场风险能力。公司针对不同应用场景开发了适配数据中心、消费电子、工业物联网等多层次的产品线。多元化策略使公司能够灵活应对下游行业波动，避免单一市场依赖，例如在消费电子需求疲软时，企业级和工业级业务仍能提供稳定收入来源。同时，公司通过产品技术的持续迭代，实现跨产品线的研发资源高效复用，降低研发成本，提升整体运营效率。这种协同效应不仅强化了产品竞争力，还为公司在人工智能等新兴领域业务的快速扩展奠定基础。

(3) 拥有下游领域的头部客户资源

公司秉持“立足中国，服务全球”的宗旨，拥有广泛的国际国内头部客户资源，形成了坚实的客户基础和市场认可。公司产品广泛应用于下游技术要求最高的企业级客户与知名消费级客户，并实现规模出货，包括客户 A、联想、新华三、客户 C、长江计算、超云、长城等国内头部服务器厂商，客户 B、Bilibili、腾讯等互联网及云计算厂商，客户 E、闪迪、威刚科技、佰维存储、江波龙等国际颗粒原厂及存储模组厂商，终端客户触达互联网、云计算、AI 模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等各主要细分应用场景。企业级和工业级客户对产品可靠性、性能及售后服务要求极高，通常需经过历时较长的严苛导入流程，一旦完成即形成高黏性合作关系。公司凭借芯片及固态硬盘全栈自研优势，能够提供定制化解决方案和持续固件更新，满足客户在数据存储性能、安全性和适配性方面的深度需求，从而巩固长期合作。优质客户资源的积累在驱动业务规模快速增长的同时，进一步提升品牌影响力，为公司在全球市场中与国际龙头厂商同台竞技提供支撑。

(4) 核心团队拥有顶尖的行业经验和国际化视野

公司核心团队具有丰富的存储行业从业经历、领先的国际视野和实践经验，具备国际领先存储企业的资深工作经验，深入理解全球存储产业的技术趋势、市

场规则与创新路径。

公司始终坚持“全球引才”的人才战略，积极吸纳全球范围内的顶尖技术人才，构建起一支分工明确、凝聚力强、兼具国际视野与本土实践能力的核心团队。团队不仅具备完整自主的芯片研发与迭代能力，更拥有强烈的知识产权保护意识，严格遵守全球知识产权规则，为公司持续保持产品领先，突破关键领域核心技术，实现国产替代，赋能我国大数据存储自主可控战略奠定了坚实的基础，具有显著的竞争优势。

2、竞争劣势

(1) 融资方式单一

目前公司正处于快速发展阶段，在研发投入、人才引进、设备购置、市场拓展等方面均迫切需要大量资金，但是公司目前主要的资金来源为股东投资，资金来源有限，未来迫切需要拓宽融资渠道，寻求更多的资金支持，保证产品端的持续创新和产品板块的整体扩展。

(2) 经营规模相对较小，规模效应尚未充分显现

公司近年来业务发展迅速，产品线已覆盖从 SATA 到 PCIe 5.0 的多代际存储解决方案，并在互联网、云计算、AI 模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等重要领域实现批量出货，销售规模亦快速增长，营业收入由 2023 年的 35,777.31 万元增长至 2025 年的 103,418.31 万元，但与国际存储行业龙头企业相比，公司现阶段在营业收入、市场份额、经营规模等方面仍有一定差距。

三、发行人销售情况和主要客户

(一) 主要产品的销售情况

1、主营业务收入主要构成

公司主营业务的收入构成情况参见“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入构成及变动分析”的相关内容。

2、主要产品的产能、产量和销量情况

报告期内，公司芯片产品制造采用 Fabless 模式，固态硬盘组装生产等环节

均为委外生产，不存在产能限制。公司主要产品的产销情况如下：

单位：万颗、万TB

期间	产品类别	产量	销量	产销率
2025 年度	数据存储主控芯片	784.14	396.48	50.56%
2024 年度		662.46	611.26	92.27%
2023 年度		911.27	882.24	96.81%
2025 年度	固态硬盘	168.04	159.22	94.75%
2024 年度		94.09	82.12	87.28%
2023 年度		51.47	44.64	86.72%

注：数据存储主控芯片产量及销量不包含用于固态硬盘部分。

(二) 主要客户情况

报告期内，公司对前五大客户销售情况如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	销售金额	占收入总额比例
2025 年	1	客户 A	29,091.86	28.13%
	2	客户 B	26,391.95	25.52%
	3	联想	7,361.36	7.12%
	4	新华三	5,318.92	5.14%
	5	畅快算	4,057.16	3.92%
	合计			72,221.25
2024 年	1	客户 A	12,321.58	19.72%
	2	芯科睿	11,372.01	18.20%
	3	德梧信息	4,064.04	6.50%
	4	客户 D	3,955.80	6.33%
	5	湖南天硕	3,912.82	6.26%
	合计			35,626.25
2023 年	1	佰维存储	9,255.27	25.87%
	2	芯科睿	7,604.07	21.25%
	3	江波龙	4,421.83	12.36%
	4	威刚科技	4,151.34	11.60%

时间	序号	客户名称	销售金额	占收入总额比例
	5	时创意	2,817.35	7.87%
	合计		28,249.86	78.96%

注：同一控制下企业已合并计算。

报告期内，公司前五大客户包括客户 A、联想、新华三等服务器厂商，客户 B 等互联网及云计算厂商，以及佰维存储等存储模组厂商，公司向上述客户销售的产品包括固态硬盘及数据存储主控芯片等，不存在向单个客户销售比例超过营业收入 50% 的情形。

上述客户中，佰维存储系公司关联方，具体关联关系及与公司业务合作情况参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“八、关联交易情况”相关内容。除此之外，上述主要客户与公司及其董事、高级管理人员、核心技术人员及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系。

四、发行人采购情况和主要供应商

(一) 主要采购情况

1、主要原材料采购情况

(1) 主要原材料采购金额情况

公司采购的主要原材料主要包括 NAND 闪存颗粒、晶圆和 DRAM。报告期内，公司原材料主要采购情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
NAND	84,543.76	68.79%	60,249.96	74.77%	10,807.99	52.50%
晶圆	14,859.08	12.09%	13,372.32	16.59%	8,754.11	42.52%
DRAM	15,015.99	12.22%	2,318.71	2.88%	388.33	1.89%
其他	8,489.85	6.91%	4,642.87	5.76%	636.57	3.09%
合计	122,908.67	100.00%	80,583.86	100.00%	20,587.01	100.00%

(2) 主要原材料价格变动趋势

报告期内，公司各类主要原材料采购单价变化情况如下表所示：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	单价	变动率	单价	变动率	单价
NAND	2.20	-9.24%	2.42	142.03%	1.00
晶圆	1.29	12.35%	1.15	14.93%	1.00
DRAM	3.68	329.60%	0.86	-14.41%	1.00

注：上述采购单价属于发行人商业秘密，故分别以 2023 年度采购单价作为 1.00 基准，以系数表示不同年度间采购单价的差异。

2024 年公司 NAND 闪存颗粒采购单价上涨，主要系当年 NAND 闪存颗粒市场价格上涨及公司增加企业级 NAND 闪存颗粒采购占比；2025 年公司采购单价略微下降，主要系公司经营规模扩大后采购议价能力提高。

2024 年，公司 DRAM 采购单价下滑，主要系采购 DRAM 容量规格的调整；2025 年，随着三季度以来 DRAM 原材料市场价格剧烈上涨，公司采购单价相应上涨。

2、委托加工情况

公司的主营产品数据存储主控芯片的封装及测试环节及固态硬盘的组装制造均采用委托加工模式。报告期内，公司采购委托加工交易金额如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
封装费	3,739.31	44.75%	2,966.03	50.12%	4,047.15	71.64%
委托组装费	2,579.32	30.87%	1,694.89	28.64%	310.78	5.50%
测试费	1,637.57	19.60%	1,237.91	20.92%	1,287.99	22.80%
其他	399.75	4.78%	18.90	0.32%	3.29	0.06%
合计	8,355.96	100.00%	5,917.74	100.00%	5,649.21	100.00%

注：上述委托组装费不包含代工厂代采辅料的金额，相关采购统计在外购原材料中。

报告期内，公司采购委托加工服务单价如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	单价	变动率	单价	变动率	单价
封装费	1.13	8.43%	1.04	3.98%	1.00
委托组装费	0.91	-8.23%	0.99	-0.89%	1.00

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	单价	变动率	单价	变动率	单价
测试费	1.34	6.27%	1.26	25.84%	1.00

注：上述采购单价属于发行人商业秘密，故分别以 2023 年度采购单价作为 1.00 基准，以系数表示不同年度间采购单价的差异。

2、主要能源采购情况

公司主要从事数据存储主控芯片和固态硬盘的研发、设计及销售，主要能源采购为水电。报告期内，公司经营活动耗用的能源主要为办公用水用电，均由市政供应，价格稳定且消耗量较小，占公司整体成本和费用的比例较低，未对公司的经营业绩造成重大影响。

(二) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商采购的情况如下表所示：

时间	序号	供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额比例
2025 年	1	雅创电子	29,709.86	22.63%
	2	供应商 B	23,629.50	18.00%
	3	宏芯凯	20,305.17	15.47%
	4	供应商 D	13,782.36	10.50%
	5	艾登集团	4,572.83	3.48%
		合计		91,999.72
2024 年	1	供应商 A	20,010.78	23.13%
	2	供应商 B	9,122.94	10.55%
	3	供应商 D	8,012.02	9.26%
	4	优特技术	6,409.70	7.41%
	5	知芯微	5,381.68	6.22%
		合计		48,937.13
2023 年	1	供应商 E	5,296.17	20.19%
	2	WINWARD	3,502.10	13.35%
	3	供应商 D	3,078.04	11.73%
	4	供应商 A	3,030.12	11.55%

时间	序号	供应商名称	采购金额(万元)	占采购总额比例
	5	供应商 F	3,027.92	11.54%
	合计		17,934.36	68.36%

注：同一控制下企业已合并计算。

报告期内，公司主要向外部采购 NAND 闪存颗粒、晶圆、DRAM 以及主控芯片代工和固态硬盘委外组装等，公司对前五大供应商采购占比分别为 68.36%、56.57%和 70.09%。报告期内，公司不存在向单一供应商采购占比超过 50%的情形。发行人及其董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述前五大供应商中未占有任何权益。

五、发行人主要固定资产和无形资产

(一) 主要固定资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人固定资产包括电子设备、机器设备和办公家具，具体情况如下：

单位：万元

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
电子设备	1,971.12	1,351.03	620.09	31.46%
办公家具	126.21	94.38	31.83	25.22%
机器设备	4,984.16	3,871.92	1,112.24	22.32%
合计	7,081.50	5,317.33	1,764.16	24.91%

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人未拥有自有房屋及建筑物，用于业务开展及经营的租赁房屋情况具体如下：

序号	承租人	出租人	租赁地址	面积(m ²)	租赁期限	租赁用途
1	英韧科技	上海张江集成电路产业区开发有限公司	上海市张江高科技园区盛夏路 565 弄 40 号 601-606 室	2,021.84	2024.10.01-2027.09.30	办公
2	英韧科技	北京中基宏源房地产开发有限公司	北京市海淀区北三环西路 99 号院西海国际中心 1 号楼 9 层 907-3 单元	125.00	2024.11.01-2026.12.31	办公
3	长鹰芯存	上海开创企业发展有限公司	上海市静安区康宁路 288 弄 2 号 2 层 201 室	581.29	2025.05.04-2027.05.03	办公
4	南京英韧	南京芯聚睿科技发展有限公司	南京市浦口经济开发区中科创创新产业园 C10 独栋房间	2,214.00	2021.11.01-2027.01.31	办公

序号	承租人	出租人	租赁地址	面积(m ²)	租赁期限	租赁用途
5	深圳英韧	中国长城科技集团股份有限公司	深圳市南山区粤海街道科发路中电长城大厦(工业区)A座5层502、503、504号	761.36	2023.11.01-2026.10.31	办公
6	成都英韧	成都华诚信息产业有限公司	成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元601	1,308.73	2024.05.07-2026.05.06 [注]	办公
7	武汉英韧	武汉市星火源科技企业孵化器有限公司	武汉市江夏区大桥新区智能制造产业基地8号楼2层G001工位	6.00	2025.12.25-2027.12.24	办公

注：成都英韧已于2026年5月同成都华诚信息产业有限公司就该租赁物业签署新的租赁合同完成续租，租赁期限为2026年5月7日起至2028年5月6日。

(二) 主要无形资产

1、专利

截至2025年12月31日，发行人及其控股子公司拥有63项中国境内专利、102项境外专利，其中发明专利156项、实用新型专利2项、外观设计专利7项。已授权专利具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、发行人主要无形资产”。

2、商标

截至2025年12月31日，发行人及其控股子公司拥有77项中国境内注册商标、4项境外注册商标，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、发行人主要无形资产”。

3、软件著作权

截至2025年12月31日，发行人及其控股子公司拥有13项软件著作权，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、发行人主要无形资产”。

4、集成电路布图设计专有权

截至2025年12月31日，发行人及其控股子公司拥有39项集成电路布图设计专有权，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、发行人主要无形资产”。

(三) 主要经营资质情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有的主要经营资质情况如下：

序号	证书名称	证书编号	备案日期/有效期限	颁证机关
1	高新技术企业证书	GR202431006551	2024年12月-2027年12月	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局
2	质量管理体系认证 ISO 9001:2015	CN052925	2024年12月-2027年11月	必维认证集团认证控股有限公司
3	环境管理体系认证 ISO 14001:2015	CN051603	2024年9月-2027年9月	必维认证集团认证控股有限公司
4	职业健康安全管理体系认证 ISO 45001:2018	CN051604	2024年9月-2027年9月	必维认证集团认证控股有限公司
5	信息安全管理体系认证 ISO/IEC 27001:2022	IS791381	2024年2月-2027年2月	British Standards Institution
6	海关进出口货物收发货人备案	310696002T	2020年11月至长期	上海车站海关
7	海关进出口货物收发货人备案	320136027Y	2019年8月至长期	金陵海关
8	海关进出口货物收发货人备案	3122249788	2018年5月至长期	浦东海关

(四) 上述资产与公司产品或服务的内在联系及对公司持续经营的影响

发行人专注数据存储主控芯片和固态硬盘的研发、设计及销售，目前相关生产环节委外完成，发行人及子公司均不直接从事生产制造业务。发行人拥有的固定资产、无形资产、经营资质等资源要素，是从事固态硬盘主控芯片设计研发、固件内算法实现和模组研发设计的必要基础，资产情况契合发行人目前的主营业务和经营模式。

(五) 各要素瑕疵、纠纷情况

截至本招股说明书签署日，发行人主要固定资产、无形产权属清晰，不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，对发行人持续经营不存在重大不利影响。

(六) 拥有的特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，发行人未拥有特许经营权。

六、发行人核心技术及研发情况

(一) 核心技术情况

1、发行人的核心技术

公司通过自主研发的方式形成了具备较强行业竞争力的核心技术体系，在各系列主要产品中发挥了重要作用，截至本招股说明书签署日，公司的核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
一、芯片设计、固件与算法技术			
1	超强纠错编解码技术	自主研发	包括先进的低密度奇偶校验码（LDPC 码）、高效的编解码算法架构、超短延时的 BCH 编解码引擎等一系列 ECC 算法、固件框架以及一系列对应的芯片内加速器 IP。该技术在极大提高数据容错性和固态硬盘使用寿命的同时，增加系统的吞吐量并有效的控制系统功耗和成本。
2	灵活配置的地址映射技术	自主研发	该技术支持动态配置地址映射大小和无 DDR 地址映射，解决大容量固态硬盘的 L2P 映射表的额外的存储消耗和转换过程中的地址空间浪费，使得在有限的 DRAM 的资源下实现更大容量，从而提升存储主控芯片可支持的最大容量。
3	融合 CPU IP 和加速器 IP 的多核低功耗架构	自主研发	在存储主控芯片设计中使用业内主流的 ARM 处理器架构，并且在 PCIe 5.0 主控芯片设计中采用 RISC-V 处理器架构，通过处理器核与多个加速器 IP 之间，以及处理器核与核之间的高速通信与协同工作，以较低功耗实现高算力，保证存储设备拥有更好性能、更低功耗和更高可靠性，并推进 RISC-V 架构在存储领域的应用落地。
4	增强型 HMB 设计	自主研发	增强型 HMB（Host Memory Buffer）技术依靠主控芯片内的固件与对应的加速器 IP 共同合作，直接调用主系统内存，使得固态硬盘无需再具备专用的缓存芯片，节省成本的同时仍能够保证产品性能。
5	融合 CXL 协议和闪存控制的技术	自主研发	CXL 协议扩展了主机和存储子系统进行通信的距离，允许主机跨越更远距离与存储目标进行通信，同时保持超低延时。公司开发的结合 CXL 和闪存的技术为主机提供了大容量、低延时的内存扩展方案。
二、颗粒适配与加速技术			
1	软硬件结合的颗粒适配与加速技术	自主研发	公司全系列产品均支持并行多个 NAND 通道，通过 ONFI 和 Toggle 等接口支持 SLC（单层单元）、MLC（多层单元）、TLC（三层单元）和 QLC（四层单元）的 NAND 闪存颗粒。已完成多款 NAND 闪存适配，覆盖业界主流 NAND。
2	NAND 错误控制技术	自主研发	NAND 错误控制技术包括一系列具体技术以及在对应的一系列加速器 IP 内的实现，错误控制技术与 ECC 纠错技术互相配合，共同确保固态硬盘数据的可靠性与完整性。

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
3	超高速与混合自适应的闪存接口技术	自主研发	通过芯片内固件与闪存控制器 IP 的合作对闪存进行读写训练,从而找到每个闪存通道能够运行的最高速率,实现系统性能的最优化。
4	新一代高性能低延时 SCM 颗粒的适配与加速技术	自主研发	通过主控芯片内超短延时队列流水线、芯片内 CPU 核上固件算法以及可动态调度的颗粒指令序列设计,综合提高新一代 SCM 颗粒的可用寿命、读写带宽与数据吞吐性能。
三、企业与数据中心固态硬盘技术			
1	端到端数据保护技术	自主研发	端到端数据保护技术支持各种类型 CRC 和 memoryECC 对数据链路进行保护,并利用一系列芯片内加速器 IP 的相应子功能进行加速,除此以外,并引入内部 PI 的机制,确保数据在每一个传输环节的完整性。
2	数据安全引擎技术	自主研发	数据加密算法及其芯片内对应 IP 全面支持国家密码管理局审定批准的多种加密算法,并创新性的提供灵活高效的权限管理与分区加密功能,为用户认证和数据安全提供强有力保护。
3	高速 DDR 接口控制器	自主研发	公司高速 DDR 控制器 IP 支持多端口以及多种 ECC 模式,具有更高的预读取、更高的突发长度和更高的并行能力。
4	DDR 环回测试技术	自主研发	DDR 环回测试技术配合高速 DDR 接口控制器,通过多路复用和流程控制等技术,实现针对 DDR 控制器电子电路的环回测试方案,高效验证芯片的输入输出(IO)端口功能是否正常。
5	地址映射加速器技术	自主研发	L2P 地址映射加速器技术利用芯片内加速器 IP 来处理复杂的地址转化计算、快速查找有效存储单元、记录磨损周期并提供比较结果,保证大容量固态硬盘在系统中的可靠性和耐用性。
6	数据智能管理与压缩技术	自主研发	采取去重算法以及压缩算法,消除冗余数据,减少垃圾数据的收集,提升存储设备的使用效率和性能,同时对敏感数据提供符合用户特色的安全保护方式。
7	动态低功耗技术	自主研发	动态低功耗技术依靠芯片内一系列加速器与控制器 IP 内的相关功能,使得固件通过监控系统传输速率,灵活决定电源精细化管理状态,具有更低的进出延迟,同时又达到节省功耗的效果。
8	智能温控与高级电源管理技术	自主研发	智能控温与高级电源管理技术在固态硬盘的温度升高到可能对其造成损害时,自动减慢或限制固态硬盘的性能以降低温度并确保其安全运行,同时通过管理和优化固态硬盘的电源消耗,整体上降低固态硬盘功耗,延长寿命,并在需要时提供快速的响应。
9	固件安全启动技术与在线固件安全升级技术	自主研发	用于保护固态硬盘固件启动加载,防止未经授权的固件修改。
10	其他企业级模组技术	自主研发	通过企业级模组内部部件的键合设计、拓扑设计、信号完整性设计、热导设计等,为企业级模组高性能、低功耗与热管理的综合特性提供技术基础。
11	AI SSD 模组与硬件子系统综	自主研发	通过综合设计模组内并行队列与子系统队列的流水线与调度算法以及优化接口协议,提高 AI 存储系统的使用寿

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
	合设计		命、性能与功耗表现。

2、核心技术的保护措施

公司通过申请专利对核心技术进行保护的同时,根据自身实际情况制定并执行了较为完善的研发保密制度,明确研发部门各岗位职责与义务,重视员工保密意识培训,严格执行技术保密管理措施。此外,公司与研发技术人员及接触秘密信息的相关人员签署了劳动合同与保密协议,对技术秘密和商业秘密的内容与范围、员工保密义务、竞业限制、职务发明及成果归属等有关的事项进行了明确约定。

随着生产经营规模的不断扩大,公司正不断深化和完善核心技术的专利布局,截至 2025 年 12 月 31 日,公司已取得发明专利 156 项。

(二) 在研项目情况

截至报告期末,公司正在进行对公司目前及未来经营有重大影响的研究项目如下:

序号	项目名称	拟达到的研发目标	进展情况
1	企业级 PCIe 6.0 智能存储控制器芯片	自研数据存储主控芯片实现 PCIe 6.0 协议的升级;物理层速率达到 64 GT/s, PCIe 6.0x4 双向理论带宽不低于 26 GB/s;支持下一代 CPU 与 GPU 对于 I/O 速度的最新要求。同时,整合了 PCIe 6.0 的物理层协议与 CXL3.0 控制协议的新型产品,可以满足内存扩展和内存池化的要求	开发阶段
2	新一代低功耗消费级存储控制器芯片研发与产业化项目	自研无缓存低功耗 PCIe 4.0x4 存储主控芯片及相关产品的解决方案,为客户提供多种类型的闪存颗粒适配与优化。该产品采用结合硬件加速的无 DRAM 架构,在保持低峰值功耗的同时,可提供 7.4GB/s 和 6.8GB/s 的顺序读写速度	开发阶段
3	基于自研主控的企业级 PCIe 5.0 高性能固态硬盘项目	基于自研 PCIe 5.0 主控芯片,开发搭载多种闪存颗粒的企业级固态硬盘产品线,构建 PCIe 5.0 SSD 高性能产品矩阵。该产品系列顺序读写速度最高可达 14.6GB/s 和 12.4GB/s;随机读写速度可达 3.5M IOPS 和 1.1M IOPS	开发阶段
4	基于自研主控的企业级 PCIe 5.0 超高密度固态硬盘项目	基于自研 PCIe 5.0 主控芯片,开发搭载多种 QLC 闪存颗粒的企业级固态硬盘产品线,构建 PCIe 5.0 SSD 最高可达 122.88TB 超大容量产品矩阵。该产品顺序读写速度可达 14.5GB/s	开发阶段

序号	项目名称	拟达到的研发目标	进展情况
		和 3.6GB/s; 4KB 随机读取速度可达 2M IOPS、16KB 随机写入速度可达 45K IOPS	
5	基于自研主控的企业级 AI SSD 固态硬盘项目	基于自研 PCIe 5.0 主控芯片, 开发搭载多种 SCM 级闪存颗粒的企业级固态硬盘产品线, 构建 PCIe 5.0 算力直连 AI SSD 产品矩阵。该产品随机读写速度可达 3.5M IOPS 和 1.6M IOPS; 低延时读写能力如 4KB 随机读写延时可缩减至 13us/4us	开发阶段
6	面向下一代存储介质的高带宽超融合智能纠错技术项目	研发满足下一代存储介质在 PCIe 6.0/7.0 和 CXL 3.0/CXL 4.0 带宽需求下的自适应的 ECC 架构, ECC 解码能力可有效降低 CFR 1~2 个数量级, 支持多种存储介质与不同接口产品复用	开发阶段

(三) 承担的重大科研项目情况

公司作为国内技术领先的存储厂商承担了 2 项省市级重大科研专项, 专注于突破存储领域的关键核心技术, 为推动行业技术进步和国家自主创新能力的提升贡献了坚实力量, 符合国家科技创新规划。

(四) 合作研发情况

报告期内, 发行人不存在合作研发情形。

(五) 研发投入情况

报告期内, 公司研发投入情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“(四) 期间费用分析”之“3、研发费用”。公司将持续加大技术研发与创新投入, 为公司的持续创新提供保障, 从而增强公司核心竞争力。

(六) 研发人员与核心技术人员情况

1、研发人员情况

发行人以员工所在岗位的工作职责及内容作为研发人员的认定标准, 研发人员能够明确划分。

报告期各期末, 公司研发人员人数及占比情况如下:

单位: 人

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
研发人员	198	187	203

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
总人数	308	296	298
研发人员占比	64.29%	63.18%	68.12%

截至报告期期末，公司共有 198 名研发人员，其中博士 3 名，硕士 101 名，超过 50% 的研发人员具备硕士及以上学历。报告期各期末，公司研发人员学历分布情况如下：

单位：人

学历	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
博士	3	1.52%	5	2.67%	9	4.43%
硕士	101	51.01%	92	49.20%	100	49.26%
本科	91	45.96%	87	46.52%	91	44.83%
大专及以下	3	1.52%	3	1.60%	3	1.48%
合计	198	100.00%	187	100.00%	203	100.00%

注：研发人员中博士学位人员变动，主要系因参与定制化开发项目，由研发人员调整至技术支持及市场人员所致。

2、核心技术人员情况

公司高度重视技术落地能力，鼓励创新，不断在市场实践中培养和锻炼技术团队，逐步在多个专业领域实现了技术迭代和延展，形成了较为完善的人才梯队。截至本招股书签署日，公司共有 3 名核心技术人员，分别为武剑、冯正田、周晓东，均对集成电路行业拥有深刻理解并具备多年技术专业经验。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，具体情况如下：

序号	姓名	研发贡献、重要科研成果和获奖情况
1	武剑	(1) 在半导体 SoC 芯片领域拥有二十余年的深厚研发经验，是固态存储技术及高速总线技术领域资深专家； (2) 负责公司芯片产品的研发设计工作，主要包括性能指标制定、芯片架构设计、关键核心模块的设计与验证，以及研发进程管理等； (3) 在国际知名期刊及学术会议发表论文 8 篇，担任多家国际核心期刊审稿人。
2	冯正田	(1) 拥有二十余年存储领域研发经验，是 SSD 固件架构与存储系统领域资深专家； (2) 负责公司 SSD 产品固件架构规划、固件设计、研发管理、测试验证和量产交付，主导多个高性能 SSD 产品成功实现产业化。
3	周晓东	(1) 拥有二十余年服务器主板及存储系统硬件研发经验，是系统级硬件架构、系统硬件设计工程及系统可靠性领域资深专家；

序号	姓名	研发贡献、重要科研成果和获奖情况
		(2) 负责公司存储系统及 SSD 产品的硬件架构设计、PCB 设计、结构与散热设计、可靠性设计及系统验证测试工作, 成功支撑公司多个企业级存储产品实现高质量量产和规模化交付。

(七) 荣誉奖项

公司将研发积累和技术创新放在企业发展首位, 切实贯彻并坚持以技术创新作为企业核心竞争力, 截至本招股说明书签署日, 发行人获得的荣誉奖项具体情况如下:

序号	认定、荣誉或奖项	授予单位	获得时间
1	国家级专精特新重点“小巨人”企业	中华人民共和国工业和信息化部	2025
2	上海市市级企业技术中心	上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海海关	2024
3	上海市“专精特新”中小企业	上海市经济和信息化委员会	2022
4	上海市“科技创新行动计划”科技小巨人企业	上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市财政局	2022
5	上海高新技术企业创新投入百强榜	上海社会科学院应用经济研究所、上海市科技创业中心	2022
6	中国 IC 设计 Fabless100 排行榜-TOP 10 存储器公司	AspenCore	2025
7	中国 IC 设计成就奖-年度创新 IC 设计公司	AspenCore	2025
8	第十九届“中国芯”优秀技术创新产品	中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)	2024
9	第十八届“中国芯”优秀市场表现产品	中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)	2023
10	第十七届“中国芯”优秀技术创新产品	中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)	2022
11	胡润全球瞪羚企业	胡润集团	2025
12	VENTURE50 硬科技企业	清科创业、投资界	2024
13	“十四五”科技创新示范单位	中国科学家论坛组委会	2023
14	科技创新优秀成果	中国科学家论坛组委会	2023
15	杰出主控标杆奖	全球存储器行业创新论坛	2023

七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司从事的主营业务不属于国家规定的重污染行业, 生产经营活动不涉及环

境污染情形。公司专注于数据存储主控芯片和固态硬盘的研发、设计及销售，将主要的晶圆制造、封装测试及组装生产环节通过委外方式进行，自身从事产品的研发、销售和少量产品测试，不存在高危险、重污染的情形。公司在经营活动中严格遵守国家、地方相关环保法律法规，报告期内不存在环保违法违规行为。

八、发行人境外生产经营情况

报告期内，公司在中国大陆以外的地区设有境外经营子公司，相关子公司的基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人控股、参股公司情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节披露或引用的财务会计数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告或根据其计算得出。除另有注明外，本节讨论与分析所用数据均指合并口径或根据其计算得出。

本节对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解公司报告期的会计政策、财务状况、经营成果和现金流量，公司提醒投资者关注和阅读本招股说明书所附财务报告及审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、发行人财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	396,039,611.33	104,806,145.76	610,373,912.32
交易性金融资产	-	1,400,000.00	1,900,000.00
应收票据	18,292,068.14	7,925,435.43	2,792,837.47
应收账款	533,396,944.71	395,338,418.21	148,393,821.11
应收款项融资	5,446,328.17	1,000,000.00	-
预付款项	14,103,047.19	7,965,405.13	40,628,663.44
其他应收款	9,667,761.68	3,657,046.66	13,393,684.45
存货	686,437,998.38	395,934,440.68	165,696,421.42
其他流动资产	78,498,619.59	71,727,137.92	15,732,252.81
流动资产合计	1,741,882,379.19	989,754,029.79	998,911,593.02
非流动资产：			
固定资产	17,641,648.95	17,698,380.66	20,161,349.12
在建工程	-	454,551.99	580,441.60
使用权资产	12,785,795.34	20,975,958.86	18,771,339.23
无形资产	49,696,746.55	48,582,640.14	22,178,807.01
长期应收款	1,941,775.70	2,349,443.23	2,355,492.99

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
长期待摊费用	1,834,186.86	4,693,651.87	8,028,770.20
其他非流动资产	8,146,788.99	-	-
非流动资产合计	92,046,942.39	94,754,626.75	72,076,200.15
资产总计	1,833,929,321.58	1,084,508,656.54	1,070,987,793.17
流动负债:			
短期借款	546,401,758.43	559,304,964.83	318,382,120.71
应付票据	24,000,000.00	-	-
应付账款	164,591,050.06	85,763,219.48	14,145,090.33
合同负债	62,136,087.17	19,476,249.83	5,637,275.89
应付职工薪酬	56,789,001.89	61,300,751.49	58,641,673.25
应交税费	5,315,775.29	4,174,557.75	3,746,429.34
其他应付款	41,705,308.38	13,359,872.31	19,015,400.98
其他流动负债	5,010,595.65	1,194,872.83	817,891.72
一年内到期的非流动负债	170,827,226.85	92,673,861.75	28,261,329.47
流动负债合计	1,076,776,803.72	837,248,350.27	448,647,211.69
非流动负债:			
长期借款	40,535,855.64	131,119,000.00	92,254,750.00
租赁负债	5,547,823.56	12,999,961.30	12,812,788.68
长期应付款	20,213,334.61	23,096,802.35	4,778,702.94
预计负债	-	-	89,463.00
递延收益	1,060,615.60	-	855,451.78
非流动负债合计	67,357,629.41	167,215,763.65	110,791,156.40
负债合计	1,144,134,433.13	1,004,464,113.92	559,438,368.09
股东/所有者权益:			
股本/实收资本	430,261,427.00	360,000,000.00	55,885,121.00
资本公积	1,536,974,286.17	529,754,905.03	725,539,581.92
其他综合收益	1,821,370.41	-735,126.45	-728,280.49
未弥补亏损	-1,279,262,195.13	-808,975,235.96	-269,146,997.35

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
股东/所有者权益合计	689,794,888.45	80,044,542.62	511,549,425.08
负债和股东/所有者权益合计	1,833,929,321.58	1,084,508,656.54	1,070,987,793.17

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业总收入	1,034,183,143.08	624,967,655.22	357,773,141.69
其中：营业收入	1,034,183,143.08	624,967,655.22	357,773,141.69
二、营业总成本	1,434,654,479.54	1,019,532,516.69	726,978,292.20
其中：营业成本	977,552,122.68	556,369,886.08	238,092,322.19
税金及附加	2,583,811.33	1,164,459.08	636,780.34
销售费用	67,929,757.79	60,785,346.94	63,372,659.90
管理费用	78,702,883.26	71,903,988.96	79,606,727.61
研发费用	266,439,343.55	305,127,875.88	333,443,904.59
财务费用	41,446,560.93	24,180,959.75	11,825,897.57
其中：利息费用	33,118,877.36	22,145,128.62	13,137,649.74
利息收入	1,731,100.69	3,837,029.66	3,417,136.07
加：其他收益	19,063,358.62	6,853,478.31	16,690,026.10
投资收益（损失以“-”号填列）	255,364.61	1,355,528.63	30,728.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,598,114.72	-7,917,232.04	-3,735,615.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,341,847.98	-145,502,856.71	-9,315,045.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,603.77	-31,773.70	49,543.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-470,112,179.70	-539,807,716.98	-365,485,512.77
加：营业外收入	14,607.80	66,377.04	17,234.67
减：营业外支出	2,615.65	891.46	158,605.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-470,100,187.55	-539,742,231.40	-365,626,883.68
减：所得税费用	186,771.62	86,007.21	65,325.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-470,286,959.17	-539,828,238.61	-365,692,209.59

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
(一) 按经营持续性分类	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-470,286,959.17	-539,828,238.61	-365,692,209.59
(二) 按所有权归属分类	-	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-470,286,959.17	-539,828,238.61	-365,692,209.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	2,556,496.86	-6,845.96	659,370.05
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,556,496.86	-6,845.96	659,370.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中：外币财务报表折算差额	2,556,496.86	-6,845.96	659,370.05
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-467,730,462.31	-539,835,084.57	-365,032,839.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-467,730,462.31	-539,835,084.57	-365,032,839.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益	-	-	-
(一) 基本每股收益	-1.22	-1.50	-1.38
(二) 稀释每股收益	-1.22	-1.50	-1.38

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	973,460,901.11	407,760,728.38	315,895,885.09
收到的税费返还	103,317,146.94	19,649,619.60	32,804,948.28
收到其他与经营活动有关的现金	304,772,099.04	32,126,637.45	52,398,641.19
经营活动现金流入小计	1,381,550,147.09	459,536,985.43	401,099,474.56

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,089,137.81	894,673,118.13	370,452,557.03
支付给职工以及为职工支付的现金	246,646,724.93	247,932,774.56	221,823,311.94
支付的各项税费	4,641,460.81	4,350,288.71	2,976,706.08
支付其他与经营活动有关的现金	395,976,652.88	164,303,005.59	181,045,881.59
经营活动现金流出小计	2,034,353,976.43	1,311,259,186.99	776,298,456.64
经营活动产生的现金流量净额	-652,803,829.34	-851,722,201.56	-375,198,982.08
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	86,400,000.00	30,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	255,364.61	1,355,528.63	30,728.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	2,332.20	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	1,629,928.45
投资活动现金流入小计	86,660,564.61	31,857,860.83	1,660,657.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,982,439.52	12,636,708.45	17,198,010.28
投资支付的现金	85,000,000.00	30,000,000.00	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	852,678.89
投资活动现金流出小计	105,982,439.52	42,636,708.45	18,550,689.17
投资活动产生的现金流量净额	-19,321,874.91	-10,778,847.62	-16,890,031.97
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	1,059,999,977.66	80,000,000.00	471,587,691.03
取得借款收到的现金	848,013,545.83	939,723,082.85	523,089,861.91
筹资活动现金流入小计	1,908,013,523.49	1,019,723,082.85	994,677,552.94
偿还债务支付的现金	875,407,956.10	611,542,656.04	271,392,255.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,902,248.95	19,071,444.62	10,815,398.54
支付其他与筹资活动有关的现金	38,841,950.59	32,564,245.22	42,417,860.65
筹资活动现金流出小计	944,152,155.64	663,178,345.88	324,625,514.44

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动产生的现金流量净额	963,861,367.85	356,544,736.97	670,052,038.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-502,198.03	388,545.65	574,951.12
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	291,233,465.57	-505,567,766.56	278,537,975.57
加：期/年初现金及现金等价物余额	104,806,145.76	610,373,912.32	331,835,936.75
六、期/年末现金及现金等价物余额	396,039,611.33	104,806,145.76	610,373,912.32

二、会计师事务所审计意见类型

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：安永华明（2026）审字第 70059504_K02 号）。

发行人会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、关键审计事项

安永会计师在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	在审计中如何应对关键审计事项
1、存货跌价准备	
2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日公司存货账面价值为 16,569.64 万元、39,593.44 万元、68,643.80 万元，占公司总资产的 15.47%、36.51%、37.43%，存货跌价准备余额为 4,840.39 万元、18,464.97 万元、18,483.00 万元。 由于存货金额重大，且确定存货跌价准备涉及管理层的重大会计估计，因此安永将存货	实施的审计程序主要包括： 1) 了解并测试关于存货跌价准备计提的流程以及管理层的关键内部控制； 2) 了解并评价存货跌价准备计提政策，检查这些会计政策是否于各会计期间得到一贯执行； 3) 获取管理层编制的存货跌价准备计算表，检查管理层计算的准确性； 4) 复核管理层对于可变现净值估计的重要假设，选取样本检查管理层确认存货可变现净值时使用的预计售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的合理性； 5) 选取样本检查管理层编制的存货库龄表的准确性，并结合存货监盘及存货周转情况，评估库龄较长、呆滞或毁损的

关键审计事项	在审计中如何应对关键审计事项
跌价准备作为关键审计事项。	存货是否已被识别及计提了恰当的跌价准备； 6) 检查存货的期后消耗和销售情况； 7) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报和披露。
2、收入确认	
2023 年度、2024 年度及 2025 年度公司财务报表中商品销售收入金额为 35,777.31 万元、62,496.77 万元、103,418.31 万元。 由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，且对公司总体财务报表影响重大，因此收入确认为关键审计事项。	实施的审计程序主要包括： 1) 了解并测试与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行的有效性； 2) 了解收入确认的相关政策，检查主要客户的销售合同条款及合同条款的实际执行情况，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的规定； 3) 对主要客户就销售额进行函证，对于未回函的客户，执行检查销售出库单、货物签收单、销售发票、出口报关单、提单及期后收款等替代性程序； 4) 对主要客户进行实地走访，了解与公司之间的业务模式、结算方式等； 5) 执行细节测试，抽取样本，检查销售合同或订单、销售出库单、货物签收单、销售发票、出口报关单、提单、银行水单等原始单据； 6) 执行截止性测试，抽取样本，复核收入是否确认在恰当的会计期间； 7) 对主要产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； 8) 复核财务报表中与收入相关披露的适当性。

四、分部信息

基于经营管理需要，公司集中于数据存储主控芯片和固态硬盘的研发、设计与销售业务，属于单一经营分部，因此无需列报更详细的经营分部信息。

五、财务报表的编制基础及合并报表范围

(一) 财务报表编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

(二) 合并财务报表范围及变化情况

1、合并报表范围

截至报告期末，公司纳入合并报表范围的控股子（孙）公司如下：

序号	子公司名称	持股比例	
		直接	间接
1	成都英韧	100.00%	-
2	南京英韧	100.00%	-
3	深圳英韧	100.00%	-
4	长鹰芯存	100.00%	-
5	上海芯乾	100.00%	-
6	鄂州英韧	100.00%	-
7	武汉英韧	100.00%	-
8	Nyquist HK	-	100.00%
9	境外子公司 A	-	100.00%

2、报告期内合并报表范围变化情况

(1) 合并范围增加

序号	公司名称	新增期间	股权纳入合并范围原因
1	鄂州英韧	2025 年度	新设
2	武汉英韧	2025 年度	新设
3	长鹰芯存	2023 年度	新设

(2) 合并范围减少

序号	股权处置方式	减少期间	不纳入合并范围原因
1	安存科技	2025 年度	注销

六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计

本节仅披露报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的重要会计政策和会计估计，其他会计政策和会计估计参见申报会计师出具的审计报告后附的财务报表附注之“三、重要会计政策及会计估计”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日的财务状况以及2023年度、2024年度及2025年度的经营成果和现金流量。

(二) 收入确认

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

公司的收入类型主要分为货物销售收入和服务收入,主要产品为数据存储主控芯片和固态硬盘(SSD),主营服务为提供芯片设计或固态硬盘(SSD)设计相关的技术服务。

1、销售商品合同

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,于客户取得相关商品控制权的时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

遵循上述一般原则的情况下,公司收入确认的具体情况如下:

(1) 境内销售:若合同或订单约定运输至客户指定地点,则按照合同或订单约定将产品运至客户指定的交货地点,由客户或其委托第三方签收后确认收入;若合同约定存放在客户指定地点,客户按需领用,每月与公司核对账确认领用情况,则根据客户领用对账邮件或结算单据确认领用后确认收入;

(2) 境外销售:基于合同约定的国际贸易条款,结合《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点及合同的其他条款分析确定商品控制权转移时点,以客户或承运人取得货物或装运港提单出具日或将产品运至客户指定的交货地点之时确认收入。

根据合同约定、法律规定等,公司为所销售的商品提供质量保证,属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,公司按照预计负债进行

会计处理。

公司根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断从事交易时公司的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品前能够控制该商品的,公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

2、提供技术服务合同

公司提供技术服务,属于在某一时点履行履约义务。由于不能满足以下任何一种情况,公司将其作为在某一时点履行的履约义务:(1)客户在公司履约的同时取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户控制公司履约过程中在建的产品;(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。公司在已提供技术服务、将研发技术服务成果提交给客户并获取客户确认后确认技术服务收入。

(三) 金融工具

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满;

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取

代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产,是指按照合同规定购买或出售金融资产,并且该合同条款规定,根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

(1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量

仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具减值

(1) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

公司考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据评估金融工具的预期信用损失。公司将应收账款划分为：基于账龄确定信用风险特征组合和其他组合；将其他金融资产划分为：违约概率和违约损失率确认的回收风险较低组合。

公司依据信用风险特征将金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

基于账龄确定信用风险特征组合	合并的应收账款、商业承兑汇票
应收账款的其他组合	母公司应收合并范围内关联方的账款
回收风险较低组合	应收押金、保证金、银行承兑汇票及长期应收款

(3) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

公司根据入账日期确定账龄。

1) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。公司对于①已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失；②与对手方修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失。

2) 减值准备的核销

当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。

(四) 存货

存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。各类存货可变现净值的确定依据如下：

1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

3、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

归类为流动资产的合同履约成本列示于存货。

(五) 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他

支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

项目	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备	3-10 年	0%	33.33%-10.00%
办公家具	5 年	0%	20.00%
电子设备	3 年	0%	33.33%

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(六) 无形资产

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命如下：

项目	使用寿命	确定依据
EDA 及软件	1-3 年	合同约定与预计使用期限孰短

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(七) 股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价

值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(八) 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

(一) 非经常性损益明细情况

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益的专项说明》（安永华明（2026）专字第 70059504_K07 号），报告期内，公司非经常性损益明细表如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
计入当期损益的政府补助（与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,731.02	641.23	1,534.99
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益	25.54	135.55	3.07
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	-650.31
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.96	-3.18	4.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.20	6.55	-14.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7.70	0.05	-
非经常性损益项目合计	1,763.50	780.21	878.57
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	-0.35	-0.86	-0.31
合计	1,763.85	781.07	878.88

(二) 非经常性损益对当期经营成果的影响

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净亏损的比例分别为-2.40%、-1.45%以及-3.75%，占比较小，对公司整体经营影响有限。公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,763.85	781.07	878.88
归属于母公司股东的净亏损	-47,028.70	-53,982.82	-36,569.22
归属于母公司股东的非经常	-3.75%	-1.45%	-2.40%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
性损益净额占归属于母公司股东的净亏损的比例			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损	-48,792.55	-54,763.89	-37,448.10

八、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额和适用税率计算的销项税额，抵扣准予抵扣的进项税额后的差额。国内货物出口实行“免、退”和“免、抵、退”税政策，出口退税率主要为 13%。货物出口零增值税率。	13%或 6%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	参见下表

公司不同税率的纳税主体企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
英韧科技	15%
南京英韧	25%或 15%
成都英韧	20%
上海芯乾	25%
安存科技	20%
深圳英韧	20%
长鹰芯存	20%
鄂州英韧	20%
武汉英韧	20%
Nyquist HK	16.5%和 8.25%
境外子公司 A	***

(二) 税收优惠

英韧科技于 2021 年和 2024 年取得高新技术企业资质，自 2021 年起至 2026

年,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定享受企业所得税优惠政策,减按 15%税率缴纳企业所得税。

南京英韧 2021 年取得高新技术企业资质,自 2021 年起至 2023 年,按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定享受企业所得税优惠政策,减按 15%税率缴纳企业所得税,自 2024 年始,南京英韧按照 25%税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日;以及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)文件有关规定,对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

成都英韧、安存科技、深圳英韧及长鹰芯存于 2023 年度、2024 年度及 2025 年度适用小型微利企业税收优惠。

鄂州英韧从 2025 年 8 月成立之日起至 2025 年 12 月 31 日适用小型微利企业税收优惠。

武汉英韧自 2025 年 11 月成立之日起至 2025 年 12 月 31 日适用小型微利企业税收优惠。

根据中国香港特区政府于 2018 年 3 月 29 日刊宪的《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》,在中国香港成立的合资格法团实行两级利得税制度,即:合资格法团首 200 万港元应课税利润利得税税率降至 8.25%,其后超过 200 万港元的应课税利润则继续按 16.5%征税。不符合两级制利得税税率制度资格的法团应课税利润于两年均继续按 16.5%之税率征收税项。Nyquist HK 于 2023 年度、2024 年度及 2025 年度适用两级制利得税率制度。

(三) 税收优惠的影响及可持续性

报告期内,公司尚未实现盈利,公司适用的税收政策整体较为稳定,未发生重大不利变化,相关税收优惠政策未对发行人的经营成果产生重大影响,发行人

对相关税收优惠不存在重大依赖。

九、主要财务指标

(一) 主要财务指标

报告期内，发行人主要财务指标如下：

财务指标	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
流动比率（倍）	1.62	1.18	2.23
速动比率（倍）	0.89	0.61	1.73
资产负债率（合并）	62.39%	92.62%	52.24%
利息保障倍数（倍）	-13.19	-23.37	-26.83
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	1.60	0.22	9.15
应收账款周转率（次）	2.12	2.21	2.75
存货周转率（次）	1.35	1.40	1.19
息税折旧摊销前利润（万元）	-39,022.45	-46,410.02	-29,716.01
归属于发行人股东的净利润（万元）	-47,028.70	-53,982.82	-36,569.22
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润（万元）	-48,792.55	-54,763.89	-37,448.10
研发投入占营业收入的比例	25.76%	48.82%	93.20%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-1.52	-2.37	-6.71
每股净现金流量（元/股）	0.68	-1.40	4.98

(二) 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，发行人报告期内的每股收益、净资产收益率如下：

净利润计算口径	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025年度	-197.04%	-1.22	-1.22
	2024年度	-171.39%	-1.50	-1.50

净利润计算口径	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2023 年度	-183.44%	-1.38	-1.38
	2025 年度	-204.43%	-1.26	-1.26
	2024 年度	-173.87%	-1.52	-1.52
	2023 年度	-187.85%	-1.42	-1.42

十、经营成果分析

报告期内，公司的主要经营成果如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
营业收入	103,418.31	100.00%	62,496.77	100.00%	35,777.31	100.00%
营业成本	97,755.21	94.52%	55,636.99	89.02%	23,809.23	66.55%
销售费用	6,792.98	6.57%	6,078.53	9.73%	6,337.27	17.71%
管理费用	7,870.29	7.61%	7,190.40	11.51%	7,960.67	22.25%
研发费用	26,643.93	25.76%	30,512.79	48.82%	33,344.39	93.20%
财务费用	4,144.66	4.01%	2,418.10	3.87%	1,182.59	3.31%
营业利润	-47,011.22	-45.46%	-53,980.77	-86.37%	-36,548.55	-102.16%
利润总额	-47,010.02	-45.46%	-53,974.22	-86.36%	-36,562.69	-102.20%
净利润	-47,028.70	-45.47%	-53,982.82	-86.38%	-36,569.22	-102.21%
归属于母公司股东/所有者的净利润	-47,028.70	-45.47%	-53,982.82	-86.38%	-36,569.22	-102.21%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-48,792.55	-47.18%	-54,763.89	-87.63%	-37,448.10	-104.67%

报告期各期，公司营业收入分别为 35,777.31 万元、62,496.77 万元和 103,418.31 万元，2023-2025 年营业收入复合增长率为 70.02%，实现了营业收入的跨越式增长，主要得益于公司产品线由主控芯片延伸至消费级及企业级固态硬

盘，且固态硬盘销售收入增速较快。

(一) 营业收入构成及变动分析

1、营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	103,138.17	99.73%	62,401.86	99.85%	35,406.12	98.96%
其他业务收入	280.14	0.27%	94.90	0.15%	371.19	1.04%
合计	103,418.31	100.00%	62,496.77	100.00%	35,777.31	100.00%

公司主营业务收入来源于数据存储主控芯片、固态硬盘及技术服务。报告期各期，公司主营业务收入占当期营业收入的比例均超过 98%，主营业务突出。公司的其他业务收入主要来源于配件销售等。

2、主营业务收入按产品类别构成及变动分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成的情况如下：

单位：万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
数据存储 主控芯片	PCIe	13,601.69	13.19%	16,480.65	26.41%	25,000.00	70.61%
	SATA	244.46	0.24%	75.13	0.12%	-	-
	小计	13,846.15	13.42%	16,555.78	26.53%	25,000.00	70.61%
固态硬盘	PCIe	58,820.66	57.03%	22,837.18	36.60%	8,992.50	25.40%
	SATA	30,072.00	29.16%	22,025.80	35.30%	1,199.25	3.39%
	小计	88,892.65	86.19%	44,862.98	71.89%	10,191.75	28.79%
技术服务		399.37	0.39%	983.11	1.58%	214.37	0.61%
合计		103,138.17	100.00%	62,401.86	100.00%	35,406.12	100.00%

报告期各期，公司主营业务收入分别为 35,406.12 万元、62,401.86 万元和 103,138.17 万元，整体呈现高速增长趋势。

报告期内，公司以完整自研高性能数据存储主控芯片技术与产品为基础，凭借自研芯片及系统级解决方案能力技术优势，将业务逐步拓展至企业级固态硬盘产品。企业级固态硬盘市场空间广阔，准入要求高，客户黏性强，从长远角度看，有利于最大化发挥技术优势带来的经济价值，同时通过紧跟终端客户需求，促进自研主控芯片技术持续迭代，保持技术优势。

2023年，公司企业级固态硬盘产品尚处于客户验证阶段，主营业务收入主要来自消费级/工业级芯片及固态硬盘。2024年及2025年，公司顺利通过多家行业头部客户的导入测试并实现规模出货，迅速覆盖互联网、国产替代等主流应用场景，企业级固态硬盘销售收入高速增长，占主营业务收入的比例迅速提升。

报告期内，公司技术服务收入金额及占比较低，主要为产品开发、固件开发等技术服务，系公司核心技术的体现。

3、主要产品的销售数量和销售价格分析

(1) 数据存储主控芯片

报告期内，公司数据存储主控芯片的销量及销售均价具体变动如下：

单位：万元、万颗、元/颗

项目	2025年度	2024年度	2023年度
销售收入	13,846.15	16,555.78	25,000.00
销售数量	396.48	611.26	882.24
平均销售单价	34.92	27.08	28.34

报告期内，公司数据存储主控芯片产品以消费级/工业级为主，销售收入受产品结构和下游市场需求变化影响存在一定波动。

2024年度，受消费级存储市场低迷及部分客户主动去库存影响，数据存储主控芯片销售价格和销售数量均有所下降，故销售收入有所下滑；2025年度，平均销售单价上升主要系高代际产品销售占比提升；销售数量下降，主要系公司消费级芯片产品定位于中高端市场，下游受存储颗粒涨价影响成本控制压力增加，对芯片价格敏感度提升，故销量存在波动。

对于数据存储主控芯片和固态硬盘产品，公司采取差异化市场定位。2024年以来，AI应用强势崛起，数据中心、AI芯片等市场需求激增，带动企业级固

态硬盘等高性能存储产品市场迎来爆发式增长；同时，消费电子终端需求持续疲软，笔记本电脑等传统应用复苏迟缓。公司坚持高端数据存储主控芯片技术迭代与应用，以有利于最大化发挥技术优势带来的经济利益为目标，结合终端市场需求，在数据存储主控芯片方面，聚焦中、高端消费级市场，持续优化产品结构，并稳步推进海外市场的拓展，目前已成功导入闪迪等客户；同时，在固态硬盘业务重点布局企业级市场，经过严苛的导入测试，已于 2024 年起陆续在多家行业头部客户实现规模出货。

(2) 固态硬盘

报告期内，公司固态硬盘产品的销量、单位容量平均单价情况如下：

单位：万元、万 TB、元/TB

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售收入	88,892.65	44,862.98	10,191.75
销售数量	159.22	82.12	44.64
平均销售单价	558.29	546.32	228.32

公司销售给下游客户的固态硬盘以整盘形态为主，同时根据下游客户需求，公司也向部分客户销售未经委外组装的固态硬盘套料产品。报告期内，公司固态硬盘产品收入实现持续增长。2023 年度，公司固态硬盘以消费级/工业级产品为主，企业级产品处于市场导入阶段。2024 年度，公司企业级固态硬盘产品在下游多家优质头部客户实现放量，收入迎来爆发式增长。企业级固态硬盘产品平均单价通常高于消费级/工业级产品，故平均单价受产品结构变化影响显著上升。2025 年度，公司企业级固态硬盘产品销售收入维持高速增长，企业级产品收入占比持续提升，带动平均单价小幅上升。

4、主营业务收入按区域分布分析

报告期内，公司主营业务收入按照客户归属地区列示如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
境内	57,181.53	55.44%	45,464.87	72.86%	11,408.81	32.22%
境外	45,956.64	44.56%	16,936.99	27.14%	23,997.31	67.78%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
合计	103,138.17	100.00%	62,401.86	100.00%	35,406.12	100.00%

注：客户归属地以其注册地址为准。

报告期内，公司境外收入占主营业务收入的比例存在一定波动，主要系①公司稳步拓展海外市场，与多家国际知名客户建立合作关系；②部分境内客户出于全球化布局、外汇结算便利、资金安排等商业考量，通过其境外关联主体与公司进行交易。由于不同客户的海外业务推进节奏及规模化采购时点存在差异，导致相关境外收入在报告期内呈现一定波动。

5、主营业务收入按销售模式分析

报告期内，公司主营业务收入按照销售模式列示如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
直销	99,532.47	96.50%	55,820.46	89.45%	32,668.73	92.27%
经销	3,605.70	3.50%	6,581.40	10.55%	2,737.39	7.73%
合计	103,138.17	100.00%	62,401.86	100.00%	35,406.12	100.00%

报告期内，公司主营业务收入以直销为主，经销收入比例整体呈现下降趋势。公司产品陆续通过优质终端客户验证并实现放量，直接与终端客户交易，故直销收入占比上升。

6、主营业务收入季节性分析

报告期内，公司主营业务收入分季度变动情况如下：

单位：万元

季度	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	6,876.79	6.67%	4,486.31	7.19%	6,966.72	19.68%
第二季度	26,599.72	25.79%	13,744.66	22.03%	7,619.58	21.52%
第三季度	39,449.98	38.25%	10,493.42	16.82%	8,685.60	24.53%
第四季度	30,211.68	29.29%	33,677.46	53.97%	12,134.23	34.27%

季度	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
总计	103,138.17	100.00%	62,401.86	100.00%	35,406.12	100.00%

报告期内，公司主营业务收入整体呈现上半年收入占比低，下半年收入占比高的状态。2023 年度，公司主营产品主要面向消费级市场。消费级市场存在一定的季节性，受“双十一”、圣诞节等大型购物促销活动及假期的影响，通常第四季度销售占比相对较高。2024 年度及 2025 年度，公司主营产品主要面向企业级市场，部分客户因执行年度采购计划，通常在下半年集中采购，因此下半年收入通常高于上半年。其中，2024 年度第四季度收入占比较高，主要系公司企业级固态硬盘产品在下半年陆续通过主流客户验证并实现批量出货，部分重点客户项目于四季度集中交付。2025 年度，企业级固态硬盘收入保持高速增长，整体维持下半年销售收入高于上半年的趋势。

7、第三方回款情况

报告期内，公司存在第三方回款的情况，具体比例及金额如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
第三方回款总额	5,241.20	4,913.62	3,489.57
其中：通过供应链公司或境外关联公司付款	4,724.40	4,913.62	2,526.98
通过下游客户付款	516.80	-	962.60
主营业务收入	103,138.17	62,401.86	35,406.12
占比	5.08%	7.87%	9.86%

注：第三方回款的统计口径为现金流发生口径，即将第三方回款金额计入回款发生的当期。

报告期内，公司第三方回款的金额占当期主营业务收入的比例分别为 9.86%、7.87%和 5.08%，交易币种均为美元。

第三方回款的原因主要系客户基于交易习惯、结算便利、资金统筹安排等原因，授权第三方供应链公司或委托境外关联公司及其客户代为支付货款，具有商业合理性。剔除客户委托第三方供应链公司及境外关联公司付款的情形后，公司第三方回款金额占当期营业收入比例分别为 2.72%、0.00%和 0.50%。

公司已建立相关内控制度，通过要求委托方提供委托付款声明、与客户进行

对账确认等措施对第三方回款进行严格管理。公司的第三方回款交易均具备商业合理性和真实的交易背景,未对业务经营、财务管理和收入真实性造成不利影响。

(二) 营业成本构成及变动分析

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

单位:万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	97,680.57	99.92%	55,587.15	99.91%	23,688.65	99.49%
其他业务成本	74.65	0.08%	49.84	0.09%	120.58	0.51%
合计	97,755.21	100.00%	55,636.99	100.00%	23,809.23	100.00%

报告期内,公司营业成本分别为 23,809.23 万元、55,636.99 万元和 97,755.21 万元,其中主营业务成本占营业成本比例均在 99%以上。

1、主营业务成本按产品类别构成及变动分析

报告期内,公司主营业务成本按产品类别构成的情况如下:

单位:万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
数据存储 主控芯片	PCIe	8,651.09	8.86%	10,814.91	19.46%	14,668.69	61.92%
	SATA	199.65	0.20%	35.14	0.06%	-	-
	小计	8,850.74	9.06%	10,850.05	19.52%	14,668.69	61.92%
固态硬盘	PCIe	56,006.52	57.34%	21,418.28	38.53%	7,997.81	33.76%
	SATA	32,772.55	33.55%	23,099.26	41.56%	995.32	4.20%
	小计	88,779.07	90.89%	44,517.54	80.09%	8,993.13	37.96%
技术服务		50.76	0.05%	219.56	0.39%	26.82	0.11%
合计		97,680.57	100.00%	55,587.15	100.00%	23,688.65	100.00%

报告期内,公司主营业务成本的构成和变动与主营业务收入情况基本保持一致。

2、主营业务成本按成本要素构成分析

报告期内，公司主营业务成本按投入构成具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	91,218.84	93.38%	49,654.10	89.33%	18,546.67	78.29%
委托加工费	5,416.31	5.54%	4,855.63	8.74%	4,438.35	18.74%
其他费用	1,045.41	1.07%	1,077.42	1.94%	703.63	2.97%
主营业务成本合计	97,680.57	100.00%	55,587.15	100.00%	23,688.65	100.00%

报告期内，公司主营业务成本结构相对稳定，由直接材料、委托加工费等成本构成。其中，直接材料是主营业务成本的重要组成部分。

公司直接材料包括晶圆、NAND 闪存颗粒和 DRAM 等。2024 年起，直接材料占比有所提升，主要系产品结构变动所致。相比于数据存储主控芯片产品，固态硬盘产品直接材料中还包含 NAND 闪存颗粒和 DRAM 等，直接材料占产品成本的比例较高，故随着固态硬盘产品收入占比提升，直接材料占主营业务成本比重有所增加。

公司不直接从事芯片和固态硬盘生产，委托加工费中包括委托封测厂对芯片进行封装、测试，及委托加工厂商对固态硬盘进行组装、生产、测试等费用。其他费用包括制造费用和特许使用权费用等。

(三) 毛利、毛利率构成及变动分析

1、综合毛利构成及变动情况

报告期内，公司毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
主营业务	5,457.61	96.37%	6,814.72	99.34%	11,717.47	97.91%
其他业务	205.50	3.63%	45.06	0.66%	250.61	2.09%
毛利合计	5,663.10	100.00%	6,859.78	100.00%	11,968.08	100.00%

报告期内，公司综合毛利主要来源于主营业务，主营业务毛利占综合毛利比例超过 96%，主营业务突出。

2、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务毛利按产品类别的构成情况如下：

单位：万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
数据存储 主控芯片	PCIe	4,950.60	90.71%	5,665.74	83.14%	10,331.31	88.17%
	SATA	44.81	0.82%	39.99	0.59%	-	-
	小计	4,995.41	91.53%	5,705.73	83.73%	10,331.31	88.17%
固态硬盘	PCIe	2,814.14	51.56%	1,418.90	20.82%	994.68	8.49%
	SATA	-2,700.56	-49.48%	-1,073.46	-15.75%	203.93	1.74%
	小计	113.58	2.08%	345.44	5.07%	1,198.62	10.23%
技术服务		348.61	6.39%	763.55	11.20%	187.55	1.60%
合计		5,457.61	100.00%	6,814.72	100.00%	11,717.47	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于数据存储主控芯片产品。2023 年度，主营业务毛利与主营业务收入结构保持一致。2024 年度及 2025 年度，主营业务毛利主要来源于数据存储主控芯片产品，主要系固态硬盘产品材料成本中 NAND 闪存颗粒、DRAM 等价值量较高，固态硬盘产品毛利率低于芯片类产品。固态硬盘产品中，SATA 产品主营业务毛利为负，主要系公司为满足金融、通信等关键领域标杆客户的代际升级和国产替代需求，扩大市场份额，主动采取较为灵活的定价策略，以快速拓展标杆客户并深入其供应体系，并夯实长期市场基础。

3、主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司分业务类别列示收入结构及各自毛利率水平情况如下：

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
数 据 存 储 主 控	PCIe	36.40%	13.19%	34.38%	26.41%	41.33%	70.61%
	SATA	18.33%	0.24%	53.23%	0.12%	-	-

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
芯片	小计	36.08%	13.42%	34.46%	26.53%	41.33%	70.61%
固态硬盘	PCIe	4.78%	57.03%	6.21%	36.60%	11.06%	25.40%
	SATA	-8.98%	29.16%	-4.87%	35.30%	17.01%	3.39%
	小计	0.13%	86.19%	0.77%	71.89%	11.76%	28.79%
技术服务		87.29%	0.39%	77.67%	1.58%	87.49%	0.61%
合计		5.29%	100.00%	10.92%	100.00%	33.09%	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利率整体呈现下降趋势，主要系固态硬盘产品销售收入在主营业务收入中占比提升，不同产品毛利率水平存在差异。

(1) 数据存储主控芯片毛利率

报告期内，公司数据存储主控芯片产品毛利率分别为 41.33%、34.46%和 36.08%。2024 年度，毛利率下降主要系产品结构影响，受消费级市场疲软与存储颗粒价格上涨的双重影响，高性价比的无缓存产品出货量增长。2025 年度，毛利率基本保持稳定。

(2) 固态硬盘毛利率

报告期内，公司固态硬盘产品毛利率分别为 11.76%、0.77%和 0.13%。

2023 年度，公司固态硬盘产品主要为消费级/工业级产品。2024 年度及 2025 年度，公司固态硬盘产品主要为企业级固态硬盘产品。报告期内，企业级固态硬盘产品毛利率水平低于消费级/工业级产品，主要系公司产品尚处于市场拓展与导入验证期，为争取标杆客户、建立长期合作关系，公司采取较为灵活的定价策略，给予重点客户一定价格优惠，压缩短期利润空间。同时，在企业级固态硬盘导入初期，规模效应尚未充分显现。2024 年度，毛利率下降主要系产品结构影响，企业级固态硬盘产品销售收入占比大幅提升。2025 年度，毛利率下降主要系原材料 DRAM 价格上涨影响。截至本招股说明书签署日，2026 年起，受益于下游需求快速增长与产品认可度提升，产品价格上涨，毛利率已有所回升。

4、同行业可比公司毛利率比较情况

报告期内，公司与同行业可比公司综合毛利率比较情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
数据存储主控芯片业务为主			
联芸科技	51.43%	47.47%	45.66%
慧荣科技	48.27%	45.89%	42.31%
群联电子	34.40%	32.42%	33.52%
Marvell	51.02%	41.31%	41.64%
FADU	47.24%	13.26%	49.38%
平均值	46.47%	36.07%	42.50%
发行人	36.08%	34.46%	41.33%
固态硬盘为主			
大普微	3.51%	27.28%	-27.12%
德明利	14.81%	17.75%	16.66%
佰维存储	21.44%	18.19%	1.76%
平均值	13.25%	21.07%	-2.90%
发行人	0.13%	0.77%	11.76%

数据存储主控芯片业务方面，公司毛利率水平与同行业企业变动趋势不存在明显差异。

固态硬盘业务方面，受产品类别、应用领域、公司发展阶段等因素影响，公司与同行业公司佰维存储、德明利可比性较弱。佰维存储主营嵌入式存储和 PC 存储，主要面向移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域，德明利主营消费级固态硬盘及移动类存储，主要面向车载电子、数据中心、新能源汽车、手机、平板、安防监控等应用场景。二者产品类别和应用市场与公司存在较大差异，且业务规模较大，在原材料采购方面具备更强的议价能力。大普微主营企业级固态硬盘产品，采取半自研半外采主控芯片模式，处于市场开拓时期，毛利率水平存在较大波动。企业级固态硬盘厂商处于国产替代初期，为迅速拓展市场，通常执行灵活的价格策略，在规模效应与可比公司上亦存在差距，故毛利率整体呈现较低水平。

(四) 期间费用分析

报告期内，公司期间费用金额及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

费用类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	6,792.98	6.57%	6,078.53	9.73%	6,337.27	17.71%
管理费用	7,870.29	7.61%	7,190.40	11.51%	7,960.67	22.25%
研发费用	26,643.93	25.76%	30,512.79	48.82%	33,344.39	93.20%
财务费用	4,144.66	4.01%	2,418.10	3.87%	1,182.59	3.31%
合计	45,451.85	43.95%	46,199.82	73.92%	48,824.92	136.47%

1、销售费用

(1) 销售费用构成及变动分析

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,465.73	51.02%	3,389.38	55.76%	3,156.42	49.81%
样品费	1,442.38	21.23%	974.70	16.04%	981.69	15.49%
服务费	978.84	14.41%	888.84	14.62%	807.45	12.74%
折旧与摊销	220.38	3.24%	155.72	2.56%	158.23	2.50%
差旅交通费	171.41	2.52%	164.51	2.71%	125.64	1.98%
业务招待费	148.25	2.18%	130.38	2.14%	78.57	1.24%
股份支付费用	139.69	2.06%	250.18	4.12%	882.02	13.92%
其他	226.29	3.33%	124.83	2.05%	147.25	2.32%
合计	6,792.98	100.00%	6,078.53	100.00%	6,337.27	100.00%

报告期内，公司的销售费用率分别为 17.71%、9.73%和 6.57%，呈下降趋势，主要系公司收入规模扩大所致。报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、样品费、服务费和股份支付费用等构成，上述费用合计占销售费用比例分别为 91.96%、90.53%和 88.72%，占比相对较高；上述费用具体分析如下：

①职工薪酬

报告期内，公司销售费用中的职工薪酬分别为 3,156.42 万元、3,389.38 万元和 3,465.73 万元，保持稳步增长，主要为销售部门人员的工资、奖金、社保公积金等。

②样品费

报告期内，公司销售费用中的样品费分别为 981.69 万元、974.70 万元和 1,442.38 万元，主要为产品导入阶段由销售部门领用后提供给客户试用的样盘、芯片等样品。受公司业务放量及原材料采购成本上升影响，2025 年样品费增幅较大。

③服务费

报告期内，公司销售费用中的服务费分别为 807.45 万元、888.84 万元和 978.84 万元，服务费主要为客户导入、维护过程中提供的销售支持等服务。报告期内，随着收入规模增长，服务费整体保持平稳增长。

④股份支付费用

报告期内，公司销售费用中股份支付分别为 882.02 万元、250.18 万元和 139.69 万元。报告期内股份支付费用持续下降，主要系前期授予的股权激励在本报告期内持续摊销所致。

(2) 销售费用率同行业比较分析

报告期内，公司剔除股份支付后的销售费用率与同行业可比公司对比情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
大普微	3.57%	6.46%	12.89%
联芸科技	2.15%	2.16%	1.74%
佰维存储	2.62%	3.10%	4.06%
德明利	0.80%	0.76%	0.87%
慧荣科技	3.88%	3.42%	4.21%
群联电子	2.27%	2.88%	2.65%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
Marvell	未披露	未披露	未披露
FADU	未披露	未披露	未披露
平均值	2.55%	3.13%	4.40%
发行人(剔除股份支付)	6.43%	9.33%	15.25%

注 1: 慧荣科技、群联电子未披露销售费用中股份支付的具体金额, 比例中未剔除股份支付。

注 2: 以上数据取自可比公司招股说明书、定期报告等公开披露材料。

报告期内, 公司剔除股份支付后的销售费用率分别为 15.25%、9.33%和 6.43%, 公司剔除股份支付后的销售费用率高于可比公司平均水平, 主要系 (1) 公司仍处于发展早期, 收入规模相比同行业可比公司较小; (2) 报告期内公司业务由自研存储主控芯片拓展至固态硬盘, 产品线的丰富导致销售支出增加。

2、管理费用

(1) 管理费用构成及变动分析

报告期内, 公司管理费用构成情况如下:

单位: 万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,463.46	44.01%	3,547.65	49.34%	3,541.85	44.49%
融资服务费	1,556.34	19.77%	505.20	7.03%	742.57	9.33%
专业服务费	666.23	8.47%	532.90	7.41%	769.53	9.67%
股份支付费用	664.65	8.44%	1,107.49	15.40%	1,330.84	16.72%
办公费	573.25	7.28%	629.62	8.76%	627.79	7.89%
折旧与摊销	465.32	5.91%	557.29	7.75%	601.16	7.55%
其他	481.04	6.11%	310.23	4.31%	346.93	4.36%
合计	7,870.29	100.00%	7,190.40	100.00%	7,960.67	100.00%

报告期内, 公司的管理费用率分别为 22.25%、11.51%和 7.61%, 受公司收入规模扩大影响, 管理费用率呈下降趋势。报告期内, 公司管理费用主要由职工薪酬、融资服务费和股份支付费用等构成, 上述费用合计占管理费用比例分别为 70.54%、71.77%和 72.23%, 占比相对较高; 上述费用具体分析如下:

①职工薪酬

报告期内，公司管理费用中的职工薪酬分别为 3,541.85 万元、3,547.65 万元和 3,463.46 万元，主要为管理部门人员的工资、奖金、社保公积金等。报告期内，职工薪酬波动较小。

②融资服务费

报告期内，公司管理费用中融资服务费分别为 742.57 万元、505.20 万元和 1,556.34 万元，主要为公司因生产经营所需进行外部融资产生的服务费。2025 年度融资服务费金额较高系当期融资金额较多所致。

③股份支付费用

报告期内，公司管理费用中股份支付分别为 1,330.84 万元、1,107.49 万元和 664.65 万元。报告期内，股份支付费用持续下降，主要系前期授予股权激励在报告期内持续摊销所致。

(2) 管理费用率与同行业比较分析

报告期内，公司剔除股份支付后的管理费用率与同行业可比公司对比情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
大普微	1.51%	2.90%	6.12%
联芸科技	3.60%	3.61%	3.18%
佰维存储	2.52%	1.86%	2.54%
德明利	1.37%	1.56%	2.96%
慧荣科技	4.22%	3.90%	4.37%
群联电子	1.65%	2.17%	1.99%
Marvell	未披露	未披露	未披露
FADU	未披露	未披露	未披露
平均值	2.48%	2.67%	3.53%
发行人(剔除股份支付)	6.97%	9.73%	18.53%

注 1：慧荣科技、群联电子未披露管理费用中股份支付的具体金额，比例中未剔除股份支付。

注 2：以上数据取自可比公司招股说明书、定期报告等公开披露材料。

报告期内,公司剔除股份支付后的管理费用率分别为 18.53%、9.73%和 6.97%,公司剔除股份支付后的管理费用率高于可比公司平均水平,主要因公司仍处于快速发展期,收入规模相比可比公司基数较小。

3、研发费用

(1) 研发费用构成及变动分析

报告期内,公司研发费用构成情况如下:

单位:万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	14,710.00	55.21%	14,713.60	48.22%	15,931.63	47.78%
委外研发服务费	4,615.75	17.32%	4,105.36	13.45%	4,898.16	14.69%
折旧与摊销	3,688.37	13.84%	4,051.72	13.28%	4,562.31	13.68%
材料费	1,260.85	4.73%	1,537.60	5.04%	997.56	2.99%
股份支付费用	802.15	3.01%	1,167.27	3.83%	2,266.67	6.80%
流片费用	635.94	2.39%	1,955.16	6.41%	1,904.34	5.71%
技术服务费用	613.74	2.30%	1,050.04	3.44%	722.92	2.17%
特许使用权费用	6.99	0.03%	1,521.97	4.99%	1,685.76	5.06%
其他	310.14	1.16%	410.07	1.34%	375.04	1.12%
合计	26,643.93	100.00%	30,512.79	100.00%	33,344.39	100.00%

报告期内,公司的研发费用率分别为 93.20%、48.82%和 25.76%,发行人各期研发费用基本稳定,随着公司营业收入规模的持续扩大,公司研发费用占营业收入比例呈现下降趋势。

报告期内,公司不存在研发费用资本化的情形,公司研发费用主要由职工薪酬、委外研发服务费、折旧与摊销、材料费和流片费用构成,上述费用合计占研发费用比例分别为 84.85%、86.40%和 93.50%,占比较高。上述费用具体分析如下:

① 职工薪酬

报告期内,公司计入研发费用的职工薪酬分别为 15,931.63 万元、14,713.60

万元和 14,710.00 万元,占当期研发费用的比例分别为 47.78%、48.22%和 55.21%。公司计入研发费用的职工薪酬主要为研发人员的工资、奖金及社保公积金等。报告期内,公司职工薪酬波动较小。

② 委外研发服务费

报告期内,公司计入研发费用的委外研发服务费分别为 4,898.16 万元、4,105.36 万元和 4,615.75 万元,占当期研发费用比例分别为 14.69%、13.45%和 17.32%。公司计入研发费用的委外研发服务费主要为公司采购的中后端芯片设计服务及各类验证测试服务等所发生的费用。报告期内,公司委外研发服务费波动较小。

③ 折旧与摊销

报告期内,公司计入研发费用的折旧与摊销金额分别为 4,562.31 万元、4,051.72 万元和 3,688.37 万元,占当期研发费用比例分别为 13.68%、13.28%和 13.84%。报告期内,公司计入研发费用的折旧和摊销主要为 EDA 软件等无形资产的摊销以及电子机器设备等固定资产的折旧费用。报告期内,公司计入研发费用的折旧和摊销总体较为稳定。

④ 材料费

报告期内,公司计入研发费用的材料费分别为 997.56 万元、1,537.60 万元和 1,260.85 万元,占当期研发费用的比例分别为 2.99%、5.04%和 4.73%,公司计入研发费用的材料费主要为工程测试用固态硬盘、主控芯片和存储颗粒等原材料以及辅助材料等。2024 年度材料费有所增加系公司为拓展企业级固态硬盘市场规模,增加了企业级固态硬盘研发投入。

⑤ 流片费用

报告期内,公司计入研发费用的流片费分别为 1,904.34 万元、1,955.16 万元和 635.94 万元,占当期研发费用的比例分别为 5.71%、6.41%和 2.39%。因芯片研发项目进度差异,2025 年主要系改版升级需求,因此流片费用较之前年度有所下降。

(2) 公司主要研发项目支出情况

报告期内，公司计入研发费用的主要研发项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	研发预算	报告期内累计支出	进展情况
1	基于自研主控的企业级 PCIe4.0 固态硬盘项目	28,000.00	14,689.06	完成
2	企业级 PCIe 6.0 智能存储控制器芯片	20,000.00	13,280.10	在研
3	新一代低功耗消费级存储控制器芯片研发与产业化项目	15,000.00	10,142.33	在研
4	企业级 PCIe 5.0 存储控制器芯片	31,000.00	9,248.57	完成
5	基于自研主控的企业级 PCIe 5.0 高性能固态硬盘项目	15,000.00	8,983.69	在研
6	基于自研主控的企业级 SATA 固态硬盘项目	17,000.00	8,501.46	完成
7	基于自研主控的消费级 PCIe 4.0 存储平台化开发项目	14,000.00	7,222.40	完成

(3) 研发费用率与同行业比较分析

报告期内，公司剔除股份支付后的研发费用率与同行业可比公司对比情况如下：

公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
大普微	13.14%	24.21%	44.45%
联芸科技	35.98%	34.64%	33.89%
佰维存储	4.76%	4.76%	5.41%
德明利	2.43%	3.81%	5.46%
慧荣科技	29.66%	27.11%	27.28%
群联电子	18.96%	21.35%	21.37%
Marvell	25.32%	33.82%	34.43%
FADU	74.35%	151.93%	230.26%
平均值	25.58%	37.70%	50.32%
发行人(剔除股份支付)	24.99%	46.96%	86.86%

注 1：慧荣科技、群联电子、Marvell 和 FADU 未披露研发费用中股份支付的具体金额，比例中未剔除股份支付。

注 2：以上数据取自可比公司招股说明书、定期报告等公开披露材料。

报告期内，公司剔除股份支付后的研发费用率显著高于同行业可比公司平均水平，主要系公司长期以来高度重视技术创新和研发投入，且公司所处行业研发

难度高、人力物力投入需求大，因此研发投入相对较高；同时，公司主营业务仍处于快速成长期，营业收入的总体规模相较于同行业可比公司处于较低水平，因此研发费用率比例较高。随着公司收入规模的快速增长，研发费用率与行业平均水平趋于一致。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息支出	3,311.89	79.91%	2,214.51	91.58%	1,313.76	111.09%
其中：租赁利息支出	86.67	2.09%	86.10	3.56%	100.34	8.48%
其中：长期应付款利息支出	298.63	7.21%	230.97	9.55%	121.31	10.26%
减：利息收入	173.11	4.18%	383.70	15.87%	341.71	28.90%
汇兑损益	924.68	22.31%	546.64	22.61%	189.44	16.02%
手续费	81.20	1.96%	40.64	1.68%	21.09	1.78%
合计	4,144.66	100.00%	2,418.10	100.00%	1,182.59	100.00%

报告期内公司财务费用分别为1,182.59万元、2,418.10万元和4,144.66万元，占当期营业收入比例分别为3.31%、3.87%和4.01%，公司财务费用主要由利息支出和汇兑损益组成。报告期内利息支出持续上升主要系为满足日常营运资金需求增加借款所致。报告期内公司汇兑损益增幅较快，主要系美元兑人民币汇率波动较大影响，叠加公司以美元结算销售和采购快速增长共同作用所致。

(五) 其他影响利润的主要项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与日常活动相关的政府补助	1,863.68	656.89	1,648.41
个税手续费返还	34.96	28.40	20.59

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其他	7.70	0.05	-
合计	1,906.34	685.35	1,669.00

报告期内，公司其他收益金额分别为 1,669.00 万元、685.35 万元、1,906.34 万元，主要为公司收到的政府补助。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	-	119.62	3.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	25.54	15.93	-
合计	25.54	135.55	3.07

报告期内，公司的投资收益主要为理财收益，相关投资收益金额较小，未对公司经营产生重大影响。

3、信用减值损失和资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失明细如下：

单位：万元

项目	类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
信用减值损失	坏账损失	1,659.81	791.72	373.56
资产减值损失	存货跌价准备	7,234.18	14,550.29	931.50
合计		8,894.00	15,342.01	1,305.07

报告期内，公司应收账款和其他应收款账龄较短、回款情况良好，信用减值损失规模及营业收入占比均较小，对公司的盈利状况影响较小。

报告期内，公司存货跌价损失金额较高，存货跌价准备计提的具体情况参见本节“十一、资产质量分析”之“（二）流动资产构成及变动分析”之“7、存货”。

4、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为 4.95 万元、-3.18 万元和-1.96 万元，金

额较小，主要为固定资产处置损益。

5、营业外收入

报告期内，公司的营业外收入分别为 1.72 万元、6.64 万元和 1.46 万元，金额相对较小。

6、营业外支出

报告期内，公司营业外支出分别为 15.86 万元、0.09 万元和 0.26 万元，整体金额较小，主要为房屋租赁纠纷支出、税收滞纳金、资产报废损失等。

(六) 非经常性损益分析

1、非经常性损益的具体内容及金额

公司非经常性损益主要为政府补助、投资收益、一次性确认的股份支付费用等，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
计入当期损益的政府补助（与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,731.02	641.23	1,534.99
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益	25.54	135.55	3.07
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	-650.31
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.96	-3.18	4.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1.20	6.55	-14.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7.70	0.05	-
非经常性损益项目合计	1,763.50	780.21	878.57
所得税影响数	-0.35	-0.86	-0.31
合计	1,763.85	781.07	878.88

2、非经常性损益对当期经营成果的影响

报告期内，非经常性损益对当期经营成果的影响情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于母公司股东的非经常性损益影响数①	1,763.85	781.07	878.88
归属于母公司股东的净利润②	-47,028.70	-53,982.82	-36,569.22
占比①/②	-3.75%	-1.45%	-2.40%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-48,792.55	-54,763.89	-37,448.10

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，整体金额较小，对公司经营状况影响有限。

(七) 纳税情况

1、报告期内公司缴纳的主要税费

发行人报告期内主要税种缴纳情况如下：

(1) 增值税

单位：万元

期间	期初未交数	本期已交数	期末未交数
2023 年度	102.92	218.88	41.78
2024 年度	41.78	237.87	95.76
2025 年度	95.76	262.43	110.37

(2) 企业所得税

单位：万元

期间	期初未交数	本期已交数	期末未交数
2023 年度	3.01	4.16	5.44
2024 年度	5.44	17.86	0.67
2025 年度	0.67	3.67	15.11

2、报告期税收政策的变化及对发行人的影响

报告期内，公司不存在重大税收政策变化，税收优惠对经营成果的影响参见本节之“八、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策”之“（三）税收优惠的影响及可持续性”相关内容。

(八) 尚未盈利或存在累计未弥补亏损

报告期各期,公司归属于母公司股东的净利润分别为-36,569.22万元、-53,982.82万元、-47,028.70万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-37,448.10万元、-54,763.89万元和-48,792.55万元。截至报告期期末,公司累计未分配利润-127,926.22万元,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

1、原因分析

(1) 研发费用因素

为服务国家关键信息基础设施建设,满足自主存储供应链的重大战略需求并保持行业技术领先地位,公司连续多年投入大量资金用于研发高性能数据存储主控芯片及企业级固态硬盘,数据存储主控芯片和固态硬盘已实现从 SATA 到 PCIe 5.0 的主流代次全覆盖,以及企业级、消费级、工业级的应用领域全覆盖。报告期内,公司研发投入分别为 33,344.39 万元、30,512.79 万元和 26,643.93 万元,占当期营业收入的比重分别为 93.20%、48.82%和 25.76%,符合存储行业高研发投入的特点。

(2) 业务发展阶段因素

报告期内,公司以完整自研高性能数据存储主控芯片技术与产品为基础,凭借自研芯片及系统级解决方案能力技术优势,将业务逐步拓展至企业级固态硬盘产品,固态硬盘毛利率为 11.76%、0.77%和 0.13%。公司企业级固态硬盘业务持续导入大客户,为加快市场拓展,采取较为灵活的定价策略,且成本端规模效应未完全释放,故毛利率处于较低水平。

(3) 资产减值损失因素

报告期各期末,公司存货账面价值分别为 16,569.64 万元、39,593.44 万元和 68,643.80 万元,主要由原材料、产成品和合同履约成本构成。公司根据下游市场需求及主要原材料价格变动趋势管控存货规模。报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为 4,840.39 万元、18,464.97 万元和 18,483.00 万元,公司已根据存货的可变现净值低于成本的金额谨慎计提存货跌价准备。

(4) 股份支付因素

报告期内,公司为调动员工积极性,对员工进行股权激励,各期的股份支付费用分别为4,655.78万元、2,833.02万元和1,748.08万元,对当期净利润和期末大额未弥补亏损产生一定程度的影响,但随着业务规模的扩大,股份支付对公司业绩的影响逐渐减弱。

2、影响分析

(1) 对公司现金流的影响

报告期内,公司经营活动处于现金净流出状态,主要原因系①公司为保持行业地位持续进行高强度的研发投入;②销售规模持续扩大及主要原材料价格波动,公司基于业务发展预期而进行合理备货,因此各期支付的采购原材料金额较大,购买商品、接受劳务支付的现金较多。

公司作为以完整自研高性能数据存储主控芯片技术与产品为基础,将业务逐步拓展至企业级固态硬盘的半导体存储解决方案提供商,报告期内主要通过股权及银行贷款融资,融资渠道通畅。未来随着AI发展带动存储需求快速增长及国产替代趋势愈加明晰,公司销售规模将进一步扩大,盈利能力得到改善,经营性亏损金额将有望逐步缩小,能够通过持续性的经营活动产生现金流入。

(2) 对公司业务拓展的影响

公司拥有广泛的国际国内头部客户资源,形成了坚实的客户基础和市场认可,产品广泛应用于下游技术要求最高的企业级客户与知名消费级客户,并实现规模出货,包括客户A、联想、新华三、客户C、长江计算、超云、长城等国内头部服务器厂商,客户B、Bilibili、腾讯等互联网及云计算厂商,客户E、闪迪、威刚科技、佰维存储、江波龙等国际颗粒原厂及存储模组厂商,终端客户触达互联网、云计算、AI模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等各主要细分应用场景。

公司凭借芯片及固态硬盘全栈自研优势,能够提供定制化解决方案和持续固件更新,满足客户在数据存储性能、安全性和适配性方面的深度需求,从而实现业务的快速拓展。公司产品赋能全应用场景的竞争力和交付能力得到充分验证。因此,公司尚未实现盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损不会对公司业务拓展产生重大不利影响。

(3) 对公司人才吸引和团队稳定性的影响

公司高度重视优秀人才的引进和培养,将公司研发和技术创新团队的能力视为公司的核心资源。公司自成立以来建立了完善的人才招聘、培养和激励制度,聘用了大量行业知名专业人员,建立了一支卓越的全球化研发团队,并通过人才培养和人才梯队建设,为公司的可持续化发展提供人员保障。截至 2025 年末,公司研发人员数量为 198 人,占员工总数的比例为 64.29%。公司还通过员工持股计划,将员工的个人利益与公司的长远利益深度绑定,提高了员工对公司的认同度,增强了团队稳定性。因此,公司尚未实现盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损不会对公司团队建设产生重大不利影响。

(4) 对公司研发投入的影响

公司作为国际领先的数据存储主控芯片与半导体存储产品提供商,坚持以 AI SSD 为代表的企业级产品为核心,依托自主研发能力,突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈,实现信息存储核心环节的自主可控,产品广泛应用于 AI 驱动的算力中心、云服务等前沿场景。报告期各期,公司研发投入分别为 33,344.39 万元、30,512.79 万元和 26,643.93 万元。公司资金满足研发投入的需求,在不懈的高研发投入及攻坚下,公司芯片及固态硬盘产品已覆盖 SATA 到 PCIe 5.0,最新一代 PCIe 6.0 主控芯片和 CXL 主控芯片已于 2026 年上半年流片,产品代次发布国内领先,技术水平位居国际第一梯队。因此,公司尚未实现盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损不会对公司研发投入和战略性投入产生重大不利影响。

(5) 对公司生产经营可持续性的影响

公司以数据存储主控芯片技术为核心、以固态硬盘解决方案为载体为国内外市场提供存储相关产品与服务,实现了从 SATA 到 PCIe 全系列技术覆盖,并在固件内算法实现和模组设计上实现全面自研。公司最新一代 CXL 芯片作为国内首颗获得国际颗粒原厂合同的数据存储主控芯片,满足算力直连存储最新需求,预计将协同 GPU 共同驱动尖端 AI 应用场景,通过 GPU 直连架构、CXL 高速互连等前沿技术,与国内外 GPU 大厂深度协同,为人工智能算力中心提供高带宽、低延迟的存算一体解决方案。未来随着国产 GPU 在算力性能上的持续突破,公

公司将通过持续迭代的存算一体解决方案,带动国产 AI 基础设施实现跨越式发展。基于持续增长的市场需求及不断优化的产品结构,公司尚未实现盈利且最近一期未存在的累计未弥补亏损不会对公司生产经营可持续性产生重大不利影响。

3、趋势分析

公司是国内极少数具备企业级主控芯片及固态硬盘完整迭代研发能力的企业,助力我国半导体存储行业构建起从主控芯片、固件实现到存储模组的完整国产化链条,终端客户触达互联网、云计算、AI 模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等各主要细分应用场景。

报告期内,公司营业收入分别为 35,777.31 万元、62,496.77 万元和 103,418.31 万元,2023-2025 年营业收入复合增长率为 70.02%。公司持续推动产品迭代升级,并不断深化与优质客户的合作关系。随着公司自研数据存储主控芯片及固态硬盘产品陆续推出并全面导入下游客户,叠加人工智能等下游市场需求开始显现,2024 年至 2025 年度,公司经营业绩大幅增长。

未来,随着 AI 发展带动存储需求快速增长及国产替代趋势愈加明晰,市场规模持续扩大以及国产化份额进一步提升,加之公司不断完善产品布局、客户及市场影响力进一步增强,公司营业收入持续保持增长趋势确定性较大,未来成长具有可持续性。同时,随着公司市场地位的提升、业务规模的扩大,公司盈利情况将逐步改善。

4、风险因素

发行人已在本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一)重大风险提示”和“第三节 风险因素”之“二、与发行人相关的风险”中披露了发行人“尚未盈利且存在累计未弥补亏损风险”。

5、投资者保护措施及承诺

发行人已在本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序”披露了发行人在本次发行上市后,由公司全体新老股东按照本次发行上市后的持股比例共同享有(共同承担)本次发行前滚存的未分配利润(亏损)。发行人已在本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺事项”之“(二)关于持股意向和减持意向的

承诺”披露了发行人相关主体就减持股票做出的相关承诺。

十一、资产质量分析

(一) 资产总体分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	174,188.24	94.98%	98,975.40	91.26%	99,891.16	93.27%
非流动资产	9,204.69	5.02%	9,475.46	8.74%	7,207.62	6.73%
资产合计	183,392.93	100.00%	108,450.87	100.00%	107,098.78	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 107,098.78 万元、108,450.87 万元和 183,392.93 万元，随着公司经营及融资规模的扩大，公司的货币资金、应收账款、存货等资产规模不断增长。

报告期内，公司芯片产品制造采用 Fabless 模式，晶圆代工、封装、测试等工序均为委外生产，固态硬盘产品同样主要通过委外加工的方式进行生产装配，因此公司资产构成以流动资产为主，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 93.27%、91.26%和 94.98%，占比较高。

(二) 流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产的具体构成如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	39,603.96	22.74%	10,480.61	10.59%	61,037.39	61.10%
交易性金融资产	-	-	140.00	0.14%	190.00	0.19%
应收票据	1,829.21	1.05%	792.54	0.80%	279.28	0.28%
应收账款	53,339.69	30.62%	39,533.84	39.94%	14,839.38	14.86%
应收款项融资	544.63	0.31%	100.00	0.10%	-	-
预付款项	1,410.30	0.81%	796.54	0.80%	4,062.87	4.07%

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应收款	966.78	0.56%	365.70	0.37%	1,339.37	1.34%
存货	68,643.80	39.41%	39,593.44	40.00%	16,569.64	16.59%
其他流动资产	7,849.86	4.51%	7,172.71	7.25%	1,573.23	1.57%
流动资产合计	174,188.24	100.00%	98,975.40	100.00%	99,891.16	100.00%

公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。报告期各期末，上述三项合计占流动资产的比重分别为 92.55%、90.54%及 92.77%。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
银行存款	39,599.21	10,480.46	61,036.84
其他货币资金	4.75	0.16	0.55
合计	39,603.96	10,480.61	61,037.39

报告期各期末，公司货币资金分别为 61,037.39 万元、10,480.61 万元和 39,603.96 万元，占当期流动资产比例分别为 61.10%、10.59%和 22.74%。2024 年较 2023 年公司货币资金减少，主要系公司固态硬盘业务销售规模增长相应导致营运资金增加，另外为满足客户需求，公司增加 NAND 闪存颗粒、DRAM 等主要原材料的采购进行合理备货。2025 年公司货币资金增加主要系当年公司股权融资金额较大。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 190.00 万元、140.00 万元和 0 万元。报告期内公司为提高资金使用效率，使用闲置货币资金购买少量理财产品。

3、应收票据及应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资情况如下：

单位：万元

种类		2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收票据	银行承兑汇票	805.69	178.63	123.35
	商业承兑汇票	1,038.17	622.56	173.74
	减：坏账准备	14.65	8.65	17.81
	应收票据合计	1,829.21	792.54	279.28
应收款项融资	银行承兑汇票	544.63	100.00	-
	应收款项融资合计	544.63	100.00	-

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资的账面价值分别为 279.28 万元、892.54 万元和 2,373.84 万元，占流动资产的比例分别为 0.28%、0.90% 和 1.36%。报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资占流动资产比例较低，余额随销售规模增长有所增加。

报告期各期，公司所持银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失；公司接收的商业承兑汇票出票人主要为大型国企等信用良好的机构，报告期内未发生违约的情况，发生坏账的风险较小，公司已相应计提银行承兑汇票和商业承兑汇票的坏账准备。

4、应收账款

(1) 应收账款构成和变动分析

报告期各期末，公司应收账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收账款余额①	56,366.04	40,978.66	15,472.34
坏账准备②	3,026.35	1,444.82	632.96
坏账准备计提比例②/①	5.37%	3.53%	4.09%
应收账款账面价值③=①-②	53,339.69	39,533.84	14,839.38
流动资产④	174,188.24	98,975.40	99,891.16
应收账款账面价值/流动资产③/④	30.62%	39.94%	14.86%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 14,839.38 万元、39,533.84 万

元和 53,339.69 万元，占当期流动资产比例分别为 14.86%、39.94%和 30.62%。报告期各期末，公司应收账款账面价值持续增长主要系公司收入逐年增长，应收账款增长与营业收入增长趋势相同。

(2) 应收账款账龄及坏账准备分析

报告期各期末，公司应收账款余额账龄及坏账准备分析情况如下：

A、采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：万元

日期	账龄	账面余额		坏账准备	计提比例
		金额	占比		
2025 年 12 月 31 日	1 年以内	38,708.63	68.85%	433.98	1.12%
	1-2 年	15,573.85	27.70%	1,557.38	10.00%
	2-3 年	388.10	0.69%	116.43	30.00%
	3-4 年	1,553.81	2.76%	776.91	50.00%
	小计	56,224.39	100.00%	2,884.70	5.13%
2024 年 12 月 31 日	1 年以内	37,622.61	92.14%	459.98	1.22%
	1-2 年	637.09	1.56%	63.71	10.00%
	2-3 年	2,553.86	6.25%	766.16	30.00%
	3-4 年	20.26	0.05%	10.13	50.00%
	小计	40,833.82	100.00%	1,299.98	3.18%
2023 年 12 月 31 日	1 年以内	12,002.12	78.36%	140.89	1.17%
	1-2 年	3,293.30	21.50%	329.33	10.00%
	2-3 年	20.26	0.13%	6.08	30.00%
	小计	15,315.68	100.00%	476.30	3.11%

报告期各期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款余额占按组合计提的应收账款余额的比例均超过 60%，应收账款流动性较好、回收风险较小。

B、单项计提坏账准备

报告期各期末，公司按单项评估计提的坏账准备金额分别为 156.65 万元、144.84 万元和 141.65 万元，占各期末应收账款坏账准备余额的 24.75%、10.02%和 4.68%，主要系相关项目预计款项回收困难，故单项计提坏账准备。

(3) 坏账准备计提政策与同行业可比公司对比分析

公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司对比分析如下：

单位：%

账龄	0-3月	4-6月	7-12月	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
大普微	1	1	5	10	20	50	80	100
佰维存储	1	5	5	10	20	50	80	100
德明利	1	1	5	10	50	100	100	100
平均值	1	2	5	10	30	67	87	100
发行人	1	1	5	10	30	50	80	100

数据来源：同行业可比公司披露的年度报告或招股说明书；

注：联芸科技未披露坏账计提准备政策。

报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司无显著差异，应收账款坏账准备计提政策合理。

(4) 应收账款客户分析

报告期各期末，公司应收账款前五名客户的应收账款余额合计分别为12,789.32万元、28,890.96万元和36,584.64万元，占各期末应收账款余额的比例分别为82.66%、70.50%和64.91%。报告期各期末，公司应收账款前五名客户的情况如下：

①2025年12月31日

单位：万元

序号	单位名称	应收账款账面余额	占应收账款期末余额的比例	坏账准备
1	客户A	15,171.20	26.92%	151.71
2	芯科睿	7,231.73	12.83%	406.65
3	德梧信息	5,254.84	9.32%	453.11
4	新华三	4,837.20	8.58%	48.37
5	湖南天硕	4,089.66	7.26%	386.58
	小计	36,584.64	64.91%	1,446.43

注：同一控制下的客户合并列示，下同。

②2024年12月31日

单位：万元

序号	单位名称	应收账款账面余额	占应收账款期末余额的比例	坏账准备
1	芯科睿	8,941.66	21.82%	138.30
2	客户 A	7,483.43	18.26%	74.83
3	德梧信息	4,450.65	10.86%	44.51
4	圣鼎达	4,036.35	9.85%	842.76
5	湖南天硕	3,978.88	9.71%	39.79
小计		28,890.96	70.50%	1,140.19

③2023 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	单位名称	应收账款账面余额	占应收账款期末余额的比例	坏账准备
1	圣鼎达	4,343.46	28.07%	353.05
2	佰维存储	4,172.44	26.97%	41.72
3	芯科睿	2,641.11	17.07%	26.41
4	威刚科技	1,000.19	6.46%	10.00
5	江波龙	632.13	4.09%	6.32
小计		12,789.32	82.66%	437.51

(5) 应收账款期后回款情况

报告期各期末，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
应收账款账面余额	56,366.04	40,978.66	15,472.34
期后回款金额 (注)	45,625.05	35,193.89	15,448.65
占比	80.94%	85.88%	99.85%

注：期后回款金额系截至 2026 年 6 月 18 日回款金额。

5、预付款项

(1) 预付款项总体情况

报告期各期末，公司预付款项账龄情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,410.30	100.00%	796.54	100.00%	4,062.70	99.99%
1-2年	-	-	-	-	0.17	0.01%
合计	1,410.30	100.00%	796.54	100.00%	4,062.87	100.00%

报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为4,062.87万元、796.54万元和1,410.30万元，占当期流动资产比例分别为4.07%、0.80%和0.81%，占比较小，主要为预付晶圆厂的材料款项、委外加工费等。

(2) 预付款项供应商分析

报告期各期末，公司预付款项前五名供应商的预付款项余额合计分别为3,920.59万元、638.72万元和1,246.02万元，占各期末预付款项余额的比例分别为96.49%、80.18%和88.35%。报告期各期末，公司预付款项前五名供应商的情况如下：

① 2025年12月31日

单位：万元

序号	供应商名称	预付款项账面余额	占预付款项期末余额的比例	账龄
1	联芯集成	436.72	30.97%	1年以内
2	供应商C	433.71	30.75%	1年以内
3	供应商F	266.28	18.88%	1年以内
4	供应商G	90.91	6.45%	1年以内
5	上海一平知识产权代理有限公司	18.40	1.30%	1年以内
小计		1,246.02	88.35%	-

② 2024年12月31日

单位：万元

序号	供应商名称	预付款项账面余额	占预付款项期末余额的比例	账龄
1	供应商D	453.64	56.95%	1年以内
2	联芯集成	94.10	11.81%	1年以内
3	中国平安财产保险股份有限公司	49.16	6.17%	1年以内

序号	供应商名称	预付款项账面余额	占预付款项期末余额的比例	账龄
4	浙江华忆芯科技有限公司	23.22	2.91%	1年以内
5	上海一平知识产权代理有限公司	18.61	2.34%	1年以内
小计		638.72	80.18%	-

③2023年12月31日

单位：万元

序号	供应商名称	预付款项账面余额	占预付款项期末余额的比例	账龄
1	供应商 E	2,700.25	66.46%	1年以内
2	供应商 D	1,157.99	28.50%	1年以内
3	联芯集成	33.47	0.82%	1年以内
4	上海陆家嘴物业管理有限公司	15.40	0.38%	1年以内
5	上海一平知识产权代理有限公司	13.48	0.33%	1年以内
小计		3,920.59	96.49%	-

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款按款项性质分类情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
代收代付款	912.69	93.48%	227.80	61.50%	899.30	66.49%
押金及保证金	63.65	6.52%	142.63	38.50%	415.45	30.71%
其他	-	-	-	-	37.87	2.80%
账面余额合计	976.34	100.00%	370.43	100.00%	1,352.62	100.00%
减：其他应收坏账准备	9.57	0.98%	4.73	1.28%	13.26	0.98%
账面价值合计	966.78	99.02%	365.70	98.72%	1,339.37	99.02%

报告期各期末，其他应收款的账面价值分别为 1,339.37 万元、365.70 万元和 966.78 万元，占当期流动资产比例分别为 1.34%、0.37%和 0.56%，占比较小。2024 年公司其他应收款账面价值较低，主要系 2024 年公司代客户采购产品金额减少所致。

7、存货

(1) 存货构成情况

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
原材料	31,414.04	45.76%	17,420.06	44.00%	2,286.29	13.80%
在产品	5,290.19	7.71%	5,695.51	14.38%	2,961.13	17.87%
产成品	23,039.85	33.56%	12,434.85	31.41%	8,062.90	48.66%
发出商品	1,342.74	1.96%	155.21	0.39%	-	-
合同履约成本	7,556.98	11.01%	3,887.82	9.82%	3,259.33	19.67%
合计	68,643.80	100.00%	39,593.44	100.00%	16,569.64	100.00%

公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、发出商品和合同履约成本。报告期各期末，公司存货账面价值分别为16,569.64万元、39,593.44万元和68,643.80万元，占流动资产比例分别为16.59%、40.00%及39.41%。

公司原材料主要为 NAND 闪存颗粒、DRAM、晶圆等材料。公司晶圆材料出库并在封装代工厂及测试厂商加工时为在产品；芯片的全部生产、封装、测试环节完成并入库后为产成品。公司 NAND 闪存颗粒及 DRAM 等原材料出库并在委托加工厂商进行委托组装及组装测试等生产环节时为在产品；固态硬盘的全部组装生产及固件烧录、成品测试等环节完成后转为产成品。公司的合同履约成本主要为尚未满足收入确认条件的技术服务项目已投入的成本等。

(2) 存货变动原因分析

2024 年度，公司主营业务中固态硬盘业务快速增长，公司对 NAND 闪存颗粒及 DRAM 采购量显著上升。同时，随着存储行业上游供给侧库存调节政策效果显著，NAND 闪存颗粒及 DRAM 市场价格呈现总体上涨态势，因此原材料金额上涨。此外，在公司业务快速扩张的背景下，加之企业级固态硬盘下游应用场景不断丰富市场需求迅速增长，公司结合自身对行业发展趋势的预测及下游客户需求积极采购原材料进行备货，推动存货金额上涨。2025 年度，公司存货金额

上涨，主要系一方面公司业务规模快速扩张，相应提高备货量；另一方面，原材料市场价格上涨态势进一步加剧。

(3) 存货跌价准备情况

报告期各期末，公司存货余额及计提跌价准备情况如下：

单位：万元

2025年12月31日					
项目	账面余额	跌价准备	计提比例	账面价值	账面价值占比
原材料	36,533.08	5,119.04	14.01%	31,414.04	45.76%
在产品	6,436.46	1,146.27	17.81%	5,290.19	7.71%
产成品	28,028.71	4,988.86	17.80%	23,039.85	33.56%
发出商品	1,382.07	39.33	2.85%	1,342.74	1.96%
合同履约成本	14,746.49	7,189.50	48.75%	7,556.98	11.01%
合计	87,126.80	18,483.00	21.21%	68,643.80	100.00%
2024年12月31日					
项目	账面余额	跌价准备	计提比例	账面价值	账面价值占比
原材料	21,842.19	4,422.13	20.25%	17,420.06	44.00%
在产品	6,376.89	681.39	10.69%	5,695.51	14.38%
产成品	18,454.11	6,019.26	32.62%	12,434.85	31.41%
发出商品	155.21	-	-	155.21	0.39%
合同履约成本	11,230.02	7,342.20	65.38%	3,887.82	9.82%
合计	58,058.42	18,464.97	31.80%	39,593.44	100.00%
2023年12月31日					
项目	账面余额	跌价准备	计提比例	账面价值	账面价值占比
原材料	3,978.21	1,691.92	42.53%	2,286.29	13.80%
在产品	3,542.64	581.51	16.41%	2,961.13	17.87%
产成品	10,629.86	2,566.96	24.15%	8,062.90	48.66%
合同履约成本	3,259.33	-	-	3,259.33	19.67%
合计	21,410.04	4,840.39	22.61%	16,569.64	100.00%

公司存货跌价准备按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。报告期各期末，

公司存货跌价准备余额分别为 4,840.39 万元、18,464.97 万元和 18,483.00 万元，存货跌价计提比例分别为 22.61%、31.80%和 21.21%。2024 年存货跌价准备余额上升，主要系公司主营业务中固态硬盘业务快速增长，由于金融、通信等关键领域的代际升级和国产替代需求竞争剧烈，为快速提高市场占有率并夯实长期市场基础，公司采取灵活定价策略，因此公司计提了较大规模的存货跌价准备。2025 年，由于部分主要原材料价格剧烈波动导致公司采购成本上升，公司相应计提较大规模的存货跌价准备。

合同履行成本主要系为客户开发数据存储主控芯片产品和固态硬盘产品等。由于客户规划调整、新增服务内容等特殊原因，导致项目产生额外的成本，因此计提较大规模的减值准备。

(4) 存货跌价准备计提比例比较

公司与同行业可比公司的存货跌价准备综合计提比例情况对比如下：

可比公司	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
大普微	4.72%	12.66%	37.68%
佰维存储	2.40%	7.43%	6.55%
德明利	0.50%	1.50%	1.34%
联芸科技	3.91%	10.05%	11.90%
慧荣科技	未披露	未披露	未披露
群联电子	未披露	未披露	未披露
Marvell	未披露	未披露	未披露
FADU	未披露	未披露	未披露
平均值	2.89%	7.91%	14.37%
英韧科技	21.21%	31.80%	22.61%
英韧科技(剔除合同履行成本影响)	15.60%	23.75%	26.67%

注：以上数据取自可比公司招股说明书、定期报告等公开披露材料。

报告期内，公司存货跌价准备比例高于同行业平均水平。公司与联芸科技、德明利、佰维存储在产品结构和存货构成上存在差异：联芸科技主要产品为芯片类产品，毛利率相对较高；德明利和佰维存储主要产品为消费级固态硬盘及嵌入式存储，相比于企业级固态硬盘，其市场相对成熟，因此存货跌价计提比例较低。

2023 年度，公司存货跌价比例低于大普微，主要系大普微 2023 年企业级存储硬盘产品代际更迭对低代际产品计提较高比例存货跌价。2024 年度，公司存货跌价比例高于大普微，主要系为提高金融、通信等关键领域的国产替代市场占有率，公司采取灵活定价策略，因此存货跌价计提比例较高。2025 年度，公司存货跌价比例高于大普微，主要系公司部分主要原材料价格剧烈波动导致公司采购成本上升，公司计提较大的跌价比例。

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待认证和待抵扣进项税	7,410.41	6,996.40	1,528.79
上市费用	394.54	127.21	-
预付税金	44.91	49.10	44.43
合计	7,849.86	7,172.71	1,573.23

报告期各期末，公司其他流动资产期末余额分别为 1,573.23 万元、7,172.71 万元和 7,849.86 万元，占流动资产的比例分别为 1.57%、7.25%和 4.51%。主要为公司待认证和待抵扣进项税。2024 年及 2025 年，公司待认证和待抵扣进项税增长，主要系主营业务中固态硬盘业务快速增长，公司相应增加 NAND 闪存颗粒、DRAM、晶圆等原材料的采购。

(三) 非流动资产构成及变动分析

报告期内，公司非流动资产的构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期应收款	194.18	2.11%	234.94	2.48%	235.55	3.27%
固定资产	1,764.16	19.17%	1,769.84	18.68%	2,016.13	27.97%
在建工程	-	-	45.46	0.48%	58.04	0.81%
使用权资产	1,278.58	13.89%	2,097.60	22.14%	1,877.13	26.04%
无形资产	4,969.67	53.99%	4,858.26	51.27%	2,217.88	30.77%

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期待摊费用	183.42	1.99%	469.37	4.95%	802.88	11.14%
其他非流动资产	814.68	8.85%	-	-	-	-
非流动资产合计	9,204.69	100.00%	9,475.46	100.00%	7,207.62	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、使用权资产、无形资产构成，上述三项合计占非流动资产的比例均超过 80%。

1、固定资产

(1) 基本情况

报告期各期末，公司固定资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子设备	620.09	35.15%	697.68	39.42%	508.91	25.24%
机器设备	1,112.24	63.05%	1,021.52	57.72%	1,443.57	71.60%
办公家具	31.83	1.80%	50.64	2.86%	63.65	3.16%
合计	1,764.16	100.00%	1,769.84	100.00%	2,016.13	100.00%

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,016.13 万元、1,769.84 万元和 1,764.16 万元，占非流动资产的比例 27.97%、18.68%和 19.17%。报告期内，公司办公场所均为租赁取得，公司芯片产品制造采用 Fabless 模式，晶圆代工、封装、测试等工序均为委外生产，固态硬盘产品同样主要通过委外加工的方式进行生产装配，具有“轻资产”的特点。公司固定资产以电子设备及机器设备为主，电子设备主要包括服务器及 IT 设备，机器设备主要包括用于研发、生产测试的产线设备。

(2) 固定资产原值及折旧计提情况

报告期各期末，公司固定资产原值及折旧情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
一、账面原值			
电子设备	1,971.12	1,671.79	1,156.74
机器设备	4,984.16	4,281.53	3,882.72
办公家具	126.21	126.94	124.78
合计	7,081.50	6,080.25	5,164.25
二、累计折旧			
电子设备	1,351.03	974.11	647.83
机器设备	3,871.92	3,260.00	2,439.15
办公家具	94.38	76.30	61.13
合计	5,317.33	4,310.41	3,148.11
三、账面价值			
电子设备	620.09	697.68	508.91
机器设备	1,112.24	1,021.52	1,443.57
办公家具	31.83	50.64	63.65
合计	1,764.16	1,769.84	2,016.13

报告期内，公司固定资产运行状况良好，不存在减值迹象，公司未对其计提减值准备。

(3) 固定资产折旧政策及同行业可比公司比较分析

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，与同行业可比公司的对比情况如下：

类别	折旧年限				
	联芸科技	德明利	佰维存储	大普微	发行人
电子设备	3-6年	5年	3-10年	-	3年
机器设备	专用设备3-7年/通用设备3-6年	10年	10年	专用设备5-10年/通用设备5年	3年-10年
办公家具	-	-	-	-	5年
其他设备	-	-	-	3年	-

经对比,公司与同行业上市公司固定资产的折旧年限基本一致,不存在重大差异。

2、在建工程

报告期各期末,公司在建工程余额分别为 58.04 万元、45.46 万元和 0 万元,主要为房屋装修及尚未达到可使用状态的办公软件。

3、使用权资产

报告期各期末,公司使用权资产情况如下:

单位:万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面原值	4,993.18	4,882.99	3,703.07
累计折旧	3,714.60	2,785.39	1,825.94
账面价值	1,278.58	2,097.60	1,877.13

报告期各期末,公司使用权资产账面价值分别为 1,877.13 万元、2,097.60 万元和 1,278.58 万元。公司报告期内执行新租赁准则,对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。公司将用于办公及研发的租赁的房屋及建筑物计入使用权资产。

4、无形资产

报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为 2,217.88 万元、4,858.26 万元和 4,969.67 万元,公司无形资产主要为 EDA 及软件,无形资产账面价值情况如下:

单位:万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
EDA 及软件	4,969.67	4,858.26	2,217.88
合计	4,969.67	4,858.26	2,217.88

报告期各期末,公司无形资产原值与摊销情况如下:

单位:万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
原值	9,441.48	7,737.43	11,402.51

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
累计摊销	4,471.81	2,879.16	9,184.63
账面价值	4,969.67	4,858.26	2,217.88

报告期内，公司无形资产状况良好，主要系 EDA 及软件，不存在资产减值情况。

5、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为 802.88 万元、469.37 万元和 183.42 万元。具体如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
装修工程	183.42	469.37	802.88
合计	183.42	469.37	802.88

2023 年末长期待摊费用增长幅度较大，主要系办公室装修完工转入所致。

6、长期应收款

报告期各期末，公司长期应收款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
产能保证金	-	-	106.24
房租押金	196.10	237.27	131.64
坏账准备	1.92	2.33	2.33
合计	194.18	234.94	235.55

报告期各期末，公司长期应收款分别为 235.55 万元、234.94 万元和 194.18 万元，主要为房屋租金及产能保证金。

7、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元和 814.68 万元，主要为新购置用于生产经营的房产所支付的款项。

(四) 资产周转能力分析

1、公司资产周转能力情况

报告期各期，公司主要资产周转能力指标如下：

单位：次

营运能力指标	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收账款周转率	2.12	2.21	2.75
存货周转率	1.35	1.40	1.19

2、资产周转能力同行业对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司资产周转能力对比如下：

(1) 应收账款周转率

单位：次

可比公司	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
大普微	4.61	5.10	2.99
联芸科技	3.45	3.22	4.77
佰维存储	9.29	9.24	6.21
德明利	18.89	11.30	4.21
慧荣科技	3.93	3.78	3.22
群联电子	6.12	6.14	5.46
Marvell	4.54	4.85	4.43
FADU	9.42	5.61	5.32
平均值	7.53	6.15	4.58
本公司	2.12	2.21	2.75

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.75 倍、2.21 倍和 2.12 倍。报告期内，公司应收账款周转率总体低于同行业可比公司水平，主要系①公司业绩处于高速增长阶段，且下半年销售收入高于上半年，故年末应收账款金额较大；②部分客户资金周转影响，资金周转存在一定压力，回款期较长。

(2) 存货周转率

单位：次

可比公司	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
大普微	1.62	0.88	1.68
联芸科技	1.37	2.24	1.77
佰维存储	1.49	1.44	1.20
德明利	1.58	1.21	1.08
慧荣科技	1.46	2.11	1.47
群联电子	1.58	1.59	1.44
Marvell	3.28	3.59	3.41
FADU	1.34	1.55	0.83
平均值	1.72	1.83	1.61
本公司	1.35	1.40	1.19

2023年至2025年,公司存货周转率与同行业可比公司不存在重大差异。2023年度,公司存货周转率低于同行业可比公司,主要系公司企业级固态硬盘产品尚处于客户验证阶段初期,经营规模相对较小;2024年公司顺利通过多家行业头部客户的导入测试并实现规模出货,存货周转率上升,2025年度公司存货周转率下降,主要系在公司业务规模快速扩张的背景下,加之原材料市场剧烈波动,公司结合下游客户需求和市场预测积极采购原材料进行备货从而导致期末存货金额较高。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

(一) 负债总体分析

报告期各期末,公司负债构成情况如下:

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	107,677.68	94.11%	83,724.84	83.35%	44,864.72	80.20%
非流动负债	6,735.76	5.89%	16,721.58	16.65%	11,079.12	19.80%
负债合计	114,413.44	100.00%	100,446.41	100.00%	55,943.84	100.00%

报告期各期末,公司流动负债余额分别为44,864.72万元、83,724.84万元和

107,677.68 万元，占负债总额的比例分别为 80.20%、83.35%和 94.11%，公司负债以流动负债为主，流动负债主要来自短期借款及生产经营过程中产生的应付账款等经营性流动负债。

(二) 流动负债构成及变化分析

报告期各期末，公司的流动负债具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	54,640.18	50.74%	55,930.50	66.80%	31,838.21	70.96%
应付账款	16,459.11	15.29%	8,576.32	10.24%	1,414.51	3.15%
应付票据	2,400.00	2.23%	-	-	-	-
合同负债	6,213.61	5.77%	1,947.62	2.33%	563.73	1.26%
应付职工薪酬	5,678.90	5.27%	6,130.08	7.32%	5,864.17	13.07%
应交税费	531.58	0.49%	417.46	0.50%	374.64	0.84%
其他应付款	4,170.53	3.87%	1,335.99	1.60%	1,901.54	4.24%
其他流动负债	501.06	0.47%	119.49	0.14%	81.79	0.18%
一年内到期的非流动负债	17,082.72	15.86%	9,267.39	11.07%	2,826.13	6.30%
流动负债合计	107,677.68	100.00%	83,724.84	100.00%	44,864.72	100.00%

报告期各期末，流动负债主要由短期借款、应付账款、应付票据、应付职工薪酬以及一年内到期的非流动负债构成，上述项目合计占流动负债的比例分别为 93.49%、95.44%和 89.40%，占比相对较高。公司流动负债的具体情况如下：

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 31,838.21 万元、55,930.50 万元和 54,640.18 万元，主要为公司日常营运所需的银行借款，报告期内，公司不存在逾期未偿还的短期借款。

2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 0 万元、0 万元和 2,400.00 万元，公司应付票据为支付供应商采购款开具的银行承兑汇票。

3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付采购款	16,459.11	8,576.32	1,414.51
合计	16,459.11	8,576.32	1,414.51

报告期各期末，公司应付账款金额分别为 1,414.51 万元、8,576.32 万元和 16,459.11 万元，占流动负债比例为 3.15%、10.24%和 15.29%，主要系应付供应商的货款。

2024 年末，公司企业级固态硬盘销售规模增长，公司相应增加 NAND 闪存颗粒及 DRAM 采购，且原材料市场价格呈现总体上涨态势，公司结合自身对行业发展趋势的预测及下游客户需求进行合理备货，推动应付账款余额增加。2025 年末，应付账款余额进一步增长，主要系公司业务规模增长、主要原材料涨价及公司进行合理备货所致。

4、合同负债

报告期各期末，公司合同负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
预收服务费	6,179.64	1,780.89	208.18
货物返利	9.05	159.76	354.12
预收货款	24.91	6.97	1.42
合计	6,213.61	1,947.62	563.73

报告期各期末，公司合同负债分别为 563.73 万元、1,947.62 万元和 6,213.61 万元。2024 年及 2025 年末，合同负债余额增幅较快主要因技术服务项目而取得的预收款项较大。

5、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
短期薪酬	5,588.11	6,044.98	5,784.27
离职后福利—设定提存计划	90.79	85.09	79.90
合计	5,678.90	6,130.08	5,864.17

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 5,864.17 万元、6,130.08 万元和 5,678.90 万元，占流动负债比例分别为 13.07%、7.32%和 5.27%，主要为员工工资、奖金、社保公积金等。

6、应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为 374.64 万元、417.46 万元和 531.58 万元，占流动负债的比例分别为 0.84%、0.50%和 0.49%，占比较小，主要为代扣代缴个人所得税、增值税等。

7、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
代收代付款	1,901.32	-	984.46
应付服务费	1,751.64	806.01	102.89
应付设备服务费	179.25	124.16	31.69
应付员工福利费	130.54	97.28	154.86
应付办公费	86.71	124.08	137.00
应付采购款	50.42	122.94	466.18
应付利息	20.80	19.11	11.24
其他	49.86	42.40	13.23
合计	4,170.53	1,335.99	1,901.54

报告期各期末，公司其他应付款分别为 1,901.54 万元、1,335.99 万元和 4,170.53 万元，公司其他应付款主要为代收代付款及应付服务费，其中应付服务费主要系财务顾问融资服务费用、技术服务费用。

8、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 81.79 万元、119.49 万元和 501.06 万元，公司其他流动负债主要为产品质量保证金。

9、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应付款	2,675.38	2,305.78	1,110.73
一年内到期的租赁负债	873.85	925.57	568.68
一年内到期的长期借款	13,533.49	6,036.04	1,146.73
合计	17,082.72	9,267.39	2,826.13

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 2,826.13 万元、9,267.39 万元和 17,082.72 万元，占当期流动负债的比例分别为 6.30%、11.07%和 15.86%，主要为一年内到期的长期应付款和一年内到期的长期借款。

(三) 非流动负债构成及变化分析

报告期内，公司非流动负债的构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	4,053.59	60.18%	13,111.90	78.41%	9,225.48	83.27%
租赁负债	554.78	8.24%	1,300.00	7.77%	1,281.28	11.56%
长期应付款	2,021.33	30.01%	2,309.68	13.81%	477.87	4.31%
预计负债	-	-	-	-	8.95	0.08%
递延收益	106.06	1.57%	-	-	85.55	0.77%
非流动负债合计	6,735.76	100.00%	16,721.58	100.00%	11,079.12	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债分别为 11,079.12 万元、16,721.58 万元和 6,735.76 万元，主要由长期借款、租赁负债和长期应付款构成，上述项目合计占非流动负债的比例分别为 99.15%、100%和 98.43%。公司非流动负债的具体情况

如下:

1、长期借款

报告期各期末,公司长期借款分别为9,225.48万元、13,111.90万元和4,053.59万元,主要为保障公司业务发展、补充运营资金等合理商业需求向商业银行申请的长期贷款。

2、租赁负债

报告期各期末,公司租赁负债分别为1,281.28万元、1,300.00万元和554.78万元,占非流动负债的比例分别为11.56%、7.77%和8.24%。租赁负债主要系发行人租用办公场所需要支付的房屋租金。

3、长期应付款

报告期各期末,公司长期应付款分别为477.87万元、2,309.68万元和2,021.33万元,长期应付款主要为根据相关合同,未来需支付的软件使用许可费。

4、预计负债

报告期各期末,公司预计负债分别为8.95万元、0万元和0万元,主要为未决诉讼计提的预计负债。上述金额较小,不会对公司业务开展、持续经营及偿债能力产生重大不利影响。

5、递延收益

报告期各期末,公司递延收益分别为85.55万元、0.00万元和106.06万元,主要为已收到未摊销的政府补助。

(四) 偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债指标如下:

偿债指标	2025年度/末	2024年度/末	2023年度/末
流动比率(倍)	1.62	1.18	2.23
速动比率(倍)	0.89	0.61	1.73
资产负债率(合并)	62.39%	92.62%	52.24%
利息保障倍数(倍)	-13.19	-23.37	-26.83

偿债指标	2025 年度/末	2024 年度/末	2023 年度/末
息税折旧摊销前利润(万元)	-39,022.45	-46,410.02	-29,716.01

报告期各期末,公司流动比率分别为 2.23 倍、1.18 倍和 1.62 倍,速动比率分别为 1.73 倍、0.61 倍及 0.89 倍,资产负债率分别为 52.24%、92.62%和 62.39%。2024 年末,公司流动比率、速动比率有所下降,资产负债率较之前年度有所上升,主要系当年度为满足日常生产经营借款增加所致;随着 2025 年度公司完成融资,账面货币资金增幅较大,流动比率及速动比率均较 2024 年有所提升,资产负债率大幅降低,公司偿债能力得以改善。

报告期内,公司息税折旧摊销前利润分别为-29,716.01 万元、-46,410.02 万元和-39,022.45 万元。2024 年公司息税折旧摊销前利润较之前年度降低,主要系公司主营业务中固态硬盘业务快速增长,为保持技术先进性持续进行大额研发投入,及存储行业周期波动导致存货跌价计提金额较大等因素共同作用所致。2025 年公司息税折旧摊销前利润收窄,虽然公司经营规模扩张较快,但因公司研发投入、存货跌价计提仍较大,息税折旧摊销前利润较之前年度有所增加。

1、短期偿债能力分析

报告期各期末,公司流动比率、速动比率与同行业可比公司的对比情况如下:

项目	公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率	大普微	1.14	1.67	1.90
	联芸科技	5.31	6.06	3.19
	佰维存储	1.64	1.24	1.25
	德明利	1.54	1.94	1.49
	慧荣科技	2.79	3.98	3.73
	群联电子	2.71	3.80	2.29
	Marvell	2.01	1.54	1.69
	FADU	1.07	3.16	4.05
	平均值	2.28	2.92	2.45
	本公司	1.62	1.18	2.23
速动比率	大普微	0.48	0.52	1.12

项目	公司名称	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
	联芸科技	3.84	5.07	2.24
	佰维存储	0.50	0.40	0.26
	德明利	0.24	0.43	0.38
	慧荣科技	1.22	2.56	2.39
	群联电子	1.27	2.03	1.16
	Marvell	1.50	0.98	1.14
	FADU	0.55	1.95	3.65
	平均值	1.20	1.74	1.54
	本公司	0.89	0.61	1.73

注：以上数据取自可比公司招股说明书、定期报告等公开披露材料。

公司各期末流动比率低于同行业可比公司平均值，系同行业可比公司主要为上市公司，可通过多元化融资方式进行融资，且鉴于报告期内公司业务快速扩张，日常经营所需资金较多，公司流动比率低于同行业可比公司平均值具有合理性。

2023年末，公司速动比率与同行业可比公司平均水平差异较小；2024年末，因日常生产经营所需借款增幅较大所致，公司速动比率低于同行业可比公司平均值，随着2025年度公司完成融资，公司偿债能力得以改善，速动比率与同行业可比公司差异缩小。

2、长期偿债能力分析

公司资产负债率与同行业可比公司对比如下：

公司名称	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
大普微	85.65%	57.00%	46.73%
联芸科技	19.08%	18.05%	39.37%
佰维存储	64.47%	69.47%	69.66%
德明利	69.87%	62.22%	65.84%
慧荣科技	32.06%	25.12%	27.11%
群联电子	29.91%	29.24%	34.13%
Marvell	35.79%	33.54%	30.13%
FADU	83.86%	27.14%	23.52%

公司名称	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
平均值	52.59%	40.22%	42.06%
本公司	62.39%	92.62%	52.24%

注：以上数据取自可比公司招股说明书、定期报告等公开披露材料。

鉴于同行业可比公司主要为上市公司，融资渠道较为多元，且发行人尚处未盈利阶段，发行人资产负债率整体高于可比公司平均水平具有合理性。

公司2023年、2025年末资产负债率与同行业可比公司水平差异较小，2024年公司资产负债率高于同行业可比公司，主要系公司为满足当年度生产经营借款所致，随着公司2025年度完成融资，公司资产负债率降幅较大，公司偿债能力得以改善。

(五) 现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	-65,280.38	-85,172.22	-37,519.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,932.19	-1,077.88	-1,689.00
筹资活动产生的现金流量净额	96,386.14	35,654.47	67,005.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50.22	38.85	57.50
现金及现金等价物净增加额	29,123.35	-50,556.78	27,853.80
期初现金及现金等价物余额	10,480.61	61,037.39	33,183.59
期末现金及现金等价物余额	39,603.96	10,480.61	61,037.39

1、经营活动产生的现金流量分析

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额变动分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
销售商品、提供劳务收到的现金	97,346.09	40,776.07	31,589.59
收到的税费返还	10,331.71	1,964.96	3,280.49
收到其他与经营活动有关的现金	30,477.21	3,212.66	5,239.86

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计①	138,155.01	45,953.70	40,109.95
购买商品、接受劳务支付的现金	138,708.91	89,467.31	37,045.26
支付给职工以及为职工支付的现金	24,664.67	24,793.28	22,182.33
支付的各项税费	464.15	435.03	297.67
支付其他与经营活动有关的现金	39,597.67	16,430.30	18,104.59
经营活动现金流出小计②	203,435.40	131,125.92	77,629.85
经营活动产生的现金流量净额③=②-①	-65,280.38	-85,172.22	-37,519.90

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-37,519.90 万元、-85,172.22 万元和-65,280.38 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出，主要系①报告期内公司处于尚未盈利阶段。公司为提升产品竞争力，持续保持高强度研发投入，经营活动流入现金尚无法全部覆盖各项成本费用支出；②报告期内因销售规模持续扩大及主要原材料价格波动，公司进行合理备货，故购买商品、接受劳务支付的现金较多。

(2) 经营活动现金流量净额与净利润匹配关系分析

报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量的过程如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净亏损	-47,028.70	-53,982.82	-36,569.22
加：资产减值损失	7,234.18	14,550.29	931.50
信用减值损失	1,659.81	791.72	373.56
固定资产折旧	1,048.95	1,115.43	1,155.23
使用权资产折旧	955.43	950.18	873.19
无形资产摊销	2,447.07	2,881.97	3,211.27
长期待摊费用摊销	224.22	402.11	293.22
股份支付费用	1,606.48	2,524.94	4,481.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/收益	1.96	3.18	-4.95
财务费用	3,435.56	2,281.94	1,313.76
投资收益	-25.54	-135.55	-3.07

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货的增加	-35,981.54	-37,399.89	-4,407.98
经营性应收项目的增加	-18,371.82	-21,728.09	-9,399.21
经营性应付项目的增加	17,337.66	2,642.19	208.77
汇兑损益	175.88	-69.81	22.52
经营活动使用的现金流量净额	-65,280.38	-85,172.22	-37,519.90

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要受存货、经营性应收项目和股份支付变动所致。该差异主要是随着公司快速发展，公司存货规模、应收账款相应和股份支付增加所致，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额勾稽关系合理，与公司的实际经营情况相匹配。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	8,640.00	3,050.00	-
取得投资收益收到的现金	25.54	135.55	3.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.52	0.23	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	162.99
投资活动现金流入小计	8,666.06	3,185.79	166.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,098.24	1,263.67	1,719.80
投资支付的现金	8,500.00	3,000.00	50.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	85.27
投资活动现金流出小计	10,598.24	4,263.67	1,855.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,932.19	-1,077.88	-1,689.00

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,689.00 万元、-1,077.88 万元和-1,932.19 万元。公司收回投资收到的现金以及投资支付的现金主要系理财产品的赎回和购买。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	106,000.00	8,000.00	47,158.77
取得借款收到的现金	84,801.35	93,972.31	52,308.99
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	190,801.35	101,972.31	99,467.76
偿还债务支付的现金	87,540.80	61,154.27	27,139.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,990.22	1,907.14	1,081.54
支付其他与筹资活动有关的现金	3,884.20	3,256.42	4,241.79
筹资活动现金流出小计	94,415.22	66,317.83	32,462.55
筹资活动产生的现金流量净额	96,386.14	35,654.47	67,005.20

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 67,005.20 万元、35,654.47 万元和 96,386.14 万元。公司筹资活动现金流入主要为公司进行股权融资和借款获得的现金，筹资活动现金流出主要为偿还借款本金和利息而支付的现金。

(六) 重大资本性支出分析

1、报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司重大资本性支出主要是购买芯片设计所需的 EDA 及软件、检测设备和办公场所装修等发生的资本性支出。报告期各期，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项下的现金流出分别为 1,719.80 万元、1,263.67 万元和 2,098.24 万元。

2、未来可预见的重大资本性支出情况

本次募集资金投资项目的投资支出情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”相关内容。

(七) 流动性变化趋势及应对措施

报告期内，公司负债以流动负债为主，主要系短期借款及公司经营过程中形

成的经营性负债，随着公司业务规模的扩大，经营性负债也随之增加，该部分负债不存在重大流动性风险。

目前，公司已建立了完善的资金管理制度，通过强化内部控制和实行合理监督以提高营运资金使用效率，防范流动性风险。未来，公司将通过公开发行股票、申请中长期贷款、提高应收账款回款速度等方式降低财务杠杆、优化债务结构和改善经营活动现金流，以降低公司的流动性风险。

(八) 报告期内股利分配情况

报告期内，公司未实施股利分配。

(九) 持续经营能力分析

本公司是一家国际领先的数据存储主控芯片与半导体存储产品提供商，主营业务为数据存储主控芯片和固态硬盘（SSD）的研发、设计及销售，完整覆盖企业级、工业级和消费级应用。公司以 AI SSD 为代表的企业级产品为核心，依托自主研发能力，突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈，实现信息存储核心环节的自主可控，产品广泛应用于 AI 驱动的算力中心、云服务等前沿场景。

随着公司的上市，法人治理结构将得到进一步完善，各项制度将得到更加有效的执行，从而有利于公司市场竞争力的提升和盈利能力的加强，因此公司具备持续经营能力。公司报告期内的经营策略以及未来经营计划参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、未来发展规划”。

结合公司的业务和产品定位、报告期经营以及未来经营计划，管理层认为公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化，相关风险因素参见本招股说明书“第三节 风险因素”。

十三、重大资产业务重组或股权收购合并事项

报告期内，发行人不存在重大资产业务重组事项。

十四、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项

(一) 资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日, 发行人不存在需要说明的重大资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

截至本招股说明书签署日, 发行人不存在需要披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

截至本招股说明书签署日, 发行人不存在需要披露的其他重要事项。

(四) 重大担保、诉讼事项

截至本招股说明书签署日, 发行人不存在需要披露的重大担保、诉讼事项。

十五、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、本次募集资金运用基本情况

(一) 募集资金运用概况

本次发行募集资金扣除相应发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	备案情况
1	新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目	149,837.26	127,200.00	已备案
2	面向 AI 领域存储系统方案研发项目	99,522.59	99,100.00	已备案
3	补充流动资金	97,000.00	97,000.00	-
合计		346,359.85	323,300.00	

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述项目所需资金，则超出部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定、公司的实际经营需求，用于公司主营业务的发展。

(二) 募集资金使用管理制度

为了规范募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，制定了上市后适用的《募集资金管理制度》。公司成功发行并上市后，相关募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用；公司将严格按照《科创板上市规则》等法律法规，以及公司募集资金管理制度的规定，规范使用募集资金。

(三) 募集资金重点投向科技创新领域的具体安排，对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

公司本次募集资金用于投资“新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目”、“面向 AI 领域存储系统方案研发项目”，均系围绕公司主营业务、核心技术投向科技创新领域，积极响应国家关于加快存储产业自主可控、推动算力基础设施高质量发展的战略导向，符合公司打造国际化先进半导体存储解

决方案提供商的长期发展战略。

随着大模型训练、AI 推理等应用场景的加速落地，全球算力中心对存储系统的带宽、延迟、容量和能效提出更高要求。存储产业正迎来以 CXL、PCIe 6.0/7.0 为代表的新一代接口技术换代周期。“新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目”依托公司长期积累的技术储备和丰富实践经验，开展 PCIe 6.0 存储主控芯片及模组产品的研发与产业化，并同步布局 PCIe 7.0 等前沿接口技术。本项目将显著提升公司在高性能企业级存储产品领域的自主研发能力，助力公司在存储技术领域始终保持国际领先地位。

“面向 AI 领域存储系统方案研发项目”基于当前的发展阶段和现有的技术储备，结合对全球存储介质发展趋势的深刻理解，重点研发“新型非易失性介质端口控制器及物理层(PHY)开发技术”以实现与新型存储介质的高速稳定互联，同时攻关“多介质混合的异构存储架构方案”，通过优化存储资源调度与协同机制充分释放不同存储介质的性能优势，最大化发挥其在存储密度、读写速率、可靠性等方面的核心价值，为 AI 训练、边缘推理等场景提供高性能存储解决方案。项目建成后，公司将完善面向全球 AI 市场的先进存储产品系列，进一步提升在国内外高端存储市场的竞争力，显著增强公司国际影响力。

二、募投项目可行性及与发行人主要业务、核心技术的关系

(一) 募投项目可行性分析

1、积极的产业政策为项目提供了可靠支撑

目前，我国政府主导大力发展集成电路产业，国家和各地方关于促进集成电路发展的政策频出，涉及产业发展目标、企业优惠政策、人才培养政策等多个方面。国家曾先后出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》等一系列发展规划、技术及资金扶持政策，为集成电路产业的自主创新和快速发展提供了动力。

在 AI 领域，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，将人工智能上升至国家战略层面，提出：“到 2030 年人工智能产业竞争力达到国际领先水平，人

工智能核心产业规模超过 1 万亿元，带动相关产业规模超过 10 万亿元”的战略目标。工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确利用 AI、先进计算等技术精准识别和培育高潜能未来产业。工信部等四部门发布《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035 年）》，提出研制新型存储、处理器等高端芯片标准，开展人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研究。

上述产业政策的出台和实施，为促进我国数据存储主控芯片及固态硬盘行业发展提供了有力的政策支持、营造了良好的政策环境，为实施本次募投项目提供了良好的政策基础。

2、旺盛的市场需求为项目提供了有力保障

AI 技术的快速迭代与普及，特别是大模型训练和推理需求的爆发式增长，正驱动全球数据中心建设进入高速发展期，这为上游的存储芯片与解决方案提供商带来了明确且持续的市场机遇。算力规模的迅速增长催生了对高性能、高可靠性存储基础设施的强劲需求。根据 Frost&Sullivan 统计，全球数据中心新增机柜数量从 2020 年的 80.6 万台增长至 2024 年的 119 万台，预计 2029 年将达到 193 万台。固态硬盘以高性能、高可靠、高容量等特性，成为新一代企业级主要存储介质，随着下游市场存储需求急剧增加，固态硬盘将迎来新的增长推动力。

上述领域的旺盛需求为公司产品提供了广阔的市场空间，为公司募集资金投资项目的建设奠定了有力的市场保障。

3、深厚的技术积累为项目提供了坚实基础

公司自成立以来，不断突破高性能数据存储主控芯片及固态硬盘关键领域技术难关，已掌握二十项具有自主知识产权的核心技术，在芯片设计、固件内算法实现和模组设计等方面形成了坚实的技术壁垒。公司研发团队长期从事高性能数据存储主控芯片及固态硬盘开发工作，具有丰富的存储行业从业经历和实践经验，为本项目的实施提供了人才保障。此外，公司还建立了科学规范的研发流程和研发管理体系，并随着公司业务规模的扩大而不断健全和完善。

报告期内，公司的研发费用分别为 33,344.39 万元、30,512.79 万元和 26,643.93 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 198 人，占员工总数的比

例为 64.29%。报告期内发行人研发投入较高，研发人员数量占比也位居行业可比公司前列。公司持续的研发投入以及专业的研发团队，为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了坚实基础。

(二) 与发行人主要业务、核心技术的关系

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、顺应未来市场需求、契合公司发展战略。募集资金投资项目以公司数据存储主控芯片和固态硬盘从 SATA 到 PCIe 5.0 的技术迭代、升级拓展为基础，开发新一代 PCIe 6.0/7.0 存储主控芯片，并在此基础上开发相应的高性能存储模组产品。项目实施将进一步增强公司核心技术的先进性，升级与完善现有产品体系，通过深入挖掘市场机会，扩大细分领域的市场份额，进而巩固提升公司的市场地位，推动公司现有业务向更高层次发展。

三、未来发展规划

(一) 公司战略规划

公司未来发展战略将以“技术自主、创新引领、全球布局”为核心支柱，锚定存储技术前沿与全球市场需求，构建“自主创新为基、全球协同为翼、本地适配为根”的发展格局，助力中国半导体存储产业突围全球，成为全球存储领域的核心引领者之一。

公司以 AI SSD 为代表的企业级产品为核心，依托自主研发能力，突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈，实现信息存储核心环节的自主可控。公司将以完整自研的数据存储主控芯片技术为基石，通过持续的技术研发，构建可扩展、可迭代的统一芯片架构平台，不断巩固并扩大在企业级、消费级和工业级市场的产品覆盖范围。公司将坚持聚焦于技术壁垒更高、产品性能更优的高性能存储主控芯片及固态硬盘产品研发，进一步提升对国产闪存颗粒的深度适配与性能调优能力，打通“核心算法芯片加速-固件适配客户需求-闪存调优平台化”的完整技术链，助力我国半导体存储行业构建起从主控芯片、固件实现到存储模组的完整国产化链条，实现信息存储核心环节的自主可控。同时，公司将对标全球最高技术标准，同步推进与国际主流闪存颗粒厂商的兼容性适配与联合优化，确保产品在全球范围内的技术领先性与竞争力。

公司将秉持“创新”与“坚韧”的初心，积极探索更强性能、更高带宽、更

大容量的下一代存储技术,旨在突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈,引领新颗粒、新代次、新架构革命。通过对 PCIe 6.0、CXL 等企业级存储产品的不断深入研发,公司计划产品将协同 GPU 共同驱动尖端 AI 应用场景,从而为 AI 算力中心、云服务等提供高性能、高安全的存储解决方案。通过深化与上下游行业头部客户的战略协同,公司将不断拓展在 AI 计算、互联网、云计算等核心应用场景的广度与深度,最终引领国内存储产业的技术提升,以领先的存储创新,为全球市场注入澎湃的“中国芯”动力。

(二) 报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、持续进行技术创新,具备较强的国际竞争力

公司自成立以来始终坚持独立自主的数据存储主控芯片技术创新,积累了丰富的技术经验。公司坚持自主研发主控芯片和固件内算法实现,通过多代际技术迭代,已成功推出覆盖 SATA、PCIe 3.0、PCIe 4.0 及 PCIe 5.0 等接口标准的主控芯片产品,并配套自研固件,支持并行队列动态管理、智能资源管理和颗粒管理与优化等先进算法。这种芯片完整自研模式不仅确保了产品性能的持续领先,还赋予公司快速响应市场变化的能力,能够根据客户需求高效实现功能定制和迭代升级,缩短产品研发周期。得益于持续的技术创新,公司的技术能力具备较强的国际竞争力。

2、高度重视人才引进和培养,人才队伍不断优化

公司高度重视优秀人才的引进和培养,将公司研发和技术创新团队的能力视为公司的核心资源。公司自成立以来建立了完善的人才招聘、培养和激励制度,聘用了大量行业知名专业人员,建立了一支卓越的全球化研发团队,并通过人才培养和人才梯队建设,为公司的可持续化发展提供人员保障。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司研发人员数量为 198 人,占员工总数的比例为 64.29%。公司还通过员工持股计划,将员工的个人利益与公司的长远利益深度绑定,提高了员工对公司的认同度,增强了团队稳定性。

3、积极开拓市场,形成了国际化的营销网络和客户基础

公司自成立以来不断拓展营销渠道,建立了国际化的营销网络和客户基础,积极围绕客户开展销售和技术支持,实现对客户需求的快速响应,产品认可度和

行业影响力逐渐提高。基于国际化的市场营销网络,公司现拥有遍布全球多个国家、地区的客户群体。凭借长期的行业积累,公司与客户建立了密切、稳定的合作关系。

(三) 发行人未来具体发展计划及采取的措施

1、产品与技术研发规划

公司将继续坚持核心技术自研的立身之本,致力于持续突破 PCIe 6.0/7.0、CXL 等前沿接口技术,并深度优化适配国产闪存颗粒,构建从芯片设计、固件算法到系统集成的自主可控能力。公司将不断推出全新一代、更高性能的数据存储主控芯片和固态硬盘产品,补充已有的产品系列和类型,实现人工智能领域的优先布局,并根据不断变化的市场需求及产品特点,形成全新的产品系列类型,公司产品结构将更加丰富。

2、人才发展规划

公司所处行业为技术密集型行业,对于技术人员知识背景、研发能力及工作经验均有较高要求,随着公司规模的不扩大和产品线的不断丰富,公司面临的挑战也愈发多样,而优秀人才是公司未来稳健发展的关键。公司将根据未来发展的战略规划,持续优化人力资源配置,加快对优秀人才的培养和引进:一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务精的技术人才、管理人才和营销人才;另一方面,公司将加大力度引进认同公司文化和价值观的外部技术专家和管理人才。公司将持续加大资金投入,建立有效的激励机制,充分调动员工的工作积极性和创造性,提升员工对企业的认同感和稳定性。

3、市场开发规划

未来公司将在现有国际化的市场营销布局的基础上,持续加大对海内外地区的市场营销和技术支持网络建设力度,积极参加行业展会、加强媒体宣传,不断提升公司产品的国际影响力,保持数据存储主控芯片和固态硬盘产品经济效益持续增长,扩大公司全球市场份额。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司自股份公司设立以来,已逐步建立健全股东会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书及专门委员会制度,已根据有关法律、法规及《公司章程》制定了三会议事规则、《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关规章制度。公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,为董事会重大决策提供咨询、建议。

目前,公司股东会、董事会、监事会以及管理层均严格按照《公司章程》规范运作,切实履行各自应尽的职责和义务,保障公司和全体股东的利益。

二、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的审计意见

(一) 公司管理层对内部控制制度的自我评价

公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司管理层认为:根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,本公司内部控制于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

(二) 注册会计师对公司内部控制的审核意见

安永为公司出具的“安永华明(2026)专字第 70059504_K06 号”《内部控制审计报告》认为,“英韧科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

三、发行人报告期内存在的违法违规情况

报告期内,发行人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营活动,不存在重大违法违规行为,不存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为,也不存在受到监督管理措施、纪

律处分或自律监管措施的情况。

四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，公司与关联方之间存在资金往来，参见本节之“八、关联交易情况”。

截至本招股说明书签署日，公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

(一) 资产独立完整情况

公司由英韧有限整体变更设立，依法承继了英韧有限的全部资产，公司设立时发起人投入的资产已足额到位，公司与各发起人之间产权关系明确。公司拥有独立完整的与经营相关的业务体系和相关资产，包括采购、研发、测试、销售体系。截至本招股说明书签署日，不存在实际控制人及其控制的其他企业违规占用发行人资产的情形。

(二) 人员独立情况

公司拥有独立的人事管理制度，公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任，不存在股东超越公司董事会和董事会作出人事任免决定的情况。截至本招股说明书签署日，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；且公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职。

(三) 财务独立情况

公司已设立独立的财务部门、配备专职财务会计人员，并已按照企业会计准则

和会计规范制度，建立了独立的财务核算体系和规范的子公司管理制度。公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形。公司独立设立银行账户，依法独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

(四) 机构独立情况

公司依法建立健全了股东会、董事会、监事会等公司治理架构，根据业务经营需要设置了内部经营管理机构及相关职能部门，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

(五) 业务独立情况

公司拥有独立完整的业务经营体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策，并独立承担责任及风险。公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，同时亦不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。

六、同业竞争情况

(一) 公司与实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况

1、公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为 ZINING WU。公司实际控制人控制的除发行人之外的其他企业情况如下：

序号	名称	情况说明	主营业务及其与发行人的关系
1	开曼英韧	ZINING WU 实际控制并担任董事	无实际经营业务，公司员工持股平台
2	英韧集成	开曼英韧持有 100% 股权	无实际经营业务，公司持股平台
3	韧存集成	英韧集成持有 100% 股权	无实际经营业务，公司持股平台
4	上海韧存	韧存集成担任执行事务合伙人	无实际经营业务，公司员工持股平台
5	RENCUN ULELA	ZINING WU 实际控制并担任管理人	无实际经营业务，公司持股平台

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人均未从事或通过控制的其他企业从事与公司相同、相似的业务，上述主体与公司均不存在同业竞争关系。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺事项”之“(七)关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规关于关联方和关联关系的有关规定，截至报告期末，公司主要关联方及关联关系情况如下：

(一) 公司控股股东及实际控制人

公司无控股股东，实际控制人为 ZINING WU，相关内容参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“(一) 控股股东、实际控制人基本情况”。

(二) 直接或间接持有 5%以上股份的自然人

除公司实际控制人外，无其他直接或间接持有 5%以上股份的自然人。

(三) 发行人董事、监事、高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员为公司关联方，相关内容参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”及“(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况”。

(四) 与前述关联自然人关系密切的家庭成员

与前述第 1-3 项涉及的关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母构成发行人的关联方。

(五) 直接持有 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人

直接持有 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联方。除公司实际控制人外，其他直接持有 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动

人相关内容参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东”。

（六）由上述第 1-5 项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司及 1-5 项列示以外的法人或者其他组织

截至报告期末，前述 1-5 项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的（除公司及其控股子公司及 1-5 项列示以外）的法人或者其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	英韧集成	ZINING WU 控制并担任执行董事
2	韧存集成	ZINING WU 控制并担任执行董事
3	RENCUN ULELA	ZINING WU 持股 100%，担任管理人
4	常州一倩企业管理中心	吴一亮持股 100%
5	上海承芯集成电路有限公司	吴一亮担任执行董事
6	北京一倩科技有限公司	吴一亮持股 100%，担任执行董事、经理
7	上海合见工业软件集团股份有限公司	吴一亮担任董事、张帅担任董事
8	常州承芯半导体有限公司	吴一亮担任董事
9	北京海尔集成电路设计有限公司	吴一亮担任董事
10	圆周率科技（常州）有限公司	吴一亮担任董事
11	毫厘科技（常州）有限公司	吴一亮担任董事
12	昂宝集成电路股份有限公司	吴一亮担任董事
13	昆泰集成电路（常州）有限公司	吴一亮担任董事
14	芯合电子（上海）有限公司	吴一亮担任董事
15	北京贝利农垦饲料有限公司	于力关系密切的家庭成员控制
16	几只狮子（北京）文创科技有限公司	于力关系密切的家庭成员控制
17	北京宠悟旅游发展有限公司	于力关系密切的家庭成员控制
18	中电通商	陈冲担任董事
19	长沙军民先进技术研究有限公司	陈冲担任董事

序号	关联方名称	关联关系
20	重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司	陈冲担任董事
21	澜至电子科技(成都)有限公司	陈冲担任董事
22	驭势科技(北京)股份有限公司	JUN WU 担任董事
23	芳春丹桂	刘刚持有 61.7245% 合伙份额, 担任执行事务合伙人
24	上海芯镒	刘刚控制的芳春丹桂担任执行事务合伙人
25	芯韧一号	刘刚担任执行事务合伙人
26	芯韧二号	刘刚担任执行事务合伙人
27	芯韧三号	刘刚担任执行事务合伙人
28	芯韧四号	刘刚担任执行事务合伙人
29	芯韧五号	刘刚担任执行事务合伙人
30	芯韧六号	刘刚担任执行事务合伙人
31	深圳市博圣达投资发展企业(有限合伙)	蒙刚担任执行事务合伙人
32	深圳市耀汇隆投资发展有限公司	蒙刚担任执行董事、总经理
33	合源生物科技股份有限公司	蒙刚担任董事
34	江苏量点科技有限公司	蒙刚担任董事
35	哈尔滨瀚邦生物制药有限公司	蒙刚担任董事
36	陕西天基通信科技有限责任公司	蒙刚担任董事
37	深圳飞特尔科技有限公司	蒙刚担任董事
38	广东艾勒可科技有限公司	蒙刚担任董事
39	贵州嘉宝医疗科技有限公司	蒙刚担任董事
40	北京力泰克科技有限公司	蒙刚担任董事
41	深圳市右城规划建筑设计有限公司	蒙刚关系密切的家庭成员控制
42	赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	张帅担任董事
43	北京赛微电子股份有限公司	张帅担任董事
44	北京奕斯伟计算技术股份有限公司	张帅担任董事
45	北京华大九天科技股份有限公司	张帅担任董事
46	深圳鸿芯微纳技术有限公司	张帅担任董事
47	芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	张帅担任董事

序号	关联方名称	关联关系
48	上海燧原科技股份有限公司	张帅担任董事
49	硕橙(厦门)科技有限公司	郑焱担任董事
50	矽杰微电子(厦门)有限公司	郑焱担任董事
51	银联智策顾问(上海)有限公司	钟晓蕙担任董事

注：报告期后，郑焱于 2026 年 2 月辞任监事，公司补选冯正田担任监事。蔡勇基于个人原因于 2026 年 4 月辞任监事职务，股东交融君泓三期提名汪滢担任监事。

(七) 间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人

序号	关联方名称	关联关系
1	上海芯镒	通过上海韧存间接持有发行人 5%以上股份

(八) 发行人直接或间接控制的企业

公司控股子公司相关内容参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人控股、参股公司情况”。

(九) 其他关联方

报告期内，与发行人曾存在关联关系且存在关联交易的法人或其他组织的具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	SPV A1	实际控制人 ZINING WU 曾担任管理人，已于 2023 年 4 月卸任
2	公司 A	***，于 2022 年 7 月注销
3	佰维存储	张帅曾担任佰维存储董事，于 2025 年 9 月辞任

此外，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，基于实质重于形式原则认定的与公司有特殊关系、可能导致公司利益对其倾斜的，或者在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效安排实施后 12 个月内，具有上述关联情形之一的法人、其他组织或自然人，亦视同发行人的关联方。

八、关联交易情况

(一) 关联交易的总体情况及重大关联交易的判断标准和依据

根据《科创板上市规则》规定，上市公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000

万元，提交股东会审议。发行人将满足前述标准的关联交易定为重大关联交易。

报告期内，公司关联交易的总体情况汇总如下：

交易类型	关联方	关联交易主要内容	是否属于重大关联交易
经常性关联交易	佰维存储	销售商品及提供服务	是
		采购原材料及接受服务	否
	关键管理人员	薪酬	否
偶发性关联交易	公司 A	资金拆借	否
	开曼英韧	资金拆借	否
	SPV A1	资金拆借	否
	上海韧存	资金拆借	否

(二) 经常性关联交易

报告期内，公司发生的经常性关联交易包括向关联方购销商品、提供和接受服务、向关键管理人员及其他关联方支付薪酬等，均为经营所需，具体情况如下：

1、销售商品和提供技术服务的情况

单位：万元

关联方名称	主要交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
佰维存储	销售商品及提供服务	1,843.48	3,156.87	9,255.27

自 2023 年以来，公司向关联方销售商品和提供劳务的关联交易总规模整体呈下降趋势。关联交易金额占报告期各期营业收入比重分别为 25.87%、5.05%和 1.78%，预计未来与佰维存储及其下属企业的关联交易将持续发生。报告期内，公司向佰维存储及其下属企业销售数据存储主控芯片的价格根据市场原则定价，主要根据公司产品性能及市场竞争力、客户采购量等多重因素确定产品价格；向佰维存储及其下属企业提供服务采用成本加成法定价，公司根据承接的服务具体内容测算相应的人工、材料及其他费用，在确定项目成本的基础上加成合理利润，并与客户协商确定服务价格。

2、采购原材料、接受劳务

单位：万元

关联方名称	主要交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
佰维存储	采购原材料及接受服务	-	1.56	21.12

公司向佰维存储采购原材料及接受服务系根据市场价格结合供应商经营情况进行定价。

3、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	2,269.47	2,735.48	2,163.02

注：关键管理人员薪酬包含公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额（包含股份支付）。

（三）偶发性关联交易

1、关联资金拆借

报告期内，公司与关联方之间不存在资金拆入，均为资金拆出，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	期初余额	利息收入	本期拆出	本期归还	汇率损益	期末余额	是否计息
2023 年资金拆出情况							
公司 A	0.52	-	-	0.53	0.01	-	是
开曼英韧	73.54	2.63	83.62	160.66	0.87	-	是
SPV A1	0.01	0.03	1.65	1.68	0.00	-	是
上海韧存	0.12	0.00	-	0.12	-	-	是

注：期初、期末余额按照即期汇率折算，利息收入、本期拆出、归还金额按照当期平均汇率折算。

报告期以前年度，由于公司 A 注销清算需求，公司向公司 A 拆出资金，其拆借本金已于报告期前归还，拆借利息已于 2023 年度归还。

报告期以前年度以及 2023 年，由于开曼英韧法律咨询服务需求，公司向开曼英韧拆出资金，其拆借本金和拆借利息已于 2023 年度归还。

报告期以前年度以及 2023 年，由于 SPV A1 法律咨询服务需求，公司向关联方 SPV A1 拆出资金，其拆借本金和拆借利息已于 2023 年度归还。

报告期以前年度，由于上海韧存支付银行手续费用需求，公司向上海韧存拆出资金 0.10 万元，其拆借本金和拆借利息已于 2023 年度归还。

公司已按照银行同期利率向上述关联方收取资金拆借利息。

(四) 关联方往来款项余额

报告期各期末，公司对关联方往来款项情况如下：

1、应收关联方款项

报告期各期末，公司应收关联方款项如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	佰维存储	403.98	1,043.86	4,172.44

报告期各期末，公司与佰维存储之间的应收账款主要系公司正常业务经营中销售发生。

2、应付关联方款项

报告期各期末，公司应付关联方款项如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合同负债	佰维存储	8.21	12.05	255.21

报告期各期末，公司与佰维存储之间的合同负债主要系公司正常业务经营中产生的返利款项。

(五) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

发行人报告期内的关联交易均系为满足正常业务需求而发生，具备商业合理性、必要性，定价公允，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用的情形，不存在利益输送的情形，未对公司的独立性以及财务状况、经营成果等造成重大不利影响。

九、报告期内关联交易程序履行情况和独立董事的意见

2026年5月,发行人分别召开第一届董事会第三十次会议和2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》,就发行人报告期内发生的各项关联交易之合法合规性等事宜予以确认,所涉关联董事、关联股东均回避表决。

2026年5月,发行人召开第一届董事会独立董事2026年第二次专门会议,审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》,认为公司报告期内发生的关联交易系为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了必要性、合理性和公允性的原则,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和股东利益的情况。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

根据公司 2026 年第一次临时股东会批准，若公司本次公开发行股票并上市成功，则公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有，累计未弥补亏损由发行后新老股东按照本次发行后的股份比例相应承担。

二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策

(一) 本次发行前后股利分配政策的差异情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《监管规则适用指引——发行类第 10 号》等相关规定，制定、明确和细化了发行后的利润分配原则、形式及时间间隔、现金分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配方案的决策程序和监督机制、利润分配政策的调整等事项，发行后的利润分配政策和未来分红规划更加重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，进一步加强对公司全体股东特别是中小投资者的利益保护和回馈。

(二) 本次发行后的股利分配政策

1、公司章程中股利分配相关规定

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《英韧科技股份有限公司章程(草案)》，公司本次发行后的股利分配政策如下：

“（一）股利分配的基本原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）股利分配的决策程序和机制

1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、

资金需求等因素,研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,拟定利润分配预案,独立董事发表明确意见后,提交股东会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。监事会应当就利润分配的提案提出明确意见。

2、公司董事会需确保每三年重新审阅一次股东分红回报规划,并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订,确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。

3、股东会审议利润分配方案前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

4、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。

5、上市后前三年(含上市当年),如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的,新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

6、如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的,应当经过详细论证后根据《公司章程》规定履行相应的决策程序,并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(三) 股利分配的具体政策

1、股利分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利;凡具备现金分红条件的,公司原则上应当优先采用现金分红的利润分配方式。在满足公司现金支出计划的前提下,公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

2、股利分配的时间间隔

公司原则进行年度利润分配,在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司经营情况提议公司进行中期现金分红。

3、公司实行现金分红的条件

在满足①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)的情况下,公司应当进行现金分配,且每年以现金方式分配的利润(包括中期已分配的现金红利)不少于当年实现的可分配利润的 10%或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%;在不满足前述条件的情况下,公司可根据实际情况确定是否进行现金分配。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

(1) 公司未来 12 个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元;

(2) 公司未来 12 个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司市值的 50%以上;

(3) 公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、公司实行现金分红的比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。“重大资金支出安排”的标准参照前述“重大投资计划或重大现金支出”标准执行。

5、公司发放股票股利的条件

公司主要的分红方式为现金分红。在履行上述现金分红之余，在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司董事会可以提出发放股票股利的利润分配方案交由股东会审议。在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。”

2、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司拟订了《首次公开发行股票并在科创板上市后三年（含上市当年）内股东分红回报规划》。2026年1月21日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年（含上市当年）内股东分红回报规划的议案》。

制定本规划考虑的因素如下：根据公司战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑行业特点、公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、公司现金流状况等因素，并结合法律、法规要求以及《公司章程（草案）》相关规定，审慎制定对投资者的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排。

本规划制定的利润分配基本原则如下：公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、发行人上市后三年内的股利分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排

(1) 发行人上市后三年内的股利分配计划

①股利分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利；凡具备现金分红条件的，公司原则上应当优先采用现金分红的利润分配方式。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

②股利分配的时间间隔

公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营情况提议公司进行中期现金分红。

③公司实行现金分红的条件

在满足①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的情况下，公司应当进行现金分配，且每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）不少于当年实现的可分配利润的 10%或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；在不满足前述条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1) 公司未来 12 个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

2) 公司未来 12 个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司市值的 50%以上；

3) 公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

④公司实行现金分红的比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。“重大资金支出安排”的标准参照前述“重大投资计划或重大现金支出”标准执行。

⑤公司发放股票股利的条件

公司主要的分红方式为现金分红。在履行上述现金分红之余，在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司董事会可以提出发放股票股利的利润分配方案交由股东会审议。在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

(2) 制订的依据和可行性

公司上市后三年内的股利分配计划的制定依据参见本节之“二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策”之“(二)本次发行后的股利分配政策”之“2、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由”，上述股利分配计划具有可行性。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、累计未弥补亏损的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排。

公司报告期末存在累计未弥补亏损为-127,926.22 万元。

四、尚未盈利、存在累计未弥补亏损情况的投资者保护措施

截至报告期末，发行人尚未实现盈利。截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人、上海韧存、开曼英韧、其他持股 5%以上股东已出具了关于持股意向和减持意向的承诺函，具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺事项”。

第十节 其他重要事项

一、重大合同及其对发行人的影响和存在的风险

(一) 重大销售合同

截至 2025 年 12 月 31 日，报告期内合计销售金额排名前五的客户，履行完毕或正在履行的框架合同以及发行人客户中单笔交易金额超过 5,000 万元（等值外币）的销售订单如下：

序号	客户	合同类型	交易内容	签订日期	合同/订单金额	履行情况
1	客户 A	框架协议	数据存储主控芯片	2024 年	以订单为准	正在履行
2	客户 A	框架协议	固态硬盘	2024 年	以订单为准	正在履行
3	客户 A	框架协议	固态硬盘	2025 年	以订单为准	正在履行
4	客户 B	框架协议	固态硬盘	2025 年	以订单为准	正在履行
5	客户 B	框架协议	固态硬盘	2023 年	以订单为准	履行完毕
6	客户 B	订单	固态硬盘	2025 年	711.00 万美元	履行完毕
7	客户 B	订单	固态硬盘	2025 年	711.00 万美元	履行完毕
8	深圳市芯科睿电子科技有限公司	框架协议	数据存储主控芯片、固态硬盘	2022 年	以订单为准	履行完毕
9	深圳佰维存储科技股份有限公司	框架协议	数据存储主控芯片	2022 年	以订单为准	履行完毕
10	江波龙电子（香港）有限公司	框架协议	数据存储主控芯片	2024 年	以订单为准	正在履行
11	深圳市江波龙电子股份有限公司	框架协议	数据存储主控芯片	2022 年	以订单为准	履行完毕
12	深圳市江波龙电子股份有限公司	框架协议	数据存储主控芯片	2022 年	以订单为准	正在履行
13	江波龙电子（香港）有限公司	框架协议	数据存储主控芯片	2021 年	以订单为准	正在履行
14	客户 E	框架协议	产品开发服务	2023 年	2,110.00 万美元	正在履行

(二) 重大采购合同

截至 2025 年 12 月 31 日，报告期内合计采购金额排名前五的供应商，履行完毕或正在履行的框架合同以及发行人供应商中单笔交易金额超过 5,000 万元

(等值外币)的采购订单如下:

序号	供应商	合同类型	交易内容	签订日期	合同/订单金额	履行情况
1	供应商A	框架协议	闪存颗粒(NAND)	2023年	以订单为准	履行完毕
2	供应商B	框架协议	闪存颗粒(NAND)、DRAM	2024年	以订单为准	正在履行
3	供应商B	框架协议	委托加工	2024年	以订单为准	正在履行
4	江苏宏芯凯电子科技有限公司	框架协议	闪存颗粒(NAND)	2025年	以订单为准	正在履行
5	香港雅创台信电子有限公司	框架协议	闪存颗粒(NAND)	2025年	1,632.89万美元	履行完毕
6	香港雅创台信电子有限公司	框架协议	闪存颗粒(NAND)	2025年	120.78万美元	履行完毕
7	香港雅创台信电子有限公司 ^{注1}	框架协议	闪存颗粒(NAND)	2025年	以订单为准	正在履行
8	香港雅创台信电子有限公司 ^{注1}	框架协议	闪存颗粒(NAND)	2025年	以订单为准	正在履行
9	上海旭择电子零件有限公司 ^{注1}	框架协议	闪存颗粒(NAND)	2025年	以订单为准	正在履行
10	供应商A	订单	闪存颗粒(NAND)	2025年	1,585.45万美元	履行完毕
11	供应商A	订单	闪存颗粒(NAND)	2024年	921.58万美元	履行完毕
12	供应商A	订单	闪存颗粒(NAND)	2023年	816.29万美元	履行完毕
13	上海旭择电子零件有限公司	订单	闪存颗粒(NAND)	2025年	11,227.76万元	履行完毕
14	供应商D ^{注2}	订单	晶圆	2025年	106.43 万美元	履行完毕
15	供应商D ^{注2}	订单	晶圆	2024年	181.62 万美元	履行完毕
16	供应商D ^{注2}	订单	晶圆	2023年	181.62 万美元	履行完毕

注 1: 上海旭择电子零件有限公司及香港雅创台信电子有限公司为雅创电子子公司, 香港雅创台信电子有限公司分别与英韧科技及英韧鄂州签署框架协议。

注 2: 供应商 D 为报告期采购金额排名前五的供应商, 前述供应商无框架合同, 则报告期各期披露当期最大的一笔采购订单。

(三) 银行借款合同

截至 2025 年 12 月 31 日, 发行人及其子公司报告期内, 履行完毕和正在履行的借款金额在 5,000 万元以上的借款合同情况如下:

序号	贷款银行	借款人	期限	贷款金额 (万元)	履行情况
1	上海银行股份有限公司 浦东大道支行	英韧科技	2023.2-2025.2	7,000.00	履行完毕
2	上海银行股份有限公司 浦东大道支行	英韧科技	2025.8-2026.8	5,000.00	正在履行
3	上海银行股份有限公司 浦东大道支行	英韧科技	2024.6-2026.6	5,164.00	正在履行
4	上海银行股份有限公司 浦东大道支行	英韧科技	2024.3-2026.3	5,100.00	正在履行
5	中国光大银行股份有限 公司上海分行	英韧科技	2025.11-2026.11	5,000.00	正在履行
6	招商银行股份有限公司 上海分行	英韧科技	2025.11-2026.11	7,000.00	正在履行

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保情况。

三、重大诉讼或仲裁情况

(一) 公司重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在重大未决诉讼与仲裁事项。

(二) 实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的诉讼、仲裁事项





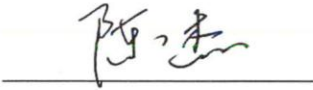
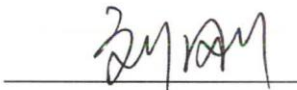


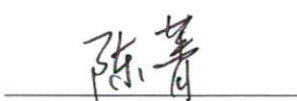


截至本招股说明书签署日，公司的实际控制人、控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，亦不存在尚未了结或可能面临的重大诉讼。

第十一节 声明

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

 ZINING WU	 吴一亮	 于力
 陈冲	 陈杰	 刘刚
 JUN WU	 魏晨阳	 陈菁
 Hao Xu	 陈志武	


英韧科技股份有限公司
2016年6月18日

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：


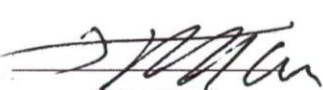
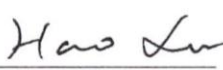
_____ ZINING WU	_____ 吴一亮	_____ 于力
_____ 陈冲	_____ 陈杰	_____ 刘刚
_____ JUN WU	_____ 魏晨阳	_____ 陈菁
_____ Hao Xu	_____ 陈志武	


英韧科技股份有限公司
2016年6月18日

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

<hr/> <p>ZINING WU</p>	<hr/> <p>吴一亮</p>	 <hr/> <p>于力</p>
<hr/> <p>陈冲</p>	<hr/> <p>陈杰</p>	<hr/> <p>刘刚</p>
 <hr/> <p>JUN WU</p>	<hr/> <p>魏晨阳</p>	<hr/> <p>陈菁</p>
 <hr/> <p>Hao Xu</p>	<hr/> <p>陈志武</p>	


英韧科技股份有限公司
2016年6月18日

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

ZINING WU	吴一亮	于力
		
陈冲	陈杰	刘刚
JUN WU	魏晨阳	陈菁
Hao Xu	陈志武	



英韧科技股份有限公司

2016年6月18日

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

ZINING WU	吴一亮	于力
陈冲	陈杰	刘刚
JUN WU	魏晨阳	陈菁
Hao Xu	 陈志武	

英韧科技股份有限公司
2016年6月18日

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

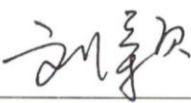
全体监事：

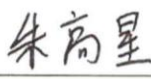

张 帅


蒙 刚


汪 滢


冯正田


刘 颖


朱高星



英韧科技股份有限公司
2016年6月18日

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

除董事以外的其他高级管理人员：


Lin Chen


钟晓蕙


金昊



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：



ZINING WU

2016年6月18日

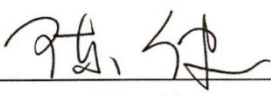
三、保荐人(主承销商)声明

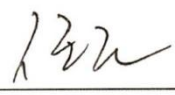
本公司已对招股说明书进行核查,确认招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

项目协办人:


林 韬

保荐代表人:


陈 健


任 飞

法定代表人/董事长:


朱 健



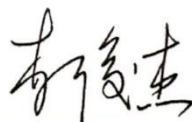
国泰海通证券股份有限公司

2026年6月18日

保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读英韧科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理（总裁）：



李俊杰

法定代表人（董事长）：



朱健



国泰君安证券股份有限公司


2026年6月18日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

经办律师签名:


冯泽伟


李博然


栾容儿

律师事务所负责人签名:


张学兵



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读英韧科技股份有限公司招股说明书(申报稿)(“招股说明书”),确认招股说明书中引用的经审计的财务报表、内部控制审计报告、非经常性损益明细表的内容,与本所出具的审计报告(报告编号:安永华明(2026)审字第70059504_K02号)、内部控制审计报告(报告编号:安永华明(2026)专字第70059504_K06号)及非经常性损益明细表的专项说明(专项说明编号:安永华明(2026)专字第70059504_K07号)的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对英韧科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告和专项说明的内容无异议,确认招股说明书不致因上述报告和专项说明而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述报告和专项说明承担相应的法律责任。

本声明仅供英韧科技股份有限公司本次申请首次公开发行A股股票使用,不适用于其他用途。



韩云翠

签字注册会计师:韩云翠



文玲

签字注册会计师:文玲



毛鞍宁

会计师事务所负责人:毛鞍宁



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2026年6月18日

资产评估复核机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的资产评估复核报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估复核报告的专业结论无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

经办评估师:




唐成



吴雪纯

评估机构负责人:



陈广宇

洲蓝(上海)资产评估有限公司



验资会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读英韧科技股份有限公司招股说明书(申报稿)(“招股说明书”),确认招股说明书中引用的验资报告与本所出具的验资报告(报告编号:安永华明(2023)验字第61559770_K01号)的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对英韧科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述验资报告而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述验资报告承担相应的法律责任。

本声明仅供英韧科技股份有限公司本次申请首次公开发行A股股票使用,不适用于其他用途。

签字注册会计师:顾兆峰(已离职)



韩云翠

签字注册会计师:韩云翠



毛鞍宁

会计师事务所负责人:毛鞍宁

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



2026年6月8日

签字注册会计师离职说明

编号为安永华明(2023)验字第61559770_K01号的审计报告的签字注册会计师顾兆峰已从本所离职,故未签署英韧科技股份有限公司招股说明书(申报稿)中的验资会计师事务所声明。

本说明仅供英韧科技股份有限公司本次申请首次公开发行A股股票使用,不适用于其他用途。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2026年6月18日



实收资本/股本复核会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读英韧科技股份有限公司招股说明书(申报稿)(“招股说明书”),确认招股说明书中引用的实收资本/股本复核报告与本所出具的实收资本/股本复核报告(报告编号:安永华明(2026)专字第70059504_K05号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师已阅读英韧科技股份有限公司招股说明书(申报稿)(“招股说明书”),确认招股说明书中引用的实收资本/股本复核报告与本所出具的实收资本/股本复核报告(报告编号:安永华明(2026)专字第70059504_K05号)的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对英韧科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述实收资本/股本复核报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述实收资本/股本复核报告而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述实收资本/股本复核报告承担相应的法律责任。

本声明仅供英韧科技股份有限公司本次申请首次公开发行A股股票使用,不适用于其他用途。



韩云翠

签字注册会计师:韩云翠



文玲

签字注册会计师:文玲



毛鞍宁

会计师事务所负责人:毛鞍宁



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2026年6月18日

第十二节 附件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书;
- (二) 上市保荐书;
- (三) 法律意见书;
- (四) 财务报告及审计报告;
- (五) 公司章程(草案);
- (六) 落实投资者关系管理相关的安排、股份分配决策程序、股东投票机制建立情况;
- (七) 与投资者保护相关的承诺;
- (八) 发行人、股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件承诺事项的履行情况;
- (九) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项;
- (十) 内部控制审核报告;
- (十一) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表;
- (十二) 股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明;
- (十三) 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明;
- (十四) 子公司、参股公司简要情况;
- (十五) 公司主要固定资产、无形资产情况;
- (十六) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

(一) 查阅时间

本次股票发行期间工作日：上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。

(二) 查阅地点

在本次发行承销期间，上述备查文件将存放于发行人和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可在公司股票发行承销期间内查阅。

三、与投资者保护相关的承诺事项

(一) 关于股份锁定的承诺

1、实际控制人的相关承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺：

“1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。

2、如本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；在发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价的，本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整。

3、在发行人实现盈利前，自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人直接或间接持有的发行

人首次公开发行股票前已发行的股份,但应遵循本承诺函及相关法律法规的规定。

4、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月;发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月;发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

5、本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%,本人在离职后 6 个月内,不转让本人所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的,本人承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,继续遵守上述对董事/监事/高级管理人员股份转让的限制性规定。

6、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所规则中关于持股及股份变动的有关规定。

7、上述股份锁定承诺不因本人不再作为发行人实际控制人而终止,亦不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

2、上海韧存、开曼英韧的相关承诺

发行人股东上海韧存、开曼英韧承诺:

“1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业持有的上述股份。

2、如本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价;在发行人股票上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价,或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价的,本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整。

3、在发行人实现盈利前，自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后，本企业可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，但应遵循本承诺函及相关法律法规的规定。

4、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

5、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所规则中关于持股及股份变动的有关规定。”

3、其他股东的相关承诺

除上海韧存、开曼英韧外，发行人其他股东承诺：

“1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的上述股份。对于本企业作为发行人申报前 12 个月内新增股东所取得的股份，及本企业所持有的发行人申报前 6 个月内进行增资扩股的新增股份（如适用），自本企业取得发行人股份之日起 36 个月内（如分次取得股份的，则自每次取得股份之日起算股份锁定时间），本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票并上市之前持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所规则中关于持股及股份变动的有关规定。”

4、核心技术人员的相关承诺

发行人核心技术人员武剑、冯正田、周晓东承诺：

“1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。

2、在发行人实现盈利前，自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，但应遵循本承诺函及相关法律法规的规定。

3、本人作为发行人核心技术人员，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；本人在离职后 6 个月内，不转让本人所持首次公开发行股票前已发行股份。

4、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所规则中关于持股及股份变动的有关规定。

5、上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

(二) 关于持股意向和减持意向的承诺

1、实际控制人的相关承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺：

“1、本人拟长期持有发行人股票。如在锁定期届满后，本人拟减持持有的发行人股票的，本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

2、本人在所持有的股份锁定期届满后减持发行人股份，将严格遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所规则中关于持股及股份变动的有关规定。

3、本人减持所持有的发行人股份时，本人将按照届时有效的法律、法规、

规范性文件及证券交易所规则，履行相应程序和信息披露义务。

4、本人因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，也应当遵循上述承诺。

5、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，本人承诺将按照届时有效的法律、法规、规范性文件及证券交易所规则，承担相应法律责任。”

2、上海韧存、开曼英韧的相关承诺

发行人股东上海韧存、开曼英韧承诺：

“1、本企业拟长期持有发行人股票。如在锁定期届满后，本企业拟减持持有的发行人股票的，本企业将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东、实际控制人一致行动人减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

2、本企业在所持有的股份锁定期届满后减持发行人股份，将严格遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所规则中关于持股及股份变动的有关规定。

3、本企业减持所持有的发行人股份时，本企业将按照届时有效的法律、法规、规范性文件及证券交易所规则，履行相应程序和信息披露义务。

4、本企业因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，也应当遵循上述承诺。

5、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，本企业承诺将按照届时有效的法律、法规、规范性文件及证券交易所规则，承担相应法律责任。”

3、其他持股 5%以上股东的相关承诺

除上海韧存、开曼英韧外，其他持股 5%以上股东朗玛峰、武岳峰承诺：

“1、如在锁定期届满后，本企业拟减持持有的发行人股票的，本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

2、本企业在所持有的股份锁定期届满后减持发行人股份,将严格遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所规则中关于持股及股份变动的有关规定。

3、本企业减持所持有的发行人股份且减持前本企业与本企业一致行动人合计持有发行人5%以上股份时,本企业将按照届时有效的法律、法规、规范性文件及证券交易所规则,履行相应程序和信息披露义务。

4、本企业因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的,也应当遵循上述承诺。

5、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的,本企业承诺将按照届时有效的法律、法规、规范性文件及证券交易所规则,承担相应法律责任。”

(三) 关于稳定股价的措施和承诺

1、关于首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案

为维护公众投资者的利益,增强投资者信心,公司根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,制定了《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》。其具体内容如下:

“一、启动股价稳定措施的具体条件

在满足法律、法规、规范性文件以及证券交易所关于业绩发布、增持或回购相关规定,且实施股价稳定措施不会导致公司不符合法定上市条件,不会迫使实际控制人履行要约收购义务的情况下,自公司本次股票上市之日起三年内,非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司A股股票收盘价连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产值(第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下同),则公司及实际控制人、董事和高级管理人员等相关主体将在触发稳定股价措施日股票收盘后,宣布启动稳定公司股价的措施。

公司实施股价稳定措施的目标为促使公司二级市场股价回升,但并不以公司股价达到或超过最近一期经审计的每股净资产为目标。

公司已宣布启动稳定股价的措施,但尚未实施或实施过程中公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产时,公司可以终止实施稳定股价的措施。

二、稳定公司股价的责任主体

公司采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司实际控制人以及公司的董事(不包括未领薪非独立董事和公司独立董事,下同)和高级管理人员。

应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司本次股票上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。

三、稳定公司股价的具体措施

公司股价稳定措施采取如下顺序与方式:

1、公司回购股票

(1)公司在触发稳定股价措施日起10个交易日内,经有提案权的人士或股东提案,公司将召开董事会审议公司回购股份的议案,并提交股东会审议。公司股东会批准实施回购股票的议案后,公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务(如需)。

(2)公司回购股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产,回购股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,公司单次用于回购股份的资金金额不低于公司获得募集资金净额的2%,单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过公司获得募集资金净额的8%。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,公司每股净资产将相应进行除权、除息调整。

(3)公司回购股份后,将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定,对回购股份予以处置,包括但不限于注销或用于员工激励。

2、实际控制人增持公司股票

(1)公司启动稳定股价措施后,公司股票仍触发上述稳定股价条件的,或公司无法实施上述稳定股价措施的,公司实际控制人在触发实际控制人增持公司股票措施之日起10个交易日内,书面通知公司董事会其增持公司A股股票的计

划并由公司公告。

(2) 公司实际控制人增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,其单次用于增持的资金原则上不低于其上一会计年度自公司获得的税后现金分红金额的 20%,单一会计年度用于增持的资金合计不超过上一会计年度自公司获得的税后现金分红金额的 50%。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,公司每股净资产将相应进行除权、除息调整。

(3) 实际控制人承诺在其符合稳定股价预案条件时,实际控制人提名的董事及其将在董事会、股东会上对回购股份的预案投赞成票。

3、董事和高级管理人员增持公司股票

(1) 公司实际控制人启动稳定股价措施后,公司股票仍触发上述稳定股价条件的,或公司实际控制人无法实施上述稳定股价措施的,公司的董事和高级管理人员在触发董事和高级管理人员增持公司股票措施之日起 10 个交易日内,书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告。

(2) 公司董事、高级管理人员增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,各董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金原则上不低于其上一会计年度自公司领取的税后薪酬的 10%,单一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度自公司领取的税后薪酬的 30%。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,公司每股净资产将相应进行除权、除息调整。

(3) 公司已将做出履行上述稳定公司股价义务的相应承诺作为上市后三年内聘任公司董事和高级管理人员的必要条件,并在将来新聘该等人员时,要求该等人员就此做出书面承诺。

4、经董事会、股东会审议通过的其他稳定股价方案

公司及相关主体可以根据公司及市场情况,采取上述措施维护公司股价稳定。在每个自然年度,公司及相关主体履行稳定股价措施的义务仅限一次,公司及相关主体依据本预案第一部分的约定,在方案实施过程中因股价上涨而终止实施稳

定股价措施的,视同已履行稳定股价措施的义务。上述具体措施实施时应以维护公司上市地位,保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规及证券交易所的相关规定,并应按照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

四、未能履行承诺的约束措施

1、若公司股价稳定措施涉及公司回购义务,公司无正当理由未履行稳定公司股价的承诺,则公司将向投资者公开道歉并说明未能积极履行承诺的原因。

2、若公司股价稳定措施涉及公司实际控制人增持公司股票,如实际控制人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺,公司有权责令实际控制人在限期内履行增持股票义务。实际控制人仍不履行的,公司有权扣减其应向实际控制人及其控制的股东支付的分红。

3、若公司股价稳定措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票,如董事、高级管理人员无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺,公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。公司董事和高级管理人员仍不履行的,公司有权扣减应向董事、高级管理人员支付的报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行预案规定的股票增持承诺情节严重的,实际控制人控制的股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东会同意更换相关董事,公司董事会会有权解聘相关高级管理人员。”

2、发行人的相关承诺

发行人承诺:

“公司将严格按照公司股东会审议通过的《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的相关规定执行稳定股价的措施,履行相关义务,充分维护股东利益。”

3、实际控制人的相关承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺:

“1、本人将严格按照英韧科技股东会审议通过的《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的相关规定执行

稳定股价的措施，履行相关义务。

2、本人将根据英韧科技股东会审议通过的《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的相关规定，在英韧科技就回购股份事宜召开的董事会或股东会上，本人及本人控制的发行人股东将对回购股份的相关决议投赞成票。”

4、在公司领薪的董事（独立董事除外）、高级管理人员的相关承诺

公司领薪的董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：

“1、本人将严格按照英韧科技股东会审议通过的《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的相关规定执行稳定股价的措施，履行相关义务。

2、本人将根据英韧科技股东会审议通过的《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的相关规定，在英韧科技就回购股份事宜召开的董事会上，本人将对回购股份的相关决议投赞成票。”

（四）关于欺诈发行上市的股份回购承诺

1、发行人的相关承诺

发行人承诺：

“1、在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，如因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，进而被中国证券监督管理委员会确认构成欺诈发行并撤销发行注册决定的，对于已发行但尚未上市交易的新股，公司承诺将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，按照投资者所缴纳股票申购款加算银行同期存款利息对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

2、在公司首次公开发行的股票上市交易后，如因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，进而被中国证券监督管理委员会确认构成欺诈发行并责令回购股份的，公司承诺将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认

后5个工作日内启动股份购回程序,按照相关法律法规规定的价格及程序购回公司本次公开发行的全部新股。”

2、实际控制人的相关承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺:

“1、在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,如因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,进而被中国证券监督管理委员会确认构成欺诈发行并撤销发行注册决定的,对于已发行但尚未上市交易的新股,本人承诺将促使公司在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,按照投资者所缴纳股票申购款加算银行同期存款利息对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。本人将就前述退款义务与公司承担连带责任,但是能够证明自己没有过错的除外。

2、在公司首次公开发行的股票上市交易后,如因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,进而被中国证券监督管理委员会确认构成欺诈发行并责令购回股份的,本人承诺将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,按照相关法律法规规定的价格及程序购回公司本次公开发行的全部新股。”

(五) 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、关于首次公开发行股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报的措施

根据公司首次公开发行股票并上市工作的需要,为了更好保护投资者合法权益,公司制定了首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施。其具体内容如下:

“1、积极实施募投项目,加强募集资金管理

本次发行募投项目的实施将提升公司研发水平,扩充生产规模,提高公司综合竞争实力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取募投项目早日实现预期效益,增强未来几年的股东回报。公司将根据相关法

律法规和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用,合理防范募集资金使用风险。

2、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,提升资金使用效率,节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制,发挥企业管控效能。推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督全面有效地控制公司经营和管控风险。

3、进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制

公司已经按照相关法律法规的规定制订了《公司章程(草案)》及《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年(含上市当年)内股东分红回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,公司将按照《公司章程(草案)》及《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年(含上市当年)内股东分红回报规划》的规定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。”

2、发行人的相关承诺

发行人承诺:

“本次发行完成后,公司将按照《公司章程(草案)》及《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年(含上市当年)内股东分红回报规划》的规定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。”

3、董事、高级管理人员的相关承诺

董事、高级管理人员承诺:

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

- 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺在自身职责和权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若公司后续推出股权激励政策，则在自身职责和权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的责任。”

(六) 关于利润分配政策的承诺

发行人就利润分配政策的措施承诺如下：

“1、本公司将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、若因本公司未执行该承诺而给投资者造成直接经济损失的，本公司将在该等事实被中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。本公司将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。”

(七) 关于避免同业竞争的承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺：

“1、本人及本人直接或间接控制的其他企业、组织或机构（英韧科技除外，下同）目前没有、将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、合营或者联营）从事与英韧科技主营业务相同或相似且对英韧科技构成重大不利影响的业务。

2、如果英韧科技认为本人及本人控制的其他企业、组织或机构所从事的业务对英韧科技的主营业务构成竞争且可能对英韧科技构成重大不利影响，本人及本人控制的企业将终止从事该业务，或对本人控制的该等业务或企业控制权进行处置，英韧科技在同等条件下有权优先收购该业务所涉资产或股权（权益）。

3、如果本人及本人控制的其他企业、组织或机构将来可能存在任何与英韧科技主营业务产生直接或间接竞争且对英韧科技构成重大不利影响的业务机会，

应立即通知英韧科技并尽力促使该业务机会按英韧科技能合理接受的条款和条件首先提供给英韧科技，英韧科技对上述业务享有优先权。

4、若英韧科技将来开拓新的业务领域，而导致本人及本人控制的其他企业、组织或机构所从事的业务与英韧科技构成竞争且英韧科技认为可能对英韧科技构成重大不利影响，本人及本人控制的其他企业、组织或机构将终止从事该业务，或对本人控制的该等业务或企业控制权进行处置，英韧科技在同等条件下有权优先收购该业务所涉资产或股权（权益）。

5、本人承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致英韧科技和其他股东遭受的一切损失、损害和开支，本人应予以赔偿。本承诺函自本人签字之日起生效，直至本人不再为英韧科技实际控制人为止。”

（八）关于规范和减少关联交易的承诺

1、实际控制人的相关承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺：

“1、本人将尽可能地避免和减少本人及本人控制的其他企业、组织或机构与英韧科技及其下属企业之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业、组织或机构将根据有关法律、法规和规范性文件以及英韧科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与英韧科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护英韧科技及其股东（特别是中小股东）的利益。

2、本人及本人控制的其他企业、组织或机构将根据有关法律、法规和规范性文件以及英韧科技公司章程的规定，在审议关联交易事项时，遵守英韧科技董事会、股东会进行关联交易表决时的回避程序。

3、本人保证不利用在英韧科技中的地位 and 影响，通过关联交易损害英韧科技及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人及本人控制的其他企业、组织或机构保证不利用本人在英韧科技中的地位 and 影响，违规占用或转移英韧科技的资金、资产及其他资源，或违规要求英韧科技提供担保。

4、本承诺函在本人依照中国证券监督管理委员会或证券交易所相关规定被认定为英韧科技的关联方期间内有效。”

2、持股 5%以上股东的相关承诺

持股 5%以上股东上海韧存、开曼英韧、朗玛峰、武岳峰承诺：

“1、本企业将尽可能地避免和减少本企业及本企业控制的其他企业、组织或机构与英韧科技及其下属企业之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业、组织或机构将根据有关法律、法规和规范性文件以及英韧科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与英韧科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护英韧科技及其股东（特别是中小股东）的利益。

2、本企业及本企业控制的其他企业、组织或机构将根据有关法律、法规和规范性文件以及英韧科技公司章程的规定，在审议关联交易事项时，遵守英韧科技董事会、股东会进行关联交易表决时的回避程序。

3、本企业保证不利用在英韧科技中的地位 and 影响，通过关联交易损害英韧科技及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本企业及本企业控制的其他企业、组织或机构保证不利用本企业在英韧科技中的地位 and 影响，违规占用或转移英韧科技的资金、资产及其他资源，或违规要求英韧科技提供担保。

4、本承诺函在本企业依照中国证券监督管理委员会或证券交易所相关规定被认定为英韧科技的关联方期间内有效。”

3、董事、监事、高级管理人员的相关承诺

董事、监事、高级管理人员承诺：

“1、本人将尽可能地避免和减少本人及本人控制的其他企业、组织或机构与英韧科技及其下属企业之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业、组织或机构将根据有关法律、法规和规范性文件以及英韧科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与英韧科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格

公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护英韧科技及其股东（特别是中小股东）的利益。

2、本人及本人控制的其他企业、组织或机构将根据有关法律、法规和规范性文件以及英韧科技公司章程的规定，在审议关联交易事项时，遵守英韧科技董事会、股东会进行关联交易表决时的回避程序。

3、本人保证不利用在英韧科技中的地位 and 影响，通过关联交易损害英韧科技及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人及本人控制的其他企业、组织或机构保证不利用本人在英韧科技中的地位 and 影响，违规占用或转移英韧科技的资金、资产及其他资源，或违规要求英韧科技提供担保。

4、本承诺函在本人依照中国证券监督管理委员会或证券交易所相关规定被认定为英韧科技的关联方期间内有效。”

（九）关于依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人的相关承诺

发行人承诺：

“1、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，公司将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。”

2、实际控制人的相关承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺：

“1、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

在证券交易中遭受损失的,并已由中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的,本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等,赔偿投资者实际遭受的直接损失。”

3、董事、监事、高级管理人员的相关承诺

董事、监事、高级管理人员承诺:

“1、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的,本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。”

(十) 关于未履行承诺事项的约束性措施的承诺

1、发行人的相关承诺

发行人承诺:

“1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;

(2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;

(3) 给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因;

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东会审议,尽可能地保护公司投资者利益。”

2、实际控制人的相关承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺:

“1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人需接受如下约束措施:

(1) 提出补充承诺或替代承诺;

(2) 本人未履行公开承诺事项,给投资者造成损失且责任主体及相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,依法承担赔偿责任。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人需接受如下约束措施:

(1) 提出补充承诺或替代承诺;

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。”

3、上海韧存、开曼英韧的相关承诺

上海韧存、开曼英韧承诺:

“1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本企业需接受如下约束措施:

(1) 提出补充承诺或替代承诺;

(2) 本企业未履行公开承诺事项,给投资者造成损失且责任主体及相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,依法承担赔偿责任。

2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本企业需接受如下约束措施:

(1) 提出补充承诺或替代承诺;

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。”

4、其他股东的相关承诺

除上海韧存、开曼英韧外, 发行人其他股东承诺:

“1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 本企业需接受如下约束措施:

(1) 提出补充承诺或替代承诺;

(2) 本企业未履行公开承诺事项, 给投资者造成损失且责任主体及相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的, 依法承担赔偿责任。

2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 本企业需接受如下约束措施:

(1) 提出补充承诺或替代承诺;

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。”

5、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的相关承诺

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺:

“1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 本人需接受如下约束措施:

(1) 提出补充承诺或替代承诺;

(2) 本人未履行公开承诺事项, 给投资者造成损失且责任主体及相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的, 依法承担赔偿责任。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 本人需接受如下约束措施:

(1) 提出补充承诺或替代承诺;

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。”

(十一) 关于公司股东信息披露的承诺函

发行人就股东信息披露事项承诺：

“一、公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了相关股东信息；

二、公司股东持有的发行人股份权属清晰，不存在股份代持等情况，不存在权属纠纷或潜在纠纷；

三、公司股东均具备持有公司股份的主体资格，不存在法律法规和中国证监会规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；

四、除招股说明书中已披露的情况外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形；

五、公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形；

六、若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

(十二) 关于避免资金占用和违规担保的承诺

1、实际控制人的相关承诺

实际控制人 ZINING WU 承诺：

“截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业、组织或机构不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形，也不存在发行人或其控股子公司违规为本人或本人控制的其他企业、组织或机构提供担保的情形。

本人承诺，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及发行人公司章程等相关规章制度的规定，依法行使实际控制人、董事权利，不滥用实际控制人、董事权利损害发行人或者发行人其他股东的利益，本人及本人控制的其他企业、组织或机构不以任何方式占用发行人或其控股子公司资金及要求发行人或其控股子公司违法违规为本人提供担保。

上述承诺为本人真实意思表示，自本人签署之日起生效，在本人作为发行人实际控制人期间持续有效。”

2、持股 5%以上股东的相关承诺

持股 5%以上股东上海韧存、开曼英韧、朗玛峰、武岳峰承诺：

“截至本承诺函出具之日，本企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形，也不存在发行人或其控股子公司违规为本企业提供担保的情形。

本企业承诺，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及发行人公司章程等相关规章制度的规定，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害发行人或者发行人其他股东的利益，本企业不以任何方式占用发行人或其控股子公司资金及要求发行人或其控股子公司违法违规为本企业提供担保。

上述承诺为本企业真实意思表示，自本企业签署之日起生效，在本企业作为发行人股东期间持续有效。”

四、发行人主要无形资产

(一) 专利

1、境内专利

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	英韧科技	发明	具有在数据安全桥中实现的安全功能的安全数据存储设备	ZL201810311988.1	2018.04.09	继受取得	无
2	英韧科技	发明	芯片指纹管理装置及安全芯片	ZL201810456424.7	2018.05.14	原始取得	无
3	英韧科技	发明	用于解码纠错码的系统和方法	ZL201811021325.2	2018.09.03	继受取得	无
4	英韧科技	发明	用于解码纠错码的系统和方法	ZL201811223155.6	2018.10.19	继受取得	无
5	英韧科技	发明	快速访问非易失性存储器设备的系统和方法	ZL201880057148.5	2018.10.23	原始取得	无
6	英韧科技	发明	用于解码纠错码的系统和方法	ZL201811301582.1	2018.11.02	继受取得	无
7	英韧科技	发明	解码低密度奇偶校验编码码字的系统和方法	ZL201811316911.X	2018.11.07	继受取得	无
8	英韧科技	发明	选择性连接到非易失性存储器的数据存储设备	ZL201910190754.0	2019.03.13	继受取得	无
9	英韧科技	发明	解码 BCH 编码码字的系统和方法	ZL201910223920.2	2019.03.22	继受取得	无
10	英韧科技	发明	数据处理方法及装置	ZL201910262141.3	2019.04.02	原始取得	无
11	英韧科技	发明	用于超快的具有奇偶校验的纠错码的系统和方法	ZL201910305027.4	2019.04.16	继受取得	无
12	英韧科技	发明	用于解码具有自生成对数似然比的纠错码的系统和方法	ZL201910465431.8	2019.05.30	继受取得	无
13	英韧科技	发明	参考电压确定方法及装置	ZL201910645148.3	2019.07.17	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
14	英韧科技	发明	用于混合非易失性存储系统的系统和方法	ZL201910678724.4	2019.07.25	继受取得	无
15	英韧科技	发明	用于组合多个存储信道的系统和方法	ZL201910833324.6	2019.09.04	原始取得	无
16	英韧科技	发明	硬件友好的数据压缩方法、系统及装置	ZL201910972547.0	2019.10.10	原始取得	无
17	英韧科技	发明	硬件友好的数据压缩方法、系统及装置	ZL202110338304.9	2019.10.10	原始取得	无
18	英韧科技	发明	具有内存映射的纠错码架构的系统和方法	ZL201911284577.9	2019.12.13	原始取得	无
19	英韧科技	发明	具有优先级任务队列的纠错码架构的系统和方法	ZL202010066309.6	2020.01.20	原始取得	无
20	英韧科技	发明	硬件友好地数据压缩	ZL202010297782.5	2020.04.15	原始取得	无
21	英韧科技	发明	固件安全验证方法及装置	ZL202010934468.3	2020.09.08	原始取得	无
22	英韧科技	发明	具有混合引线键合焊盘的半导体芯片	ZL202011056865.1	2020.09.30	原始取得	无
23	英韧科技	发明	固态硬盘及其读写方法	ZL202011123714.3	2020.10.20	原始取得	无
24	英韧科技	发明	温度辅助的 NAND 闪存管理	ZL202011260215.9	2020.11.12	原始取得	无
25	英韧科技	发明	由 NAND 闪存控制器实现的电镜像	ZL202011378509.1	2020.11.30	原始取得	无
26	英韧科技	发明	由 NAND 闪存控制器实现的电镜像	ZL202411513305.2	2020.11.30	原始取得	无
27	英韧科技	发明	硬件友好的数据压缩方法、压缩器	ZL202110013408.2	2021.01.06	原始取得	无
28	英韧科技	发明	VLSI 和 SOC 的电压降管理	ZL202110071390.1	2021.01.19	原始取得	无
29	英韧科技	发明	应用磁性盖封装的封装级芯片、芯片模组及电子产品	ZL202110193674.8	2021.02.20	原始取得	无
30	英韧科技	发明	可移动的非易失性存储卡	ZL202110266746.7	2021.03.11	原始取得	无
31	英韧科技	发明	振荡器电路	ZL202110349925.7	2021.03.31	原始取得	无
32	英韧科技	发明	具有部分逻辑到物理地址转换表的非易失性存储控制器	ZL202110564695.6	2021.05.24	原始取得	无
33	英韧科技	发明	寻找最佳读取电压的方法、闪存系统	ZL202110772261.5	2021.07.08	原始取得	无
34	英韧科技	发明	闪存转换层仿真测试系统及方法	ZL202110812619.2	2021.07.19	原始取得	无
35	英韧科技	发明	用于 VLSI 应用的片上热管理	ZL202110914826.9	2021.08.10	原始取得	无
36	英韧科技	发明	张弛振荡器、集成电路和电子设备	ZL202111086861.2	2021.09.16	原始取得	无
37	英韧科技	发明	温度传感器电路	ZL202111209484.7	2021.10.18	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
38	英韧科技	发明	具有备份块的缓存编程	ZL202111216689.8	2021.10.19	原始取得	无
39	英韧科技	发明	存储装置和存储系统	ZL202111265593.0	2021.10.28	原始取得	无
40	英韧科技	发明	耐用性预知的 NAND 闪存管理	ZL202111493176.1	2021.12.08	原始取得	无
41	英韧科技	发明	具有差分环回测试的内存控制器物理接口	ZL202210239406.X	2022.03.11	原始取得	无
42	英韧科技	发明	使用自适应 LLR 查找表进行错误恢复	ZL202210239434.1	2022.03.11	原始取得	无
43	英韧科技	发明	数据写入方法和装置以及存储介质	ZL202210258759.4	2022.03.16	原始取得	无
44	英韧科技	发明	寻找公共最佳参考电压的方法、存储系统	ZL202210343438.4	2022.03.31	原始取得	无
45	英韧科技	发明	具有可拆卸电容壳部的固态硬盘	ZL202210488118.8	2022.05.06	原始取得	无
46	英韧科技	发明	对 SSD 部分空间进行保护的方法及存储系统	ZL202211236522.2	2022.10.10	原始取得	无
47	英韧科技	发明	动态容量缓存加速的 SSD 设备	ZL202211627624.7	2022.12.16	原始取得	无
48	英韧科技	发明	键值数据库的数据读写方法	ZL202411820218.1	2022.12.11	原始取得	无
49	英韧科技	实用新型	存储设备和用于存储设备的站	ZL201820494790.7	2018.04.09	继受取得	无
50	英韧科技	实用新型	固态硬盘转接板及固态硬盘组件	ZL202421829529.X	2024.07.31	原始取得	无
51	英韧科技	外观设计	固态硬盘(样式1)	ZL202330550046.0	2023.08.25	原始取得	无
52	英韧科技	外观设计	固态硬盘(样式2)	ZL202330550053.0	2023.08.25	原始取得	无
53	英韧科技	外观设计	固态硬盘(样式3)	ZL202330550054.5	2023.08.25	原始取得	无
54	英韧科技	外观设计	固态硬盘(样式4)	ZL202330550056.4	2023.08.25	原始取得	无
55	英韧科技	外观设计	固态硬盘(样式5)	ZL202330589229.3	2023.09.11	原始取得	无
56	英韧科技	外观设计	固态硬盘	ZL202430526155.3	2024.08.19	原始取得	无
57	英韧科技	外观设计	固态硬盘(E3.S 接口)	ZL202530070765.1	2025.02.18	原始取得	无
58	南京英韧	发明	安全装置及安全芯片	ZL201810458094.5	2018.05.14	继受取得	无
59	南京英韧	发明	数据写入方法及装置、存储介质	ZL201910145200.9	2019.02.27	继受取得	无
60	南京英韧	发明	主控内嵌式指令和数据记录装置	ZL202210046129.0	2022.01.17	原始取得	无
61	南京英韧	发明	使用减量的出现次数的数据压缩	ZL202110668364.7	2021.06.16	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
62	南京英韧	发明	硬件友好的数据解压缩	ZL202110674195.8	2021.06.17	原始取得	无
63	南京英韧	发明	硬件友好的数据解压缩	ZL202110219951.8	2021.02.26	原始取得	无

注：上表中英韧科技继受取得的专利均系继受自 Nyquist Cayman，南京英韧继受取得的专利均系继受自英韧科技。

2、境外专利

序号	专利权人	国别	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	英韧科技	美国	发明	SECURE DATA STORAGE DEVICE WITH SECURITY FUNCTION IMPLEMENTED IN A DATA SECURITY BRIDGE	US10929572B2	2017.04.10	继受取得	无
2	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING ERROR CORRECTING CODES	US10574274B2	2017.09.29	继受取得	无
3	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING ERROR CORRECTING CODES	US10511326B2	2017.11.14	继受取得	无
4	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING ERROR CORRECTING CODES	US10491244B2	2017.11.14	继受取得	无
5	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR FAST ACCESS OF NON-VOLATILE STORAGE DEVICES	US10719394B2	2018.04.02	原始取得	无
6	英韧科技	美国	发明	DATA STORAGE DEVICE WITH SELECTIVE CONNECTION TO NON-VOLATILE MEMORIES	US10564858B2	2018.05.02	继受取得	无
7	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR ULTRA FAST ECC WITH PARITY	US10817372B2	2018.06.13	原始取得	无
8	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING ERROR CORRECTING CODES WITH SELF-GENERATED LLR	US10715182B2	2018.07.27	原始取得	无
9	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING LOW DENSITY PARITY CHECK ENCODED CODEWORDS	US10637503B2	2018.08.03	原始取得	无
10	英韧科技	美国	发明	SECURITY DATA GENERATION BASED UPON SOFTWARE UNREADABLE REGISTERS	US11308241B2	2018.09.19	原始取得	无
11	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING BOSE-CHAUDHURI-HOCQUENGHEM ENCODED CODEWORDS	US10756763B2	2018.09.28	原始取得	无
12	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR PROVIDING MULTIPLE MEMORY CHANNELS WITH ONE SET OF SHARED ADDRESS PINS ON THE PHYSICAL INTERFACE	US11048654B2	2018.10.24	原始取得	无
13	英韧科技	美国	发明	HARDWARE FRIENDLY DATA COMPRESSION	US10476518B1	2018.12.06	继受取得	无
14	英韧科技	美国	发明	CHIP FINGERPRINT MANAGEMENT BASED UPON ONE-TIME	US11106829B2	2018.12.07	原始取得	无

序号	专利权人	国别	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
				PROGRAMMABLE MEMORY				
15	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR AN ECC ARCHITECTURE WITH MEMORY MAPPING	US11237902B2	2019.03.15	继受取得	无
16	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR AN ECC ARCHITECTURE WITH PRIORITIZED TASK QUEUES	US11204829B2	2019.03.26	原始取得	无
17	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR A DATA STORAGE SYSTEM	US11321636B2	2019.07.18	原始取得	无
18	英韧科技	美国	发明	HARDWARE FRIENDLY DATA COMPRESSION	US10587285B1	2019.10.03	继受取得	无
19	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING ERROR CORRECTING CODES	US11115051B2	2019.10.25	原始取得	无
20	英韧科技	美国	发明	METHOD AND SYSTEM FOR DATA PROCESSING	US11494117B2	2020.01.18	原始取得	无
21	英韧科技	美国	发明	DATA STORAGE DEVICE, SYSTEM, AND DATA WRITING METHOD	US11188245B2	2020.01.18	原始取得	无
22	英韧科技	美国	发明	METHOD OF WRITING DATA TO A STORAGE DEVICE USING AGGREGATED QUEUES	US11188263B2	2020.01.18	原始取得	无
23	英韧科技	美国	发明	HARDWARE FRIENDLY DATA COMPRESSION	US10938410B2	2020.01.29	原始取得	无
24	英韧科技	美国	发明	MULTI-FREQUENCY MEMORY INTERFACE AND METHODS FOR CONFIGURATING THE SAME	US11379393B2	2020.02.28	原始取得	无
25	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING ERROR CORRECTING CODES WITH HISTORICAL DECODING INFORMATION	US11159182B1	2020.04.06	原始取得	无
26	英韧科技	美国	发明	COMMAND BASED ON-DIE TERMINATION FOR HIGH-SPEED NAND INTERFACE	US11200190B2	2020.04.21	原始取得	无
27	英韧科技	美国	发明	METHOD OF DETERMINING READ REFERENCE VOLTAGE FOR BLOCKS BASED ON NUMBER OF ERRONEOUS BITS	US11335414B2	2020.04.24	原始取得	无
28	英韧科技	美国	发明	SEMICONDUCTOR DIE WITH HYBRID WIRE BOND PADS	US11043435B1	2020.05.18	原始取得	无
29	英韧科技	美国	发明	GROUND REFERENCE SHAPE FOR HIGH SPEED INTERCONNECT	US11276655B2	2020.05.22	原始取得	无
30	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR EVALUATING A STORAGE MEDIUM	US11651065B2	2020.05.27	原始取得	无
31	英韧科技	美国	发明	ELECTRICAL MIRRORING BY NAND FLASH CONTROLLER	US11249674B2	2020.06.03	原始取得	无
32	英韧科技	美国	发明	BIT-FLIPPING METHOD FOR DECODING LDPC CODE AND SYSTEM USING THE SAME	US11146290B1	2020.07.01	原始取得	无
33	英韧科技	美国	发明	DATA COMPRESSION USING REDUCED NUMBERS OF OCCURRENCES	US11296720B2	2020.08.24	原始取得	无

序号	专利权人	国别	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
34	英韧科技	美国	发明	HARDWARE FRIENDLY DATA COMPRESSION	US11184023B1	2020.08.24	原始取得	无
35	英韧科技	美国	发明	HARDWARE FRIENDLY DATA DECOMPRESSION	US11115049B1	2020.08.24	原始取得	无
36	英韧科技	美国	发明	HARDWARE FRIENDLY DATA DECOMPRESSION	US11115050B1	2020.08.24	原始取得	无
37	英韧科技	美国	发明	TEMPERATURE ASSISTED NAND FLASH MANAGEMENT	US11886313B2	2020.09.21	原始取得	无
38	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR ULTRA FAST ECC WITH PARITY	US11397641B2	2020.09.24	原始取得	无
39	英韧科技	美国	发明	ON-DIE THERMAL MANAGEMENT FOR VLSI APPLICATIONS	US11450585B2	2020.11.02	原始取得	无
40	英韧科技	美国	发明	SOLID-STATE DISK AND READING AND WRITING METHOD THEREOF	US11500721B2	2020.11.25	原始取得	无
41	英韧科技	美国	发明	CACHE PROGRAM WITH BACKUP BLOCKS	US11940887B2	2020.12.04	原始取得	无
42	英韧科技	美国	发明	FIRMWARE SECURITY VERIFICATION METHOD AND DEVICE	US11829479B2	2020.12.17	原始取得	无
43	英韧科技	美国	发明	VOLTAGE DROP MANAGEMENT FOR VLSI AND SOC	US11385698B1	2020.12.30	原始取得	无
44	英韧科技	美国	发明	REFERENCE VOLTAGE ADJUSTMENT BASED ON POST-DECODING AND PRE-DECODING STATE INFORMATION	US11521700B2	2021.01.04	原始取得	无
45	英韧科技	美国	发明	GROUPING FLASH STORAGE BLOCKS BASED ON ROBUSTNESS FOR CACHE PROGRAM OPERATIONS AND REGULAR PROGRAM OPERATIONS	US11488678B2	2021.01.13	原始取得	无
46	英韧科技	美国	发明	REMOVABLE NON-VOLATILE STORAGE CARD	US11308380B1	2021.02.24	原始取得	无
47	英韧科技	美国	发明	ERROR RECOVERY USING ADAPTIVE LLR LOOKUP TABLE	US11528039B2	2021.03.17	原始取得	无
48	英韧科技	美国	发明	MEMORY CONTROLLER PHYSICAL INTERFACE WITH DIFFERENTIAL LOOPBACK TESTING	US11594296B2	2021.03.18	原始取得	无
49	英韧科技	美国	发明	SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING SOLID STATE STORAGE DEVICES IN LOW TEMPERATURE ENVIRONMENT	US11861186B2	2021.04.10	原始取得	无
50	英韧科技	美国	发明	NON-VOLATILE STORAGE CONTROLLER WITH PARTIAL LOGICAL-TO-PHYSICAL (L2P) ADDRESS TRANSLATION TABLE	US11537530B2	2021.05.10	原始取得	无
51	英韧科技	美国	发明	PARTIAL LOGICAL-TO-PHYSICAL (L2P) ADDRESS TRANSLATION TABLE FOR MULTIPLE NAMESPACES	US11409665B1	2021.05.10	原始取得	无
52	英韧科技	美国	发明	OSCILLATOR CIRCUIT	US11329606B1	2021.05.21	原始取得	无
53	英韧科技	美国	发明	PACKAGING-LEVEL CHIP AND CHIP MODULE PACKAGED WITH MAGNETIC COVER, AND ELECTRONIC PRODUCT	US11769708B2	2021.05.26	原始取得	无

序号	专利权人	国别	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
54	英韧科技	美国	发明	CONCATENATED ERROR CORRECTING CODES	US11621728B2	2021.06.01	原始取得	无
55	英韧科技	美国	发明	MULTILAYER CIRCUIT BOARD	US11706878B2	2021.06.18	原始取得	无
56	英韧科技	日本	发明	REMOVABLE NON-VOLATILE STORAGE CARD	特許第 7759085 号	2021.06.23	原始取得	无
57	英韧科技	美国	发明	METHOD FOR FINDING OPTIMUM READ VOLTAGE AND FLASH MEMORY SYSTEM	US11776635B2	2021.09.02	原始取得	无
58	英韧科技	美国	发明	SELECTING READ REFERENCE VOLTAGE USING HISTORICAL DECODING INFORMATION	US11735286B2	2021.09.30	原始取得	无
59	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING ERROR CORRECTING CODES WITH HISTORICAL DECODING INFORMATION	US11695434B2	2021.09.30	原始取得	无
60	英韧科技	美国	发明	ADAPTIVE THERMAL CALIBRATION FOR THROTTLING PREVENTION	US12416667B2	2021.10.02	原始取得	无
61	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING CODEWORDS IN A SAME PAGE WITH HISTORICAL DECODING INFORMATION	US11569847B1	2021.10.04	原始取得	无
62	英韧科技	美国	发明	COMMAND BASED ON-DIE TERMINATION FOR HIGH-SPEED NAND INTERFACE	US11709789B2	2021.10.29	原始取得	无
63	英韧科技	美国	发明	SOLID STATE STORAGE SYSTEM WITH DATA LOSS PREVENTION AND USER ALERT	US11934662B2	2021.11.01	原始取得	无
64	英韧科技	美国	发明	TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT	US12111216B2	2021.11.30	原始取得	无
65	英韧科技	美国	发明	EMULATION TEST SYSTEM FOR FLASH TRANSLATION LAYER AND METHOD THEREOF	US11537329B1	2021.12.17	原始取得	无
66	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR AN ECC ARCHITECTURE WITH MEMORY MAPPING	US11734109B2	2021.12.20	原始取得	无
67	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR AN ECC ARCHITECTURE WITH MEMORY MAPPING	US11726872B2	2021.12.20	原始取得	无
68	英韧科技	美国	发明	ELECTRICAL MIRRORING BY NAND FLASH CONTROLLER	US11726695B2	2021.12.28	原始取得	无
69	英韧科技	美国	发明	SYSTEM AND METHOD FOR POWER MANAGEMENT IN SOLID STATE STORAGE SYSTEMS	US11989426B2	2022.04.27	原始取得	无
70	英韧科技	美国	发明	DATA WRITING METHOD AND APPARATUS, AND STORAGE MEDIUM	US12159060B2	2022.06.02	原始取得	无
71	英韧科技	美国	发明	RELAXATION OSCILLATOR, INTEGRATED CIRCUIT AND ELECTRONIC APPARATUS	US11705865B2	2022.06.22	原始取得	无
72	英韧科技	美国	发明	PARTIAL LOGICAL-TO-PHYSICAL (L2P) ADDRESS TRANSLATION TABLE FOR MULTIPLE NAMESPACEs	US12038852B2	2022.06.30	原始取得	无

序号	专利权人	国别	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
73	英韧科技	美国	发明	SOFT DECODING CORRECTABLE PAGE ASSISTED REFERENCE VOLTAGE TRACKING	US12136464B2	2022.07.06	原始取得	无
74	英韧科技	美国	发明	SOFT DECODING CORRECTABLE PAGE ASSISTED LLR ESTIMATION	US11973516B2	2022.07.06	原始取得	无
75	英韧科技	美国	发明	HYBRID PCB TOPOLOGY AND LAYOUT WITH CLAMSHELL PLACEMENT FOR STORAGE APPLICATIONS	US12032499B2	2022.07.11	原始取得	无
76	英韧科技	美国	发明	ROBUSTNESS-AWARE NAND FLASH MANAGEMENT	US11837298B2	2022.09.06	原始取得	无
77	英韧科技	美国	发明	VALID DATA RETRIEVAL FOR GARBAGE COLLECTION	US11994986B2	2022.09.14	原始取得	无
78	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR POWER AND THERMAL MANAGEMENT IN A SOLID STATE DRIVE	US12210753B2	2022.09.15	原始取得	无
79	英韧科技	美国	发明	STORAGE DEVICE AND STORAGE SYSTEM	US11966585B2	2022.10.28	原始取得	无
80	英韧科技	美国	发明	REFERENCE VOLTAGE ADJUSTMENT BASED ON POST-DECODING AND PRE-DECODING STATE INFORMATION	US11923028B2	2022.11.03	原始取得	无
81	英韧科技	美国	发明	ERROR RECOVERY USING ADAPTIVE LLR LOOKUP TABLE	US12009841B2	2022.11.12	原始取得	无
82	英韧科技	美国	发明	NON-VOLATILE STORAGE CONTROLLER WITH PARTIAL LOGICAL-TO-PHYSICAL (L2P) ADDRESS TRANSLATION TABLE	US11836092B2	2022.11.21	原始取得	无
83	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING CODEWORDS IN A SAME PAGE WITH HISTORICAL DECODING INFORMATION	US11936403B2	2022.12.12	原始取得	无
84	英韧科技	美国	发明	COMPRESSION ACCELERATOR CARD AND METHOD OF SIMULATING HARD DISK MODE TO ACCESS THE COMPRESSION ACCELERATOR CARD	US12321638B2	2023.01.13	原始取得	无
85	英韧科技	美国	发明	CONCATENATED ERROR CORRECTING CODES	US11967971B2	2023.03.02	原始取得	无
86	英韧科技	美国	发明	METHOD FOR FINDING COMMON OPTIMAL REFERENCE VOLTAGE AND MEMORY STORAGE SYSTEM	US12315584B2	2023.03.31	原始取得	无
87	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS, METHODS AND DEVICES FOR READING A MEMORY OF A STORAGE DEVICE	US12223205B2	2023.04.13	原始取得	无
88	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR EVALUATING A STORAGE MEDIUM	US12147525B2	2023.04.25	原始取得	无
89	英韧科技	美国	发明	METHOD FOR INSTRUCTION TRANSMISSION FOR MEMORY DEVICES AND STORAGE SYSTEM	US12399651B2	2023.06.29	原始取得	无
90	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR AN ECC ARCHITECTURE WITH MEMORY MAPPING	US12105587B2	2023.06.30	原始取得	无
91	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR AN ECC ARCHITECTURE WITH MEMORY	US12032441B2	2023.06.30	原始取得	无

序号	专利权人	国别	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	他项权利
				MAPPING				
92	英韧科技	美国	发明	SELECTING READ REFERENCE VOLTAGE USING HISTORICAL DECODING INFORMATION	US12431210B2	2023.07.03	原始取得	无
93	英韧科技	美国	发明	METHOD FOR FINDING COMMON OPTIMAL READ VOLTAGE OF MULTI-DIES, STORAGE SYSTEM	US12512171B2	2023.07.05	原始取得	无
94	英韧科技	美国	发明	METHOD AND SYSTEM OF USING HMB AS A CACHE OF PHYSICAL ADDRESS MAPPING TABLE	US12287737B2	2023.08.04	原始取得	无
95	英韧科技	美国	发明	METHOD FOR PROTECTING PARTIAL SPACE OF SSD SPACE AND STORAGE SYSTEM	US12333157B2	2023.10.10	原始取得	无
96	英韧科技	美国	发明	SYSTEMS AND METHODS FOR DECODING CODEWORDS	US12431917B2	2023.11.17	原始取得	无
97	英韧科技	美国	发明	NON-VOLATILE MEMORY WITH AN ARBITRATION FUNCTION ON SHARED STATUS CHANNEL	US12346558B1	2023.12.14	原始取得	无
98	英韧科技	美国	发明	SSD DEVICE ACCELERATED BY DYNAMIC CAPACITY CACHE	US12511049B2	2024.01.31	原始取得	无
99	英韧科技	美国	发明	SYSTEM AND METHOD FOR POWER MANAGEMENT IN SOLID STATE STORAGE SYSTEMS	US12399631B2	2024.04.18	原始取得	无
100	英韧科技	美国	发明	VALID DATA RETRIEVAL FOR GARBAGE COLLECTION	US12399821B2	2024.04.24	原始取得	无
101	南京英韧	美国	发明	METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING READ COMMAND, CONTROLLER, AND STORAGE MEDIUM	US12333187B2	2023.08.10	原始取得	无
102	境外子公司 A	***	发明	***	***	2022.09.12	原始取得	无

注：上表中英韧科技继受取得的专利均系继受自 Nyquist Cayman。

(二) 商标

1、境内商标

序号	权利人	注册号	国际分类	期限	商标	取得方式	他项权利
1	英韧科技	78296659	09	2024.12.28-2034.12.27		原始取得	无
2	英韧科技	78302053	09	2025.03.28-2035.03.27		原始取得	无
3	英韧科技	75880090	09	2025.02.07-2035.02.06		原始取得	无
4	英韧科技	75883773	42	2024.08.28-2034.08.27		原始取得	无
5	英韧科技	75872540	38	2024.08.21-2034.08.20		原始取得	无


序号	权利人	注册号	国际分类	期限	商标	取得方式	他项权利
6	英韧科技	75875632	09	2025.06.07-2035.06.06		原始取得	无
7	英韧科技	73309381	09	2024.12.21-2034.12.20		原始取得	无
8	英韧科技	73304778	37	2024.02.14-2034.02.13		原始取得	无
9	英韧科技	73307841	39	2024.02.14-2034.02.13		原始取得	无
10	英韧科技	73309319	35	2024.04.14-2034.04.13		原始取得	无
11	英韧科技	73322473	39	2024.02.14-2034.02.13		原始取得	无
12	英韧科技	73322515	35	2024.04.21-2034.04.20		原始取得	无
13	英韧科技	73329303	38	2024.10.07-2034.10.06		原始取得	无
14	英韧科技	73329358	38	2024.02.14-2034.02.13		原始取得	无
15	英韧科技	73324213	09	2025.06.14-2035.06.13		原始取得	无
16	英韧科技	73325887	42	2025.02.21-2035.02.20		原始取得	无
17	英韧科技	73317791	42	2024.10.07-2034.10.06		原始取得	无
18	英韧科技	67044414	09	2023.04.21-2033.04.20	Shasta	原始取得	无
19	英韧科技	65204631	42	2024.02.21-2034.02.20	Shasta	原始取得	无
20	英韧科技	62925588	42	2023.07.14-2033.07.13	Shasta	原始取得	无
21	英韧科技	62933373	09	2022.11.21-2032.11.20	Shasta	原始取得	无
22	英韧科技	60130981	09	2023.10.07-2033.10.06	Shasta	原始取得	无
23	英韧科技	60014998	09	2022.06.21-2032.06.20	Eastlake	原始取得	无
24	英韧科技	60029702	42	2022.06.28-2032.06.27	Dongting	原始取得	无
25	英韧科技	60022301	09	2022.07.07-2032.07.06	Dongting	原始取得	无
26	英韧科技	60028185	09	2022.07.07-2032.07.06	Donghu	原始取得	无

序号	权利人	注册号	国际分类	期限	商标	取得方式	他项权利
27	英韧科技	60006150	42	2022.04.14-2032.04.13	Eastlake	原始取得	无
28	英韧科技	58620501	42	2023.02.07-2033.02.06	Shasta	原始取得	无
29	英韧科技	58641025	42	2022.10.14-2032.10.13	ArcDom	原始取得	无
30	英韧科技	55160829	38	2021.10.28-2031.10.27	Shasta	原始取得	无
31	英韧科技	55164100	38	2021.10.28-2031.10.27	Shasta+	原始取得	无
32	英韧科技	55170795	35	2022.01.07-2032.01.06	Shasta+	原始取得	无
33	英韧科技	55170798	35	2021.11.07-2031.11.06	ArcDom	原始取得	无
34	英韧科技	55176935	09	2021.10.28-2031.10.27	ArcDom	原始取得	无
35	英韧科技	55178407	42	2022.01.07-2032.01.06	Shasta+	原始取得	无
36	英韧科技	55185139	12	2021.11.21-2031.11.20	ArcDom	原始取得	无
37	英韧科技	55186050	09	2022.01.28-2032.01.27	Shasta+	原始取得	无
38	英韧科技	55191907	38	2021.11.07-2031.11.06	ArcDom	原始取得	无
39	英韧科技	55193697	09	2023.01.14-2033.01.13	Shasta	原始取得	无
40	英韧科技	55195050	42	2022.09.21-2032.09.20	Shasta	原始取得	无
41	英韧科技	55195059	42	2022.09.07-2032.09.06	ArcDom	原始取得	无
42	英韧科技	55195426	35	2022.01.07-2032.01.06	Shasta	原始取得	无
43	英韧科技	38413365	42	2020.01.28-2030.01.27	英 韧 科 技	原始取得	无
44	英韧科技	38423650	42	2020.02.07-2030.02.06	INNOGRIT	原始取得	无
45	英韧科技	38417887	38	2020.01.21-2030.01.20	英 韧 科 技	原始取得	无
46	英韧科技	38416725	38	2020.02.07-2030.02.06	INNOGRIT	原始取得	无

序号	权利人	注册号	国际分类	期限	商标	取得方式	他项权利
47	英韧科技	38432494	35	2020.01.21-2030.01.20	英 韧 科 技	原始取得	无
48	英韧科技	38433819	35	2020.02.07-2030.02.06	INNOGRIT	原始取得	无
49	英韧科技	38424537	12	2020.02.07-2030.02.06	INNOGRIT	原始取得	无
50	英韧科技	38437580	09	2020.02.07-2030.02.06	INNOGRIT	原始取得	无
51	英韧科技	38437578	09	2020.01.28-2030.01.27	英 韧 科 技	原始取得	无
52	英韧科技	38424538	12	2020.01.28-2030.01.27	英 韧 科 技	原始取得	无
53	英韧科技	27123959	38	2018.10.07-2028.10.06	英韧创	原始取得	无
54	英韧科技	27125788	35	2018.10.07-2028.10.06	英韧	原始取得	无
55	英韧科技	27126334	42	2018.10.07-2028.10.06	英韧创	原始取得	无
56	英韧科技	27128007	38	2018.10.14-2028.10.13	INNOGRIT	原始取得	无
57	英韧科技	27128026	42	2018.10.07-2028.10.06	INNOGRIT	原始取得	无
58	英韧科技	27133153	35	2018.10.07-2028.10.06	英韧创	原始取得	无
59	英韧科技	27137092	09	2018.10.07-2028.10.06	INNOGRIT	原始取得	无
60	英韧科技	27137146	12	2018.10.07-2028.10.06	英韧创	原始取得	无
61	英韧科技	27139593	38	2018.10.07-2028.10.06	英韧	原始取得	无
62	英韧科技	27140237	12	2018.10.07-2028.10.06	英韧	原始取得	无
63	英韧科技	27141344	42	2018.10.07-2028.10.06	英韧	原始取得	无
64	英韧科技	27145110	09	2018.10.07-2028.10.06	英韧	原始取得	无
65	英韧科技	27145120	09	2018.10.07-2028.10.06	英韧创	原始取得	无
66	英韧科技	27145166	12	2018.10.07-2028.10.06	INNOGRIT	原始取得	无

序号	权利人	注册号	国际分类	期限	商标	取得方式	他项权利
67	英韧科技	27146215	35	2018.10.07-2028.10.06	INNOGRIT	原始取得	无
68	长鹰芯存	78521057	09	2025.01.07-2035.01.06		原始取得	无
69	长鹰芯存	77601458	42	2024.09.14-2034.09.13		原始取得	无
70	长鹰芯存	77602362	35	2024.09.14-2034.09.13		原始取得	无
71	长鹰芯存	77604653	09	2025.06.14-2035.06.13		原始取得	无
72	长鹰芯存	76269078	42	2025.07.07-2035.07.06		原始取得	无
73	长鹰芯存	76290403	09	2025.07.07-2035.07.06		原始取得	无
74	长鹰芯存	76272121	35	2025.07.07-2035.07.06		原始取得	无
75	长鹰芯存	73506437	09	2025.06.28-2035.06.27		原始取得	无
76	长鹰芯存	73507812	42	2025.06.28-2035.06.27		原始取得	无
77	长鹰芯存	73520133	35	2025.06.28-2035.06.27		原始取得	无

2、境外商标

序号	权利人	注册号	国别	国际分类	期限	商标	取得方式	他项权利
1	英韧科技	1784614	韩国、日本、 欧盟、英国	9、12、35、 38、42	2023.12.21-20 33.12.21	INNOGRIT	原始取得	无
		美国注册号: 7962994 国际注册号: 1784614	美国	9、42				
2	英韧科技	02385236	中国台湾	9	2024.07.01-20 34.06.30	INNOGRIT	原始取得	无
3	英韧科技	02387023	中国台湾	42	2020.04.28-20 30.04.27	INNOGRIT	原始取得	无
4	英韧科技	306370209	中国香港	9、42	2023.10.11-20 33.10.10		原始取得	无

(三) 软件著作权

序号	权利人	名称	登记号	登记日期	取得方式
1	英韧科技	固态硬盘控制器软件[简称: SSD FW]1.0	2019SR0040630	2019.01.14	原始取得

序号	权利人	名称	登记号	登记日期	取得方式
2	英韧科技	基于嵌入式控制器的固态硬盘 RAID 机制软件[简称: SSD FW]1.0	2020SR0705036	2020.07.01	原始取得
3	英韧科技	针对 DDR 硬件加速中逻辑地址-物理地址转换表的软件[简称: SSD FW]1.0	2020SR0994396	2020.08.27	原始取得
4	英韧科技	基于 X86 平台的闪存转换层仿真验证软件[简称: SSD FW]1.0	2021SR0824548	2021.06.03	原始取得
5	南京英韧	基于 SSD 控制器的多核处理器的消息处理模型软件[简称: SSD FW]1.0	2020SR0737312	2020.07.08	原始取得
6	南京英韧	基于嵌入式控制器的 PCIe 层复位机制软件[简称: SSD FW]1.0	2020SR1207338	2020.10.12	原始取得
7	南京英韧	基于嵌入式控制器的名称空间管理软件[简称: SSD FW]1.0	2020SR1735162	2020.12.04	原始取得
8	南京英韧	IG280AG-YA001T0 型加密固态硬盘 (1.T.V.2Y) 温控算法实现软件	2023SR0062456	2023.01.11	原始取得
9	南京英韧	IG5216 型加密固态硬盘 fatal reset 算法实现软件[简称: SSDFW]1.0	2023SR1504214	2023.11.24	原始取得
10	南京英韧	IG5216 型加密固态硬盘重读算法实现软件[简称: SSD FW]1.0	2023SR1507342	2023.11.24	原始取得
11	南京英韧	IG5216 型基于 HMB 缓存技术的固态硬盘 PCIE 复位方法实现软件[简称: SSD FW]1.0	2023SR1504218	2023.11.24	原始取得
12	南京英韧	IG5216 型基于 HMB 缓存技术的固态硬盘数据传输备份重写方法[简称: SSD FW]1.0	2023SR1507485	2023.11.24	原始取得
13	南京英韧	基于 overlay 技术使用 nand-flash 来共享内存的方法实现软件[简称: SSD FW]1.0	2023SR1510954	2023.11.27	原始取得

(四) 集成电路布图设计专有权

序号	权利人	登记号	名称	申请日	颁证日
1	英韧科技	BS.195586603	Shasta	2019.04.12	2019.05.08
2	英韧科技	BS.205571824	CAB	2020.09.11	2020.10.27
3	英韧科技	BS.205574750	DDR IO SUBPHY	2020.09.21	2020.11.11
4	英韧科技	BS.205574777	LDO PCIe Master	2020.09.21	2020.11.11
5	英韧科技	BS.205574793	LDO SoC Master	2020.09.21	2020.11.11
6	英韧科技	BS.205574815	LDO SoC Slave	2020.09.21	2020.11.11
7	英韧科技	BS.205574858	OSC2M	2020.09.21	2020.11.11
8	英韧科技	BS.205574823	ND CM SUBPHY	2020.09.21	2020.11.12
9	英韧科技	BS.205616674	DDR IO DQS	2020.12.10	2021.01.11

序号	权利人	登记号	名称	申请日	颁证日
10	英韧科技	BS.205616666	DDR IO DQ	2020.12.10	2021.01.13
11	英韧科技	BS.205616658	OSC2M	2020.12.10	2021.01.18
12	英韧科技	BS.215543416	Rainier Q	2021.04.21	2021.06.08
13	英韧科技	BS.235556688	TACOMA12 AO CHIP TOP	2023.07.18	2023.10.10
14	英韧科技	BS.235556734	TACOMA12 AO DDR IO SUBPHY H	2023.07.18	2023.10.10
15	英韧科技	BS.235606537	TSMCN12_RAINIERHS_FC	2023.12.12	2024.02.22
16	英韧科技	BS.245550976	TACOMA12 PLL TOP	2024.07.16	2024.10.24
17	英韧科技	BS.245550992	TACOMA12 POR TOP	2024.07.16	2024.10.24
18	英韧科技	BS.245550968	TACOMA12 TSENSOR TOP	2024.07.16	2024.10.24
19	英韧科技	BS.24555100X	TSMCN12_RAINIERHS DDR IO SUBPHY 11 H	2024.07.16	2024.10.24
20	英韧科技	BS.245551018	RAINIERHS DDR VGEN_H	2024.07.16	2024.10.24
21	英韧科技	BS.245551034	RAINIERHS DDR INGVSS H	2024.07.16	2024.10.24
22	英韧科技	BS.245551050	RAINIERHS ND CM SUBPHY H	2024.07.16	2024.10.24
23	英韧科技	BS.245573089	DDR_VGEN	2024.09.19	2024.12.24
24	英韧科技	BS.245573062	DDR_IO_SUBPHY	2024.09.19	2024.12.24
25	英韧科技	BS.245573119	ND_IO_SUBPHY_H	2024.09.19	2024.12.24
26	英韧科技	BS.245573100	ND_ASYNC	2024.09.19	2024.12.24
27	英韧科技	BS.245573135	ND_SYNC	2024.09.19	2024.12.24
28	英韧科技	BS.245573194	ND_SYNC_H	2024.09.19	2024.12.24
29	英韧科技	BS.255502656	RAINIERX_CHIP_TOP	2025.01.13	2025.04.14
30	南京英韧	BS.205527264	Shasta+	2020.04.30	2020.06.08
31	南京英韧	BS.205527337	Rainier	2020.04.30	2020.06.08
32	南京英韧	BS.205616690	DDR SYNC	2020.12.10	2021.01.11
33	南京英韧	BS.205616763	ND ASYNC	2020.12.10	2021.01.13
34	南京英韧	BS.205616739	DDR VGEN	2020.12.10	2021.01.18
35	南京英韧	BS.205616704	DDR ASYNC	2020.12.10	2021.02.10
36	南京英韧	BS.205616801	ND VREF	2020.12.10	2021.02.10
37	南京英韧	BS.235571121	DDR VGEN	2023.08.29	2023.11.20

序号	权利人	登记号	名称	申请日	颁证日
38	南京英韧	BS.235571148	TSENSOR	2023.08.29	2023.11.20
39	南京英韧	BS.235571156	CHIN SNAPSHOT	2023.08.29	2023.11.20

五、发行人申报前十二个月新增股东基本情况

(一) 朗玛一号

朗玛一号的基本情况参见“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“(三) 其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东”之“3、朗玛峰”。

(二) 朗玛永祥

朗玛永祥的基本情况参见“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“(三) 其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东”之“3、朗玛峰”。

(三) 共青城栋晖峰

截至本招股说明书签署日，共青城栋晖峰的基本情况如下：

企业名称	共青城栋晖峰创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MAERFNW134
执行事务合伙人	王栋
认缴出资额	2,000 万元人民币
成立日期	2025-08-14
企业类型	有限合伙企业
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，共青城栋晖峰的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	王栋	普通合伙人	900.00	45.00
2	陈胤铭	有限合伙人	1,000.00	50.00

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
3	陈晖	有限合伙人	100.00	5.00
合计			2,000.00	100.00

(四) 鄂州芯存储

截至本招股说明书签署日，鄂州芯存储的基本情况如下：

企业名称	鄂州市葛店芯存储产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91420710MAE7WAXG1F
执行事务合伙人	湖北国翼投资管理有限公司
认缴出资额	10,100 万元人民币
成立日期	2025-01-03
企业类型	有限合伙企业
注册地址	湖北省鄂州市葛店经济技术开发区聚贤路 23 号（自主申报）
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本招股说明书签署日，鄂州芯存储的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	湖北国翼投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.99
2	鄂州市昌达产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,000.00	59.41
3	鄂州市芯智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	39.60
合计			10,100.00	100.00

(五) 张江燧锋

截至本招股说明书签署日，张江燧锋的基本情况如下：

企业名称	上海张江燧锋二期创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MADGFUXJ4K
执行事务合伙人	上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司
认缴出资额	116,958 万元人民币
成立日期	2024-03-27

企业类型	有限合伙企业
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-07室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，张江燧锋的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,158.00	0.99
2	上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	29,200.00	24.97
3	上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	17.10
4	上海浦东引领区海通私募投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	11,600.00	9.92
5	上海张江高科技园区开发股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	8.55
6	上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	8.55
7	中金曜盛（绍兴上虞）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	8.55
8	启东创新发展投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	8.55
9	宁波晟顺股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	8.55
10	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	3.42
11	上海环境节能工程股份有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.86
合计			116,958.00	100.00

（六）湖杉明芯

截至本招股说明书签署日，湖杉明芯的基本情况如下：

企业名称	湖杉明芯（成都）创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91510100MAC0F7AR4H
执行事务合伙人	无锡湖杉投资中心（有限合伙）
认缴出资额	67,700 万元人民币
成立日期	2022-10-20
企业类型	有限合伙企业

注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，湖杉明芯的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	无锡湖杉投资中心（有限合伙）	普通合伙人	1,500.00	2.22
2	西安欣柯启辰股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,500.00	15.51
3	成都天府创新股权投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	14.77
4	苏州湖杉智芯创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,700.00	14.33
5	无锡经开尚贤湖投资有限公司	有限合伙人	8,000.00	11.82
6	嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	7.39
7	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	有限合伙人	4,000.00	5.91
8	厦门金圆展鸿二期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	5.91
9	苏州高新新一代信息技术产业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,500.00	5.17
10	苏州高新阳光汇利股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	4.43
12	衢州汇衢股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	2.95
13	安徽泰运投资管理有限公司	有限合伙人	2,000.00	2.95
14	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	有限合伙人	1,500.00	2.22
15	常熟开晟东南创业投资管理有限公司	有限合伙人	1,500.00	2.22
16	上海乾银投资有限公司	有限合伙人	1,500.00	2.22
合计			67,700.00	100.00

（七）经纬壹号

截至本招股说明书签署日，经纬壹号的基本情况如下：

企业名称	南京经纬创壹号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA25JE0QXE
执行事务合伙人	南京经纬江创投资管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	744,782.18 万元人民币

成立日期	2021-03-29
企业类型	有限合伙企业
注册地址	南京市江北新区浦东北路5号扬子江数字基地B区8幢201-7室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，经纬壹号的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	10,000.00	1.34
2	全国社会保障基金理事会	有限合伙人	200,000.00	26.85
3	博时资本管理有限公司	有限合伙人	119,330.00	16.02
4	中国文化产业投资基金二期(有限合伙)	有限合伙人	50,000.00	6.71
5	南京市产业发展基金有限公司	有限合伙人	28,000.00	3.76
6	芜湖歌斐承卓股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	24,653.32	3.31
7	平阳荣礼股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	24,050.00	3.23
8	银河资本资产管理有限公司	有限合伙人	23,000.00	3.09
9	芜湖歌斐承兆股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	22,771.99	3.06
10	芜湖歌斐祥如股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	21,586.30	2.90
11	北海航景恒晟投资发展有限公司	有限合伙人	21,300.00	2.86
12	平阳荣诺股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,290.00	2.72
13	南京扬子江创新创业投资基金(有限合伙)	有限合伙人	20,000.00	2.69
14	平阳荣函股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	18,910.00	2.54
15	芜湖歌斐承宇股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	18,542.49	2.49
16	青岛陆晖股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	15,600.00	2.09
17	平阳许兴股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	15,000.00	2.01
18	芜湖歌斐祥意股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	13,418.09	1.80
19	富安达资产管理(上海)有限公司	有限合伙人	12,670.00	1.70

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
20	瑞元资本管理有限公司	有限合伙人	12,420.00	1.67
21	北京首钢基金有限公司	有限合伙人	10,500.00	1.41
22	厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	1.34
23	珠海横琴任君淳宜股权投资基金(有限合伙)	有限合伙人	5,500.00	0.74
24	淄博昭淳股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,320.00	0.58
25	深圳涵鑫七号投资中心(有限合伙)	有限合伙人	4,000.00	0.54
26	深圳涵鑫八号投资中心(有限合伙)	有限合伙人	4,000.00	0.54
27	济南大得宏强投资中心(有限合伙)	有限合伙人	4,000.00	0.54
28	重庆两江新区金智私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,500.00	0.47
29	鹰潭榕棠达鑫企业服务中心(有限合伙)	有限合伙人	2,320.00	0.31
30	天津经成信息咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,100.00	0.28
31	中投瑞石浦钰贰期壹号私募股权投资母基金(珠海横琴)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,878.90	0.25
32	中投瑞石浦钰贰期贰号私募股权投资母基金(珠海横琴)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,121.10	0.15
合计			744,782.18	100.00

(八) 经纬叁号

截至本招股说明书签署日,经纬叁号的基本情况如下:

企业名称	南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320191MA257MBW54
执行事务合伙人	南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)
认缴出资额	203,335 万元人民币
成立日期	2021-02-10
企业类型	有限合伙企业
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区南京片区万寿路 15 号 D4 栋 B-179(信息申报)
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活

	动)；股权投资；创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	---

截至本招股说明书签署日，经纬叁号的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	235.00	0.12
2	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	有限合伙人	60,000.00	29.51
3	太保长航股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	50,000.00	24.59
4	友邦人寿保险有限公司	有限合伙人	40,000.00	19.67
5	南京经岚企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	23,300.00	11.46
6	中美联泰大都会人寿保险有限公司	有限合伙人	20,000.00	9.84
7	普洛斯建发(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	2.46
8	南京经曼企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,800.00	2.36
合计			203,335.00	100.00

(九) 南海成长湾科

截至本招股说明书签署日，南海成长湾科的基本情况如下：

企业名称	深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5H5GFH73
执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司
认缴出资额	400,000 万元人民币
成立日期	2021-12-16
企业类型	有限合伙企业
注册地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座5层
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至本招股说明书签署日，南海成长湾科的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳同创锦绣资产管理有限公司	普通合伙人	5,000.00	1.25
2	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	90,000.00	22.50
3	深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	有限合伙人	43,300.00	10.83
4	太保长航股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000.00	7.50
5	郑州国创产业投资有限公司	有限合伙人	28,500.00	7.13
6	扬州同创同享股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	21,915.00	5.48
7	上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	21,000.00	5.25
8	江西省现代产业引导基金(有限合伙)	有限合伙人	20,000.00	5.00
9	中金旗盛(新昌)股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	15,000.00	3.75
10	扬州同创同航创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	11,410.00	2.85
11	山东财金科技创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	2.50
12	中山市创业发展母基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	2.50
13	上海国际集团创科三期创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	2.50
14	湖北夏创星源产业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	2.50
15	深圳开源证券投资咨询有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.50
16	深圳同创伟业资产管理股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.50
17	国信资本有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	2.50
18	扬州陆鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,690.00	1.67
19	嘉和盛行投资(海南)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,000.00	1.50
20	郑州中原科技城产业引导基金有限责任公司	有限合伙人	5,000.00	1.25
21	湖南财鑫资本管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.25
22	云南金产股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	1.25
23	深圳冰川网络股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.25
24	陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,500.00	0.88
25	宁波甬才股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	0.75

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
26	嘉兴陆逸股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,320.00	0.58
27	扬州同创致高股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,365.00	0.34
28	云南泽辰私募股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.25
合计			400,000.00	100.00

(十) 普华创投

截至本招股说明书签署日，普华创投的基本情况如下：

企业名称	普华中小二期(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330102MADL6G508L
执行事务合伙人	杭州普华至勤创业投资合伙企业(有限合伙)
认缴出资额	300,000 万元人民币
成立日期	2024-05-31
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 678 室
经营范围	一般项目：创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日，普华创投的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	杭州普华至勤创业投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	3,000.00	1.00
2	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	90,000.00	30.00
3	杭州产业投资有限公司	有限合伙人	72,000.00	24.00
4	永康普华穗安创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000.00	6.67
5	桐乡市金信普华企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000.00	6.67
6	杭州临安创临自有资金投资有限公司	有限合伙人	20,000.00	6.67
7	杭州高新创业投资有限公司	有限合伙人	15,000.00	5.00
8	杭州上城领航创业投资有限公司	有限合伙人	15,000.00	5.00
9	诸暨普臻韬辰创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	3.33

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
10	衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	3.33
11	建德普华创芯创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	9,000.00	3.00
12	嘉兴普华景淮股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,000.00	2.00
13	长兴产业投资发展集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.67
14	长兴溪美投资开发有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.67
合计			300,000.00	100.00

(十一) 上海科创有限

截至本招股说明书签署日，上海科创有限的基本情况如下：

企业名称	上海科技创业投资有限公司
统一社会信用代码	91310000132215222E
法定代表人	项亦男
注册资本	173,856.80 万人民币
成立日期	1992-12-03
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市静安区铜仁路 269 号第三层 301 室至 306 室
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；科技产业投资；投资管理；资产管理；科技型孵化器企业的建设及管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本招股说明书签署日，上海科创有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海科技创业投资(集团)有限公司	173,856.80	100.00
合计		173,856.80	100.00

(十二) 同创同运

截至本招股说明书签署日，同创同运的基本情况如下：

企业名称	苏州同创同运创业投资合伙企业(有限合伙)
------	----------------------

统一社会信用代码	91320509MA273C1882
执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司
认缴出资额	108,060 万元人民币
成立日期	2021-09-16
企业类型	有限合伙企业
注册地址	苏州市吴江区江陵街道运东大道 997 号东方海悦花园 4 幢 605 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，同创同运的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳同创锦绣资产管理有限公司	普通合伙人	1,220.00	1.13
2	杭州同创同运创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	23,200.00	21.47
3	青岛同创致长创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	15,600.00	14.44
4	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	9.25
5	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	9.25
6	青岛同创同优私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,670.00	8.95
7	苏州市吴江产业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.63
8	苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.63
9	厦门铜鱼创业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.63
10	青岛洪昀私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.63
11	青岛顺东汇升私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,990.00	4.62
12	青岛同创同享私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,870.00	3.58
13	厦门国升增长股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	2.78
14	周剑	有限合伙人	2,500.00	2.31
15	海南中璟辰熙私募基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	0.93
16	东莞生益资本投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.93
17	黄燕	有限合伙人	1,000.00	0.93

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
18	孙建妹	有限合伙人	1,000.00	0.93
19	张一巍	有限合伙人	10.00	0.01
合计			108,060.00	100.00

(十三) 锡创聚成

截至本招股说明书签署日，锡创聚成的基本情况如下：

企业名称	杭州锡创聚成股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330127MAC4MWJN9T
执行事务合伙人	上海弘信股权投资基金管理有限公司
认缴出资额	42,900 万元人民币
成立日期	2022-12-21
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 99 号 130-1
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署日，锡创聚成的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海弘信股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	476.66	1.11
2	中山聚成投资有限公司	有限合伙人	28,600.00	66.67
3	无锡市创新投资集团有限公司	有限合伙人	6,864.00	16.00
4	嘉利（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,430.00	3.33
5	袁皓	有限合伙人	953.33	2.22
6	谭建文	有限合伙人	953.33	2.22
7	庄文玉	有限合伙人	762.67	1.78
8	林炳云	有限合伙人	476.67	1.11
9	杨昉	有限合伙人	476.67	1.11
10	谭登平	有限合伙人	476.67	1.11
11	周辉	有限合伙人	476.67	1.11

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
12	王美华	有限合伙人	381.33	0.89
13	许锦开	有限合伙人	286.00	0.67
14	蔡铭基	有限合伙人	286.00	0.67
合计			42,900.00	100.00

(十四) 夏创星火

截至本招股说明书签署日，夏创星火的基本情况如下：

企业名称	湖北夏创星火创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91420115MAC4NR8Q50
执行事务合伙人	湖北夏创创业投资管理有限公司
认缴出资额	150,000 万元人民币
成立日期	2022-11-21
企业类型	有限合伙企业
注册地址	湖北省武汉市江夏区大桥新区智能制造产业基地企业服务中心1层
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本招股说明书签署日，夏创星火的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	湖北夏创创业投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.07
2	武汉市江夏科技投资集团有限公司	有限合伙人	149,800.00	99.87
3	武汉市江夏文化旅游发展集团有限公司	有限合伙人	100.00	0.07
合计			150,000.00	100.00

(十五) 中网投

截至本招股说明书签署日，中网投的基本情况如下：

企业名称	中国互联网投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91110000MA00CXL49H

执行事务合伙人	中国互联网投资基金管理有限公司
认缴出资额	3,010,000 万元人民币
成立日期	2017-03-23
企业类型	有限合伙企业
注册地址	北京市大兴区大兴经济开发区科苑路 18 号 2 幢一层 A032 号 (国家新媒体产业基地内)
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至本招股说明书签署日,中网投的股东及其出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国互联网投资基金管理有限公司	普通合伙人	42,500.00	1.41
2	工银瑞信投资管理有限公司	有限合伙人	1,000,000.00	33.22
3	中邮人寿保险股份有限公司	有限合伙人	600,000.00	19.93
4	农银汇理资产管理有限公司	有限合伙人	500,000.00	16.61
5	中国移动通信集团有限公司	有限合伙人	300,000.00	9.97
6	中华人民共和国财政部	有限合伙人	200,000.00	6.64
7	北京中移和创股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	100,000.00	3.32
8	中国联合网络通信集团有限公司	有限合伙人	100,000.00	3.32
9	中国电信集团有限公司	有限合伙人	100,000.00	3.32
10	中信国安实业集团有限公司	有限合伙人	67,500.00	2.24
合计			3,010,000.00	100.00

(十六) 中信金石

截至本招股说明书签署日,中信金石的基本情况如下:

企业名称	金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330106MACPWQBB7E
执行事务合伙人	中信金石投资有限公司

认缴出资额	500,000 万元人民币
成立日期	2023-07-27
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 358 号 4 幢 304 室
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署日，中信金石的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	中信金石投资有限公司	普通合伙人	62,000.00	12.40
2	中信城西科创大走廊（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000.00	10.00
3	江西省铁航产业投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	10.00
4	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	40,000.00	8.00
5	北京首开盈信投资管理有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.00
6	金发科技股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.00
7	中信信托有限责任公司	有限合伙人	30,000.00	6.00
8	瑞众人寿保险有限责任公司	有限合伙人	27,250.00	5.45
9	金石泮盈（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,520.00	3.10
10	新华人寿保险股份有限公司	有限合伙人	12,750.00	2.55
11	华龙金城投资有限公司	有限合伙人	12,000.00	2.40
12	文轩投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00
13	卧龙电气驱动集团股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00
14	海南启合投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00
15	西安金涛投资（集团）有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00
16	海南兆迈企业管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00
17	山东省国控资本投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00
18	宁波景盈企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,000.00	1.60
19	北京创合启航科技中心（有限合伙）	有限合伙人	7,000.00	1.40
20	宁夏汉尧富锂科技有限责任公司	有限合伙人	6,000.00	1.20
21	竞拓（海南）投资有限责任公司	有限合伙人	5,000.00	1.00

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
22	湖南兴建咨询服务合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	1.00
23	威海鲸园建工开发有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00
24	福州市创业投资有限责任公司	有限合伙人	5,000.00	1.00
25	广州产投先进制造专项母基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	1.00
26	河北高速天呈投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00
27	海南鑫兆晟投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00
28	重庆成渝共兴私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	1.00
29	紫金财产保险股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00
30	华富瑞兴投资管理有限公司	有限合伙人	3,000.00	0.60
31	红正均方投资有限公司	有限合伙人	2,980.00	0.60
32	杭州鑫博资本管理有限公司	有限合伙人	2,500.00	0.50
33	桐庐申悦智造科技合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,500.00	0.50
34	湖南盛力投资有限责任公司	有限合伙人	2,000.00	0.40
35	金石润泽(淄博)投资咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,500.00	0.30
合计			500,000.00	100.00

(十七) 济南云盛

截至本招股说明书签署日，济南云盛的基本情况如下：

企业名称	济南云盛投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91370100MAE2H2L49C
执行事务合伙人	云涌(济南)产业投资有限公司
认缴出资额	5,000 万人民币
成立日期	2024-10-31
企业类型	有限合伙企业
注册地址	山东省济南市高新区舜华路街道浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 15 层 F 区(一址多照)
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至本招股说明书签署日，济南云盛的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	云涌(济南)产业投资有限公司	普通合伙人	50.00	1.00
2	山东浪潮产业投资有限公司	有限合伙人	4,950.00	99.00
合计			5,000.00	100.00

(十八) 济南云涌

截至本招股说明书签署日, 济南云涌的基本情况如下:

企业名称	济南云涌资本投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91370100MAD7CJ1A2L
执行事务合伙人	云涌(济南)产业投资有限公司
认缴出资额	20,000 万元人民币
成立日期	2023-12-26
企业类型	有限合伙企业
注册地址	山东省济南市高新区舜华路街道经十路 7000 号汉峪金谷 A7-6 栋科创金融大厦 8 楼 809-33 席位
经营范围	一般项目: 以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至本招股说明书签署日, 济南云涌的股东及其出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	云涌(济南)产业投资有限公司	普通合伙人	400.00	2.00
2	山东浪潮产业投资有限公司	有限合伙人	19,600.00	98.00
合计			20,000.00	100.00

(十九) 济南云智

截至本招股说明书签署日, 济南云智的基本情况如下:

企业名称	济南云智投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91370100MACLP2MD6J
执行事务合伙人	山东浪潮投资管理有限公司
认缴出资额	4,000 万人民币
成立日期	2023-06-25
企业类型	有限合伙企业

注册地址	山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 楼 15 层 A 区
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，济南云智的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	山东浪潮投资管理有限公司	普通合伙人	40.00	1.00
2	山东浪潮产业投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	50.00
3	浪潮智能终端有限公司	有限合伙人	1,960.00	49.00
合计			4,000.00	100.00

(二十) 地纬华宸

截至本招股说明书签署日，地纬华宸的基本情况如下：

企业名称	山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370100MA958JQ25B
执行事务合伙人	山东华宸股权投资管理有限公司
认缴出资额	40,000 万元人民币
成立日期	2021-11-09
企业类型	有限合伙企业
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A7-6 科创金融大厦 705 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，地纬华宸的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	山东华宸股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,900.00	4.75
2	济南高新财金投资有限公司	有限合伙人	15,000.00	37.50
3	山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	12,000.00	30.00
4	地纬智能科技股份有限公司	有限合伙人	8,000.00	20.00
5	山东凯庆股权投资管理有限公司	有限合伙人	3,100.00	7.75

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
合计			40,000.00	100.00

(二十一) 华鲁产投

截至本招股说明书签署日，华鲁产投的基本情况如下：

企业名称	华鲁产业股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370100MAC114QK5R
执行事务合伙人	上海华鲁弘信私募基金管理有限公司
认缴出资额	100,000 万元人民币
成立日期	2022-10-14
企业类型	有限合伙企业
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 A4-4-306-1
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，华鲁产投的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海华鲁弘信私募基金管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	1.00
2	华鲁投资发展有限公司	有限合伙人	69,000.00	69.00
3	山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	20,000.00	20.00
4	平潭盈岚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,500.00	7.50
5	佛山市顺悦汇商贸有限公司	有限合伙人	2,500.00	2.50
合计			100,000.00	100.00

(二十二) 山东新动能

截至本招股说明书签署日，山东新动能的基本情况如下：

企业名称	山东省新动能投资管理有限公司
统一社会信用代码	91370100MA3RRDRYX6

法定代表人	张钊
注册资本	200,000 万人民币
成立日期	2020-04-13
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼21层2101
经营范围	受托管理股权投资基金、从事股权投资管理及相关咨询服务;以自有资金投资;创业投资(未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本招股说明书签署日,山东新动能的股东及其出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	山东省新动能基金管理有限公司	200,000.00	100.00
	合计	200,000.00	100.00

(二十三) 超越未来

截至本招股说明书签署日,超越未来的基本情况如下:

企业名称	深圳市超越未来创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5HRJ9P21
执行事务合伙人	海南超越创业投资有限公司
认缴出资额	60,000 万元人民币
成立日期	2023-03-30
企业类型	有限合伙企业
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区南环路28号深圳湾科技生态园8栋121
经营范围	创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无

截至本招股说明书签署日,超越未来的股东及其出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	海南超越创业投资有限公司	普通合伙人	300.00	0.50
2	昌都市凯丰投资管理有限公司	有限合伙人	20,000.00	33.33
3	服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	有限合伙人	12,000.00	20.00

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
4	青岛坤吾聚元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	16.67
5	深圳市嘉昕投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	5.00
6	陈炳安	有限合伙人	3,000.00	5.00
7	天津盛业投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	5.00
8	彭超	有限合伙人	2,000.00	3.33
9	深圳市寰洋科技有限公司	有限合伙人	1,500.00	2.50
10	刘建峰	有限合伙人	1,200.00	2.00
11	陈驹	有限合伙人	1,000.00	1.67
12	佛山市杰祥泰物业管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	1.67
13	朱琳	有限合伙人	1,000.00	1.67
14	吴星	有限合伙人	1,000.00	1.67
合计			60,000.00	100.00

(二十四) 深圳海鼎永和

截至本招股说明书签署日,深圳海鼎永和的基本情况如下:

企业名称	深圳海鼎永和创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MAE622J05B
执行事务合伙人	海鼎私募基金管理(海南)有限公司
认缴出资额	2,610 万元人民币
成立日期	2024-12-11
企业类型	有限合伙企业
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 59 号北科大厦 1543
经营范围	创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至本招股说明书签署日,深圳海鼎永和的股东及其出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	海鼎私募基金管理(海南)有限公司	普通合伙人	1.00	0.04
2	张明义	有限合伙人	809.00	31.00

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
3	钟剑	有限合伙人	500.00	19.16
4	王志武	有限合伙人	500.00	19.16
5	吴晟	有限合伙人	200.00	7.66
6	马晓冬	有限合伙人	100.00	3.83
7	简军	有限合伙人	100.00	3.83
8	张睿安	有限合伙人	100.00	3.83
9	徐丽	有限合伙人	100.00	3.83
10	李健	有限合伙人	100.00	3.83
11	候本青	有限合伙人	100.00	3.83
合计			2,610.00	100.00

(二十五) 厦门融汇

截至本招股说明书签署日，厦门融汇的基本情况如下：

企业名称	厦门融汇弘上二期股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350211MA8TXCM513
执行事务合伙人	厦门融汇华臻股权投资合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	200,000 万元人民币
成立日期	2021-09-06
企业类型	有限合伙企业
注册地址	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2105 单元 B02
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至本招股说明书签署日，厦门融汇的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	厦门融汇华臻股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	4,156.00	2.08
2	阳光人寿保险股份有限公司	有限合伙人	90,000.00	45.00
3	厦门集美产业投资集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	10.00

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
4	厦门市产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	31,900.00	15.95
5	阳光财产保险股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	5.00
6	厦门朝聚医疗科技集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	5.00
7	厦门汇资融创九号股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,000.00	3.00
8	金科智慧服务集团股份有限公司	有限合伙人	5,100.00	2.55
9	厦门融汇荣泰股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,950.00	2.48
10	厦门国升增长股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,000.00	2.00
11	无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,000.00	2.00
12	厦门汇资融创十号股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,344.00	1.67
13	宁波琅臻企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,000.00	1.00
14	厦门轻工集团创业投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	1.00
15	珠海市正菱创业投资有限公司	有限合伙人	1,550.00	0.78
16	厦门融汇鼎安投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	0.50
合计			200,000.00	100.00

(二十六) 中电投资

截至本招股说明书签署日，中电投资的基本情况如下：

企业名称	中国电子投资控股有限公司
统一社会信用代码	91110000717833800A
法定代表人	许海东
注册资本	148,465.25 万元人民币
成立日期	2012-08-27
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号57幢18层1801(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
经营范围	股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署日，中电投资的股东及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国电子信息产业集团有限公司	74,227.80	50.00
2	北京瑞祥长青投资管理中心(有限合伙)	29,693.05	20.00
3	北京亦庄国际投资发展有限公司	22,272.20	15.00
4	天津伊莱克企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	22,272.20	15.00
合计		148,465.25	100.00

六、募集资金具体运用情况

(一) 新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目

1、项目基本情况

本项目将根据数据中心场景和企业应用市场的实际需求，开发新一代 PCIe 6.0 数据存储主控芯片，并在此基础上开发相应的高性能存储模组产品。同时，公司还将紧跟行业趋势和标准，提前布局 PCIe 7.0 数据存储主控芯片及其模组产品，完善公司产品矩阵。本项目建设完成后，公司产品将能够支持更高的协议标准，适配新一代 NAND 闪存颗粒，并具有更大容量、更低延迟以及更高的稳定性和数据安全性，性能全面增强，能够更好满足下一代服务器以及新型计算架构对存储模组的性能需求。

2、项目投资概算

本项目计划投资总额 149,837.26 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	硬件设备购置	2,475.67	1.65%
2	软件/EDA/IP 采购费用	20,107.50	13.42%
3	研发人员工资	75,195.34	50.18%
4	测试认证及委外封装费	184.20	0.12%
5	流片费用	15,166.67	10.12%
6	其他研发费用	22,921.93	15.30%
7	基本预备费	2,721.03	1.82%

序号	项目名称	投资总额	占比
8	铺底流动资金	11,064.92	7.38%
合计		149,837.26	100.00%

3、项目实施进度安排

本项目预计建设期为8年（其中PCIe 6.0芯片的建设周期为4年，PCIe 6.0模组的建设周期为4年；PCIe 7.0芯片的建设周期为4年，PCIe 7.0模组的建设周期为3年），项目具体实施进度安排如下：

(1) PCIe 6.0 芯片实施进度表

单位：月

项目	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48
软硬件购置	■	■	■	■	■	■	■	
人员调配及招募		■	■	■	■	■	■	
产品设计开发		■	■	■	■	■	■	
流片与测试					■	■	■	
试产与优化						■	■	
小批量量产						■	■	
市场推广与客户验证							■	■

(2) PCIe 6.0 模组实施进度表

单位：月

项目	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48
软硬件购置	■	■	■	■	■	■	■	
人员调配及招募		■	■	■	■	■	■	
产品设计开发		■	■	■	■	■	■	
试产与优化				■	■	■	■	
小批量量产					■	■	■	■
市场推广与客户验证							■	■

(3) PCIe 7.0 芯片实施进度表

单位：月

项目	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48

项目	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48
软硬件购置								
人员调配及招募								
产品设计开发								
流片与测试								
试产与优化								
小批量量产								
市场推广与客户验证								

(4) PCIe 7.0 模组实施进度表

单位：月

项目	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
软硬件购置						
人员调配及招募						
产品设计开发						
试产与优化						
小批量量产						
市场推广与客户验证						

4、项目环保情况

本项目不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

(二) 面向 AI 领域存储系统方案研发项目

1、项目基本情况

本项目将围绕新一代智能存储系统平台关键技术，进行 NAND 闪存与新型存储介质的开发应用，并立足新型存储介质在存储密度、读写特性、寿命机制等方面的差异化特征，开展核心技术研发与架构创新。同时，本项目还将进行存储系统生态与智能化技术研发，聚焦核心应用需求，针对性研发自主知识产权的数据智能管理、IO 调度与流量预测技术等，构建智能化、安全可信的计算感知存算一体技术平台，全方位支撑存储系统生态升级与智能化应用落地。

2、项目投资概算

本项目计划投资总额 99,522.59 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	硬件设备购置	2,071.14	2.08%
2	软件/EDA/IP 采购费用	12,298.96	12.36%
3	研发人员工资	36,991.85	37.17%
4	测试认证及委外封装费	161.60	0.16%
5	流片费用	22,000.00	22.11%
6	其他研发费用	24,047.62	24.16%
7	基本预备费	1,951.42	1.96%
合计		99,522.59	100.00%

3、项目实施进度安排

本项目预计建设期为 5 年，项目具体实施进度安排如下：

单位：月

项目	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48	T+54	T+60
软硬件购置及安装	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
人员招聘及培训		■	■	■	■	■	■	■	■	
产品研发及测试		■	■	■	■	■	■	■	■	■

4、项目环保情况

本项目不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。